

# Fokus

**GESCHÄFTSBERICHT 2014**

# KENNZAHLEN

in Mio. €	2014	2013	Veränderung 2014/2013
<b>Geschäftsentwicklung</b>			
Auftragseingang	134,3	135,0	-0,5%
Auftragsbestand zum 31.12.	75,6	85,7	-11,8%
Umsatz gesamt	145,3	134,5	8,0%
Umsatzrendite	3,2 %	-11,9 %	15,1%-Punkte
Rohertrag	48,8	21,8	123,9%
Rohertragsmarge	33,6 %	16,2 %	17,4%-Punkte
Herstellungskosten	96,5	112,7	-14,4%
Forschungs- und Entwicklungskosten	10,5	10,2	2,9%
EBITDA	12,6	-13,4	–
EBITDA-Marge	8,7%	-10,0%	18,7%-Punkte
EBIT	8,4	-19,4	–
EBIT-Marge	5,8%	-14,4%	20,2%-Punkte
Ergebnis nach Steuern	4,6	-16,0	–
Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)	0,24	-0,84	–
<b>Bilanz und Cashflow</b>			
Eigenkapital	116,1	109,4	6,1%
Eigenkapitalquote	69,1%	60,8%	8,3%-Punkte
Eigenkapitalrentabilität	4,0%	-14,6%	18,6%-Punkte
Bilanzsumme	168,0	179,9	-6,6%
Net Cash	38,0	35,7	6,4%
Free Cashflow <sup>1</sup>	2,1	4,1	-48,8%
<b>Weitere Kennzahlen</b>			
Investitionen	3,0	12,2	-75,4%
Investitionsquote	2,1%	9,1%	-7,0%-Punkte
Abschreibungen	4,2	6,0	-30,0%
Mitarbeiter zum 31.12.	659	655	0,6%

<sup>1</sup> vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen

A close-up photograph of a SÜSS MicroTec lithography machine. The image shows a polished metal head with a yellow ring, positioned above a silicon wafer. The wafer surface is covered in a grid of small, rectangular patterns, some of which are highlighted in red. The background is dark and out of focus, emphasizing the precision of the manufacturing process.

*SÜSS MicroTec ist einer der weltweit führenden Hersteller von Anlagen- und Prozesslösungen für die Mikrostrukturierung in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten. In enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern treibt SÜSS MicroTec die Entwicklung von neuen Technologien wie 3D-Integration und Nanoimprint-Lithografie sowie Schlüsselprozesse für die MEMS- und LED-Produktion voran.*

# SEGMENTE

## Fotomaschinen Equipment

- › Fotomaschinen-  
bearbeitungssysteme

Auftragseingang: 20,2 Mio. Euro  
Umsatz: 20,8 Mio. Euro  
EBIT: 4,7 Mio. Euro

## Lithografie

- › Mask Aligner
- › UV-Projektionsbelichtungs-  
systeme
- › Laser Prozessierungssysteme
- › Coater / Developer

Auftragseingang: 91,5 Mio. Euro  
Umsatz: 96,7 Mio. Euro  
EBIT: 10,7 Mio. Euro

## Substrat Bonder

- › Substrat (Wafer) Bonder

Auftragseingang: 17,2 Mio. Euro  
Umsatz: 22,4 Mio. Euro  
EBIT: -2,4 Mio. Euro

## Sonstige

- › Mikrooptik und -linsen
- › C4NP
- › Zentrale  
Konzernfunktionen

Auftragseingang: 5,4 Mio. Euro  
Umsatz: 5,4 Mio. Euro  
EBIT: -4,5 Mio. Euro

Stand 31.12.2014

# INHALT

Vorstandsinterview	
Vernetzung	
Fokus	
Bericht des Aufsichtsrats	2
Investor Relations	6
Corporate Governance	10
Zusammengefasster Lagebericht	16
Konzernabschluss nach IFRS	64
Anhang zum IFRS-Konzernabschluss	80
Glossar	123

# WELTWEIT



- Produktion
- Vertrieb

## Mitarbeiter nach Regionen

EMEA	419
Nordamerika	118
Japan	18
Sonstiges Asien	104

## Umsatz nach Regionen in Mio. Euro

EMEA	42,7
Nordamerika	21,5
Japan	10,2
Sonstiges Asien	70,9

Stand 31.12.2014

# 01

## Interview mit dem Vorstand

**Vor einigen Jahren hat der Vorstand eine bis heute gültige Unternehmensstrategie eingeführt, können Sie uns diese kurz erläutern?**

**Michael Knopp:** Sehr gern! Wir haben die Überarbeitung unserer strategischen Ausrichtung mit einer kritischen Bestandsaufnahme in der ersten Jahreshälfte 2009 begonnen. Nach einer umfassenden Analyse des damaligen Geschäftsmodells, der erwarteten Marktentwicklung sowie der Wettbewerbssituation, haben wir wichtige Weichenstellungen für die strategische Neuausrichtung des Konzerns vorgenommen. Unser Ziel war es, das Unternehmen auf die Kernkompetenzen Lithografie und Substrat Bonder zu fokussieren, sinnvolle

Ergänzungen des Portfolios vorzunehmen und uns von wettbewerbsintensiven beziehungsweise unprofitablen Randbereichen zu trennen. Anfang 2010 haben wir uns im Rahmen dieser Strategie vom verlustträchtigen Bereich Test Systeme getrennt. 2011 haben wir die, mit dem Kerngeschäft wenig synergetische, SÜSS MicroTec Precision Photomask Inc. im Rahmen eines Asset-Deals verkauft. Mit der Akquisition der HamaTech APE haben wir zur Abrundung unseres Produktportfolios im Bereich der Nassprozesse die Kernkompetenz der Fotomaskenreinigung erworben. Dadurch haben wir das Konzernportfolio nicht nur optimiert sondern es ist uns darüber hinaus gelungen, die Komplexität der Unternehmensstruktur deutlich zu verringern und die Kostenbasis zu senken. Heute besteht das Unternehmen aus den Segmenten Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment.

**Walter Braun:** Um der strategischen Neuausrichtung gerecht zu werden, war eine Anpassung der Organisationsstruktur nötig. So wurde die Produktion, Forschung und Entwicklung sowie die Bereiche Einkauf und Logistik der drei Produktlinien Coater / Developer, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment erfolgreich am Standort Sternenfels zusammengeführt. Die Substrat Bonder wurden in einem logistischen Großprojekt aus dem US-amerikanischen Waterbury in Vermont nach Deutschland umgesiedelt. Die Produktlinie Coater / Developer war vor dem Umzug nach Sternenfels im rund 15 Kilometer entfernten Vaihingen an der Enz beheimatet, hier konnte der Umzug innerhalb kürzester Zeit durchgeführt werden. Auch das Thema Synergien in der Bauweise unserer Maschinen – Stichwort Plattformstrategie – wurde weiter vorangetrieben. Wir haben mit diesen Maßnahmen am Standort Sternenfels ein innovatives und segmentübergreifendes Kompetenzzentrum für Nassprozesse geschaffen. Neben dem positiven Marktumfeld hat die strategische Neuausrichtung zu der sehr erfreulichen Ergebnissituation der Jahre 2010 bis 2012 beigetragen.

**Im Geschäftsjahr 2012 haben Sie zusätzlich zu den eben genannten Maßnahmen die Tamarack Scientific in Corona, USA, erworben. Wie glücklich sind Sie mit dieser Investition?**

**Michael Knopp:** Mit der Akquisition von Tamarack Scientific (heute SÜSS MicroTec Photonic Systems) haben wir uns im April 2012 die zukunftssträchtige



**SEIT DEM 1. AUGUST 2007  
IST MICHAEL KNOPP ALS  
FINANZVORSTAND (CFO) FÜR  
SÜSS MicroTec TÄTIG.**



Das Ziel des Vorstands lautet:  
Rückkehr zu alter Profitabilität

Technologiekompetenz der UV-Projektionslithografie und der Lasertechnologie ins Haus geholt. Ich bin überzeugt davon, dass wir mit der Akquisition den richtigen Schritt gemacht haben, auch wenn die operative Entwicklung bisher deutlich hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben ist. Wir sind jedoch sehr zuversichtlich, dass dieser Bereich in Zukunft positiv zur Unternehmensentwicklung beitragen wird. Ein wichtiger Indikator hierfür ist die Markteinführung neuer Produkte, für die wir bereits erste Aufträge internationaler Großkunden im Geschäftsjahr 2014 verbuchen konnten.

**Warum haben Sie – für uns überraschend – im Geschäftsjahr 2013 die Produktlinie der Bond Cluster Systeme eingestellt? Erwarten Sie nicht gerade in diesem Bereich durch die 3D-Integration einen zukünftigen Wachstumsschub?**

**Michael Knopp:** In unserem Segment Substrat Bonder muss man zwischen permanenten und temporären Bond Systemen unterscheiden. Die Korrektur unserer strategischen Ausrichtung zum Jahresende 2013 betrifft die permanenten Bond Systeme und dabei konkret nur die permanenten Bond Cluster, die Vollautomaten. Die Entscheidung zur Einstellung der Produktion von permanenten Bond Clustern folgte aufgrund einer Neubewertung der Geschäftssituation sowie der anhaltend unbefriedigenden Ertragslage in diesem Bereich. Unsere am Markt erfolgreichen manuellen permanenten Bonder haben wir weiterhin im Produktportfolio. Wir haben zuletzt im Oktober 2014 die neueste Gerätegeneration des halbautomatischen permanent Wafer Bonders SB6/8 Gen2 erfolgreich in den Markt eingeführt und sehen bereits großes Interesse bei den Kunden.

Substrat Bonder zum temporären Bonden sind dagegen ein wichtiger Bestandteil der Prozesskette in der 3D-Integration. Wie wir in unseren Pressemitteilungen veröffentlicht haben, konnten wir in der Vergangenheit wichtige Aufträge bei Industriekunden und Forschungsinstituten gewinnen. Bisher hat sich der Markt für die 3D-Integration deutlich langsamer entwickelt als ursprünglich erwartet, aber wir sind weiterhin

zuversichtlich, dass dieser Bereich in Zukunft maßgeblich zum Umsatz- und Ergebniswachstum des Unternehmens beitragen wird.

**Es gab letztes Jahr einen Wechsel im Vorstand. Können Sie uns mehr dazu sagen? Welche Auswirkungen hat dies auf die Unternehmensstrategie?**

**Michael Knopp:** Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG hatte aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung und deren Umsetzung im Unternehmen die Bestellung von Frank Averdung als Vorstandsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG zum 24. August 2014 aufgehoben. Tatsächlich ging es dabei weniger um die grundsätzliche strategische Ausrichtung des Unternehmens als vielmehr um die Art und Weise, wie die definierte Strategie erfolgreich umgesetzt werden kann. Bis der neue CEO seine Arbeit aufnimmt, werden die Aufgaben übergangsweise durch uns, Michael Knopp und Walter Braun, wahrgenommen. Unsere Aktionärinnen und Aktionäre können versichert sein, dass Vorstand und Aufsichtsrat weiterhin mit vereinten Kräften an der Umsetzung der Unternehmensstrategie arbeiten, und wir den von uns eingeschlagenen Weg konsequent weiter verfolgen. Dies heißt zunächst eine Stärkung unseres Kerngeschäftes und den konsequenten Ausbau neuer und zukunftssträchtiger Technologien. Unsere Unternehmensstrategie unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat. Spätestens mit dem Amtsantritt unseres neuen Vorstandsvorsitzenden, Dr. Per-Ove Hansson, werden wir die strategische Weichenstellung erneut hinterfragen und, wenn nötig, Anpassungen vornehmen.

**Walter Braun:** Die zweite Veränderung auf Vorstandsebene betrifft den Bereich Produktion. Ich habe zum 1. Juli 2014 meine Tätigkeit als Produktionsvorstand bei

SÜSS MicroTec aufgenommen. Diese Position wurde neu geschaffen, um der Bedeutung von produktionsrelevanten Themen noch mehr Gewicht zu verleihen und den Fokus zudem verstärkt auf interne Abläufe, Prozesse und Prozessoptimierung sowie die Supply Chain zu richten.

**Sie sind nunmehr seit mehr als einem halben Jahr Produktionsvorstand bei SÜSS MicroTec. Welche Situation haben Sie vorgefunden?**

**Walter Braun:** Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben wir uns in einem von starkem Wettbewerb geprägten, Umfeld bewegt. Unter anderem haben die Wechselkursentwicklung des japanischen Yen und die zunehmende Konkurrenz chinesischer Equipment-Hersteller in einigen Bereichen unser Geschäft erschwert. Dennoch ist es uns gelungen, ein Umsatzwachstum von acht Prozent und ein stabiles Auftragseingangsniveau im Vergleich zum Vorjahr zu erreichen. Auf der Ergebnisseite konnten wir unsere eigenen Erwartungen übertreffen und haben ein EBIT von 8,4 Mio. Euro erwirtschaften können.

**Was waren beziehungsweise sind Ihre dringlichsten Aufgaben?**

**Walter Braun:** Mit der Zusammenlegung synergetischer Produktlinien am Standort Sternenfels ist SÜSS MicroTec bereits einen großen Schritt in Richtung Flexibilität und Effizienz gegangen. Das Gleichteile- und Plattformkonzept sowie die produktlinienübergreifenden Entwicklungsaktivitäten zeigen erste Wirkung. Meine vordringliche Aufgabe besteht in der konsequenten Weiterführung und Umsetzung dieser Strategie. Es besteht darüber hinaus Nachholbedarf bei der Projektdokumentation, und ich sehe Optimierungspotenzial im Prozessmanagement des Unternehmens.

Das Supply Chain Management ist ein weiteres Feld, auf dem ich mich zukünftig stärker engagieren werde, denn in jüngster Vergangenheit hat sich gezeigt, dass unsere Kunden immer kurzfristiger agieren. Aufträge werden sehr spät platziert, und gleichzeitig werden schnelle Lieferzeiten gefordert. Um dieser Herausforderung erfolgreich begegnen zu können, müssen wir uns verstärkt mit Themen wie Einkauf, Vorratshaltung, Prozessoptimierung und Logistik beschäftigen.

In diesem Zusammenhang ist mir auch eine frühzeitige und enge Einbindung des Bereichs Operations in bereits laufende aber vor allem in neue Entwicklungsprojekte sehr wichtig. Zudem werden wir uns zukünftig noch mehr auf wenige, dafür aber zukunftssträchtige Technologien und Projekte fokussieren, um unsere Ressourcen effizient einzusetzen und die Märkte noch gezielter bedienen zu können.

**Abschließend würden wir gern noch einen Überblick über die Finanzzahlen des abgelaufenen Geschäftsjahres bekommen.**

**Michael Knopp:** Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr 2014 lagen am oberen Ende unserer eigenen Erwartungen und erreichten ein Niveau von 145,3 Mio. Euro. Dies ist ein Plus gegenüber Vorjahr von acht Prozent. Der Auftragsingang lag mit 134,3 Mio. Euro nur um 0,7 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 135,0 Mio. Euro. Damit ergibt sich zum Stichtag 31. Dezember 2014 ein Auftragsbestand von 75,6 Mio. Euro (Vorjahr 85,7 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag mit 8,4 Mio. Euro deutlich über dem Vorjahreswert von minus 19,4 Mio. Euro. Das EBIT für 2013 enthielt Sondereffekte aus der Refokussierung der Produktlinie permanentes Bonden in Höhe von minus 13,2 Mio. Euro. Detaillierte Informationen hierzu finden Sie im Lagebericht und Anhang dieses Berichts. Die Net Cash-Position lag zum Stichtag bei 38,0 Mio. Euro (31. Dezember 2014: 35,7 Mio. Euro). Der Free Cashflow belief sich vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen auf 2,1 Mio. Euro (Vorjahr: 4,1 Mio. Euro).

Für das laufende Geschäftsjahr 2015 erwartet der Vorstand einen Umsatz von rund 130 bis 140 Mio. Euro und ein ausgeglichenes EBIT. Für das erste Quartal 2015 erwarten wir einen Auftragseingang von 25 bis 35 Mio. Euro.

**WALTER BRAUN VERANTWORTET  
DEN VORSTANDBEREICH PRODUKTION  
ALS CHIEF OPERATING OFFICER (COO)  
SEIT 1. JULI 2014.**



# 02

## Vernetzung

Seit einigen Jahren haben mobile Endgeräte den klassischen PC als zentrales Online-Medium verdrängt und Mobiltelefone werden schon seit einiger Zeit nicht mehr nur zum Telefonieren benutzt.

Zukünftig werden nicht nur Smartphones, Tablets und Ultrabooks online sein, sondern unzählige Gegenstände des alltäglichen Lebens werden plötzlich mit Hilfe von elektronischen Bauelementen und Sensoren untereinander vernetzt sein und miteinander kommunizieren. Ein weites Anwendungsfeld hierfür bietet der eigene Haushalt. Waschmaschine und Spülmaschine sind über das Internet mit dem Stromanbieter verbunden und schalten sich automatisch ein, wenn der Strom am günstigsten ist. Per Internet kann jederzeit auf die Überwachungskamera des eigenen Hauses zugegriffen werden, und über einen Knopfdruck ist im Notfall der Sicherheitsdienst sofort zu erreichen. Der Kühlschrank teilt per E-Mail mit, dass demnächst das Verfallsdatum der Milch erreicht

sein wird. Sensoren in der Smartwatch oder dem Armband überwachen permanent die eigenen Vitalfunktionen und lösen einen Alarm aus, wenn bestimmte Parameter über- oder unterschritten werden.

Dies sind nur einige Anwendungsbeispiele, bei denen die Datenerfassung, deren Auswertung, mobile Kommunikation mit anderen Geräten und entsprechende Rückmeldungen eine wichtige Rolle spielen. Laut des Marktforschungsinstituts Gartner werden in einem durchschnittlichen Haushalt im Jahr 2022 mehr als 500 vernetzte Geräte im Einsatz sein.

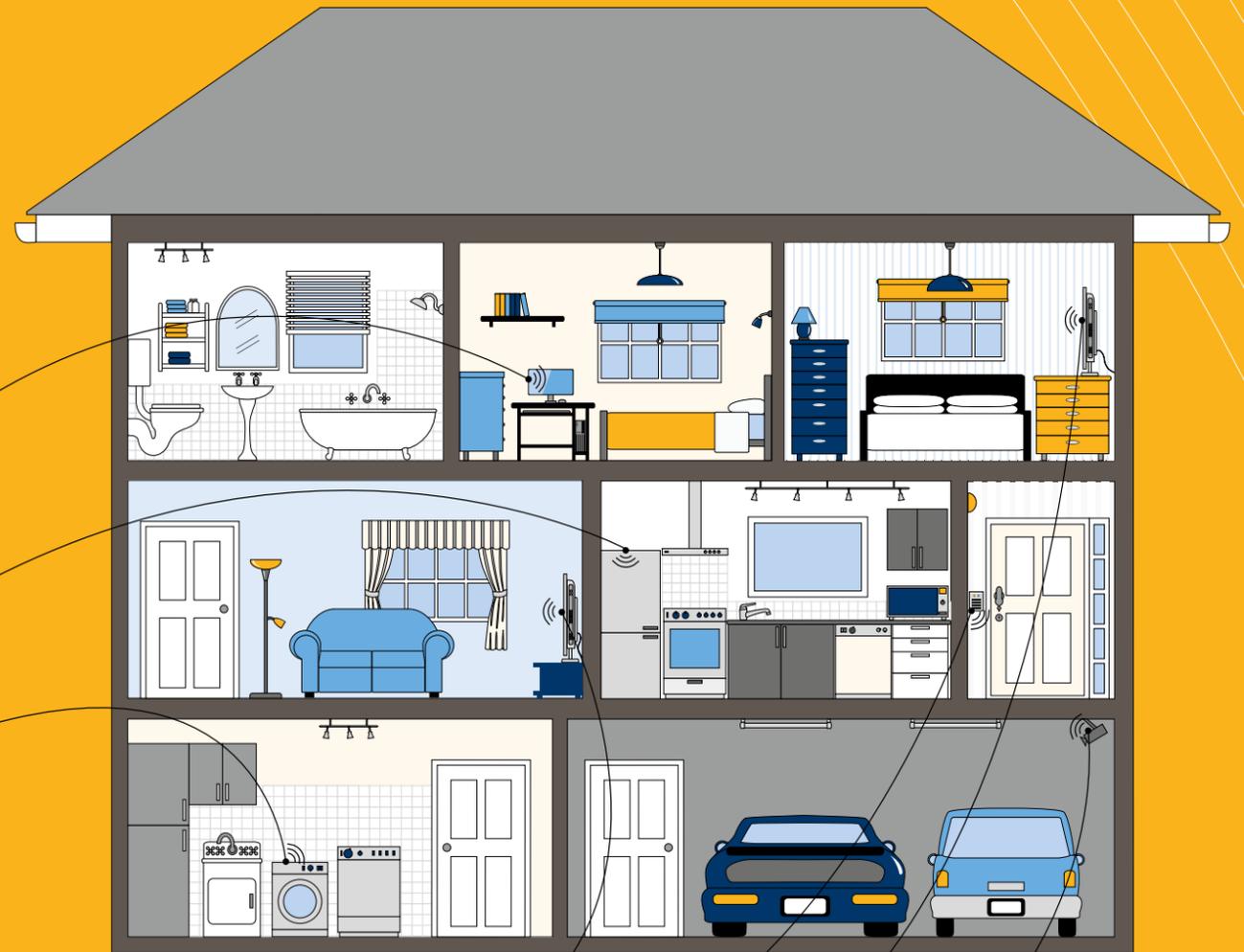
Dies gelingt nur durch den Einsatz von unzähligen elektronischen Bauelementen und Sensoren. Die Datenerfassung erfolgt beispielsweise über Bildsensoren, RFID-Chips oder MEMS (Mikroelektromechanische Systeme). Diese Sensoren messen Druck, Temperatur, Feuchtigkeitsgehalt, Höhe, Richtung oder Geschwindigkeit. Die gemessenen Daten werden mit Hilfe von Mikrochips wie beispielsweise ASICs (Anwendungsspezifische integrierte Schaltkreise), analogen Schaltkreisen und Speicherbausteinen direkt

vor Ort verarbeitet und analysiert oder weitergeleitet. Die Datenübermittlung erfolgt in der Regel über Mobilfunk, WLAN, Bluetooth oder über Radiofrequenz-Funk. Zum Senden und Empfangen dieser Informationen sind Frequenzfilter unverzichtbare Bausteine, die in WLAN-Modulen, Funkfernbedienungen oder als eigenständiges Bauteil in Mobiltelefonen zum Einsatz kommen. Viele dieser elektronischen Bauelemente basieren auf der (Verbindungs-) Halbleitertechnologie und gehören damit zu einem der Kernmärkte, die SÜSS MicroTec bedient. Insbesondere mit unseren Lithografielösungen unterstützen wir zum Beispiel die Herstellung von MEMS-Sensoren und Mikrochips.

Bei der MEMS-Herstellung kommen zudem noch unsere Substrat Bonder zum Einsatz. Erwartungsgemäß wird der Markt für elektronische Bauelemente durch die zunehmende Vernetzung, die mobile Kommunikation sowie den rapide ansteigenden Datentransfer und Speicherbedarf in Zukunft stark wachsen. SÜSS MicroTec wird auch zukünftig mit seinen innovativen und maßgeschneiderten Lösungen zur Mikrostrukturierung die kostengünstige Herstellung von qualitativ hochwertigen Bauelementen unterstützen.

„KÜHLSCHRÄNKE, DIE EIGENSTÄNDIG EINKAUFEN, WASCHMASCHINEN, DIE DANN WASCHEN, WENN DER STROM GÜNSTIG IST UND FLEISCH, DAS DATEN ÜBER SEINE HERSTELLUNG UND LIEFERWEGE SPEICHERT: IM INTERNET DER DINGE WERDEN OBJEKTE INTELLIGENT UND KÖNNEN ÜBER DAS INTERNET UNTEREINANDER INFORMATIONEN AUSTAUSCHEN.“

Fraunhofer IZM



In einem „intelligenten“ Haushalt werden Geräte eingesetzt, die aufgrund von Sensoren und Datenvernetzung den Alltag erleichtern und Arbeitsabläufe beschleunigen und verbessern sollen.



# 03

## Fokus

In den vergangenen Jahren hat SÜSS MicroTec große Veränderungen erfahren. Wir haben uns von Randbereichen getrennt und haben durch Akquisitionen neue, und mit dem bestehenden Geschäft synergetische, Fähigkeiten erworben.

Das Produktportfolio des Segments Lithografie wurde um die Technologiekompetenz der UV-Projektionslithografie und der Laser-Technologie sinnvoll erweitert. Mit dem Erwerb der HamaTech APE sind wir 2010 erstmals in das Frontend der Halbleiterfertigung eingestiegen und haben unsere Fähigkeiten im Bereich der Nassprozesse um die Fotomaskenreinigung ausgebaut. Daneben haben wir zukunftssträchtige Technologien im Haus weiterentwickelt und zur Serienreife gebracht. Insbesondere unsere Maschinen und Lösungen zum permanenten und temporären Bonden für die 3D-Integration versprechen in Zukunft ein bedeutsamer Wachstumsbereich zu werden. Aus diesem Grund haben wir, neben der Integration der neuen Geschäftsbereiche, viele Ressourcen

Fokus auf unsere Kernkompetenzen

in die Weiterentwicklung unserer temporären Bondlösungen für die 3D-Integration investiert. Durch gezielte Kooperationen mit Forschungsinstituten und eine besondere Kundennähe haben wir uns eine hervorragende Ausgangsposition geschaffen. Diese gilt es zu halten beziehungsweise auszubauen.

Gleichzeitig hat sich der Kernmarkt für unsere Lithografieprodukte verändert: kurzfristige Kundenentscheidungen, härterer Wettbewerb und eine zeitweise ungünstige Währungssituation gegenüber Japan erschweren unser Geschäft. Zudem haben wir – als mittelständisch geprägtes Unternehmen mit begrenzten Ressourcen – den Fokus in den letzten Jahren stark auf die vielversprechenden, neuen Technologien (temporäres Bonden, UV-Projektionslithografie und Laser-Technologie) gesetzt. In diesen Bereichen liegt die Grundsatzentwicklungsarbeit nunmehr hinter uns, und wir fokussieren uns auf die kundenseitigen Themen wie Prozessverbesserungen, Materialeinsatz, Durchsatz sowie Ausschuss. Ziel ist es, eine günstige Cost-of-Ownership zu bieten, damit neue Technologien und Prozesse auch aus ökonomischer Sicht für den Kunden attraktiv werden.

Zukünftig können und müssen wir uns darüber hinaus wieder verstärkt um die Bereiche Coater / Developer sowie die Produktlinie Mask Aligner kümmern. Dies sind unsere Kernbereiche, in denen wir jahrzehntelange Erfahrung haben und am Weltmarkt führend sind. Wie bereits im Vorstandsinterview angesprochen, werden wir dabei auch verstärkt an internen Prozessen und der Kostenstruktur arbeiten. Unser besonderer Fokus liegt auf der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit. Ziel ist zudem eine Optimierung, aber auch Reduzierung der Herstellungskosten, wobei unsere Aktivitäten speziell auch auf

die Optimierung des Bereichs Supply Chain abstellen. Wichtig ist darüber hinaus eine weitere Erhöhung der Flexibilität und damit eine Verkürzung der Lieferzeiten, wie häufig von unseren Kunden gefordert.

Unser Ziel muss es sein, unsere weltweit führende und margenstarke Produktlinie Mask Aligner weiter auszubauen und die sich zuletzt etwas schwächer entwickelnden Produktlinien Coater / Developer durch eine Innovationsoffensive und damit durch neue Produkte wieder zu alter Margenstärke und Attraktivität zurückzuführen. Viele Kunden entscheiden sich seit Jahren für die Qualität sowie die maßgeschneiderten Lösungen von SÜSS MicroTec und damit gegen kostengünstige Standardprodukte, zum Beispiel aus China. Zudem können wir unseren Kunden ein globales Netzwerk aus Vertrieb und Servicestandorten bieten. Diese vorteilhafte Marktposition müssen wir nutzen, um das Kerngeschäft wieder zu alter Umsatzstärke und Profitabilität zu führen.

Unsere Unternehmensstrategie unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung durch Vorstand und Aufsichtsrat. Spätestens mit Amtsantritt des Vorstandsvorsitzenden Dr. Per-Ove Hansson werden wir die strategische Weichenstellung erneut hinterfragen und, wenn nötig, Anpassungen vornehmen.

**UNSER ZIEL IST DIE RÜCKKEHR  
ZU ALTER STÄRKE SOWIE  
DER FOKUS AUF INNOVATIVE  
TECHNOLOGIEN UND  
WACHSTUMSSTARKE MÄRKTE.**

# BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat möchte Sie, sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre, im nachfolgenden Bericht über seine Tätigkeit im Geschäftsjahr 2014 informieren.

## SEHR GEEHRTE AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE,

der Aufsichtsrat ist seinen gesetzlichen Verpflichtungen sowie den in Geschäftsordnung und Satzung verankerten Aufgaben nachgekommen und hat den Vorstand im abgelaufenen Geschäftsjahr bei der Leitung des Unternehmens beraten und seine Tätigkeit überwacht. In alle Entscheidungen von grundlegender Bedeutung für das Unternehmen war der Aufsichtsrat eingebunden. Der Vorstand stimmte die strategische Ausrichtung des Unternehmens mit dem Aufsichtsrat ab und unterrichtete ihn regelmäßig schriftlich und auch mündlich, zeitnah und umfassend, über die Unternehmensplanung, den Gang der Geschäfte sowie die aktuelle Lage des Konzerns. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von der Planung wurden im Einzelnen erläutert und vom Aufsichtsrat anhand der erhaltenen Unterlagen und Informationen überprüft. Bedeutende Geschäftsvorgänge hat der Aufsichtsrat mit dem Vorstand ausführlich erörtert, zu zustimmungspflichtigen Geschäften hat der Aufsichtsrat seine Zustimmung erteilt. Im Geschäftsjahr 2014 fanden insgesamt sieben ordentliche und zwei außerordentliche Sitzungen des Aufsichtsrats statt. Bis auf die Sitzung am 6. Mai 2014 haben stets alle Mitglieder des Aufsichtsrats an den Sitzungen teilgenommen. Die ordentliche Aufsichtsratssitzung am 6. Mai 2014 fand ohne die Teilnahme von Herrn Pegam statt. Soweit es erforderlich war, hat der Aufsichtsrat Beschlüsse im schriftlichen Verfahren gefasst.

Wie auch in den vorangegangenen Jahren stand der Aufsichtsratsvorsitzende über die Aufsichtsratssitzungen hinaus mit dem Vorstand in engem Kontakt und hat sich über die aktuelle Entwicklung der Geschäftslage und die wesentlichen Geschäftsvorfälle informiert. Darüber hinaus stand der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats im regelmäßigen Austausch mit dem Vorstand und den Jahresabschlussprüfern, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zu Themen der Rechnungslegung und Jahresabschlussprüfung.



Dr. Stefan Reineck  
Aufsichtsratsvorsitzender

## SITZUNGEN UND BERATUNGSSCHWERPUNKTE

Die Finanzlage, die Investitionsprojekte sowie die Geschäftsentwicklung der SÜSS MicroTec AG, ihrer Tochtergesellschaften und des Konzerns wurden im Aufsichtsrat regelmäßig erörtert. Der Vorstand unterrichtete umfassend über die Unternehmensplanung, die strategische Weichenstellung und die Entwicklung bei Auftragseingang, Umsatz, Liquidität und Ergebnis. Der Aufsichtsrat hat sich darüber hinaus mit der Überwachung des Rechnungslegungsprozesses sowie der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems, des Risikomanagementsystems und der Unabhängigkeit des Abschlussprüfers befasst. Im Folgenden wird auf die Schwerpunkte der Aufsichtsratssitzungen eingegangen.

Am 11. Februar 2014 fand die erste ordentliche Aufsichtsratssitzung des Geschäftsjahres 2014 statt. Hierbei befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Bericht des Vorstands zum vierten Quartal 2013 und zu den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2013. Über die Planung für das Geschäftsjahr 2014 wurde intensiv diskutiert und Beschluss gefasst. Zudem wurde über die mittelfristige Planung der Jahre 2014–2016 sowie die strategische Ausrichtung des Unternehmens beraten. Weiterhin wurden die Ziele und der Bonusplan für das Geschäftsjahr 2014 mit dem Vorstand erörtert. Daneben führte der Aufsichtsrat in dieser Sitzung seine Effizienzprüfung gemäss Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch und dokumentierte diese.

Nach einem geordneten Auswahlverfahren und gründlichen Interviews wurde am 6. März 2014 im Umlaufverfahren über die Bestellung von Walter Braun zum Mitglied des Vorstands Beschluss gefasst und die Zustimmung zu seinem Dienstvertrag wurde erteilt.

An der zweiten Sitzung am 26. März 2014 haben Vertreter des Abschlussprüfers, der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, teilgenommen. Der Aufsichtsrat wurde vom Abschlussprüfer über die wesentlichen Ergebnisse der Prüfung des Jahres- und des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2013 informiert. Der Abschlussprüfer erläuterte dem Aufsichtsrat die Schwerpunkte der Einzel- und Konzernabschlussprüfung. Den Bericht des Vorstands zum Geschäftsjahr 2013 und zur aktuellen Geschäftslage im ersten Quartal 2014 hat der Aufsichtsrat zur Kenntnis genommen. Der Aufsichtsrat billigte nach eingehender Prüfung den vom Vorstand aufgestellten Jahres- und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2013. Außerdem wurde Beschluss gefasst über den Bericht des Aufsichtsrats für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der Vorstand gab dem Aufsichtsrat ein Update zum Status des Segments Substrat Bonder sowie der Situation bei SÜSS MicroTec Photonic Systems. Zudem wurde das Thema Nachhaltigkeit bei SÜSS MicroTec eingehend diskutiert. Der Aufsichtsrat fasste Beschluss über den Vorstandsbonus für das Geschäftsjahr 2013. Darüber hinaus wurden die Tagesordnung und die Beschlussvorschläge für die Hauptversammlung am 17. Juni 2014 erörtert und darüber Beschluss gefasst. In der Sitzung am 26. März 2014 wurde des Weiteren Beschluss gefasst über den Verkauf der Kapitalanteile an der Electron Mec S. R. L., Mailand, Italien, in dem der Vorstand ermächtigt wurde, alle weiteren Einzelheiten der Transaktion zu den vereinbarten Rahmenbedingungen festzulegen, zu entscheiden und die notwendigen Verträge zu verhandeln und abzuschließen.

Am 6. Mai 2014 fand die dritte ordentliche Aufsichtsratssitzung statt. Der Aufsichtsrat hat sich mit den aktuellen Zahlen zum ersten Quartal 2014 und der Prognose für das Gesamtjahr befasst. Im Rahmen dieser Sitzung hat der Vorstand dem Aufsichtsrat ein Update zur Situation bei SÜSS MicroTec Photonic Systems gegeben und über einen Besuch beim Fraunhofer IZM in Berlin berichtet.

In der Sitzung am 17. Juni 2014, unmittelbar vor der ordentlichen Hauptversammlung, hat der Vorstand den Aufsichtsrat über die aktuelle Geschäftslage informiert und ein kurzes Briefing zur bevorstehenden ordentlichen Hauptversammlung gegeben. Im Rahmen dieser Sitzung hat der Aufsichtsrat ein erneutes Update zur Situation bei SÜSS MicroTec Photonic Systems insbesondere für den Bereich Scanner und Laser-Tools erhalten. An der Sitzung hat Walter Braun als Gast teilgenommen.

Am 3. Juli 2014 fasste der Aufsichtsrat per Umlaufverfahren Beschluss über die Erteilung von Gesamtprokura für Walter Braun für alle deutschen Tochterunternehmen.

Am 5. August 2014 fand die fünfte ordentliche Aufsichtsratssitzung statt. In dieser Sitzung wurde dem Aufsichtsrat ein Update zum laufenden Geschäft und zum Ausblick auf das Gesamtjahr gegeben. Vorstand und Aufsichtsrat erörterten den Status der strategischen Ausrichtung der einzelnen Produktlinien, insbesondere der Coater/Developer sowie des Bereichs Belichtung (Exposure). Hier wurde dem Aufsichtsrat unter anderem die neu ins Leben gerufene Arbeitsgruppe „Exposure Task Force“ vorgestellt. Weiterhin stimmte der Aufsichtsrat dem Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand zu. Ein weiteres Schwerpunktthema war die Positionierung von SÜSS MicroTec vor dem Hintergrund der aktuellen Situation der Märkte für die Hersteller von Halbleitertechnik insbesondere im Mid- und Backend. Diskutiert wurden dabei vor allem die sich verstärkenden M & A-Aktivitäten anderer Unternehmen aus der Branche und deren Auswirkungen auf die Gesellschaft.

Nach intensiver Diskussion innerhalb des Aufsichtsrats wurde in einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung (per Telefon) am 24. August 2014 der Beschluss gefasst, die Bestellung von Frank Averdung als Mitglied des Vorstandes zu widerrufen.

Am 28. August 2014 fand die zweite außerordentliche Aufsichtsratssitzung des Jahres 2014 statt. Hierbei wurden die ersten Ergebnisse der „Exposure Task Force“ vorgestellt, und es wurde dem Aufsichtsrat ein Update zum Status der SUSS MicroTec Photonic Systems gegeben. Der Aufsichtsrat stimmte dem Geschäftsverteilungsplan für den Vorstand zu.

Am 4. November 2014 fand die sechste ordentliche Aufsichtsratssitzung statt. Der Vorstand berichtete über die aktuelle Geschäftslage im dritten Quartal sowie den aktualisierten Ausblick auf das Gesamtjahr. Schwerpunktthemen der Sitzung waren der Bereich Entwicklung und die Entwicklungsroadmap 2015 sowie der Beschluss über den Aufhebungsvertrag mit dem ehemaligen Vorstandsmitglied Frank Averdung. Darüber hinaus wurde Beschluss gefasst über die Verlängerung der Bestellung von Michael Knopp, dessen Amtszeit am 31. Juli 2015 ausgelaufen wäre, bis zum 31. Juli 2020 sowie über den Abschluss eines neuen Dienstvertrages mit Herrn Knopp über diesen Zeitraum und einen Nachtrag zum bestehenden Dienstvertrag. Im Rahmen der Sitzung wurde über die Entsprechenserklärung diskutiert und die Prüfungsschwerpunkte für den Jahresabschluss 2014 wurden erörtert. Ein weiteres Thema der Sitzung war Industrie 4.0 und die sich daraus ergebenden Herausforderungen und Chancen für SÜSS MicroTec.

Gegenstand der letzten Sitzung des Geschäftsjahres 2014, die am 11. Dezember 2014 stattfand, waren die aktuelle Geschäftslage sowie die vorläufige Planung für das Geschäftsjahr 2015. Weiterhin beschäftigte sich der Aufsichtsrat ausführlich mit der Corporate Governance und dabei insbesondere mit der Entsprechenserklärung und dem Fraud-Katalog der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Darüber hinaus beschäftigte sich der Aufsichtsrat mit dem Risikomanagement von SÜSS MicroTec. Weiterhin standen Vorstandsangelegenheiten auf der Tagesordnung.

## AUSSCHÜSSE

Ausschüsse hat der Aufsichtsrat aufgrund seiner Größe von drei Mitgliedern im Geschäftsjahr 2014 nicht gebildet.

## CORPORATE GOVERNANCE

Der Aufsichtsrat hat sich im Geschäftsjahr 2014 erneut mit den Inhalten und der Umsetzung des Deutschen Corporate Governance Kodex befasst. Informationen zur Corporate Governance im Unternehmen sowie der ausführliche Bericht zur Höhe und Struktur der Vergütung von Vorstand und Aufsichtsrat sind im Abschnitt Vergütungsbericht des zusammengefassten Lageberichts auf den Seiten 41 ff. wiedergegeben. Vorstand und Aufsichtsrat haben im Januar 2014 die jährliche Erklärung zum Deutschen Corporate Governance Kodex gemäß § 161 AktG beschlossen und diese den Aktionären auf der Internetseite der Gesellschaft dauerhaft zugänglich gemacht.

In seiner Sitzung vom 11. Februar 2014 führte der Aufsichtsrat seine Effizienzprüfung gemäss Ziffer 5.6 des Deutschen Corporate Governance Kodex durch und dokumentierte diese. Dabei konnten keine Defizite festgestellt werden. Die Überprüfung der Effizienz der Aufsichtsrats Tätigkeit findet in regelmäßigen Abständen durch sämtliche Mitglieder des Aufsichtsrats einzeln im Plenum mit Unterstützung von unternehmensspezifischen Frage- und Checklisten statt.

Es gab im Geschäftsjahr 2014 keine Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat gegenüber offen zu legen waren und über die die Hauptversammlung zu informieren wäre.

## JAHRES- UND KONZERNABSCHLUSSPRÜFUNG

Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, hat den nach den Vorschriften des HGB aufgestellten Jahresabschluss und den Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zum 31. Dezember 2014 sowie den Konzernabschluss und Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2014 geprüft und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht wurden gemäß § 315a HGB auf der Grundlage der internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, aufgestellt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung vorgenommen.

Die Prüfungsberichte der BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in der Bilanzsitzung des Aufsichtsrats am 26. März 2015 in Gegenwart des Abschlussprüfers umfassend behandelt. Der Abschlussprüfer berichtete über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung sowie darüber, dass keine wesentlichen Schwächen des internen Kontrollsystems und des Risikomanagementsystems vorlägen. Insbesondere hat er Erläuterungen zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft und des Konzerns abgegeben und hat dem Aufsichtsrat für ergänzende Auskünfte zur Verfügung gestanden. Der Abschlussprüfer ging ferner auf Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung ein. Schwerpunkte der diesjährigen Konzernabschlussprüfung waren unter anderem die Beurteilung der Werthaltigkeit von Vermögenswerten in den Geschäftsfeldern Bonding sowie bei der SÜSS MicroTec Photonic Systems (USA), die Erfassung und Bewertung von Rückstellungserfordernissen, die Bewertung der latenten Steueransprüche, die Beurteilung möglicher Risiken aus Planabweichungen und Margenverlusten in einzelnen Produktsegmenten sowie Fremdwährungsrisiken in Asien, insbesondere Japan.

Der Jahresabschluss der Gesellschaft und des Konzerns sowie der mit dem Konzernlagebericht zusammengefasste Lagebericht der SÜSS MicroTec AG wurden vom Aufsichtsrat geprüft. Es bestanden keine Einwände. Die Berichte des Abschlussprüfers hat der Aufsichtsrat nach eingehender Prüfung zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt und damit festgestellt. Der Aufsichtsrat hat auch den Konzernabschluss gebilligt. Dem gemeinsamen Lagebericht für die AG und den Konzern und insbesondere der Beurteilung der weiteren Entwicklung des Unternehmens hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

## BESETZUNG VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Im Geschäftsjahr 2014 gab es zwei personelle Änderungen im Vorstand. Walter Braun wurde zum 1. Juli 2014 als Chief Operating Officer in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG berufen. Am 24. August 2014 hat der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung die Bestellung von Frank Averdung als Mitglied des Vorstandes widerrufen. Die Bestellung von Michael Knopp wurde mit Beschlussfassung vom 4. November 2014 bis zum 31. Juli 2020 verlängert.

Der Aufsichtsrat blieb im Geschäftsjahr 2014 unverändert.

## DANK

Für die tatkräftige Arbeit im abgelaufenen Geschäftsjahr spricht der Aufsichtsrat den Vorständen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern großen Dank und Anerkennung aus.

Garching, 26. März 2015



Dr. Stefan Reineck  
Aufsichtsratsvorsitzender

# INVESTOR RELATIONS

Die Weltwirtschaft ist nach Aussage des letzten Herbstgutachtens führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute im Jahr 2014 mit mäßigem Tempo gewachsen. In den USA und Großbritannien hat sich der Aufschwung als robust erwiesen, wohingegen das Wirtschaftswachstum im Euroraum, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, nicht nachhaltigen Tritt fassen konnte. Belastend wirkten hier die angespannte geopolitische Situation in Russland, der Ukraine, Syrien und Israel sowie nach wie vor die Auswirkungen der Finanz- und Schuldenkrise. Inwieweit sich ein nachhaltig niedriger Ölpreis auf das Weltwirtschaftsklima auswirkt, bleibt abzuwarten. Insgesamt profitierten die Aktienmärkte vom Weltwirtschaftswachstum, wurden jedoch in der positiven Entwicklung durch die politischen Rahmenbedingungen gebremst.

## DER DEUTSCHE AKTIENMARKT HAT IM JAHRESVERLAUF ZUGELEGT

Nach einem volatilen Börsenjahr 2014 konnten alle wichtigen Indizes der Deutschen Börse, wie DAX, MDAX und TecDAX, zulegen. Auch wenn der DAX am Ende nur ein leichtes Plus gegenüber Vorjahr verzeichnete, hat sich die allgemeine Stimmung am Aktienmarkt aufgehellt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr gab es laut einer Auswertung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PWC mehr als 340 Börsengänge in Europa, die insgesamt ein Emissionsvolumen von mehr als 50 Mrd. Euro generiert haben. Damit ist nach mehreren Jahren, in denen es keine beziehungsweise kaum nennenswerte Börsengänge in Deutschland bzw. Europa gab, wieder eine Belebung des Emissionsmarktes zu spüren.

Insgesamt litten die Märkte unter der angespannten geopolitischen Situation und der erneut angestiegenen Bedrohung durch terroristische Vereinigungen sowie der anhaltenden Schuldenproblematik in einigen europäischen Staaten. Insbesondere in der Eurozone schaut man aktuell gebannt auf die angespannte politische Situation in Griechenland. Zudem haben der zuletzt stark gefallene Ölpreis und die Wechselkursstärke des US-Dollars insbesondere zum Jahresende 2014 erneut Bewegung in die Märkte gebracht.

## DIE SÜSS MicroTec-AKTIE

Nach einem für unsere Aktionäre enttäuschenden Börsenjahr 2013 konnte die SÜSS MicroTec-Aktie im ersten Quartal 2014 zulegen und entwickelte sich im Vergleich zum Referenzindex TecDAX deutlich besser. Nachdem die Aktie das Börsenjahr am 2. Januar mit einem Schlusskurs von 6,38 Euro begonnen hatte, konnte zwischenzeitlich die Marke von sieben Euro deutlich überschritten werden und am 10. Februar 2014 ein XETRA-Schlusskurs

von 7,81 Euro erreicht werden. Aufgrund eines zurückhaltenden Ausblicks auf das Gesamtjahr sowie der damals sich zuspitzenden Lage auf der Krim und in der Ukraine, verlor die Aktie wieder an Wert und bewegte sich ab Ende Februar 2014 in einer Bandbreite von 6,80 Euro bis 7,20 Euro. Das erste Quartal beendete die SÜSS MicroTec-Aktie mit einem Schlusskurs von 6,99 Euro.

Im zweiten Quartal setzte sich der Aufwärtstrend weiter fort und wurde lediglich durch vereinzelte Tagesschwankungen beeinträchtigt. Die Marke von acht Euro konnte überschritten werden, und die SÜSS MicroTec-Aktie beendete das erste Halbjahr am 30. Juni 2014 mit einem XETRA-Schlusskurs von 8,75 Euro, was einem Kurszuwachs von 35 Prozent entspricht. Auch die beiden Referenzindizes TecDAX und Prime IG Semiconductor entwickelten sich im Jahresverlauf positiv. Der TecDAX konnte im gleichen Zeitraum um zwölf Prozent, der Prime IG Semiconductor sogar um 24 Prozent zulegen. Die Gründe für den Kursanstieg waren vielseitig, zum einen hat die anhaltende Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank ein Investment in Aktien deutlich attraktiver gemacht, zum anderen konnte das Unternehmen von der verbesserten Stimmung in der Halbleiter-Branche profitieren. Mit Veröffentlichung der Zahlen zum ersten Quartal hat das Unternehmen seinen Jahresausblick bestätigt und für das zweite Quartal steigende Auftragseingänge in Aussicht gestellt. Dies hat sich neben den allgemeinen Markttrends positiv auf den Aktienkurs ausgewirkt.

Im Juli und Anfang August 2014 bewegte sich der Aktienkurs im Wesentlichen in einer Bandbreite zwischen acht und neun Euro. Mit Veröffentlichung der Halbjahreszahlen am 7. August 2014 hat SÜSS MicroTec seinen Ausblick für das Jahresergebnis 2014 leicht angehoben, was positiv am Markt aufgenommen wurde. Gleichzeitig veröffentlichte das Unternehmen eine Prognose für den Auftragseingang in der zweiten Jahreshälfte 2014 und gab damit auch eine erste Indikation der Umsatzerwartung für 2015,

welche unter der allgemeinen Markterwartung lag. Der Aktienkurs verringerte sich daraufhin deutlich in den Tagen nach der Meldung und verzeichnete bis zum Ende des dritten Quartals einen Rückgang um rund 46 Prozent auf einen Schlusskurs von 4,76 Euro am 30. September 2014. Zudem hat sich, wie eingangs beschrieben, im Verlauf des dritten Quartals die geopolitische Situation weiter angespannt, und die Aktienmärkte reagierten mit einer deutlich erhöhten Volatilität und teilweise erheblichen Kursabschlägen. Der deutsche Leitindex DAX fiel erneut unter die Marke von 9.000 Punkten, nachdem erst im Juli 2014 die damalige Rekordmarke von 10.000 Punkten erreicht worden war.

Im vierten Quartal gab es aus geopolitischer Sicht kaum eine Entspannung der Situation. Der DAX schloss das Finanzjahr bei

9.883,10 Punkten und verzeichnete somit gegenüber dem Jahresanfang 2014 ein leichtes Plus von knapp drei Prozent. Der Kurs der SÜSS MicroTec-Aktie hat sich im vierten Quartal auf einem Niveau um die 4,50 Euro stabilisiert und hat das Jahr mit einem Schlusskurs von 4,70 Euro beendet. Dies entspricht einem Minus gegenüber Jahresanfang von rund 27 Prozent.

Die Anzahl der im Tagesdurchschnitt am Börsenplatz Frankfurt und über XETRA gehandelten SÜSS MicroTec-Aktien lag im Jahr 2014 bei 114.596 Stück (Vorjahr: durchschnittlich 104.569 Aktien pro Tag).

Einen Überblick über den Kursverlauf im Jahr 2014 bietet die folgende grafische Darstellung.

**Die Kursentwicklung der SÜSS MicroTec-Aktie 2014**

Schlusskurs der SÜSS MicroTec-Aktie am 2. Januar 2014: 6,38 €

— SÜSS MicroTec AG, indiziert — TecDAX, indiziert — Prime IG Semiconductor, indiziert



### Vergleich der Kursentwicklung von SÜSS MicroTec, TecDAX und Prime IG Semiconductor im Geschäftsjahr 2014

	30.12.2014	30.12.2013	Veränderungen
TecDAX	1371	1167	+17%
Prime IG Semiconductor	184	153	+20%
SÜSS MicroTec	4,70	6,46	-27%

### Die SÜSS MicroTec-Aktie im Überblick

Wertpapierkennnummer	A1K023
ISIN	DE000A1K0235
Reuters-Kürzel	SMHN
Bloomberg-Kürzel	SMHN:GR
Börsensegment	Prime Standard
Anzahl der ausgegebenen Aktien (Stand 31. Dezember 2014)	19.115.538
Wertpapiergattung	Namensaktien
Designated Sponsor zum 31.12.2014	equinet Bank AG
Beginn der Börsennotierung	18.05.1999
Jahresanfangs- / -schlusskurs in €	6,38 € / 4,70 €
Jahreshoch- / tief in € <sup>1</sup>	9,15 € / 3,90 €

<sup>1</sup> XETRA-Schlusskurs

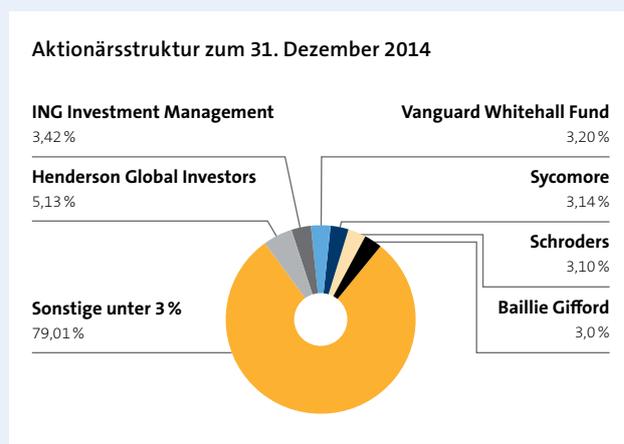
## INVESTOR RELATIONS-AKTIVITÄTEN

Investor Relations umfasst alle Maßnahmen, die der Pflege der Beziehungen eines börsennotierten Unternehmens zu den Investoren dienen. Es geht bei der Investor Relations-Arbeit unter anderem darum, den Kapitalmarkt zeitnah mit aktuellen Informationen über das Unternehmen zu versorgen und somit eine angemessene Bewertung der Aktie an der Börse zu gewährleisten. Zu den Kapitalmarktteilnehmern und damit zu den direkten Ansprechpartnern gehören beispielsweise Privataktionäre, Fondsmanager, Finanzanalysten in Bankhäusern und natürlich auch die Finanzpresse.

Dieser Aufgabe fühlt sich auch der Vorstand der SÜSS MicroTec AG verpflichtet. So besuchten Vorstand und Investor Relations im Jahr 2014 insgesamt sieben Kapitalmarktkonferenzen, darunter drei internationale Konferenzen, und absolvierten mehrere Roadshows.

Die Kapitalmarktkonferenzen fanden in München, Frankfurt, Berlin, Zürich, Paris, und New York statt. Zusätzlich dazu wurde in vielen Einzelgesprächen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit institutionellen Investoren und Analysten genutzt. Anlässlich der Veröffentlichung von Quartalsergebnissen fanden Telefonkonferenzen für Investoren und Analysten statt.

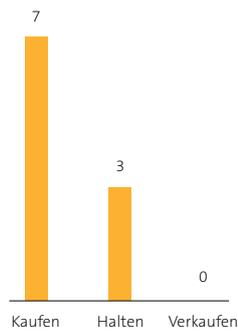
Im Jahr 2014 gab es verschiedene Veränderungen in der Aktionärsstruktur. So hat beispielsweise die Credit Suisse im Jahresverlauf eine Verringerung des Anteilsbesitzes auf unter drei Prozent bekannt gegeben. Neu hinzugekommen sind die ING Investment Management mit 3,42 Prozent Anteilsbesitz, der Vanguard Whitehall Fund mit 3,20 Prozent sowie Sycomore mit 3,14 Prozent und Baillie Gifford mit 3,0 Prozent. Henderson Global Investors aus London haben ihren Anteilsbesitz von 3,14 Prozent im Jahresverlauf auf 5,13 Prozent aufgestockt. Der Free Float beträgt zum Jahresende 2014 weiterhin 100 Prozent.



## ANALYSTENEMPFEHLUNGEN NACH KURS-RÜCKGANG ÜBERWIEGEND POSITIV

Zum Jahresende 2014 wurde das Unternehmen von insgesamt zehn Banken und Research-Häusern gecovert. Im Dezember 2014 haben sieben von zehn Analysten eine Kaufempfehlung für die SÜSS MicroTec-Aktie ausgesprochen, daneben gaben drei Analysten die Empfehlung zum Halten der Aktie. Zum Jahresende lagen keine Verkaufsempfehlungen vor. Eine Übersicht über aktuelle Research-Studien zur SÜSS MicroTec-Aktie finden Sie im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) > Investor Relations.

Analystenempfehlungen zum 31. Dezember 2014



## HAUPTVERSAMMLUNG

Am 17. Juni 2014 fand die ordentliche Hauptversammlung im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München statt. Insgesamt waren über 60 Aktionäre, Aktionärs- und Bankenvertreter sowie Gäste der Einladung des Unternehmens nach München gefolgt. Damit waren 25,03 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft anwesend. Neben der Entscheidung über die Entlastung des Vorstands sowie des Aufsichtsrats, wurde über eine Änderung des Gewinnabführungsvertrages zwischen der SÜSS MicroTec AG und der SÜSS MicroTec Lithography GmbH sowie über eine Änderung des Gewinnabführungsvertrages zwischen der SÜSS MicroTec AG und der SÜSS MicroTec REMAN GmbH abgestimmt. Die Aktionäre des Unternehmens haben ihre Zustimmung zu allen Beschlussvorlagen, die Vorstand und Aufsichtsrat auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung präsentierten, gegeben.

Der damalige Vorstandsvorsitzende Frank Averdung erläuterte in seinem Bericht die wesentlichen Entwicklungen und Ergebnisse des vergangenen Geschäftsjahres sowie des ersten Quartals 2014 und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr 2014. Im Vordergrund seiner Ausführungen standen dabei die globale Ausrichtung und die technologische Innovationskraft des Unternehmens.

# CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance steht für eine verantwortungsbewusste und auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtete Führung und Kontrolle von Unternehmen. Daneben gehören für SÜSS MicroTec Transparenz, eine offene Kommunikation mit Aktionären und Investoren sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und Vorstand zu den wesentlichen Aspekten einer guten Corporate Governance. SÜSS MicroTec orientiert sich am Deutschen Corporate Governance Kodex (DCGK), der sich als Maßstab guter Unternehmensführung in Deutschland bewährt hat. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem nachfolgenden Bericht.

## CORPORATE GOVERNANCE IM ÜBERBLICK

Mit der Zielsetzung, durch eine verantwortungsbewusste und langfristig ausgerichtete Unternehmensführung nicht nur den Fortbestand des Unternehmens, sondern auch eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes zu erreichen, hat die Corporate Governance einen hohen Stellenwert im Unternehmen. Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben sich im Geschäftsjahr 2014 erneut intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt. SÜSS MicroTec strebt in seinem unternehmerischen Handeln danach, das Vertrauen, das uns Anleger, Finanzmärkte, Geschäftspartner, Mitarbeiter und die Öffentlichkeit entgegenbringen, zu bestätigen und die Corporate Governance im Konzern fortlaufend weiterzuentwickeln. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Website unter [www.suss.com](http://www.suss.com) > Corporate Governance.

## ENTSPRECHENSERKLÄRUNG ZUM DEUTSCHEN CORPORATE GOVERNANCE KODEX

Vorstand und Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben am 9. Januar 2015 gem. § 161 Abs. 1 AktG folgende Entsprechenserklärung abgegeben:

Die SÜSS MicroTec AG wird den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 24. Juni 2014 mit den nachfolgend aufgelisteten Ausnahmen entsprechen und hat den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung am 10. Januar 2014 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen.

## SELBSTBEHALT BEI D&O-VERSICHERUNGEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 3.8 bei Abschluss einer Directors' and Officers' Liability Insurance (Vermögensschadenshaftpflichtversicherung) einen der gesetzlichen Regelung für Vorstände entsprechenden Selbstbehalt für den Aufsichtsrat der Gesellschaft zu vereinbaren. Die SÜSS MicroTec AG verfügt bereits seit mehreren Jahren über eine D&O-Versicherung ohne organspezifischen Selbstbehalt für den Aufsichtsrat. Das verantwortungsvolle Handeln des Aufsichtsrats wird nach Ansicht von SÜSS MicroTec durch Vereinbarung eines entsprechenden Selbstbehalts nicht zusätzlich gefördert.

## VERTIKALER VERGÜTUNGSVERGLEICH

In Ziffer 4.2.2 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex dem Aufsichtsrat bei der Festlegung der Vorstandsvergütung das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung des oberen Führungskreises sowie der Belegschaft insgesamt auch in der zeitlichen Entwicklung zu berücksichtigen, wobei der Aufsichtsrat festlegt, wie der obere Führungskreis und die relevante Belegschaft abzugrenzen ist.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist der Auffassung, dass die Festlegung des obersten Führungskreises und der relevanten Belegschaft unter Einbeziehung der zeitlichen Entwicklung in der Praxis zu erheblichen Rechtsunsicherheiten führen kann. Die SÜSS MicroTec AG erklärt daher insoweit vorsorglich eine Kodexabweichung.

## VERSORGUNGSZUSAGEN

Unter 4.2.3 empfiehlt der Deutsche Corporate Governance Kodex dem Aufsichtsrat bei Versorgungszusagen das jeweils angestrebte Versorgungsniveau – auch nach der Dauer der Vorstandszugehörigkeit – und den daraus abgeleiteten jährlichen sowie langfristigen Aufwand für das Unternehmen zu berücksichtigen.

Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG wird von dieser Empfehlung abweichen, da für die Vorstandsmitglieder kein bestimmtes „Versorgungsniveau“ im Ruhestand, sondern eine markt- und unternehmenskonforme Vergütung der aktiven Tätigkeit angestrebt wird. Unmittelbare Versorgungszusagen, bei denen die Gesellschaft selbst die zugesagten Leistungen erbringt, werden den Mitgliedern des Vorstands grundsätzlich nicht gewährt. Soweit die Gesellschaft den Vorständen einen Zuschuss zur Altersvorsorge gewährt und Beiträge in eine Direktversicherung (Kapitallebens- bzw. Rentenversicherung) einzahlt, ist damit keine Zusage eines bestimmten Versorgungsniveaus verbunden.

## BILDUNG VON AUSSCHÜSSEN

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.3 in Abhängigkeit von den spezifischen Gegebenheiten des Unternehmens und der Anzahl seiner Aufsichtsratsmitglieder die Bildung von fachlich qualifizierten Ausschüssen. Da der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG nur aus drei Aufsichtsratsmitgliedern besteht, ist die Bildung von Ausschüssen, die im Regelfall aus mindestens drei Mitgliedern bestehen müssen, nicht möglich und im Übrigen auch nicht erforderlich, da im Plenum eine intensive und qualifizierte Diskussion stattfinden kann.

## ZIELE FÜR DIE ZUSAMMENSETZUNG DES AUFSICHTSRATS

Der Deutsche Corporate Governance Kodex empfiehlt in Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 die Benennung konkreter Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Bei der Benennung der konkreten Ziele soll unter Beachtung der unternehmensspezifischen Situation die internationale Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle Interessenkonflikte, eine festzulegende Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder und Vielfalt (Diversity) berücksichtigt werden. Insbesondere sollen die konkreten Ziele eine angemessene Beteiligung von Frauen vorsehen. Seit der Neufassung des DCGK vom 15. Mai 2012 wird zudem die konkrete Angabe der angestrebten Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder empfohlen. Vorschläge des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung sollen

diese Ziele beachten. SÜSS MicroTec sieht von einer konkreten Zielsetzung und Quoten im vorgenannten Sinn ab. Aus Sicht von SÜSS MicroTec ist die Qualifikation der Aufsichtsratskandidaten maßgebliches Kriterium für die Übernahme eines Aufsichtsratsmandats und damit die Zusammensetzung des Aufsichtsrats. Bei den Vorschlägen für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats unterstützt und berücksichtigt die SÜSS MicroTec AG die in Ziffer 5.4.1 Abs. 2 und Abs. 3 DCGK genannten Kriterien, sieht aber konkrete Zielvorgaben oder Quoten nicht als sinnvoll an.

## KOMMUNIKATION UND TRANSPARENZ

Die Unternehmenskommunikation bei SÜSS MicroTec verfolgt den Anspruch, alle Zielgruppen gleichberechtigt und zeitnah zu informieren, und dabei größtmögliche Transparenz und Chancengleichheit für alle Kapitalmarktteilnehmer zu gewährleisten. Dazu nutzt das Unternehmen neben Quartals-, Halbjahres- und Jahresberichten die Möglichkeit von Telefongesprächen, Konferenzen und Roadshows sowie die Website, um Aktionäre, institutionelle Investoren, Analysten und sonstige Interessierte über Entwicklungen im Konzern zu informieren. SÜSS MicroTec unterrichtet seine Aktionäre im Wesentlichen vier Mal im Jahr über die Geschäftsentwicklung sowie über die aktuelle Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Sie können unter [www.suss.com](http://www.suss.com) [Investor Relations](#) neben allen Pflichtpublikationen, die dort in deutscher und englischer Sprache zum Download bereit gestellt sind, Präsentationen wesentlicher Veranstaltungen sowie Vorstandsinterviews im Video- oder Audioformat frei einsehen bzw. abrufen.

Über die wiederkehrenden Termine wie den Termin der Hauptversammlung oder die Veröffentlichungszeitpunkte der Zwischenberichte unterrichten wir die Öffentlichkeit zeitnah und regelmäßig in einem Finanzkalender, der im Geschäftsbericht, in den Zwischenberichten sowie auf der Website unserer Gesellschaft veröffentlicht ist.

## HAUPTVERSAMMLUNG

Auf der Hauptversammlung der SÜSS MicroTec AG können sich unsere Aktionäre mit Fragen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf direkt an Vorstand und Aufsichtsrat wenden. Wir bereiten die Hauptversammlung stets mit dem Ziel vor, den Aktionären alle für sie relevanten Informationen zur Verfügung zu stellen. Die Hauptversammlung beschließt darüber hinaus unter anderem über die Gewinnverwendung, die Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie über die Wahl des Abschlussprüfers.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den anstehenden Tagesordnungspunkten sowie die Erläuterung der Teilnahmebedingungen werden in der Regel fünf bis sechs Wochen vor dem Hauptversammlungstermin bekannt gemacht. Alle Dokumente und Informationen zur Hauptversammlung stehen auf der Website der Gesellschaft zum Download zur Verfügung und können ebenfalls in Kopie bei der Investor Relations-Abteilung angefordert werden. Zudem sind wir bemüht, unseren Aktionären die Ausübung ihrer Rechte zu erleichtern. Aktionäre können ihr Stimmrecht in der Hauptversammlung entweder selbst ausüben oder durch einen Bevollmächtigten ihrer Wahl oder durch einen weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Die Weisungen zur Stimmrechtsausübung können vor oder während der Hauptversammlung direkt vor Ort erteilt werden. Die Präsenz und die Abstimmungsergebnisse zur Hauptversammlung veröffentlichen wir direkt im Anschluss an die Veranstaltung im Internet.

## ZUSAMMENARBEIT VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Als Aktiengesellschaft (AG) unterliegt SÜSS MicroTec dem deutschen Aktienrecht und verfügt daher über eine zweigeteilte Führungs- und Kontrollstruktur, die von den Mitgliedern des Vorstands und den Mitgliedern des Aufsichtsrats wahrgenommen wird. Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten zielgerichtet und effizient zusammen, um – unter Beachtung der Interessen unserer Mitarbeiter und unserer Aktionäre – eine nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens voranzutreiben. Die Mitglieder des Vorstands tragen gemeinsam die Verantwortung für die gesamte Geschäftsführung. Ihnen obliegt die Entwicklung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, sie stimmen diese mit dem Aufsichtsrat ab und sorgen für deren verantwortungsvolle Umsetzung.

Der Aufsichtsrat überwacht und berät den Vorstand bei der Führung der Geschäfte und bestellt die Vorstandsmitglieder. Wesentliche Vorstandsentscheidungen – z. B. Akquisitionen, Desinvestitionen und Finanzmaßnahmen – sind an die Zustimmung des Aufsichtsrats gebunden. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG ist nicht mitbestimmt, und es wurden keine Ausschüsse gebildet, daher ist über die Zusammensetzung und Arbeitsweise der Ausschüsse nicht zu berichten.

Vorstand und Aufsichtsrat arbeiten im Interesse des Unternehmens und mit dem gemeinsamen Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern, stets sehr eng zusammen. Der Vorstand informiert den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und umfassend über die Geschäftspolitik sowie über alle für das Unternehmen relevanten Fragen der Planung, der Geschäftsentwicklung, der Risikolage und des Risikomanagements. Abweichungen des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen werden dabei erläutert und begründet.

Wie es der Deutsche Corporate Governance Kodex vorsieht, gehört dem Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG mit Dr. Stefan Reineck nicht mehr als ein ehemaliges Vorstandsmitglied an. Berater- oder sonstige Dienstleistungs- und Werkverträge zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und der Gesellschaft bestanden auch im Berichtsjahr 2014 nicht. Interessenkonflikte von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, die dem Aufsichtsrat unverzüglich offenzulegen sind, traten im Geschäftsjahr 2014 nicht auf.

## ZIELE DES AUFSICHTSRATS HINSICHTLICH SEINER ZUSAMMENSETZUNG

Ziel der Zusammensetzung des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG ist es, die Unternehmensentwicklung zu nachhaltiger Ertragskraft und permanenter Anpassung an sich schnell wandelnde Anforderungen durch konstruktive Beratung und Überwachung des Vorstandes auf der Basis relevanter Kompetenzen abzusichern. Durch eine ausreichende Kompetenzvielfalt der Mitglieder sollen ein breites Erfahrungsspektrum und unterschiedliche Sichtweisen zum Nutzen des Unternehmens eingebracht werden.

Die SÜSS MicroTec AG ist ein auf den Weltmarkt ausgerichtetes, technologieorientiertes Unternehmen, das sich in einem sehr dynamischen und technologisch anspruchsvollen Umfeld behaupten und entwickeln muss. Daher sind im Aufsichtsrat technologisches Beurteilungsvermögen und einschlägige Marktkenntnisse im internationalen Maßstab erforderlich. Folglich ist es das Ziel des Aufsichtsrats, neben dem Financial Expert erfahrene Persönlichkeiten zu gewinnen, die diese Bereiche abdecken. Für die technologische Kompetenz sind relevante Kenntnisse der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie und deren Equipment-Industrie von besonderer Bedeutung. Um Trends und Entwicklungen in unseren sehr dynamischen Märkten vorausschauend und zuverlässig beurteilen zu können, sollten im Aufsichtsrat internationale Erfahrung und möglichst aktive Verbindungen vertreten sein.

Zusätzlich zu diesen genannten wichtigen Kompetenzen erwartet das Unternehmen von erfolgreichen Aufsichtsratsmitgliedern und -kandidaten eine breite Erfahrung in anderen Bereichen, die möglichst ergänzend zu einer optimalen Besetzung des Aufsichtsrats beitragen. Dazu gehören Kenntnisse und Erfahrungen bezüglich strategischer Unternehmensentwicklung inkl. Mergers & Acquisitions, des Kapitalmarktes und der Kapitalmarktkommunikation, der Rekrutierung von Führungskräften und moderner Vergütungsmodelle für alle Ebenen sowie eine erhöhte Sensibilität für ökonomisch-ökologische Grundsatzfragen.

Abhängig von der aktuellen Unternehmenssituation kann es sinnvoll sein, die Gewichte der einzelnen Kriterien neu zu bewerten und der Hauptversammlung entsprechende Veränderungen im Aufsichtsrat vorzuschlagen. Dazu beobachtet der Aufsichtsrat die Unternehmenssituation und bewertet die Aufsichtsratsbesetzung in regelmäßigen Abständen.

Bei der Besetzung des Aufsichtsrats sollen zukünftig Frauen mit größerer Aufmerksamkeit berücksichtigt werden, um eine angemessene Frauenbeteiligung zu erreichen, ohne dass Aufsichtsrat und Vorstand die Festschreibung einer Quote derzeit für sinnvoll halten. Auch die Festlegung einer über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehenden Mindestzahl von unabhängigen Aufsichtsratsmitgliedern halten Vorstand und Aufsichtsrat angesichts der Größe des Aufsichtsrats nicht für sinnvoll, um das künftige Auswahlermessen bei der Besetzung von Aufsichtsratspositionen nicht zu stark einzuschränken.

Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder liegt bei 71 Jahren. Interessenkonflikte werden bei der Besetzung des Aufsichtsrats vermieden, indem die Kandidaten bereits im Vorfeld einer Wahl Negativverklärungen abgeben. Sollte es während einer Wahlperiode zu potenziellen oder tatsächlichen Konflikten kommen, dann führen entsprechende Regelungen für Aufsichtsrat und Vorstand zu deren Offenlegung und zu einer angemessenen Behandlung im Plenum des Aufsichtsrats.

## ORGANE

Mitglieder des Vorstands und Aufsichtsrats sowie deren Mandate:

### *Frank Averdung (bis 24. August 2014)*

- › Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender weitere Mandate
- › Semi European Advisory Board (Mitglied)
- › IMS Nanofabrication AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)

### *Michael Knopp*

- › Diplom-Kaufmann, Ratingen, Finanzvorstand, Vorstandssprecher seit 24. August 2014

weitere Mandate:

- › keine

### *Walter Braun (seit 1. Juli 2014)*

- › Diplom-Ingenieur, Altensteig, Produktionsvorstand

weitere Mandate:

- › keine

### *Dr. Stefan Reineck*

- › Kirchart, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchart; Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG

weitere Mandate:

- › AttoCube Systems AG, München (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- › AWS-Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)
- › Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im „Board of Directors“)
- › Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)

### *Jan Teichert*

- › Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar; stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG

weitere Mandate:

- › ab 1. Januar 2014 Kolb Technology GmbH, Hengersberg (Mitglied des Beirats)

### *Gerhard Pegam*

- › Au bei Bad Aibling, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting GmbH, Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec AG

weitere Mandate:

- › OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats);
- › Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)

## VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mit Wirkung vom 1. Juli 2014 wurde Walter Braun in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG berufen. In seiner Funktion verantwortet er derzeit die Bereiche Produktion, Materialwirtschaft, Logistik, Forschung und Entwicklung, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen und Konzernstrategie.

Mit Wirkung vom 24. August 2014 hat der Aufsichtsrat aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die strategische Ausrichtung des Unternehmens die Bestellung von Frank Averdung als Vorstandsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG aufgehoben.

## BESITZ VON AKTIEN UND BEZUGSRECHTEN

Die im Geschäftsjahr 2014 amtierenden Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG besitzen zum Geschäftsjahresende am 31. Dezember 2014 folgende Anzahl an Aktien und Bezugsrechten:

### Besitz von Aktien und Bezugsrechten

	Anzahl der Aktien zum 31.12.2014	Veränderung gegenüber 31.12.2013	Anzahl der Aktienoptionen zum 31.12.2014	Veränderung gegenüber 31.12.2013
<b>Aufsichtsrat</b>				
Dr. Stefan Reineck	9.600	–	0	–
Jan Teichert	0	–	0	–
Gerhard Pegam	0	–	0	–
<b>Vorstand</b>				
Michael Knopp	25.000	-3.100	0	–
Walter Braun	10.500	+10.500	0	–
Frank Averdung <sup>1</sup>	95.720	+5.180	0	–

<sup>1</sup> Vorstandsmittglied bis 24. August 2014

## MELDEPFLICHTIGE AKTIENGESCHÄFTE VON VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sind nach § 15a Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) gesetzlich verpflichtet, den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien der SÜSS MicroTec AG oder sich darauf beziehenden Finanzinstrumenten offenzulegen, soweit der Wert der von dem Mitglied und ihm nahestehenden Personen innerhalb eines Kalenderjahres getätigten Geschäfte die Summe von 5.000 Euro erreicht oder übersteigt.

Sämtliche Geschäfte des Vorstands und des Aufsichtsrats werden auf der Website des Unternehmens unter [www.suss.com](http://www.suss.com) [Investor Relations](#) [Die Aktie](#) [Directors' Dealings](#) veröffentlicht.

## RECHNUNGSLEGUNG UND ABSCHLUSSPRÜFUNG

SÜSS MicroTec erstellt den Konzernabschluss sowie die Zwischenberichte nach den International Financial Reporting Standards (IFRS), wie sie in der Europäischen Union für börsennotierte Gesellschaften anzuwenden sind. Der Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt.

Am 17. Juni 2014 bestellte die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2014 die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit Sitz in Hamburg, Zweigniederlassung München, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer der SÜSS MicroTec AG. Damit werden Jahresabschluss und Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG zum dritten Mal in Folge von einem Unternehmen der BDO-Gruppe geprüft. Die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat 2014 neben der Prüfungstätigkeit keinerlei Beratungsleistungen für SÜSS MicroTec erbracht. Als Nachweis seiner Unabhängigkeit hat der Abschlussprüfer gegenüber dem Aufsichtsrat eine Unabhängigkeitserklärung abgegeben. Des Weiteren wurde mit dem Abschlussprüfer vereinbart, dass dieser den Aufsichtsrat über alle wesentlichen Feststellungen und Vorkommnisse informiert, die sich bei der Durchführung der Abschlussprüfung ergeben. Leitender Prüfer für das Geschäftsjahr 2014 war Wirtschaftsprüfer Thomas Steiner, der die Abschlussprüfung und Konzernabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG erstmals als leitender Prüfer betreute.

## ERKLÄRUNG ZUR UNTERNEHMENSFÜHRUNG

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB ist Bestandteil des Lageberichts und wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter [www.suss.com](http://www.suss.com) [Investor Relations](#) [Corporate Governance](#) [Erklärung zur Unternehmensführung](#) allgemein zugänglich gemacht.

## VERGÜTUNGSBERICHT

Die Grundzüge des Vergütungssystems haben wir im Vergütungsbericht dargestellt, der im zusammengefassten Lagebericht abgedruckt ist.

# ZUSAMMEN- GEFASSTER LAGEBERICHT

*der SÜSS MicroTec AG  
für das Geschäftsjahr 2014*

<b>Wirtschaftsbericht</b>	<b>18</b>
Geschäftstätigkeit, Unternehmenssteuerung und strategische Ausrichtung	18
Wirtschaftliches Umfeld	21
SÜSS MicroTec in Zahlen	22
Ertragslage: Auftragseingang, Umsatz und EBIT	22
Entwicklung in den einzelnen Segmenten	24
Entwicklung in den wichtigsten Regionen	26
Finanz- und Vermögenslage	27
Investitionen	30
Forschung und Entwicklung	30
Die Holding – SÜSS MicroTec AG	33
Wesentliche Veränderungen der Vermögens- und Finanzlage	33
Wesentliche Ereignisse mit Einfluss auf die Ertragslage der Holding	34
Nachhaltigkeit	35
Compliance	35
Qualitätsmanagement	35
Umweltverantwortung	35
Mitarbeiter	37
<b>Übernahmerechtliche Angaben gemäß</b>	
<b>§ 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB</b>	<b>38</b>
<b>Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB</b>	<b>41</b>
<b>Vergütungsbericht</b>	<b>41</b>
Vergütung des Vorstands	41
Vergütung des Aufsichtsrats	45
<b>Nachtragsbericht</b>	<b>46</b>
<b>Potenziale</b>	<b>46</b>
Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung	
des SÜSS MicroTec-Konzerns	46
Chancen des Konzerns	46
Risikomanagement-System	50
Risiken des Konzerns	52
Gesamteinschätzung	58
Prognosebericht	59

---

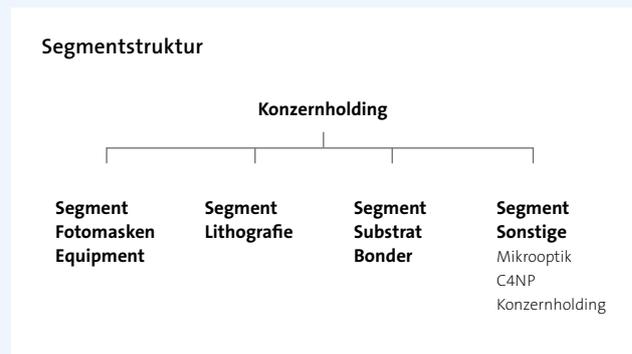
---

# Wirtschaftsbericht

## GESCHÄFTSTÄTIGKEIT, UNTERNEHMENSSTEUERUNG UND STRATEGISCHE AUSRICHTUNG

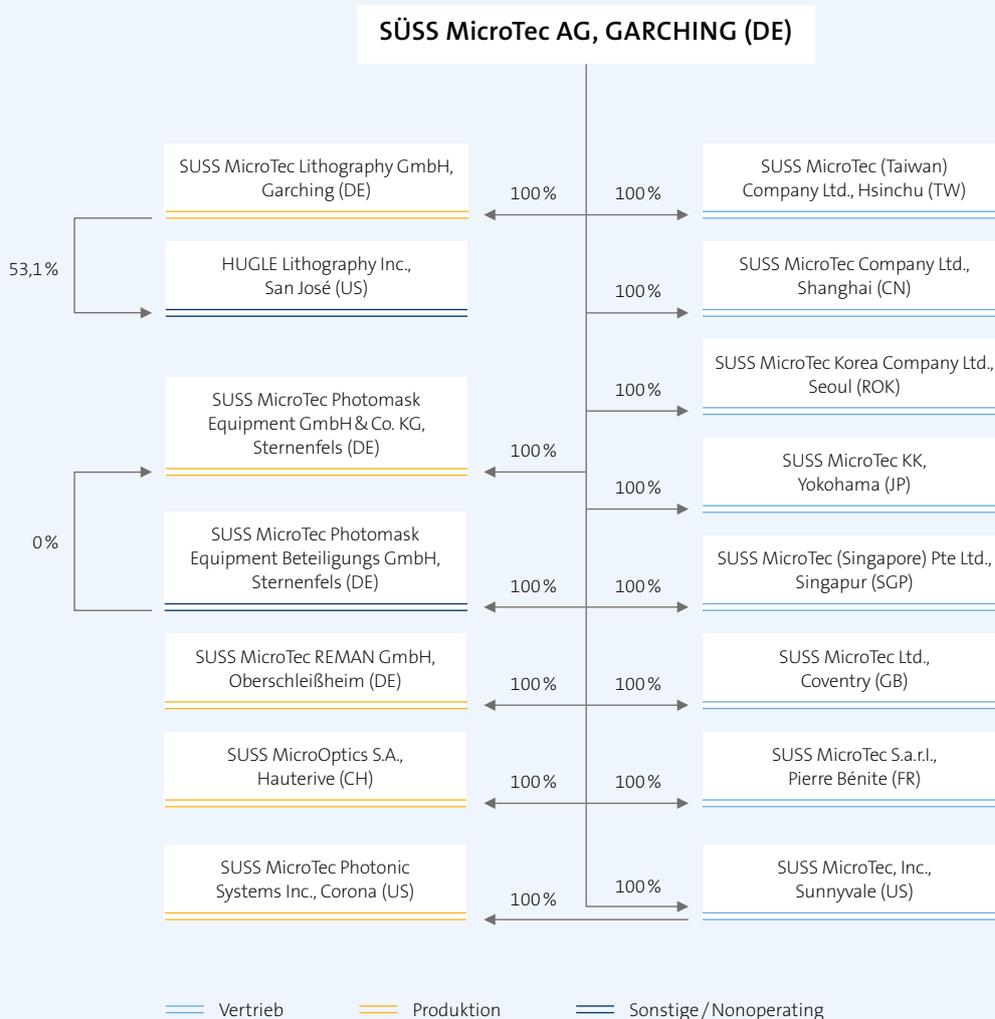
Der SÜSS MicroTec-Konzern entwickelt, fertigt und vertreibt Anlagen für die Herstellung von Mikroelektronik und Mikro-systemtechnik. Als Zulieferer von Systemlösungen für die Halbleitertechnik ist die Gruppe als leistungsstarker Partner der Halbleiterindustrie für den Labor- und den Produktionsbereich tätig. Wachstumsstarke Spezialmärkte bilden die Tätigkeitsschwerpunkte und fördern die innovative Technologieentwicklung mit langfristigem Erfolgspotenzial für zukunftsorientierte Märkte und Anwendungen. Im Mittelpunkt steht die Aufbau- und Verbindungstechnik von Mikrochips bei Anwendungen in der Chipfertigung, der Telekommunikation und der optischen Datenübertragung. Größere Prozesslinien bestehen in der Regel aus mehreren Einzelgeräten, wo die Gruppe mit internen und externen Partnern Netzwerke zur Schaffung von Wettbewerbsvorteilen bildet und nutzt.

Der Konzern ist zum 31. Dezember 2014 in vier Segmente eingeteilt, wobei das Segment „Sonstige“ aus mehreren kleineren Teileinheiten besteht, die jeweils getrennt geleitet werden. Durch die Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG (nach Umfirmierung: SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) wurde im Geschäftsjahr 2010 ein neues Segment – Fotomasken Equipment – geschaffen. Die im März 2012 akquirierte Tamarack Scientific Co., Inc. (nach Umfirmierung: SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc.) ist im Segment Lithografie angesiedelt.



### RECHTLICHE KONZERNSTRUKTUR

Die rechtliche Konzernstruktur besteht aus der Muttergesellschaft, der SÜSS MicroTec AG als Management- und Finanzierungsholding, sowie den mehrheitlich im Eigentum der Muttergesellschaft stehenden Tochtergesellschaften. In den Tochtergesellschaften sind jeweils Entwicklungs- und Produktionstätigkeiten oder auch lokale Vertriebs- und Servicetätigkeiten für den Konzern organisiert. Die Gruppe verfügt über Standorte in Deutschland, den USA, Großbritannien, Frankreich, der Schweiz, Japan, China, Singapur, Korea und Taiwan. Die geringfügige Beteiligung von zehn Prozent an der ELECTRON-MEC S.R.L., Mailand (IT) wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr verkauft, da sie nur eine unwesentliche Bedeutung für das operative Geschäft hatte.



**LEITUNG UND KONTROLLE – VERGÜTUNGSTRUKTUR FÜR DIE ORGANMITGLIEDER**

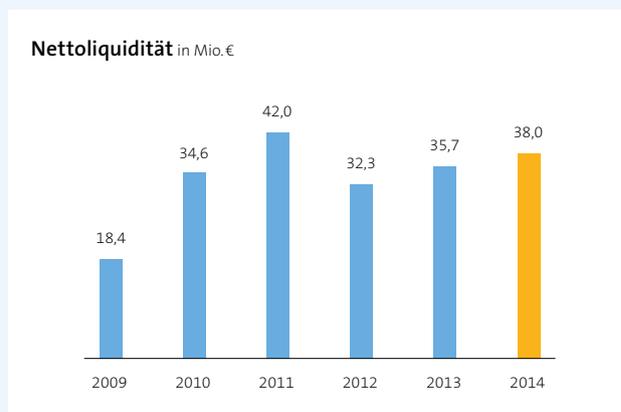
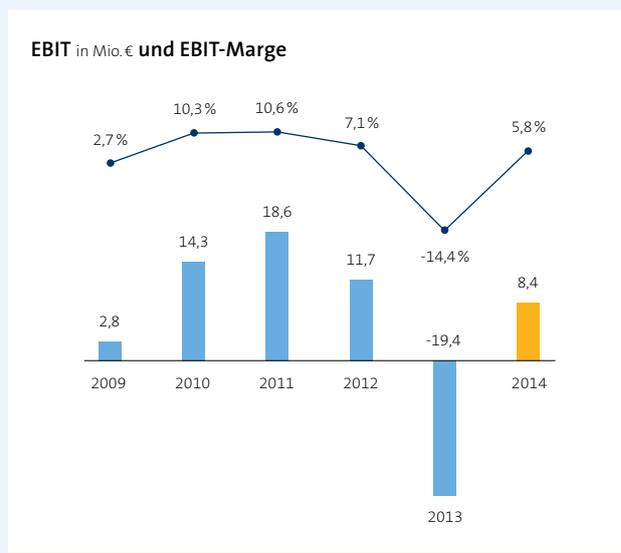
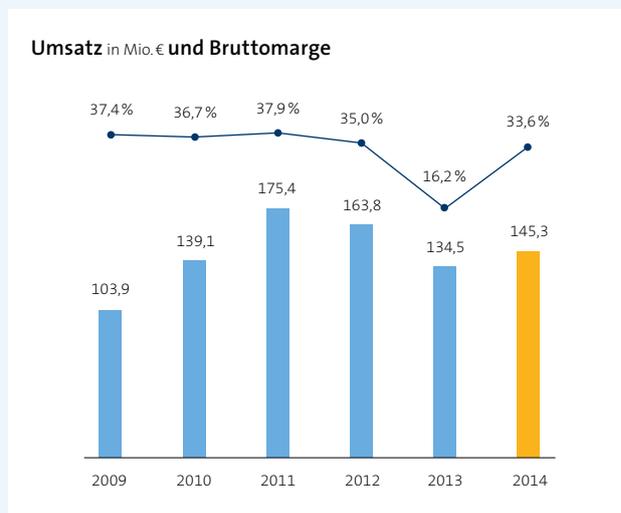
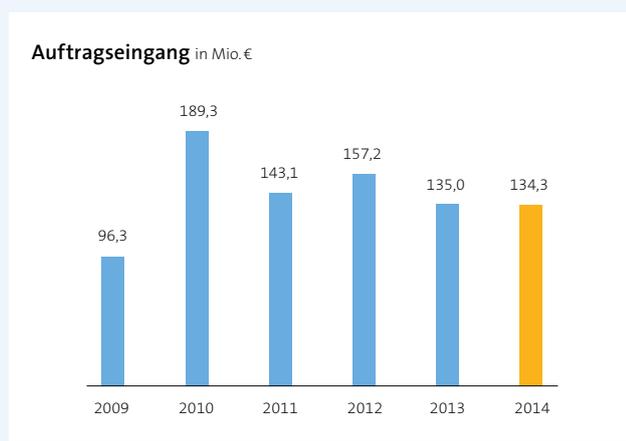
Der Vorstand erhält für seine Tätigkeit eine monatliche Festvergütung sowie eine variable Vergütung, die bei Erreichen individuell festgelegter Ziele gezahlt wird. In den Festbezügen enthalten sind Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens mit privater Nutzungsmöglichkeit und Zuschüsse zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. Verantwortung bestimmt. Den Mitgliedern des Vorstands sind zusätzlich Versorgungszusagen in Form von Direktversicherungen gemacht worden. Die variable Vergütung enthält kurzfristige und auch langfristige Komponenten, nähere Hinweise hierzu sind im Vergütungsbericht zu finden.

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Gemäß § 19 der Satzung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats folgende Vergütung: Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500€ pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000€, sein Stellvertreter 40.000€ und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000€ pro Geschäftsjahr als feste Vergütung.

## UNTERNEHMENSSTEUERUNG, ZIELE UND UNTERNEHMENSSTRATEGIE

SÜSS MicroTec verfolgt die Besetzung lukrativer Spezialmärkte in der Industrie der Halbleiterausrüster als Strategie. Ziel ist es, durch eine klare Positionierung stets innerhalb der Top-3-Anbieter in den relevanten Märkten zu agieren. Partnerschaften mit führenden Instituten und Unternehmen der Industrie sollen sicherstellen, dass wesentliche Trends oder zukunftssträchtige Technologien stets rechtzeitig erkannt und auf deren Potenziale für SÜSS MicroTec überprüft werden. Im Vordergrund steht dabei organisches Wachstum; im Falle interessanter Technologien oder sinnvoller Komplementärprodukte wird auch externes Wachstum in Betracht gezogen.

Die Unternehmenssteuerung orientiert sich insbesondere an Auftragseingang, Umsatz und Auftragsbestand der einzelnen Segmente. Die Leistungsfähigkeit der Segmente wird dabei vor allem durch Beobachtung der Entwicklung der Rohertragsmarge (Umsatz abzüglich der Herstellungskosten) sowie des Segmentergebnisses gemessen. Die Darstellung des Segmentergebnisses enthält auch Erträge und Aufwendungen aus der Fremdwährungsumrechnung und aus Anlagenabgängen. In der Summe entsprechen die Ergebnisse der Segmente dem operativen Ergebnis (EBIT) des Konzerns. Weitere Steuerungskennzahl ist die Nettoliquidität (flüssige Mittel zuzüglich verzinslicher Wertpapiere und abzüglich Finanzschulden), die eine wesentliche Steuerungsgröße für die Finanzierungsfunktion der Holding darstellt. In der folgenden Darstellung sehen Sie die Entwicklung wichtiger Kennzahlen seit 2009.



## WIRTSCHAFTLICHES UMFELD

### DIE WELTWIRTSCHAFT IST 2014 UM 3,4% GEWACHSEN

Die Weltwirtschaft ist nach Aussage des letzten Herbstgutachtens führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute mit mäßigem Tempo, voraussichtlich 3,4% gegenüber Vorjahr, gewachsen. Dabei haben sich die USA und Großbritannien als besonders robust erwiesen. Für das Geschäftsjahr 2015 erwarten die Experten vom Institut für Weltwirtschaft in Kiel ein leicht beschleunigtes, globales Wirtschaftswachstum in Höhe von 3,7%.

In Europa ist die Dynamik in den einzelnen Ländern sehr unterschiedlich. Der größte Bremsklotz für die Konjunktur war insbesondere die im Zuge der geopolitischen Krisen gestiegene Unsicherheit. Zum einen durch den Russland-Ukraine-Konflikt, der zu spürbaren Sanktionen der westlichen Staaten gegenüber Russland führte und somit zu einer Eintrübung der Stimmung in Europa beigetragen hat. Zum anderen durch die zuletzt merklich gestiegene Unsicherheit über die wirtschaftliche Entwicklung in der Eurozone. Dagegen ist der Ölpreis zuletzt erheblich gefallen und der Euro hat gegenüber dem US-Dollar an Wert verloren, dies wirkt – zumindest kurzfristig – wie ein kleines Konjunkturprogramm.

Nach einem guten Jahresauftakt hatte sich die deutsche Konjunktur im Sommer des Jahres 2014 merklich abgekühlt, zeigte aber zum Jahresanfang 2015 erste Anzeichen einer erneuten Erholung. Die Stimmungskennzeichen machen Hoffnung auf eine Wende der Konjunktur. So ist das Ifo-Geschäftsklima im Dezember zum zweiten Mal in Folge gestiegen und lag im Januar bei 105,5 Punkten.

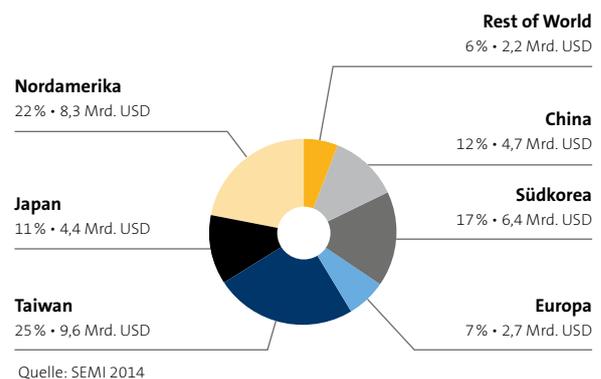
### ERNEUTES REKORDJAHR FÜR DEN HALBLEITERMARKT

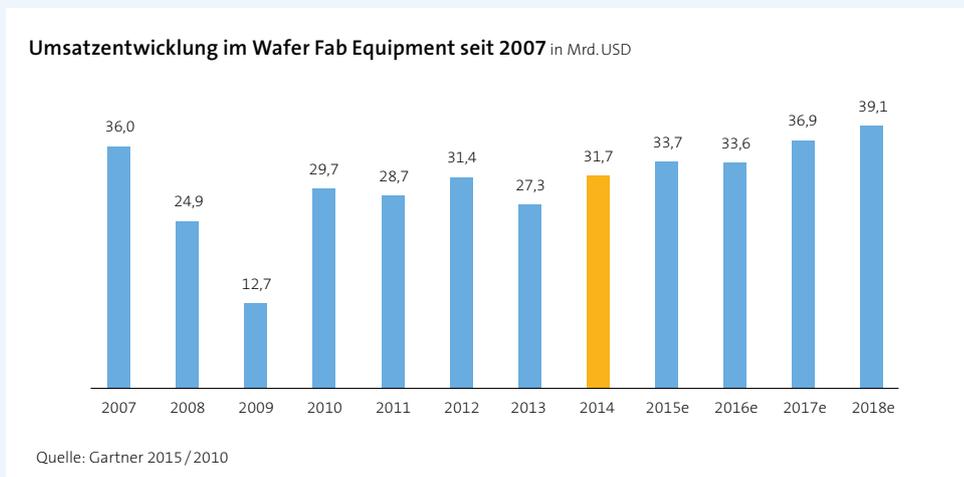
Der gesamte Halbleitermarkt ist im Geschäftsjahr um 7,9% gewachsen. Das Gesamtvolumen wuchs von 315,0 Mrd. USD im Jahr 2013 auf rund 339,8 Mrd. USD im letzten Jahr (Quelle: Gartner, Januar 2015). Getragen wurde das Wachstum durch eine weiterhin starke Nachfrage nach DRAM-Speicherbausteinen, der deutliche Nachfrageüberhang bei gleichzeitig stabilen Preisen hatte sich bereits im Vorjahr positiv auf die Entwicklung des Halbleitermarktes ausgewirkt.

### ERHOLUNG IM SEGMENT HALBLEITER EQUIPMENT

Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2013 konnte der Halbleiter-Equipment-Markt im Geschäftsjahr 2014 erneut zulegen. Das gesamte Marktsegment ist von rund 31,82 Mrd. USD auf 37,97 Mrd. USD gewachsen. Die deutlichste Erholung zeigten der US-amerikanische Equipment-Markt mit einem Plus von mehr als 57% sowie der europäische Markt mit einem Plus von 38%. Die größten asiatischen Märkte in Taiwan, Korea und China haben insgesamt leicht zulegen können, obwohl Taiwan gegenüber Vorjahr einen leicht rückläufigen Umsatz verzeichnete (Quelle: SEMI, Dezember 2014). Wie aus der folgenden Grafik ersichtlich wird, dominiert die Absatzregion Asien den Halbleiter-Equipment-Markt mit einem Anteil von deutlich über 50%.

Halbleiter-Equipment-Markt nach Regionen im Jahr 2014





## SÜSS MicroTec IN ZAHLEN

### ERTRAGSLAGE: AUFTRAGSEINGANG, UMSATZ UND EBIT

#### Vergleich Gesamtjahreszahlen 2014 – Prognose 2014

Im Prognosebericht des Lageberichts 2013 hat das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2014 einen Umsatz von 135–145 Mio. € sowie ein Ergebnis (EBIT) von minus 5–0 Mio. € in Aussicht gestellt. Im August 2014 wurde die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 2–4 Mio. € angehoben. SÜSS MicroTec hat das Geschäftsjahr 2014 mit einem Umsatz in Höhe von 145,3 Mio. € abgeschlossen. Das EBIT erreichte einen Wert von 8,4 Mio. € und lag damit deutlich über der eigenen Erwartung. Die Gründe hierfür sind der Umsatz, welcher am oberen Ende der Erwartungen lag, ein positiver Produktmix sowie Bruttomargen, die über den Erwartungen lagen.

	Prognose 2014	Angepasste Prognose 2014	Ergebnis 2014
Umsatz	135–145 Mio. €	135–145 Mio. €	145,3 Mio. €
EBIT	-5 bis 0 Mio. €	2 bis 4 Mio. €	8,4 Mio. €
EBIT-Marge	–	1,4%–3,0%	5,8%

#### Unternehmensentwicklung im Jahr 2014

Der Auftragseingang erreichte im Geschäftsjahr 2014 einen Wert von 134,3 Mio. €, dies ist ein minimaler Rückgang gegenüber Vorjahr, in welchem der Auftragseingang 135,0 Mio. € betrug. Zum 31. Dezember 2014 ergab sich ein Auftragsbestand von 75,6 Mio. €, der damit um rund 10,1 Mio. € unter dem

Auftragsbestand des Vorjahres (85,7 Mio. €) lag. Das Verhältnis von neu eingegangenen Aufträgen zu realisierten Umsätzen (Book-to-Bill-Ratio) lag bei 0,92 nach 1,0 im Vorjahr.

Die Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns zeigt im Geschäftsjahr 2014 einen Umsatzanstieg und ein deutlich positives Jahresergebnis. Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 8% und beliefen sich auf 145,3 Mio. €, während im Vorjahr Umsätze von 134,5 Mio. € erzielt wurden. Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich 2014 auf 8,4 Mio. €. 2013 wurde ein negatives EBIT von minus 19,4 Mio. € erreicht. Im EBIT des Vorjahres waren Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € enthalten, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Bond-Cluster-Systemen für das permanente Bonden angefallen sind.

Das größte Umsatzplus von 8,4 Mio. € wurde im umsatzstärksten Segment von SÜSS MicroTec, der Lithografie, erzielt. Der Anteil der Umsätze des Segments Lithografie betrug 2014 rund 67% der gesamten Konzernumsätze. Die Umsätze im Segment Substrat Bonder haben sich um rund 0,4 Mio. € reduziert. Im Segment Fotomaschinen Equipment waren Umsatzzuwächse von 2,3 Mio. € zu verzeichnen, während im Segment Sonstiges ein Umsatzanstieg von 0,5 Mio. € verbucht werden konnte.

In den Umsatzkosten sind Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 0,5 Mio. € enthalten. Die Neu-Aktivierungen beliefen sich auf 0,1 Mio. €. Sowohl die Abschreibungen als auch die Neuaktivierungen auf Entwicklungskosten betreffen ausschließlich das Segment Lithografie. Im Vorjahr wurden Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten von 2,3 Mio. € erfasst. Davon betrafen 1,2 Mio. € außerplanmäßige Abschreibungen auf Entwicklungsleistungen, die in der Vergangenheit im

Zusammenhang mit dem Bereich Permanent-Bond-Cluster aktiviert wurden. Die Neu-Aktivierungen summierten sich im Vorjahr ebenfalls auf knapp 0,1 Mio. €.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde ein Rohertrag von 48,8 Mio. € erzielt, was einer Rohertragsmarge von 33,6 % entspricht. Im Vorjahr betrug der Rohertrag 21,8 Mio. €; die Rohertragsmarge 2013 belief sich auf 16,2 %. Der Rohertrag des Vorjahres war belastet mit Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Refokussierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs. Von den gesamten Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € wurden 10,5 Mio. € in den Umsatzkosten erfasst. Darüber hinaus enthielten die Umsatzkosten im Jahr 2013 außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1,9 Mio. € auf Maschinen im Vorratsbestand der SÜSS MicroTec Photonic Systems, die im Rahmen der 2012 vorgenommenen Purchase Price Allocation neu bewertet wurden. Der um Sondereffekte bereinigte Rohertrag des Vorjahres betrug damit 34,2 Mio. €; die um Sondereffekte bereinigte Rohertragsmarge des Vorjahres hätte rund 25,4 % betragen.

Die Vertriebskosten des Geschäftsjahres haben sich absolut betrachtet nicht wesentlich verändert und lagen erneut bei 17,5 Mio. €, was – in Relation zum erzielten Umsatz – einer Aufwandsquote von 12,1 % (Vorjahr: 13,0 %) entspricht.

Die Verwaltungskosten reduzierten sich von 15,0 Mio. € im Vorjahr auf nun 14,2 Mio. € und entsprechen damit einer Aufwandsquote von 9,8 % (Vorjahr: 11,1 %).

Die Forschungs- und Entwicklungskosten erhöhten sich leicht von 10,2 Mio. € im Vorjahr auf 10,5 Mio. €.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich im Geschäftsjahr auf 4,5 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €). Sie beinhalten – wie auch im Vorjahr – hohe Fremdwährungsgewinne, die sich aus der Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro ergeben haben. 2014 konnten darüber hinaus Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen von 1,3 Mio. € realisiert werden. Im Vorjahr waren Erträge aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific) in Höhe von 2,1 Mio. € enthalten. Die Auflösung der entsprechenden Verbindlichkeit resultierte aus einer Neubeurteilung der voraussichtlichen Ertragslage von SÜSS MicroTec Photonic Systems, auf deren Basis der Earn-Out für die Verkäufer und die Mitarbeiter von Photonic Systems ermittelt wurde. Auch 2014 wurden erneut Erträge aus der Auflösung der Earn-Out-Verpflichtung Photonic Systems realisiert. Diese Erträge beliefen sich 2014 auf 0,3 Mio. €. Damit verbleibt zum 31. Dezember 2014 keine Earn-Out-Verpflichtung mehr.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beliefen sich 2014 auf 2,7 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €) und beinhalten vor allem Aufwendungen aus Fremdwährungsumrechnungen. Im Vorjahr waren darüber hinaus Aufwendungen von 1,5 Mio. € für die Bildung von Wertberichtigungen auf Kundenforderungen enthalten. Davon betrafen 0,5 Mio. € Forderungen für ein Kundenprojekt des Bereichs Permanent-Bond-Cluster, die im Rahmen der Refokussierung dieses Bereichs wertberichtigt wurden.

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 8,4 Mio. €. 2013 wurde ein negatives EBIT von minus 19,4 Mio. € erzielt. Im EBIT des Vorjahres waren Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. € enthalten, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-Systemen angefallen sind. Dabei handelte es sich um Wertminderungen auf Lagerbestände (9,3 Mio. €), außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten (1,2 Mio. €), Wertberichtigungen auf Kundenforderungen (0,5 Mio. €) und Bildung von Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen (2,2 Mio. €). Ohne diese Sonderaufwendungen hätte das EBIT 2013 rund minus 6,2 Mio. € betragen.

Das Finanzergebnis belief sich 2014 auf minus 0,2 Mio. € (nach minus 0,1 Mio. € im Vorjahr).

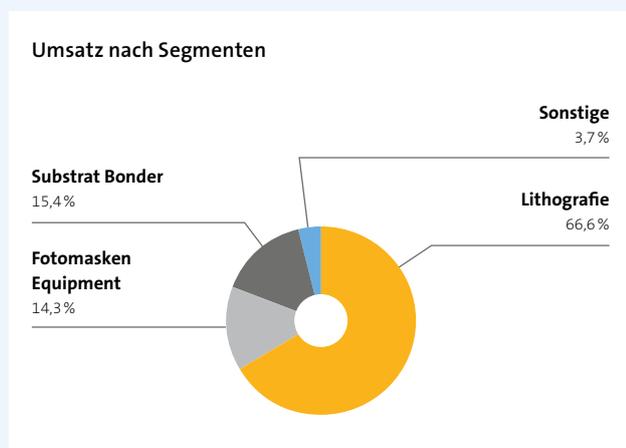
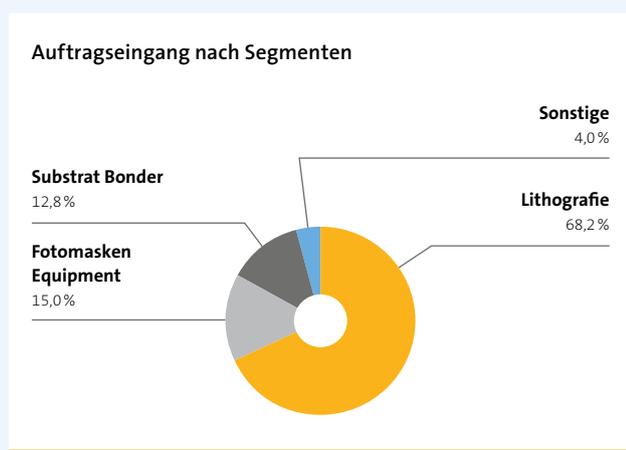
Das Konzernergebnis vor Steuern von 8,2 Mio. € ist mit einem Steueraufwand von 3,6 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von rund 44 % entspricht. Grund für den – in Relation zum Gewinn vor Steuern – hohen Steueraufwand sind vor allem im Geschäftsjahr 2014 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung (analog zu den Vorjahren) keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden. Dadurch wird für die in den ausländischen Gesellschaften entstandenen Verluste kein entsprechender Steuerertrag berücksichtigt.

Im Vorjahr war das Konzernergebnis vor Steuern von minus 19,6 Mio. € mit einem Steuerertrag von 3,6 Mio. € belegt, was einer durchschnittlichen Steueraufwandsquote von minus 18 % entspricht. Somit wich auch im Vorjahr die tatsächliche Steueraufwandsquote deutlich von der erwarteten Steueraufwandsquote ab. Grund für den – in Relation zum Verlust vor Steuern – geringen Steuerertrag waren ebenfalls im Geschäftsjahr 2013 aufgelaufene Verluste ausländischer Konzerngesellschaften (insbesondere in den USA), für die keine aktiven latenten Steuern angesetzt wurden.

Im Konzern ergab sich ein Gewinn nach Steuern von 4,6 Mio. €. Dem steht im Vorjahr ein Verlust von minus 16,0 Mio. € gegenüber. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie betrug 0,24 € nach minus 0,84 € im Vorjahr.

Der Umsatz je Mitarbeiter steigerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 7,6% von 205 Tsd. € auf 221 Tsd. € (basierend auf der jeweiligen Anzahl der Mitarbeiter zum Bilanzstichtag).

### ENTWICKLUNG IN DEN EINZELNEN SEGMENTEN



#### Lithografie

Das Segment Lithografie umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien Mask Aligner, UV-Projektions-scanner, Laser Processing Tools sowie Developer und Coater. Die Fertigung dieser Produktlinien ist in Deutschland an den Standorten Garching bei München und seit Anfang 2010 in Sternenfels angesiedelt. Die Lithografiesparte wurde im ersten Quartal 2012 mit der Akquisition der Tamarack Scientific Co., Inc. (firmiert heute unter SUSS MicroTec Photonic Systems Inc.) verstärkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Corona, Südkalifornien, USA. Das Segment Lithografie ist mit einem Umsatzanteil von mehr als 66% der größte Bereich der SÜSS MicroTec-Gruppe.

Die Komponenten, die auf diesen Maschinen gefertigt werden, gehen im Wesentlichen in die Endmärkte Advanced Packaging, Mikrosystemtechnik und Verbindungshalbleiter (LED) sowie 3D-Integration.

Im Geschäftsjahr 2014 erzielte das Segment Lithografie einen Auftragseingang von 91,5 Mio. € sowie einen Umsatz von 96,7 Mio. €. Dies entspricht einem Plus im Auftragseingang von 4,1% sowie einem Plus im Umsatz von 9,5% gegenüber dem Vorjahr. Der deutliche Umsatzanstieg wurde fast ausschließlich mit den Coater-Produktlinien erzielt. Darüber hinaus waren deutliche Umsatzzuwächse mit Upgrades zu verzeichnen.

Der Rohertrag im Segment Lithografie war im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich höher als im schwachen Vorjahr. Die Bruttomarge lag 2014 bei 35,7% nach 27,7% im Vorjahr. Die deutliche Verbesserung resultiert aus den Roherträgen der verkauften Coater, die aufgrund des günstigen Produktmixes größtenteils eine sehr gute Marge erzielten. Im Vorjahr war die Rohertragsmarge belastet durch das negative Rohergebnis der in den USA entwickelten und produzierten Produktlinien UV-Projektions-scanner und Laser Processing, die mit Umsätzen von 11,6 Mio. € einen substantiellen Umsatzbeitrag geleistet haben. Darüber hinaus haben im Vorjahr das geringe Umsatzvolumen der Produktlinien Mask Aligner und Coater sowie der ungünstige Produktmix die Rohertragsmarge negativ beeinflusst.

Das Segment Lithografie steuerte ein Segmentergebnis in Höhe von 10,7 Mio. € (Vorjahr: 3,2 Mio. €) zum Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) bei. Damit ergibt sich für das Segment Lithografie eine Umsatzrendite von 11,0%, die sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert hat (Umsatzrendite des Vorjahres: 3,6%). Das deutlich verbesserte Segmentergebnis ist vor allem auf den im Vergleich zum Vorjahr höheren Segmentumsatz sowie auf verbesserte Margen der Produktlinie Coater zurückzuführen.

#### Kennzahlen Lithografie

in Mio. €	2014	2013
Auftragseingang	91,5	87,9
Segmentumsatz	96,7	88,3
Segmentergebnis EBIT	10,7	3,2
Nettovermögen	50,3	44,3

### Substrat Bonder

Das Segment Substrat Bonder umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Substrat (Wafer) Bonder. Die Fertigung ist an unserem größten Standort in Sternenfels angesiedelt. Zu den adressierten Märkten der Substrat Bonder zählen die Mikrosystemtechnik, die Verbindungshalbleiter sowie die 3D-Integration.

Das Segment Substrat Bonder entwickelte sich sowohl im Auftragseingang mit 17,2 Mio. € (Vorjahr: 24,3 Mio. €) als auch im Umsatz mit 22,4 Mio. € (Vorjahr: 22,9 Mio. €) verhalten.

Das Rohergebnis des Segments Substrat Bonder war im abgelaufenen Geschäftsjahr positiv. Die Bruttomarge verbesserte sich deutlich von minus 53,5 % auf 13,9 %. Im Vorjahr war die Bruttomarge belastet mit Sonderaufwendungen von 10,5 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Refokussierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs angefallen sind. Auch ohne diese Sonderaufwendungen wäre die Bruttomarge des Vorjahres negativ gewesen. Die 2014 erzielten Margen im Bereich Temporary Bonding und (De)bonding sowie das verbleibende Geschäft mit permanenten Bond-Systemen haben sich somit deutlich verbessert, sind jedoch aufgrund der insgesamt niedrigen Stückzahlen weiterhin unterdurchschnittlich.

Im Segment Substrat Bonder ergibt sich ein Segmentergebnis (EBIT) von minus 2,4 Mio. € nach minus 21,7 Mio. € im Vorjahr. Das Ergebnis des Vorjahres war belastet mit Sonderaufwendungen in Höhe von 13,2 Mio. €, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produktion von Permanent-Bond-Cluster-Systemen angefallen sind.

#### Kennzahlen Substrat Bonder

in Mio. €	2014	2013
Auftragseingang	17,2	24,3
Segmentumsatz	22,4	22,9
Segmentergebnis EBIT	-2,4	-21,7
Nettovermögen	7,8	8,3

### Fotomasken Equipment

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von Maschinen, die auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisiert sind und ist am Standort Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Zu den adressierten Märkten des Segments Fotomasken Equipment zählt die Halbleiterindustrie, hier ist SÜSS MicroTec im Frontend tätig.

Das Segment Fotomasken Equipment entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr im Auftragseingang besser als im Vorjahr. Der Auftragseingang lag Ende Dezember 2014 bei 20,2 Mio. € (Vorjahr: 17,5 Mio. €). Der Segmentumsatz belief sich auf 20,8 Mio. € nach 18,4 Mio. € im Jahr 2013.

Erfreulich hat sich die Rohertragsmarge des Segments Fotomasken Equipment entwickelt. Aufgrund einiger margenstarker Aufträge lag die Rohertragsmarge deutlich über der im Vorjahr erzielten Marge. Die Bruttomarge lag nach 33,3 % im Vorjahr bei 40,3 %.

Das Segment Fotomasken Equipment trug mit einem Segmentergebnis von 4,7 Mio. € (Vorjahr: 1,6 Mio. €) zum Konzern-EBIT bei. Die Umsatzrendite lag bei 22,7 % und hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr (Umsatzrendite 2013: 8,4 %) deutlich erhöht. Grund für die erhöhte Umsatzrendite sind im Wesentlichen einige margenstarke Aufträge, die 2014 realisiert werden konnten.

#### Kennzahlen Fotomasken Equipment

in Mio. €	2014	2013
Auftragseingang	20,2	17,5
Segmentumsatz	20,8	18,4
Segmentergebnis EBIT	4,7	1,6
Nettovermögen	3,7	3,6

### Sonstige

Das Segment Sonstige umfasst die Mikrooptik-Aktivitäten am Standort Hauterive, Schweiz, und das Geschäftsfeld C4NP sowie die größtenteils auf Segmentebene nicht zurechenbaren Kosten der zentralen Konzernfunktionen. Der Anteil an dem Mikrooptik-Geschäft wurde im ersten Halbjahr 2012 von 85 % auf 100 % aufgestockt. Damit soll das Unternehmen SÜSS MicroOptics (SMO), welches wichtige Schlüsseltechnologien beherrscht, noch enger an SÜSS MicroTec gebunden werden.

Der Auftragseingang steigerte sich leicht von 5,3 Mio. € im Geschäftsjahr 2013 auf 5,4 Mio. € im Jahr 2014. Der Segmentumsatz belief sich auf 5,4 Mio. € nach 4,9 Mio. € im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Größten Anteil am Umsatz und Auftragseingang hatte dabei – wie auch im Vorjahr – das Geschäftsfeld Mikrooptik, das einen stabilen Auftragseingang von 5,1 Mio. € (Vorjahr: 5,2 Mio. €) sowie im Umsatz einen Anstieg von 4,6 Mio. € auf 5,1 Mio. € erzielt hat.

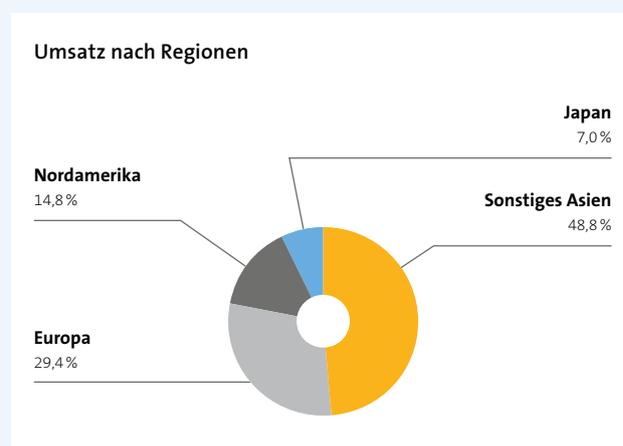
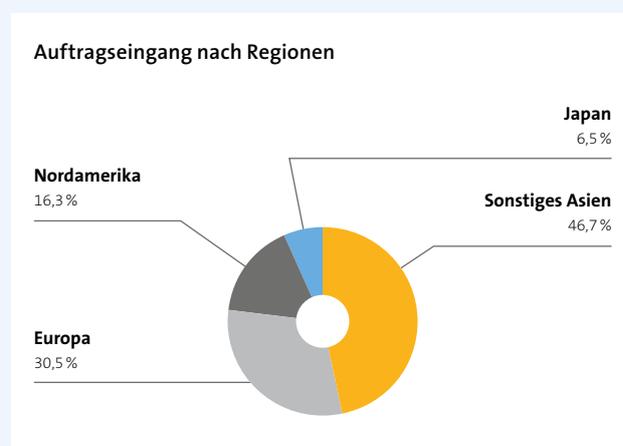
Kennzahlen Sonstige		
in Mio. €	2014	2013
Auftragseingang	5,4	5,3
Segmentumsatz	5,4	4,9
Segmentergebnis EBIT	-4,5	-2,4
Nettovermögen	19,3	18,5

### ENTWICKLUNG IN DEN WICHTIGSTEN REGIONEN

Europa, Nordamerika und Asien sind die für das Geschäft von SÜSS MicroTec wichtigen Weltregionen. Dabei unterteilen wir Asien jedoch in Japan und „Sonstiges Asien“, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass unsere Kunden im Markt Advanced Packaging vornehmlich außerhalb Japans – insbesondere in Taiwan – ansässig sind. Dieser Markt ist allerdings auch schwankungsanfälliger als jener für Verbindungshalbleiter und MEMS.

In den Regionen Nordamerika und Japan konnten im vergangenen Geschäftsjahr deutliche Zuwächse im Auftragseingang erwirtschaftet werden. Nordamerika steigerte seinen Auftragseingang von 18,9 Mio. € im Jahr 2013 auf 21,9 Mio. € im Geschäftsjahr 2014. Dies entspricht einem Zuwachs um 15,9%. Japan legte im Vergleich zum Vorjahr sogar um 31,8% zu und steigerte damit seinen Auftragseingang auf 8,7 Mio. €. In der wichtigsten Region sonstiges Asien (ohne Japan) verzeichnete die SÜSS MicroTec-Gruppe ein Auftragsminus in Höhe von 7,2% auf 62,7 Mio. € (Vorjahr: 67,6 Mio. €). Europa hat sich gegenüber Vorjahr kaum verändert und erreichte einen Auftragseingang von 41,0 Mio. €, ein leichtes Minus gegenüber Vorjahr von 2,1%.

Alle Regionen, mit Ausnahme der Region Nordamerika, konnten im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs im Umsatz beisteuern. In Europa erhöhte sich der Umsatz um 3,6% auf 42,7 Mio. € nach 41,2 Mio. € im Vorjahr. Die Region Nordamerika verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang um 4,9% auf 21,5 Mio. € (Vorjahr: 22,6 Mio. €). Japan dagegen erwirtschaftete mit 10,2 Mio. € einen deutlich höheren Wert als im Vorjahr (5,2 Mio. €). Die Region „sonstiges Asien“ verzeichnete einen Umsatzanstieg um 8,4% auf 70,9 Mio. € (Vorjahr: 65,5 Mio. €).

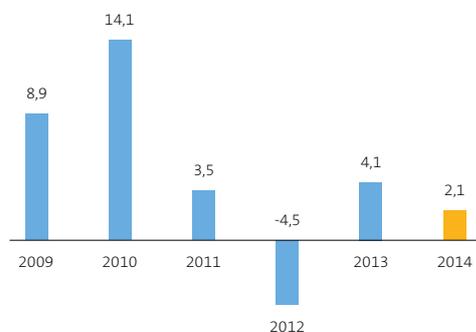


## FINANZ- UND VERMÖGENSLAGE

### Eine stabile Finanz- und Vermögenslage zeichnet SÜSS MicroTec aus

Die Net Cash-Position des Konzerns – der Saldo aus flüssigen Mitteln sowie verzinslichen Wertpapieren und Finanzverbindlichkeiten – erhöhte sich von 35,7 Mio. € im Vorjahr auf 38,0 Mio. € zum 31. Dezember 2014. Der Bestand an liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren erhöhte sich von 47,1 Mio. € im Vorjahr auf 48,3 Mio. € zum Ende des Berichtsjahres.

Free Cashflow<sup>1</sup> in Mio. €



<sup>1</sup> vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen

Nettoliiquidität in Mio. €



Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich auf 5,1 Mio. € (Vorjahr: 16,3 Mio. €). Hier machte sich neben dem positiven Jahresergebnis vor allem der deutliche Rückgang der Vorräte bemerkbar. Aus dem gesunkenen Bestand an Vorräten resultierten Mittelzuflüsse von 14,0 Mio. €. Größten Anteil an dieser Entwicklung hatte der gesunkene Bestand an Maschinen, die bereits an Kunden geliefert waren, deren Endabnahme (und damit Umsatzlegung) jedoch noch ausstand. Dieser Bestand belief sich zum 31. Dezember 2014 lediglich auf 6,8 Mio. €, während zum

31. Dezember des Vorjahres noch ein Bestand von 22,6 Mio. € ausgewiesen wurde. Gegenläufig und damit liquiditätsmindernd wirkten der geringere Bestand an erhaltenen Anzahlungen (Rückgang um 13,1 Mio. €) sowie die stichtagsbedingt niedrigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Rückgang um 2,2 Mio. €) und übrigen Verbindlichkeiten.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit betrug ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere minus 3,0 Mio. €. Die Investitionen in Sachanlagen betrafen teilweise weitere Einbauten in die gemieteten Räume der SÜSS MicroOptics (Hauterive, Schweiz), für die Mittelabflüsse von rund 0,4 Mio. € zu verzeichnen waren. Darüber hinaus wurden vor allem Neuanschaffungen in technische Anlagen und Maschinen sowie in Betriebs- und Geschäftsausstattung der deutschen Gesellschaften getätigt. Die Investitionen in immaterielle Vermögenswerte betrafen vorwiegend Erweiterungen des konzernweiten SAP-Systems sowie die Einführung eines neuen Customer Relationship Management Systems. Im Vorjahr betrug der Cashflow aus Investitionstätigkeit ohne Berücksichtigung der Investitionen in Wertpapiere und minus 12,2 Mio. €. Größten Anteil daran hatte der Erwerb der Immobilie Garching, in der die SÜSS MicroTec AG und die SÜSS MicroTec Lithography ihren Sitz haben. Der Kaufpreis für das Grundstück, die Gebäude und die für den Kauf angefallenen Nebenkosten beliefen sich auf 8,9 Mio. €.

Der freie Cashflow belief sich damit – vor Berücksichtigung von Wertpapiererwerben und -verkäufen – auf 2,1 Mio. €. Im Vorjahr wurde ein freier Cashflow (bereinigt um die Effekte aus Wertpapiererwerben und -verkäufen) von 4,1 Mio. € erzielt.

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf minus 1,2 Mio. € und resultiert aus den geleisteten Tilgungen für die beiden Bankdarlehen der SÜSS MicroTec AG, die der Finanzierung der beiden Betriebsgrundstücke Garching und Sternenfels dienen. Im Vorjahr belief sich der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit auf 7,2 Mio. €. Der Betrag des Vorjahres beinhaltet einen Zufluss von 7,5 Mio. € aus der Aufnahme eines Bankdarlehens, mit dem der Erwerb der Immobilie Garching gegenfinanziert wurde. Darüber hinaus zeigte sich im Cashflow aus Finanzierungstätigkeit des Vorjahres die planmäßige Tilgung des Immobiliendarlehens Sternenfels, die sich auf 0,2 Mio. € belief.

Neben liquiden Mitteln und verzinslichen Wertpapieren in Höhe von 48,3 Mio. € (Vorjahr: 47,1 Mio. €) verfügt der Konzern zum Ende des Berichtsjahres über inländische Aval- und Kreditlinien von 8,0 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €). Die Linie wurde im Berichtsjahr ausschließlich in Form von Avalen in Anspruch genommen. Der wesentliche Teil davon entfällt auf Anzahlungsbürgschaften. Zum Bilanzstichtag betrug die Inanspruchnahme 3,5 Mio. €.

Bis zum 15. Dezember 2014 stellte ein Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB und unter Beteiligung der Deutsche Bank AG sowie der DZ Bank AG eine Kredit- und Avallinie in Höhe von insgesamt 4,5 Mio. €. Der Kreditvertrag mit der BayernLB wurde von SÜSS MicroTec zum 15. Dezember 2014 gekündigt. Seit dem 16. Dezember 2014 wird die Kredit- und Avallinie von einem neu zusammengesetzten Bankenkonsortium fortgeführt. Als Konsortialführer fungiert nun die Deutsche Bank AG, des Weiteren sind die DZ Bank AG sowie die Baden-Württembergische Bank am Konsortium beteiligt. Die Kredit- und Avallinien des veränderten Bankenkonsortiums betragen weiterhin 4,5 Mio. €. Diese Linien können von der SÜSS MicroTec AG oder der SÜSS MicroTec Lithography GmbH in Anspruch genommen werden. Sie wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt.

Zwischen der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG und der Baden-Württembergischen Bank Mannheim besteht ein Rahmenkreditvertrag, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherungsgesellschaft besteht im Zusammenhang mit einem Kautionsversicherungsvertrag ein Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €. Der Kautionsversicherungsvertrag läuft bis auf weiteres. Zur Sicherung dieser Linie wurde ein Festgeldkonto in Höhe von 0,3 Mio. € an die Versicherungsgesellschaft abgetreten.

Der Konzern verfügt insgesamt über genügend finanziellen Spielraum, notwendige Produktentwicklungen oder andere strategische Aktivitäten zu finanzieren.

Neben dem Geschäfts- oder Firmenwert bestimmen im Wesentlichen die durch Unternehmensakquisition erworbene Technologie der SÜSS MicroTec Photonic Systems sowie die Betriebsgrundstücke in Garching und in Sternenfels die langfristigen Vermögenswerte.

Der Geschäfts- oder Firmenwert beträgt 15,5 Mio. € (Vorjahr: 15,3 Mio. €). Ein Teil des Goodwills (2,4 Mio. USD) wird in US-Dollar geführt und unterliegt daher Währungsschwankungen. Der gesamte Geschäfts- oder Firmenwert ist dem Segment Lithografie zugeordnet.

Die aktivierten Entwicklungskosten weisen zum 31. Dezember 2014 einen Buchwert von 0,4 Mio. € auf, der komplett dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Im Vorjahr betragen die aktivierten Entwicklungskosten zum Bilanzstichtag noch 0,8 Mio. €. Sie spielen für die Vermögenslage des Konzerns nur noch eine untergeordnete Rolle.

Darüber hinaus enthalten die langfristigen Vermögenswerte Lizenzen und Patente sowie das bei der SÜSS MicroTec AG aktivierte SAP-System in Höhe von 2,7 Mio. € (Vorjahr: 2,3 Mio. €). Der Restbuchwert von 2,7 Mio. € entfällt in Höhe von 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) auf die Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomaschinen Equipment sowie in Höhe von 1,2 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) auf das Segment Sonstige. Unter den immateriellen Vermögenswerten ist außerdem die im Rahmen der Photonic Systems-Akquisition erworbene Technologie ausgewiesen, die zum Stichtag einen Restbuchwert von 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) aufwies. Die Technologie dotiert in US-Dollar und wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben. Aufgrund der Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro hat sich der Buchwert im Konzern nicht reduziert.

Größten Anteil am konzernweiten Sachanlagevermögen haben die beiden Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, die zum Jahresende einen Restbuchwert von 13,7 Mio. € (Vorjahr: 13,8 Mio. €) aufwiesen. Dort sind die SÜSS MicroTec Lithography GmbH, die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG sowie die SÜSS MicroTec AG ansässig. Das Grundstück in Sternenfels gehört bereits seit 2010 zum Konzernvermögen, während das Grundstück in Garching 2013 für insgesamt 8,9 Mio. € erworben wurde.

Das übrige Sachanlagevermögen ist von geringerer Bedeutung für die Vermögenslage des Konzerns, da die Gruppe auf kostenintensive Produktionsanlagen in der Regel nicht angewiesen ist. Die Investitionen beliefen sich (ohne Grund und Boden bzw. Gebäude) im Berichtsjahr auf 1,3 Mio. € im Vergleich zu 2,4 Mio. € im Vorjahr.

Insgesamt ist das Sachanlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 0,7 Mio. € gesunken.

Die latenten Steueransprüche betragen zum Stichtag 3,9 Mio. € nach 5,7 Mio. € im Vorjahr. Sie reduzierten sich im Wesentlichen durch die Nutzung von aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge. Die ertragsteuerliche Organschaft in Deutschland (mit der SÜSS MicroTec AG als Organträger und den Organgesellschaften SÜSS MicroTec Lithography GmbH und SÜSS MicroTec REMAN GmbH) hat 2014 ein deutlich positives Ergebnis erzielt und nutzt damit einen Teil der im Vorjahr entstandenen

Verlustvorträge. Es ist davon auszugehen, dass die deutschen Gesellschaften die 2013 aufgelaufenen Verluste in den kommenden Jahren vollständig nutzen werden. Für die Verlustvorträge der US-Gesellschaften wurden hingegen – unter Berücksichtigung der aktuellen Konzernplanung – keine aktiven latenten Steuern auf Verlustvorträge angesetzt.

Die kurzfristigen Vermögenswerte sind im Berichtsjahr um 9,7 Mio. € auf nun 123,2 Mio. € zurückgegangen. Dieser Rückgang resultierte im Wesentlichen aus einem deutlich geringeren Bestand an Vorratsvermögen. Der Bestand an Wertpapieren ist ebenfalls zurückgegangen. Im Gegenzug sind jedoch die flüssigen Mittel und die Kundenforderungen zum Bilanzstichtag angestiegen.

Die Vorräte verringerten sich von 71,1 Mio. € zum Vorjahresstichtag auf 58,9 Mio. € zum Jahresende. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf den deutlich geringeren Bestand an Maschinen zurückzuführen, die bereits an Kunden ausgeliefert wurden, deren Endabnahme jedoch noch aussteht. So betrug dieser Bestand zum 31. Dezember 2014 lediglich 6,8 Mio. €, während zum Bilanzstichtag des Vorjahres ein Bestand von 22,6 Mio. € ausgewiesen wurde. Die übrigen Fertigerzeugnisse sind um rund 0,6 Mio. € angestiegen. Der Bestand an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen hat sich von 25,2 Mio. € im Vorjahr auf nun 22,1 Mio. € reduziert. Die unfertigen Erzeugnisse sind hingegen von 23,3 Mio. € im Vorjahr auf 26,1 Mio. € angestiegen. Der Bestand an Demonstrationsgeräten sank von 21,5 Mio. € im Vorjahr auf 20,5 Mio. €.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr von 11,1 Mio. € auf 13,4 Mio. €. Der Rückgang ist im Wesentlichen stichtagsbedingt.

Der Bestand an Wertpapieren des SÜSS MicroTec-Konzerns reduzierte sich 2014 leicht von 2,1 Mio. € auf 1,0 Mio. €. Bei den bilanzierten Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen. Der Bestand an liquiden Mitteln erhöhte sich im Gegenzug von 45,1 Mio. € auf 47,3 Mio. €.

Der Rückgang der sonstigen Vermögenswerte von 2,5 Mio. € im Vorjahr auf 1,7 Mio. € zum Jahresende ist im Wesentlichen auf einen geringeren Stand an geleisteten Anzahlungen zurückzuführen, die sich stichtagsbedingt ergeben haben.

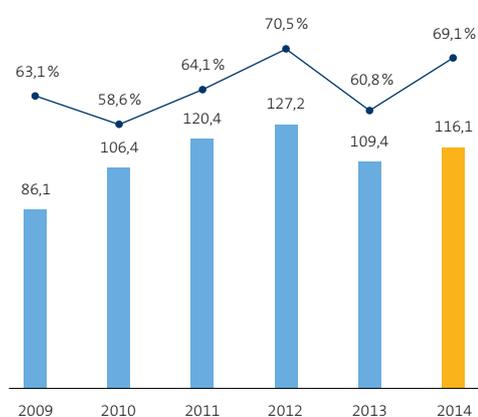
Die langfristigen Schulden reduzierten sich von 14,6 Mio. € auf 13,9 Mio. €. Größten Anteil an den langfristigen Schulden haben die Finanzverbindlichkeiten, die sich im Geschäftsjahr auf 9,1 Mio. € (Vorjahr: 10,3 Mio. €) beliefen. Neben dem langfristigen Teil des Darlehens Sternenfels wird hier auch der langfristige Teil des Darlehens ausgewiesen, das der Grundstücksfinanzierung Garching dient. Unter den sonstigen finanziellen

Verbindlichkeiten des Vorjahres waren außerdem der langfristige Teil der Earn-Out-Verpflichtung in Höhe von 0,2 Mio. € für die Akquisition der SÜSS MicroTec Photonic Systems sowie der langfristige Teil der noch ausstehenden Kaufpreisverpflichtung für den Erwerb der Minderheitenanteile an der SÜSS MicroOptics in Höhe von 0,1 Mio. € ausgewiesen. Die Earn-Out-Verpflichtung für die Akquisition der SÜSS MicroTec Photonic Systems wurde im Jahr 2014 komplett ertragswirksam aufgelöst. Die noch ausstehende Kaufpreisverpflichtung für den Erwerb der Minderheitenanteile an der SÜSS MicroOptics in Höhe von 0,1 Mio. € weist nun eine Laufzeit von bis zu einem Jahr auf und wird daher unter den kurzfristigen Schulden ausgewiesen.

Bei den kurzfristigen Schulden war ein deutlicher Rückgang von 55,8 Mio. € im Vorjahr auf 38,0 Mio. € zum Bilanzstichtag zu verzeichnen. Größten Anteil an diesem Rückgang hatte der Stand der erhaltenen Kundenanzahlungen, die sich zum Jahresende auf 18,0 Mio. € (Vorjahr: 30,8 Mio. €) beliefen. Der Rückgang ist im Wesentlichen stichtagsbedingt. Darüber hinaus sind auch die sonstigen Rückstellungen von 5,9 Mio. € im Vorjahr auf 3,2 Mio. € zum Jahresende zurückgegangen. In den Rückstellungen des Vorjahres waren 2,0 Mio. € Rückstellungen für Verpflichtungen enthalten, die im Zusammenhang mit der Refokussierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs standen und die im Jahr 2014 verbraucht wurden. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben sich stichtagsbedingt um 2,1 Mio. € auf 3,4 Mio. € verringert.

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns hat sich seit dem 31. Dezember 2013 um 6,6 Mio. € auf 116,1 Mio. € erhöht. Die Eigenkapitalquote stieg im Jahresvergleich von 60,8% auf 69,1%.

**Eigenkapital in Mio. € und Eigenkapitalquote**



## INVESTITIONEN

### Gezielte Investitionen stärken das Unternehmen

Die SÜSS MicroTec AG ist Eigentümerin der Betriebsgrundstücke in Garching und Sternenfels, an denen der Firmensitz sowie die Betriebe der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG ihren Sitz haben. Die SÜSS MicroTec AG investiert laufend in die Betriebsgebäude an den beiden Standorten, um die Lagerräume sowie die Produktions- und Verwaltungsräume auf dem neuesten technischen Stand zu halten.

Bedingt durch die Struktur des Unternehmens sind Investitionen in technische Anlagen und Maschinen keine wesentliche Komponente in der Unternehmensentwicklung. Die wesentliche Wertschöpfung entsteht durch Design, Montage und Justage der Komponenten sowie der entsprechenden Softwaresteuerung. Für diese Tätigkeiten sind keine besonderen Anlagen und Maschinen erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass sich die Investitionen in Sachanlagen langfristig in einem Bereich von ca. 1 bis 2% des Umsatzes bewegen werden. Eine Ausnahme stellt nur die in dem Segment Sonstige enthaltene Produktlinie Mikrooptik dar. In dieser Produktlinie wird Kleinserienfertigung betrieben, für die entsprechende Fertigungsmaschinen notwendig sind.

Für Entwicklungsleistungen, die nach IFRS die Voraussetzungen zur Aktivierung erfüllen, werden immaterielle Vermögenswerte erfasst. Ein Teil der Investitionen ist daher dem Bereich immaterielle Vermögenswerte zuzuordnen.

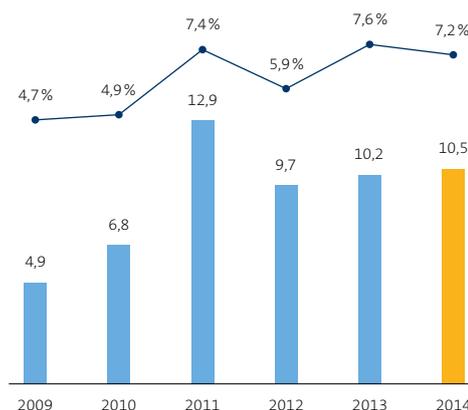
Die SÜSS MicroTec AG ist Eigentümerin des konzernweiten SAP-Systems, das sowohl von den deutschen Gesellschaften als auch von der SÜSS MicroTec, Inc. (Sunnyvale / USA) und von der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd. (Hsinchu / Taiwan) genutzt wird. 2014 wurden umfangreiche Erweiterungen an dem System vorgenommen. Zum einen wurde in Deutschland ein Modul für Personalwirtschaft (Employee Self Service sowie Manager Self Service) eingeführt. Zum anderen ist geplant, bei SÜSS MicroTec Photonic Systems (Corona / USA) im Jahr 2015 SAP einzuführen. Hierfür wurden bereits 2014 umfangreiche Arbeiten getätigt und als Eigenleistungen aktiviert.

## FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

### Forschung und Entwicklung – Eine Investition in die Zukunft

Die Forschungs- und Entwicklungsausgaben erhöhten sich von 10,2 Mio. € im Vorjahr auf 10,5 Mio. €, was 2014 in Relation zum Umsatz einer Aufwandsquote von 7,2% (Vorjahr: 7,6%) entspricht. Sie betrafen mit 6,9 Mio. € (Vorjahr: 5,5 Mio. €) das Segment Lithografie und mit 1,5 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €) das Segment Substrat Bonder. 1,6 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €) waren dem Segment Fotomasken Equipment zuzuordnen. 0,5 Mio. € (Vorjahr: 0,3 Mio. €) entfielen auf das Segment Sonstige.

Forschungs- und Entwicklungskosten in Mio. €  
Aufwandsquote in Relation zum Umsatz



Ende 2014 waren 128 Mitarbeiter – und damit fast jeder fünfte Mitarbeiter von SÜSS MicroTec – im Bereich Forschung und Entwicklung tätig (Vorjahr: 127 Mitarbeiter).

Das größte Segment, die Lithografie, vereint die Produktlinien Exposure (Mask Aligner, UV-Projektionsgeräte), Laser Processing und die Coater / Developer. Der Fokus der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich der Belackungs- und Entwicklungssysteme lag im vergangenen Geschäftsjahr auf einer weiteren Erhöhung der Prozesssicherheit und der Reduzierung laufender Betriebskosten der Anlagen. Daneben lag das Augenmerk insbesondere auf Verbesserungen bestehender als auch der Entwicklung neuer Fertigungstechnologien.

Die Produktlinie Mask Aligner hat im abgelaufenen Geschäftsjahr eine neue Maschinengenerationen des Vollautomaten MA200 Gen3 auf den Markt gebracht und hat darüber hinaus mit der halbautomatischen MA12 ein neues Gerät in den Markt eingeführt.

Die MA200 Gen3 weist gegenüber dem Vorgängermodell Verbesserungen beim Durchsatz sowie innovative neue Funktionen auf. Die Beladestation kann kontinuierlich bestückt werden, ohne dass die Maschine während des Ladevorgangs angehalten werden muss. Zudem wurden in der MA200 Gen3 automatische Korrekturroutinen eingeführt, welche auch bei beschädigten Justiermarken einen stabilen Belichtungsprozess ohne den Eingriff eines Operators ermöglichen. Die neue aktive Überwachung des Belichtungsabstands erlaubt darüber hinaus eine automatische Justage dieses Schlüsselparameters. Die vielen Neuerungen an der dritten Maschinengeneration führen insgesamt zu einer deutlich verbesserten Cost-of-Ownership und einer Reduzierung der Ausschussrate.

Auf der manuellen beziehungsweise halb-automatischen Seite wurde mit der MA12 ein neuartiges Gerät zum Einsatz in der industriellen Forschung und Produktion für 300-mm-Wafer sowie für 300 x 300-mm-Substrate entwickelt. Im Hinblick auf Genauigkeit, optische Leistungsfähigkeit und Flexibilität setzt die MA12 die neueste Mask Aligner-Technologie ein. Das anwenderunterstützte Gerät bietet höchste Prozessgenauigkeit und eine Justagepräzision im Submikrometerbereich. Damit rundet die MA12 das Produktportfolio von 300-mm-Geräten ab. Mit dem neuen Mask Aligner können empfindliche Substrate oder auch gewölbte Wafer zuverlässig verarbeitet werden.

An Verbesserungen im Bereich Wafer-Handling für Mask Aligner wird permanent gearbeitet, um auch zukünftig den anspruchsvollen Anforderungen moderner Belichtungsprozesse auf schwierigen Substraten gerecht zu werden. Somit können nun auch Taiko-Wafer und fragile Wafer für MEMS-Anwendungen durch patentgeschützte neue Lösungen zuverlässig belichtet werden.

Weitere Entwicklungshighlights des abgelaufenen Geschäftsjahres sind die Ermöglichung von Grauton-Lithografie-Prozessen auf der MA/BA8 Gen3, superebene Chucks und eine integrierte LED-Chuck Beleuchtung.

Coater / Developer – ein wesentlicher Bestandteil sowohl der Coater als auch der Developer sind die Dispensvorrichtungen für die verschiedenen Prozesschemikalien. Mit dem Ziel einer signifikanten Reduzierung der Prozesskosten wurde ein System entwickelt, welches die Dispensierung von nahezu 100% der eingesetzten Prozessmedien aus den eingesetzten Gebinden erlaubt.

Bisher verblieb ein nicht unerheblicher Anteil der häufig kostenintensiven Chemikalien in den Versorgungsbehältern zurück und musste entsorgt werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag in der Optimierung der sowohl in den 200-mm-, als auch 300-mm-Anlagen eingesetzten Hotplates. Diese Module werden insbesondere zum Ausbacken der Substrate nach erfolgter Beschichtung verwendet und sind oft mehrfach in einem Produktionssystem vorhanden. Die Optimierungen zielten vor allem auf eine verbesserte Luftdurchströmung in den Modulen, wodurch eine Kondensation der aus den Beschichtungen herausgelösten Lösungsmitteln verhindert wird. Die Arbeiten basierten auf im Haus SÜSS MicroTec durchgeführten Simulationsarbeiten und ermöglichen Hotplatemodule, welche sowohl eine kleinere Bauform, als auch ein verlängertes Wartungsintervall und einen reduzierten Wartungsaufwand erfordern.

Durch intensive Softwareentwicklung konnte ein deutlicher Versionssprung im Bereich des eingesetzten Betriebssystems im Kern der Anlagen ermöglicht werden. Dies sichert vor allem die zukünftige Verwendung jeweils aktuell verfügbarer PC-Hardware. Ferner wird durch die erhöhte Bedienerfreundlichkeit eine zeitoptimierte Inbetriebnahme der Anlagen und eine effiziente Entwicklung kundenspezifischer Softwarelösungen ermöglicht. Für die erarbeiteten technischen Lösungen wurden in mehreren Fällen Schutzrechte beantragt.

Die Forschungs- und Entwicklungsarbeit in unserer 2012 erworbenen Tochtergesellschaft SÜSS MicroTec Photonic Systems hat sich im letzten Jahr wesentlich auf die Weiterentwicklung der UV-Projektionsscanner sowie die Lösungen für Lasertechnologie im Hinblick auf Anwendungsmöglichkeiten im Advanced Packaging fokussiert. Dank dieser Bestrebungen konnten 2014 insgesamt zwei neue Produkte auf den Markt gebracht werden.

Der Projektionsscanner DSC300 Gen2 konnte bereits im März 2014 in den Markt eingeführt werden. Die einzigartige Projektionsscantechnologie von SÜSS MicroTec Photonic Systems bildet die Grundlage dieser neuen Plattform für Wafergrößen bis zu 300-mm. Das Gerät kombiniert die Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie. Ausgestattet mit einer Vollfeldmaske und einer Breitbandprojektionsoptik belichtet der Scanner den Wafer in einem kontinuierlichen Belichtungsschritt (scan). Auf Basis unserer erfolgreichen Mask Aligner-Technologie konnten vorhandene Lösungen und Konzepte für das Handling stark gewölbter oder verbogener Substrate übertragen werden. Zudem enthält die neue Generation von Projektionsscannern Verbesserungen und Neuerungen im Hinblick auf Overlay, Auflösung, Automatisierung und vor allem Durchsatzsteigerungen.

Mit der zweiten Generation der ELP300 Plattform ELP300 Gen2 wurde ein verbesserter Excimer Laser Ablation Stepper in den Markt eingeführt. Der Fokus der Entwicklungsarbeit lag vor allem darauf, die Overlay-Leistungsfähigkeit des Systems auf unter 1 µm zu verbessern. Die neue Maschinengeneration konnte darüber hinaus mit einer Infrarot-Justierung erweitert werden, um modernste Anwendungen und Prozesse zu unterstützen. Zudem wurden auch in dieser Produktplattform vorhandene Lösungen und Konzepte zum Warped Wafer Handling übertragen.

Zusätzlich hat SUSS MicroTec am Standort Corona den Fokus sehr stark auf die Entwicklung von kosteneffizienten Reinigungsverfahren für die Laser-Ablationstechnologie gelegt. Erste Erfolge wurden bereits erzielt und können nun zusammen mit dem Laser Gerät vermarktet werden.

Im Geschäftsjahr 2014 konnten zudem zwei Joint Development Projects zur Entwicklung und Prozessqualifizierung der Laser-Ablationstechnologie mit einem führenden Industriepartner und einem etablierten Forschungsinstitut durchgeführt werden.

Das Segment Substrat Bonder untergliedert sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden. Im Bereich temporäres Bonden konnten im Geschäftsjahr 2014 wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Volumenproduktion erreicht werden. So konnten beispielsweise Produktions-Bond-Cluster, welche in den Jahren 2012 und 2013 an einen asiatischen Auftragsfertiger geliefert wurden, für die Serienproduktion von innovativen 3D-MEMS-Lösungen auf 200-mm-Wafern qualifiziert werden. Darüber hinaus wurde ein Produktions-Bond-Cluster für temporäre Bondprozesse vollständig für die Serienfertigung von auf TSV-basierten 3D-Speicherchips qualifiziert. Die Fertigung dieser neuartigen Speicherchips erfolgt auf 300-mm-Wafern. Der Kunde, ein asiatischer Speicherhersteller, hat im zweiten Halbjahr 2014 die Serienfertigung aufgenommen. In der Qualifikationsphase wurden weiter kontinuierliche Verbesserungen auf Hard- und Softwareseite angestoßen, welche produktionsbegleitend weitergeführt werden, um den erarbeiteten Wettbewerbsvorsprung weiter auszubauen. Zudem konnten im Geschäftsjahr 2014 unsere innovativen Reinigungsmodule zur Reinigung von ultradünnen Wafern auf Tape Frame, welche Bestandteil der Produktlinie temporäre Bonder sind, von einem weiteren Speicherhersteller erfolgreich qualifiziert werden.

Produktseitig haben wir im Geschäftsjahr 2014 mit der ELD300 einen neu entwickelten Excimer Laser Debonder für die 3D-Integration in den Markt eingeführt. Dieser Laser Debonder kann entweder als eigenständiges, semi-automatisches Gerät eingesetzt werden oder als Modul in die vollautomatisierte XBC300 Gen2-Plattform von SÜSS MicroTec integriert werden. Bei dem Excimer Laser gestützten Debond-Verfahren wird die Klebeverbindung

zwischen dem Glasträger und dem auf Folie gehaltenen gedünnten Wafer unter Einwirkung eines 308-nm-Excimer Lasers gelöst. Die Vorteile des Excimer Laser gestützten Debondens mit dem ELD300 liegen in den sehr kurzen Prozesszeiten und damit verbundenen hohen Durchsätzen, der Selektivität des Verfahrens, der für den dünnen Wafer sehr schonenden Prozessführung und dem hohen Automatisierungsgrad, der für Volumen Anwendungen unerlässlich ist.

Darüber hinaus haben wir im Geschäftsjahr 2014 eine Metrologie-Station zur vollautomatischen Vermessung der Kleberdickenverteilung bei gebondeten Wafern entwickelt, welche uns jetzt als weiteres Modul für die temporären Produktions-Bond-Cluster zur Verfügung steht. Ein gemeinsames Entwicklungsprogramm mit einem führenden europäischen Forschungsinstitut, in dessen Rahmen temporäre und permanente Bondprozesse entwickelt, qualifiziert und optimiert werden, wurde bis Ende 2015 verlängert.

Im Bereich permanentes Bonden wurde im Geschäftsjahr 2014 ein neuer halbautomatischer Wafer Bonder entwickelt und in den Markt eingeführt. Das halbautomatische System SB6/8 Gen2 kann Wafergrößen bis 200-mm sowie verschiedene Substratgrößen und -typen bearbeiten. Das Gerät kann für manuelle Prozesse im Forschungs- und Entwicklungsbereich eingesetzt werden, ermöglicht jedoch gleichzeitig problemlos den Einsatz in Volumen Anwendungen. Mit seinem breit angelegten Kraftbereich unterstützt die SB6/8 Gen2 sowohl das adhesive Bonden sowie das Thermokompressions- und das eutektische Bonden. In der Bondkammer können verschiedene Rahmenbedingungen, wie beispielsweise Vakuum oder Überdruck, erzeugt werden. Die umfangreiche Gerätekonfiguration erlaubt eine flexible Anpassung an verschiedene Anforderungen in der Halbleiterindustrie. Hauptanwendungsgebiete der SB6/8 Gen2 sind MEMS- und LED-Anwendungen sowie die 3D-Integration. Diese zweite Maschinengeneration bietet ein verbessertes Heiz- und Kraftregelsystem sowie verbesserte Kühlraten. Diese neuen Eigenschaften ermöglichen eine noch genauere Kontrolle der Bondprozesse.

Im Segment Fotomasken Equipment besteht durch die Verzögerung der Einführung von EUVL (Extreme Ultraviolet Lithography) für die Großserienproduktion in der Halbleiterindustrie nach wie vor die Notwendigkeit, die 193i-Immersion-Lithographie im Mehrfachbelichtungsverfahren auszubauen und infolgedessen auch die damit unmittelbar verknüpften Verfahrenstechniken wie die Fotomaskenreinigung anzupassen und zu erweitern.

Die bei zunehmender Integrationsdichte immer kleiner werdenden Strukturen erfordern eine äußerst präzise Abstimmung und Weiterentwicklung von chemischen und physikalischen

Reinigungsmethoden. Im Zuge dessen lag ein Fokus auf der Untersuchung von neuen bzw. erweiterten ultraschallbasierten Verfahren, die bei SÜSS MicroTec bereits seit Jahren zum Einsatz kommen. So wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Kombination aus Kleinsttröpfchen-Sprühverfahren und Ultraschallanregung erfolgreich getestet. Darüber hinaus wurde die Verwendbarkeit einer speziellen Ultraschalldüse getestet, um damit den Wirkungsgrad bei der Entfernung kleinster Partikel zu erhöhen.

Nicht nur Partikelgröße und Wirkungsgrad werden immer kritischer, sondern auch der Erhalt der optischen Eigenschaften, insbesondere bei EUVL-Fotomasken, ist besonders wichtig. Aufgrund der Tatsache, dass diese Fotomasken kein Pellicle (Schutzhülle) besitzen, sind die aktiven Substratoberflächen unmittelbar den Umgebungsbedingungen ausgesetzt und müssen infolgedessen häufiger gereinigt werden als optische 193i-Fotomasken. Konventionelle nasschemische Verfahren wie der Einsatz von SC1 oder ozonisiertem Wasser sind dabei nur noch bedingt einsetzbar, da sie insbesondere die hochempfindliche Ru-Deckschicht einer EUVL-Fotomaske angreifen. Daher sind sehr schonende Reinigungs- und Oberflächenbehandlungsmethoden, wie Trockenreinigung erforderlich. Die Verwendung von Plasma unter Atmosphärendruck bietet hier ganz besonders viele Vorteile, da es neben dem Reinigungseffekt zusätzlich Einfluss auf die Oberflächenenergie ausübt und dadurch die Benetzbarkeit für anschließende Nassprozesse verbessert. Zudem wird mittels Plasma im Anschluss an die finale Reinigung eine Passivierung der Oberfläche erreicht. Die Entwicklung einer solchen speziellen Plasma-Einheit war ein wesentliches Projekt im Jahr 2014. Nach erfolgreichen Testläufen konnte der Prototyp dieser Einheit fertiggestellt und zum Ende des Jahres bei einem ersten Kunden installiert werden.

Im Hinblick auf die schonende Oberflächenreinigung wurde innerhalb eines Kooperationsprojektes ein neuartiges Reinigungsmedium identifiziert und auf einer SÜSS MaskTrackPRO Reinigungsanlage getestet, welches die aggressive Behandlung mittels SPM-(Piranha-) Reinigung zur Entfernung von Fotolackresten ersetzt.

Die Entwicklung der neuen Reinigungsanlagenplattform MaskTrack Gen3 – die nächste Generation der erfolgreichen MaskTrack-Serie – wurde vorangetrieben. Hierzu wurden wesentliche Konzepte im Design festgelegt, die sicherstellen, dass auch in Zukunft neue Technologien entwickelt und in eine bestehende Anlage integriert werden können. Damit wird SÜSS MicroTec auch zukünftig die Anforderungen in der Fotomaskenindustrie erfüllen und seine Marktvorherrschaft behaupten können.

## DIE HOLDING – SÜSS MicroTec AG

Die Aufgabe der Holding ist die Steuerung und Führung des SÜSS MicroTec-Konzerns. Sie übernimmt unter anderem die Aufgaben der strategischen Ausrichtung, beispielsweise der Ausweitung des Produktportfolios, Akquisitionen und Finanzfragen der gesamten Gruppe. Ebenso ist die Holding für Corporate Identity, Investor Relations und Marketing verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt die Holding die Finanzierung von strategisch bedeutsamen Entwicklungsprojekten der operativen Tochtergesellschaften.

Die SÜSS MicroTec AG (SMT AG) ist in der Regel alleinige Anteilseignerin an den im Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen. Ausleihungen der Holding erfolgten nur an Tochterunternehmen und deren Tochterunternehmen. Die Ertragslage der Holding als Einzelgesellschaft ist nicht direkt von der Entwicklung unserer Märkte abhängig. Die Holding refinanziert sich im Wesentlichen durch Umlage der umlagefähigen Kosten auf die operativen Gesellschaften, durch Vermietung der Gebäude an den Standorten Garching und Sternenfels an Tochtergesellschaften, durch Zinserträge aus den Ausleihungen an Tochterunternehmen sowie durch bestehende Ergebnisabführungsverträge.

Gesellschaft	SMT AG (HGB)			
	2014	2013	Änderung	in %
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	6.980	-20.601	27.581	–
Eigenkapital (EK)	96.139	89.159	6.980	8
Bilanzsumme	139.443	132.869	6.574	5
EK-Quote in %	69	67		
Anlagevermögen	82.751	88.336	-5.585	-6
% der Bilanzsumme	59	66		
Umlaufvermögen inkl. RAP	56.692	44.534	12.158	27
% der Bilanzsumme	41	34		

## WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN DER VERMÖGENS- UND FINANZLAGE

Die immateriellen Vermögensgegenstände stiegen im abgelaufenen Geschäftsjahr um 0,2 Mio. € und belaufen sich zum Stichtag auf 1,6 Mio. €. Wesentlichen Anteil am Anstieg der immateriellen Vermögensgegenstände haben Investitionen in die Erweiterung des konzernweiten SAP-Systems sowie die Einführung eines neuen Customer Relationship Management Systems. Diese Neuinvestitionen werden teilweise noch unter den geleisteten Anzahlungen ausgewiesen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 52,9 Mio. € und sind damit um 0,3 Mio. € geringer als im Vorjahr. Grund für den Rückgang sind außerplanmäßige Abschreibungen auf die Beteiligung an der SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (USA). Durch die Änderung des Geschäftsmodells wird die Gesellschaft zukünftig lediglich eine für eine Vertriebsgesellschaft übliche EBIT-Marge erzielen. Entsprechend zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung auf den Beteiligungsansatz an dieser Gesellschaft um rund 0,3 Mio. € an.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sanken um rund 5,3 Mio. €. Das Gesellschafterdarlehen an die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG, Sternenfels, das im Vorjahr einen Buchwert von 4,3 Mio. € aufwies, wurde von der Gesellschaft komplett getilgt. An die SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona / USA, wurden hingegen weitere Darlehensbeträge ausgereicht. Zum 31. Dezember 2014 belief sich das Darlehen auf insgesamt 22,6 Mio. USD (Vorjahr: 15,0 Mio. USD). Da für die SUSS MicroTec Photonic Systems auf Basis der aktuellen Konzernplanung ein negatives Ergebnis erwartet wird, zeigt das zur Überprüfung der Werthaltigkeit von Finanzanlagen verwendete Modell eine Abwertung dieses Gesellschafterdarlehens um rund 6,7 Mio. € an. Das Darlehen wurde entsprechend zum 31. Dezember 2014 um diesen Betrag abgewertet.

Die kurzfristigen Forderungen gegen verbundene Unternehmen stiegen um 10,2 Mio. €. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus den Ergebnisabführungen der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroTec REMAN GmbH.

Im Berichtsjahr stieg die Liquiditätsposition der SÜSS MicroTec AG leicht. Der Zuwachs resultiert im Wesentlichen aus dem positiven Free Cashflow der über das Konzern-Cashpooling mit der AG verbundenen Tochtergesellschaften. Der Anstieg der Liquiditätsposition wird im Zuwachs der Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 2,9 Mio. € sichtbar. Im Gegenzug ist der Bestand an Wertpapieren um rund 1,0 Mio. € zurückgegangen. Bei den Wertpapieren handelt es sich um Unternehmens- und Staatsanleihen, die über ein Rating im Investmentgradbereich verfügen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen blieben im Berichtsjahr beinahe unverändert. Sie sanken um 0,4 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Verlauf des Jahres 2014 um 1,2 Mio. €. Dies resultiert aus planmäßigen Tilgungen eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels und eines Darlehens zur Finanzierung des Betriebsgrundstückes in Garching.

Der Anstieg des Eigenkapitals von 7,0 Mio. € ist ausschließlich auf den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres von 7,0 Mio. € zurückzuführen.

### **WESENTLICHE EREIGNISSE MIT EINFLUSS AUF DIE ERTRAGSLAGE DER HOLDING**

Im handelsrechtlichen Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ergab sich für das Geschäftsjahr 2014 ein Jahresüberschuss von 7,0 Mio. € (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 20,6 Mio. €).

Auf Grund des zum 1. Januar 2011 gültigen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 8,8 Mio. € (Vorjahr: Aufwand aus Verlustübernahme 18,2 Mio. €) ertragswirksam erfasst. Auf Grund des im Geschäftsjahr 2008 geschlossenen Ergebnisabführungsvertrages mit der SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleißheim, wurde bei der Holding ein Ertrag aus Gewinnübernahme in Höhe von 1,1 Mio. € (Vorjahr: 0,8 Mio. €) erfasst. Darüber hinaus hat die Holding aus einer Dividendenausschüttung der SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu (Taiwan) Beteiligungserträge von rund 2,0 Mio. € erzielt.

In den Ausleihungen an verbundene Unternehmen des Vorjahres war ein Gesellschafterdarlehen an die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG enthalten, das einen Nennwert von 11,9 Mio. € aufwies. Dieses Gesellschafterdarlehen wurde im Februar 2010 im Zuge der Akquisition der HamaTech APE GmbH & Co. KG (nun: SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG) vom damaligen Gesellschafter, der Singulus Technologies AG, für einen Kaufpreis von 4,3 Mio. € erworben. Zum 31. Dezember 2014 hat die SUSS MicroTec Photomask Equipment das Darlehen komplett getilgt. Die SÜSS MicroTec AG erzielte aus der Tilgung des Darlehens einen Gewinn von 7,6 Mio. €, der unter den Erträgen aus dem Abgang von Finanzanlagen ausgewiesen ist

Gegenläufig wirkte sich eine Wertberichtigung eines Darlehens in Höhe von 6,7 Mio. € aus, das an die SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona, gewährt wird. Zudem wurde eine Wertberichtigung auf den Beteiligungsansatz der SUSS MicroTec, Inc. von 0,3 Mio. € gebucht.

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind überwiegend Mieterlöse in Höhe von 1,9 Mio. € (Vorjahr: 1,5 Mio. €) und Fremdwährungsgewinne in Höhe von 0,2 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €) enthalten.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten – neben laufenden Aufwendungen für die Verwaltung – Fremdwährungsverluste in Höhe von 4,6 Mio. € (Vorjahr: 0,6 Mio. €). Davon resultieren 4,4 Mio. € aus der Bewertung der in US-Dollar und

japanischen Yen geführten Cashpool-Verrechnungskonten mit der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec REMAN GmbH. Beide Gesellschaften weisen in ihren Einzelabschlüssen entsprechende Fremdwährungsgewinne von in Summe ebenfalls 4,4 Mio. € aus.

Die Zinsaufwendungen stiegen im Geschäftsjahr um 0,2 Mio. €, was im Wesentlichen auf das im Dezember 2013 neu aufgenommene Bankdarlehen in Höhe von 7,5 Mio. € zurückzuführen ist.

In der SÜSS MicroTec AG waren im Geschäftsjahr 2014 durchschnittlich 19 (Vorjahr: 20) Mitarbeiter tätig.

Die kurz- und mittelfristige Entwicklung der SÜSS MicroTec AG hängt vor allem von der Entwicklung der Finanz- und Ertragslage wesentlicher Tochtergesellschaften ab. Die Finanz- und Ertragslage der Tochtergesellschaften ist ausschlaggebend für die Höhe des zinstragenden Nettofinanzierungssaldos der Holding und für die Ausschüttung und Abführung von Ergebnissen an die Muttergesellschaft. Zudem ist das Ergebnis beeinflusst von Fremdwährungseffekten, die sich aus der Veränderung der Wechselkurse von US-Dollar und japanischen Yen ergeben.

## NACHHALTIGKEIT

SÜSS MicroTec verfügt über mehr als sechzig Jahre Erfahrung in der Fertigung von Anlagen und Entwicklung von Prozesslösungen für Mikrostrukturanwendungen. Das Unternehmen hat für die Halbleiterindustrie Standards im Hinblick auf Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereitzustellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht. Ein weiterer Erfolgsfaktor ist das Thema Nachhaltigkeit, welches bei uns eine sehr hohe Priorität genießt. Als Technologieführer und Innovationstreiber fühlen wir uns nicht nur der Erstklassigkeit unserer Produkte, sondern auch dem Thema Nachhaltigkeit verpflichtet. Es geht bei den Managemententscheidungen immer auch darum, die sozialen, ökologischen und ökonomischen Komponenten in Einklang zu bringen. Ob mit Kunden, Mitarbeitern oder Wettbewerbern, wir streben nach einem fairen und sozial verträglichen Umgang miteinander. Darüber hinaus legen wir die gleichen hohen Maßstäbe an Zulieferer und Geschäftspartner. Wir sind einer nachhaltigen, wirtschaftlichen Entwicklung verpflichtet und möchten den Leserinnen und Lesern auf den kommenden Seiten einen Überblick über unsere Aktivitäten im Hinblick auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung geben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter [www.suss.com](http://www.suss.com) **► Unternehmen** **► Qualitätsmanagement** **► Nachhaltigkeit**.

## COMPLIANCE

Jeder Angestellte trägt eine Mitverantwortung für das Erscheinungsbild unseres Unternehmens und dafür, dass unsere gesellschaftliche Verantwortung wahrgenommen wird. Unser Selbstverständnis umfasst zudem die Integration aller Mitarbeiter, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder Religion. Im Code of Conduct sind die Verhaltensregeln für SÜSS MicroTec-Mitarbeiter im Umgang mit Kunden, Zulieferern und anderen Geschäftspartnern sowie der Umgang unter den Mitarbeitern geregelt. Er soll helfen, die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe weiter zu stärken. Die Mitarbeiter verpflichten sich, die Verhaltensregeln des Code of Conduct und die Compliance-Regeln zu befolgen. 2014 haben wir zudem ein webbasiertes Hinweissystem (Whistleblowing) auf mögliche Compliance-Verstöße installiert. Die Meldungen gehen per E-Mail anonymisiert oder unter freiwilliger Angabe des Namens direkt an die Rechtsabteilung.

## QUALITÄTSMANAGEMENT

Die technologisch führende Position von SÜSS MicroTec in den Bereichen Lithografie, Fotomaschinen Equipment, Substrat Bonder und Mikrooptik fußt auf der starken Verpflichtung zur Einhaltung höchster Qualitätsstandards. Unsere Qualitätsziele basieren auf nachhaltigem Kundenvertrauen, Wertschätzung gegenüber unseren Kunden, Partnerschaften und motivierten Mitarbeitern. SÜSS MicroTec liefert qualitativ hochwertige Produkte und Services sowie innovative Lösungen. Alle Bereiche von SÜSS MicroTec teilen unsere Verpflichtung zu höchster Qualität. Unsere Prozesse basieren auf einem effektiven Qualitätsmanagement-System, das für die Produktionsstandorte in Deutschland und der Schweiz nach ISO 9001 zertifiziert ist und ständig verbessert wird.

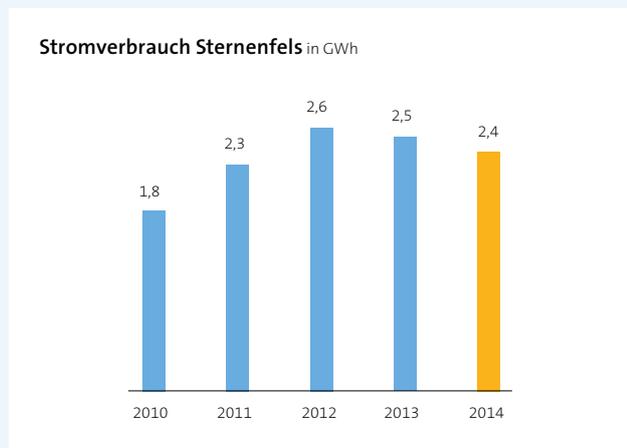
## UMWELTVERANTWORTUNG

In den vergangenen Jahren hat SÜSS MicroTec begonnen, auf breiter Linie und standortübergreifend Maßnahmen zu ergreifen, die eine effizientere Nutzung von Ressourcen gewährleisten. Dazu gehört beispielsweise die Optimierung der Pumpensysteme in der Heizungs- und Klimatechnik, der Einsatz von Druckluftkompressoren mit Wärmerückgewinnung, neue Beleuchtungskonzepte sowie generell ein bewussterer Umgang mit den natürlichen Ressourcen. Mit diesen Maßnahmen konnte beispielsweise der Stromverbrauch am Standort Garching seit 2008 um knapp 20% gesenkt werden.

Bereits im Geschäftsjahr 2013 wurden aufgrund altersbedingter Funktionsdefizite die Kälteaggregate am Standort Garching in mehreren Bauabschnitten in den Reinräumen erneuert. Der volle Einspareffekt dieser Maßnahmen wurde erstmalig im

Geschäftsjahr 2014 erzielt. Die zwei neuen Kälteaggregate, die mit einer „freien Kühlung“ ausgestattet sind, können Energieeinsparungen bei Außentemperaturen unter 11°C bewirken. Die neuen Kältemaschinen wurden in einem Kälteverbund so installiert, dass jetzt eine redundante Kälteerzeugung gegeben ist, z. B. im Störfall (Ausfall einer Kältemaschine oder Wartungsarbeiten) wird die Produktion nicht mehr beeinträchtigt. Mit diesen Umbauarbeiten hat das Unternehmen die Produktionssicherheit am Standort Garching erhöht und gleichzeitig einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Wirtschaft getan.

Nach der Übernahme des Produktionsstandorts Sternenfels und nach der Zusammenlegung von drei Produktlinien an diesem Standort, ist der Stromverbrauch zunächst deutlich angestiegen. Der Stromverbrauch ist bei uns generell stark abhängig vom Produktionsvolumen, das bedeutet in einer Phase wirtschaftlichen Aufschwungs, verbrauchen wir grundsätzlich mehr Strom, als in einer konjunkturell schwächeren Phase. Wir werden auch am Standort Sternenfels zukünftig einen noch stärkeren Fokus auf den schonenden Umgang mit Ressourcen legen.



Als Spezialmaschinenbauer im Halbleiterssegment sind wir mit Produkten am Markt, die maßgeblich dazu beitragen energieeffiziente Endprodukte herzustellen und CO<sub>2</sub>-Emissionen zu verringern. Ein Beispiel hierfür ist die Herstellung von energiesparenden Leuchtdioden (LED). Mit dem MA100 / 150e Gen2 bieten wir eine Mask Aligner-Plattform speziell für die Verarbeitung empfindlicher Verbindungshalbleiter, wie z. B. sehr heller LEDs (UBH).

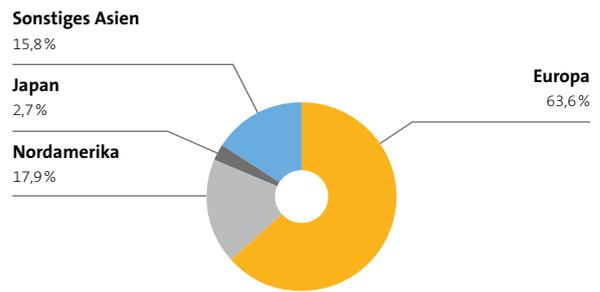
Darüber hinaus kommen viele Bauelemente (z. B. Hochleistungsschaltkreise), die unter anderem auf unseren Maschinen gefertigt werden, in der Industrie für erneuerbare Energien wie Wind und Solarenergie zum Einsatz. Aber auch die Verbesserungen der ökologischen Eigenschaften und der Umweltverträglichkeit unserer Produkte selbst sind ein wichtiger Teil unserer Entwicklungsarbeit. So legen wir verstärkt Wert auf einen möglichst geringen Einsatz von Chemikalien und gefährlichen Prozessmaterialien im Fertigungsprozess und während des Betriebs unserer Maschinen. Bei Belackungs- und Entwicklungsgeräten sowie Fotomasken Equipment lässt sich durch innovatives Prozessmanagement und ein ausgeklügeltes Maschinendesign der Verbrauch der verwendeten Medien reduzieren. Dies spart unseren Kunden bares Geld und es entlastet die Umwelt.

**MITARBEITER**

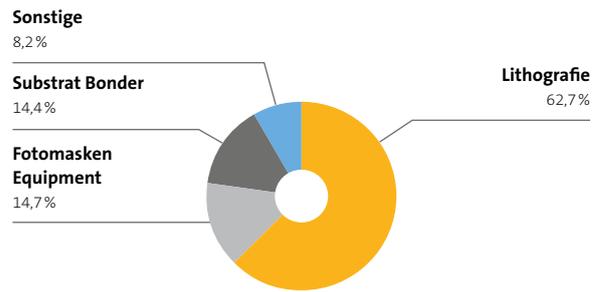
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie deren Wissen stellen einen erheblichen Teil unseres Unternehmenswerts dar. Die Anlernzeiten, insbesondere im technischen Bereich, sind aufgrund der sehr spezifischen Produkte länger als ein Jahr. Daher sind ein motivierendes Umfeld und eine leistungsgerechte Bezahlung Grundvoraussetzungen für die Erhaltung bestehender und für die Anwerbung qualifizierter neuer Mitarbeiter. Unser Geschäft ist geprägt von Internationalität, globaler Ausrichtung und kultureller Vielfalt. Über den Globus verteilt haben wir Mitarbeiter in Entwicklung, Produktion, Verwaltung, Vertrieb und Service, welche ein wichtiges Netzwerk für den standortübergreifenden Wissensaustausch und die interkulturelle Zusammenarbeit bilden. Wir arbeiten in flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen, und ermöglichen unseren Mitarbeitern, sich einzubringen und sich entsprechend ihrer Fähigkeiten und Neigungen weiter zu entwickeln. Wir respektieren die persönliche Würde, die Privatsphäre und die Persönlichkeitsrechte jedes Einzelnen.

Zum Ende des Geschäftsjahres 2014 waren 659 (Vorjahr: 655) Mitarbeiter im Konzern beschäftigt.

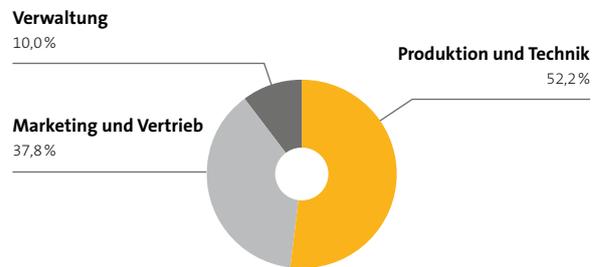
**Mitarbeiter nach Regionen 2014**



**Mitarbeiter nach Segmenten 2014**



**Mitarbeiter nach Bereichen 2014**



Die Sicherheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter liegen uns ganz besonders am Herzen. Ein sicheres und gesundes Arbeitsumfeld fördert sowohl die Produktivität als auch das Arbeitsklima im Unternehmen. Wie in unserer Erklärung zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit dargelegt, ([www.suss.com](http://www.suss.com) > *Unternehmen* > *Qualitätsmanagement* > *Umweltverantwortung*) gibt es spezielle Programme, um die höchsten Standards im Hinblick auf Sicherheit zu erfüllen. Wir führen an unseren Produktionsstandorten detaillierte Statistiken über Arbeitsunfälle und werten diese regelmäßig aus. In regelmäßigen Abständen bieten wir darüber hinaus betriebsärztliche Termine z. B. zu kostenlosen Sehtests oder Schutzimpfungen an.

Die Zusammenarbeit unserer Mitarbeiter weltweit sowie unser Umgang mit Kunden und Geschäftspartnern ist geprägt von gegenseitigem Respekt, integrem Handeln und der Einhaltung ethischer Richtlinien und Gesetze. Um die zahlreichen rechtlichen und ethischen Herausforderungen bei der täglichen Arbeit zu bewältigen, Orientierung zu schaffen und so das Vertrauen in die Leistung und Integrität der SÜSS MicroTec-Gruppe zu stärken, haben wir einen Verhaltenskodex (Code of Conduct) verabschiedet, dessen Einhaltung für alle Mitarbeiter weltweit verbindlich ist.

## KUNDENBEZIEHUNGEN

Im Umgang mit Mitarbeitern, Kunden und Geschäftspartnern legen wir großen Wert auf die Einhaltung hoher ethischer Standards. Wir sind der Meinung, dass dies entscheidend zum Unternehmenserfolg beitragen kann. Dazu gehört der korrekte Umgang mit insiderrelevanten Informationen, mit dem geistigen Eigentum der Mitarbeiter und vertraulichen Informationen von Kunden und Lieferanten.

Zu unseren Kunden zählen unter anderem namhafte Integrated Device Manufacturers (IDM) in aller Welt und zahlreiche Kunden im Bereich Outsourced Assembly and Test (OSAT). Darüber hinaus arbeiten wir seit vielen Jahren mit führenden Universitäten und Forschungsinstituten im In- und Ausland sehr erfolgreich zusammen. Im Rahmen der Entwicklung von neuen und innovativen Technologien, Maschinen und Lösungen, gehen wir zudem Partnerschaften und Kooperationen mit anderen Industrieunternehmen ein.

## Übernahmerechtliche Angaben gemäß § 289 Abs. 4 HGB und § 315 Abs. 4 HGB

### *1. Zusammensetzung des gezeichneten Kapitals*

Zum 31. Dezember 2014 belief sich das gezeichnete Kapital der Gesellschaft auf 19.115.538,00€ (Vorjahr: 19.115.538,00€). Das Grundkapital ist in 19.115.538 (Vorjahr: 19.115.538) auf Namen lautende, nennwertlose Stückaktien unterteilt, auf die ein anteiliger Betrag von 1,00€ je Aktie entfällt. Die Aktien sind voll eingezahlt.

Mit allen Aktien sind die gleichen Rechte und Pflichten verbunden. Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme und ist maßgebend für den Anteil der Aktionäre am Gewinn der Gesellschaft. Die Rechte und Pflichten der Aktionäre ergeben sich im Einzelnen aus den Regelungen des AktG, insbesondere aus den §§ 12, 53a ff., 118 ff. und 186 AktG.

Gemäß § 67 Abs. 2 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft als Aktionär nur, wer als solcher im Aktienregister eingetragen ist. Die Aktionäre haben der Gesellschaft die zur Führung des Aktienregisters erforderlichen Daten zu übermitteln.

### *2. Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen*

Beschränkungen, die Stimmrechte oder die Übertragung von Aktien betreffen, bestehen nach der Satzung nicht. Wir haben auch keine Kenntnis von dem Bestehen derartiger Vereinbarungen zwischen Aktionären.

### *3. Beteiligungen am Kapital, die 10% der Stimmrechte überschreiten*

Direkte oder indirekte Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, die 10% der Stimmrechte erreichen oder überschreiten, sind uns nicht gemeldet worden und auch nicht bekannt.

### *4. Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen*

Aktien mit Sonderrechten, die Kontrollbefugnisse verleihen, bestehen nicht.

### **5. Art der Stimmrechtskontrolle, wenn Arbeitnehmer am Kapital beteiligt sind und ihre Kontrollrechte nicht unmittelbar ausüben**

Soweit die SÜSS MicroTec AG im Rahmen eines Mitarbeiteraktienprogramms Aktien an Mitarbeiter ausgibt, werden die Aktien den Mitarbeitern unmittelbar übertragen. Die begünstigten Mitarbeiter können die ihnen aus den Mitarbeiteraktien zustehenden Kontrollrechte wie andere Aktionäre unmittelbar nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen der Satzung ausüben.

### **6. Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen der Satzung über die Ernennung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern und die Änderung der Satzung**

Die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind in den §§ 84 und 85 AktG geregelt. Danach werden Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre bestellt. Eine wiederholte Bestellung oder Verlängerung der Amtszeit, jeweils für höchstens fünf Jahre, ist zulässig. Über die Bestellung und Abberufung von Vorstandsmitgliedern beschließt der Aufsichtsrat mit der einfachen Mehrheit der Stimmen.

Der Vorstand besteht gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung aus mindestens zwei Personen, wobei die Zahl der Vorstandsmitglieder vom Aufsichtsrat bestimmt wird. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 AktG und § 7 Abs. 2 der Satzung einen Vorsitzenden bzw. Sprecher des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden bzw. Sprecher ernennen.

Fehlt ein erforderliches Vorstandsmitglied, wird das Mitglied nach § 85 AktG in dringenden Fällen auf Antrag eines Beteiligten gerichtlich bestellt. Der Aufsichtsrat kann gemäß § 84 Abs. 3 AktG die Bestellung zum Vorstandsmitglied und die Ernennung zum Vorsitzenden des Vorstands widerrufen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.

Eine Änderung der Satzung bedarf nach § 179 AktG eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu Änderungen, die nur die Fassung betreffen, ist gemäß § 17 Abs. 3 der Satzung dem Aufsichtsrat übertragen.

Satzungsändernde Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen nach §§ 133 und 179 AktG in Verbindung mit § 26 Abs. 1 der Satzung der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen und einer einfachen Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals, soweit nicht das Gesetz zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt.

### **7. Befugnisse des Vorstands, Aktien auszugeben oder zurückhalten**

Der Vorstand ist ermächtigt, in der Zeit bis zum 21. Juni 2016 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmal oder mehrfach um bis zu insgesamt 6.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 6.500.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit der Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Weiterhin ist der Vorstand ermächtigt, in der Zeit bis zum 18. Juni 2018 das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einmalig oder mehrfach um bis zu insgesamt 2.500.000,00 € durch Ausgabe von bis zu 2.500.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen. Der Vorstand ist ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats und unter Einhaltung bestimmter Bedingungen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Der Vorstand ist darüber hinaus ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2018 eigene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10% des bei der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals in Höhe von 19.115.538,00 € zu erwerben. Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Aktien, die sich im Besitz der Gesellschaft befinden oder ihr nach §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt mehr als 10% des Grundkapitals entfallen. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels in eigenen Aktien ausgeübt werden. Der Erwerb darf nach Wahl des Vorstands über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufangebotes bzw. einer an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Aufforderung an die Aktionäre zur Abgabe eines Verkaufsangebotes erfolgen. Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien zu allen gesetzlich zugelassenen Zwecken zu verwenden.

**8. Wesentliche Vereinbarungen der Gesellschaft, die unter der Bindung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots anstehen**

Mit den Banken des Konsortiums bestehen unter einem gemeinsamen Sicherheitenpool jeweils bilaterale Kreditverhältnisse, die hinsichtlich ihrer Ausgestaltung bzw. Konditionen Unterschiede aufweisen. So enthält ein Kreditverhältnis ein außerordentliches Kündigungsrecht, falls eine Änderung der Gesellschaftsverhältnisse/ein Change-of-Control eintritt und zwischen den Parteien keine rechtzeitige Einigung über die Fortsetzung zu gegebenenfalls veränderten Konditionen, z. B. hinsichtlich der Verzinsung, der Besicherung oder sonstiger Absprachen, erzielt wurde.

Sonstige wesentliche Vereinbarungen der SÜSS MicroTec AG, die unter der Bedingung eines Kontrollwechsels infolge eines Übernahmeangebots stehen, bestehen nicht.

**9. Entschädigungsvereinbarung der Gesellschaft, die für den Fall eines Übernahme-Angebots mit Vorstandsmitgliedern oder Arbeitnehmern getroffen sind**

Entschädigungsvereinbarungen o.ä. mit Arbeitnehmern bzw. Mitgliedern des Vorstands für den Fall eines Übernahmeangebots existieren nicht.

Zusammenfassend bestehen keine besonderen Regelungen bezüglich der mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte und hieraus resultierenden Kontrollmöglichkeiten, weder durch Einrichtung besonderer Aktiengattungen noch durch Stimmrechts- oder Übertragungsbeschränkungen. Über die gesetzlichen Regelungen hinausgehende Vorschriften über die Bestellung oder Abberufung von Mitgliedern des Vorstands sind nicht vorhanden. Wesentliche Geschäftsbereiche oder Aktivitäten der SÜSS MicroTec AG können im Fall eines Übernahmeangebots durch vorliegende Change-of-Control-Klauseln nicht wegfallen.

## Erklärung zur Unternehmensführung gemäß § 289a HGB

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG haben mit Datum vom 3. März 2015 eine gemeinsame Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289a HGB abgegeben und diese

auf der Internetseite der Gesellschaft unter <http://ir.suss.com/websites/suess/German/2010/erklarung-zur-unternehmens-fuehrung.html> allgemein zugänglich gemacht.

## Vergütungsbericht

### VERGÜTUNG DES VORSTANDS

SÜSS MicroTec legt die Vorstandsvergütung bereits seit mehreren Jahren individualisiert offen. Ziel des Systems der Vorstandsvergütung bei SÜSS MicroTec ist es, einen Anreiz für die langfristige und auf Nachhaltigkeit angelegte Unternehmensführung zu setzen. Besondere Leistungen sollen besonders vergütet werden. Aber auch Zielverfehlungen müssen zu einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen; darüber hinaus muss sich die Vergütung an der Größe und der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens orientieren. Die Gesamtvergütung der Vorstandsmitglieder besteht aus erfolgsunabhängigen und erfolgsbezogenen Vergütungsbestandteilen.

Für die Festlegung der Vorstandsvergütung ist der Aufsichtsrat zuständig. Das Aufsichtsratsplenum beschließt und überprüft auf regelmäßiger Basis das Vergütungssystem für den Vorstand und beschließt über die Vorstandsverträge.

Der Aufsichtsrat hat sich eingehend mit der Ausrichtung der Vorstandsvergütung an einer nachhaltigen Unternehmensführung befasst. Hierzu wurde auch ein externer Vergütungsberater hinzugezogen.

### FESTE VERGÜTUNG

Die Höhe der Festbezüge wird in erster Linie von der übertragenen Funktion bzw. der Verantwortung bestimmt. Die erfolgsunabhängigen Teile der Vergütung bestehen aus dem Grundgehalt sowie Nebenleistungen in Form eines Dienstwagens und Zuschüssen zur Krankenversicherung sowie zur freiwilligen Rentenversicherung. Darüber hinaus sind den Mitgliedern des Vorstands Versorgungszusagen (Alters-, Berufsunfähigkeits- und Witwenrente) in Form von Direktversicherungen (Kapitallebensversicherungen) gemacht worden.

### ERFOLGSBEZOGENE VERGÜTUNG

Die erfolgsbezogene Vergütung besteht aus einer variablen Vergütung.

### VARIABLE VERGÜTUNG

Die variable Vergütung kann seit dem 1. Januar 2012 höchstens 150% der Festvergütung zu Beginn des betreffenden Geschäftsjahres betragen. 70% der variablen Vergütung bestimmen sich nach Jahreszielen und 30% nach Mehrjahreszielen.

### AN JAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG A)

Die Jahresziele (Auftragseingang, Umsatz, EBITDA und Free Cashflow) werden für jeweils ein Geschäftsjahr vom Aufsichtsrat festgelegt. Werden diese Ziele zu 70% oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 130% ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70% und 130%, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln.

Die an Jahreszielen orientierte Vergütung wird jährlich ermittelt. Im Interesse einer Förderung der langfristigen Unternehmensentwicklung steht den Vorstandsmitgliedern aber nur die Hälfte der variablen Vergütung A endgültig zu. In Bezug auf die andere Hälfte des Auszahlungsbetrages (Vorbehaltshälfte) ist das Vorstandsmitglied verpflichtet, in dem ersten Handelsfenster nach Auszahlung des Auszahlungsbetrages Aktien der Gesellschaft zu erwerben und für eine Sperrfrist von drei Jahren, gerechnet ab dem letzten Tag des Handelsfensters, in dem die Aktien erworben wurden, in einem auf seinen Namen lautenden Depot zu halten.

### **AN MEHRJAHRESZIELEN ORIENTIERTE VARIABLE VERGÜTUNG (VARIABLE VERGÜTUNG B)**

30 % der variablen Vergütung entfallen auf mehrjährige Ziele, die für einen Zeitraum von regelmäßig drei Geschäftsjahren festgelegt werden.

Erstmalig erfolgte eine Festlegung der Mehrjahresziele für die Geschäftsjahre 2010 bis 2012. Dabei wurden für die jeweiligen Geschäftsjahre Zwischenziele (Milestones) definiert, die in den einzelnen Geschäftsjahren erreicht werden sollten. Der Aufsichtsrat legte nach Abschluss eines Geschäftsjahres und nach Anhörung des Vorstands durch Beschluss den Zielerreichungsgrad in Bezug auf die für die Ziele vereinbarten jeweiligen Milestones zwischen 70 % und 130 % vorläufig fest. Abhängig vom festgelegten Zielerreichungsgrad für die jeweiligen Milestones wurde der Anteil an der variablen Vergütung für das jeweilige Geschäftsjahr festgelegt. Dieser Anteil wurde zu 50 % als Vorschuss ausgezahlt und zu 50 % auf das Verrechnungskonto für die variable Vergütung als vorläufiges Guthaben vorgetragen. Nach Ablauf der Gesamtlaufzeit der mehrjährigen Ziele stellte der Aufsichtsrat für diese Ziele insgesamt in einer Bandbreite von 70 % bis 130 % den Grad der Zielerreichung für die jeweiligen Ziele abschließend fest. Für die endgültige Berechnung der variablen Vergütungsanteile für die in die Gesamtlaufzeit fallenden Geschäftsjahre waren nur diese abschließend festgestellten Zielerreichungsgrade maßgeblich, bezogen auf den Mittelwert der Maximalbeträge der betreffenden Geschäftsjahre. Die zuvor festgestellten Zielerreichungsgrade hinsichtlich der Milestones dienten nur der Bemessung der entsprechenden Vorschusszahlung.

Für die Geschäftsjahre 2013 bis 2015 erfolgte die erneute Festlegung von Mehrjahreszielen für drei Geschäftsjahre im Voraus, wobei diese sich nach Funktion und Aufgabenbereich des Vorstandsmitglieds unterscheiden können. Die derzeitigen Mehrjahresziele beziehen sich auf die Erreichung festgelegter EBIT-Margen bzw. Meilensteine von Entwicklungsprojekten in definierten Zeiträumen. Werden diese Ziele zu 70 % oder weniger erreicht, entfällt diese Vergütungskomponente. Bei einer Zielerreichung von 150 % ist der Maximalbetrag erreicht. Beträgt der Zielerreichungsgrad für ein bestimmtes Ziel zwischen 70 % und 150 %, ist der entsprechende anteilige Betrag an der variablen Vergütung im Verhältnis zum Zielerreichungsgrad zu ermitteln. Die an Mehrjahreszielen orientierte variable Vergütung B wird jährlich ermittelt und für das jeweilige Geschäftsjahr vollständig ausgezahlt.

### **ABFINDUNGEN**

In Vorstandsverträgen ist für den Fall, dass die Vorstandstätigkeit ohne wichtigen Grund vorzeitig endet, eine Ausgleichszahlung vorgesehen. Diese ist auf maximal zwei Jahresvergütungen einschließlich Nebenleistungen begrenzt (Abfindungs-Cap) und vergütet nicht mehr als die Restlaufzeit des jeweiligen Anstellungsvertrages. Eine Zusage für Leistungen aus Anlass der vorzeitigen Beendigung der Vorstandstätigkeit infolge eines Kontrollwechsels (Change-of-Control-Regelung) ist in den bestehenden Vorstandsverträgen nicht enthalten.

### **VORSTANDSVERGÜTUNG**

Die im Folgenden aufgeführten Tabellen zur Vorstandsvergütung entsprechen dem Deutschen Corporate Governance Kodex. Die Festvergütung und die Nebenleistungen richten sich nach dem vereinbarten Festbetrag. Für die variable Vergütung ist sowohl ein Zielwert für eine Erreichung von 100 % angegeben als auch die erreichbare Minimal- und Maximalvergütung.

Für die Geschäftsjahre 2014 und 2015 beträgt die Tantieme von Herrn Braun jeweils mindestens 35.625,00 €.

### **HÖHE DER VORSTANDSVERGÜTUNG**

Die folgenden Tabellen („Gewährte Zuwendungen“ und „Zufluss“) zeigen die Vergütung für die Geschäftsjahre 2014 und 2013 je Vorstandsmitglied gemäß den Anforderungen des Deutschen Corporate Governance Kodex Ziffer 4.2.5 Absatz 3. Die Angaben, die bisher gemäß § 314 HGB in der Tabelle „Vorstandsvergütung“ enthalten waren, sind nun in der Tabelle „Zufluss“ abgebildet.

Zielvergütung des Vorstands nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex:

in €	<b>Michael Knopp</b>			
	Finanzvorstand CFO (Vorstandssprecher seit 24.08.2014)			
<b>Gewährte Zuwendungen</b>	<b>2014 (100 %)</b>	<b>2014 (Min.)</b>	<b>2014 (Max.)</b>	<b>2013</b>
Festvergütung	251.254,00	251.254,00	251.254,00	236.254,00
Nebenleistungen (fix) <sup>1</sup>	21.502,56	21.502,56	21.502,56	20.549,52
Aufwand für Altersversorgung <sup>2</sup>	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
<b>Summe</b>	<b>274.904,56</b>	<b>274.904,56</b>	<b>274.904,56</b>	<b>258.951,52</b>
Einjährige variable Vergütung (A) <sup>3</sup>	128.625,00	–	257.250,00	120.750,00
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien <sup>4</sup>	64.312,50	–	128.625,00	60.375,00
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	55.125,00	–	110.250,00	51.750,00
<b>Summe</b>	<b>458.654,56</b>	<b>274.904,56</b>	<b>642.404,56</b>	<b>431.451,52</b>
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>458.654,56</b>	<b>274.904,56</b>	<b>642.404,56</b>	<b>431.451,52</b>

- <sup>1</sup> enthält: Zuschuss freiwillige Renterversicherung  
Geldwerter Vorteil Pkw  
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
- <sup>2</sup> Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)
- <sup>3</sup> Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150% der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres
- <sup>4</sup> Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

in €	<b>Walter Braun</b>			
	Produktionsvorstand COO, Eintritt: 01.07.2014			
<b>Gewährte Zuwendungen</b>	<b>2014 (100 %)</b>	<b>2014 (Min.)</b>	<b>2014 (Max.)</b>	<b>2013</b>
Festvergütung	94.998,00	94.998,00	94.998,00	–
Nebenleistungen (fix) <sup>1</sup>	9.993,66	9.993,66	9.993,66	–
Aufwand für Altersversorgung <sup>2</sup>	2.148,00	2.148,00	2.148,00	–
<b>Summe</b>	<b>107.139,66</b>	<b>107.139,66</b>	<b>107.139,66</b>	<b>–</b>
Einjährige variable Vergütung (A) <sup>3</sup>	49.875,00	35.625,00	99.750,00	–
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien <sup>4</sup>	24.937,50	17.812,50	49.875,00	–
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	21.375,00	–	42.750,00	–
<b>Summe</b>	<b>178.389,66</b>	<b>142.764,66</b>	<b>249.639,66</b>	<b>–</b>
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>178.389,66</b>	<b>142.764,66</b>	<b>249.639,66</b>	<b>–</b>

- <sup>1</sup> enthält: Zuschuss freiwillige Renterversicherung  
Geldwerter Vorteil Pkw  
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse
- <sup>2</sup> Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)
- <sup>3</sup> Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150% der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres
- <sup>4</sup> Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Zielvergütung eines ehemaligen Vorstandsmitglieds nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex:

in €	Frank Averdung Vorstandsvorsitzender CEO, Austritt: 24.08.2014			
	2014 (100 %)	2014 (Min.)	2014 (Max)	2013
<b>Gewährte Zuwendungen</b>				
Festvergütung	330.000,00	330.000,00	330.000,00	300.000,00
Nebenleistungen (fix) <sup>1</sup>	23.789,28	23.789,28	23.789,28	23.506,80
Aufwand für Altersversorgung <sup>2</sup>	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00
<b>Summe</b>	<b>355.937,28</b>	<b>355.937,28</b>	<b>355.937,28</b>	<b>325.654,80</b>
Einjährige variable Vergütung (A) <sup>3</sup>	173.250,00	–	346.500,00	157.500,00
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien <sup>4</sup>	86.625,00	–	173.250,00	78.750,00
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	74.250,00	–	148.500,00	51.750,00
<b>Summe</b>	<b>603.437,28</b>	<b>355.937,28</b>	<b>850.937,28</b>	<b>534.904,80</b>
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>603.437,28</b>	<b>355.937,28</b>	<b>850.937,28</b>	<b>534.904,80</b>

<sup>1</sup> enthält: Zuschuss freiwillige Renterversicherung  
Geldwerter Vorteil Pkw  
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

<sup>2</sup> Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

<sup>3</sup> Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150% der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

<sup>4</sup> Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

Zufluss der Vorstandsvergütung nach dem Deutschen Corporate Governance Kodex:

in €	Michael Knopp Finanzvorstand CFO (Vorstandssprecher seit 24.08.2014)		Walter Braun Produktionsvorstand COO, Eintritt: 01.07.2014	
	2014	2013	2014	2013
<b>Zufluss</b>				
Festvergütung	251.254,00	236.254,00	94.998,00	–
Nebenleistungen (fix) <sup>1</sup>	21.502,56	20.549,52	9.993,66	–
Aufwand für Altersversorgung <sup>2</sup>	2.148,00	2.148,00	–	–
<b>Summe</b>	<b>274.904,56</b>	<b>258.951,52</b>	<b>104.991,66</b>	<b>–</b>
Einjährige variable Vergütung (A) <sup>3</sup>	191.758,96	98.202,12	74.355,51	–
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien <sup>4</sup>	95.879,48	49.101,06	37.177,76	–
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	104.107,89	–	16.648,99	–
<b>Summe</b>	<b>570.771,41</b>	<b>357.153,64</b>	<b>195.996,16</b>	<b>–</b>
Versorgungsaufwand	–	–	–	–
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>570.771,41</b>	<b>357.153,64</b>	<b>195.998,16</b>	<b>–</b>

in €	Frank Averdung Vorstandsvorsitzender CEO Austritt: 24.08.2014	
	2014	2013
<b>Zufluss</b>		
Festvergütung	330.000,00	300.000,00
Nebenleistungen (fix) <sup>1</sup>	23.789,28	23.506,80
Aufwand für Altersversorgung <sup>2</sup>	2.148,00	2.148,00
Abfindungszahlungen	930.000,00	–
<b>Summe</b>	<b>1.285.937,28</b>	<b>325.654,80</b>
Einjährige variable Vergütung (A) <sup>3</sup>	120.000,00	128.089,73
davon Investition in SÜSS MicroTec-Aktien <sup>4</sup>	–	64.044,87
Mehrjährige variable Vergütung (B) (2013–2015)	–	–
<b>Summe</b>	<b>1.405.937,28</b>	<b>453.744,53</b>
Versorgungsaufwand	–	–
<b>Gesamtvergütung</b>	<b>1.405.937,28</b>	<b>453.744,53</b>

<sup>1</sup> enthält: Zuschuss freiwillige Rentenversicherung  
Geldwerter Vorteil Pkw  
Unternehmensanteil gesetzliche oder private Krankenkasse

<sup>2</sup> Aufwand für Altersversorgung (Direktversicherung)

<sup>3</sup> Variable Vergütung (einjährig und mehrjährig) maximal 150 % der Festvergütung des betreffenden Geschäftsjahres

<sup>4</sup> Für die im Rahmen der variablen Vergütung erworbenen Aktien gilt eine Sperrfrist von drei Jahren.

## PENSIONEN

Es bestehen keine Pensionsrückstellungen für Mitglieder oder ehemalige Mitglieder des Vorstands.

## VERGÜTUNG DES AUFSICHTSRATS

Die Vergütung des Aufsichtsrats ist in § 19 der Satzung der SÜSS MicroTec AG geregelt. Neben der Erstattung ihrer Auslagen und einem Sitzungsgeld von 1.500,00 € pro Sitzung erhält jedes Aufsichtsratsmitglied eine feste Vergütung, die sich an der Verantwortung und dem Tätigkeitsumfang der Aufsichtsratsmitglieder orientiert. Demnach erhält der Vorsitzende des Aufsichtsrats 45.000,00 €, sein Stellvertreter 40.000,00 € und ein einfaches Mitglied des Aufsichtsrats 35.000,00 € pro Geschäftsjahr als feste Vergütung. Die Mitglieder des Aufsichtsrats haben der Gesellschaft den rechnerischen Pro-Kopf-Anteil der von der Gesellschaft gezahlten D&O-Versicherungsprämie erstattet.

### Aufsichtsratsvergütung

2014 in €	Vergütung	Sitzungs-geld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungs-prämie
<b>Aufsichtsrat</b>			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	13.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	13.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	12.000,00	638,27

2013 in €	Vergütung	Sitzungs-geld	Abzug für anteilige D&O-Versicherungs-prämie
<b>Aufsichtsrat</b>			
Dr. Stefan Reineck (Aufsichtsratsvorsitzender)	45.000,00	10.500,00	1.914,82
Jan Teichert (Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender)	40.000,00	10.500,00	957,41
Gerhard Pegam	35.000,00	10.500,00	638,27

Im Geschäftsjahr 2014 haben weder die Mitglieder des Aufsichtsrats noch ihnen nahestehende Personen oder Unternehmen eine Vergütung bzw. Vorteile für persönlich erbrachte Leistungen, insbesondere Beratungs- und Vermittlungsleistungen, erhalten.

## Nachtragsbericht

### BERICHT ZU WESENTLICHEN EREIGNISSEN NACH ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

Am 17. Februar 2015 hat der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG Dr. Per-Ove Hansson in den Vorstand der SÜSS MicroTec AG berufen. Dr. Hansson wird zum 1. Mai 2015 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen. Dr. Hansson ist promovierter Physiker und hat umfangreiche Erfahrungen bei führenden und weltweit tätigen Semiconductor Capital Equipment Firmen gesammelt.

## Potenziale

### CHANCEN UND RISIKEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DES SÜSS MicroTec-KONZERNES

Unser Chancen- und Risikomanagement zielt darauf ab, den Unternehmenswert des SÜSS MicroTec Konzerns nachhaltig zu sichern und zu steigern. Zu unserer unternehmerischen Zielsetzung gehören das frühzeitige und erfolgreiche Erkennen von Chancen sowie die Identifikation und angemessene Bewertung der damit verbundenen Risiken und die adäquate Reaktion darauf. Die vielfältigen Chancen für unseren Konzern resultieren aus der Technologieführerschaft in unseren Geschäftsfeldern, unserem breiten Spektrum an Produkten und Lösungen für die Halbleiter-Equipment-Industrie, den Kooperationen mit internationalen Kunden und Forschungsinstituten sowie unserer globalen Ausrichtung.

Chancen und Risiken definieren wir wie folgt:

- › Chancen sind mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.
- › Unter Risiken verstehen wir mögliche künftige Entwicklungen oder Ereignisse, die zu einer für den Konzern negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können.

Die Analyse und Beurteilung der Chancen und Risiken des Konzerns ist Gegenstand fortlaufender Betrachtungen durch den Vorstand und das Management des Konzerns. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

#### CHANCEN DES KONZERNES

Die globale Geschäftstätigkeit des SÜSS MicroTec Konzerns innerhalb eines dynamischen Marktumfelds eröffnet ständig neue Chancen, die das angestrebte Wachstum von SÜSS MicroTec unterstützen und vorantreiben können. Das Erkennen und Nutzen dieser Chancen gehört daher zu den wesentlichen Bestandteilen unserer Wachstumspolitik.

#### *Gesamtwirtschaftliche Chancen*

SÜSS MicroTec ist mit Produktions-, Verkaufs- und Service-Niederlassungen weltweit vertreten und arbeitet darüber hinaus mit vielen externen Handelspartnern zusammen. Durch die internationale Präsenz bieten sich dem Konzern zahlreiche Chancen, weltweit neue Kunden zu akquirieren, neue Kooperationen einzugehen und an dem Wachstum der Industriemärkte in den bedeutenden und aufstrebenden Volkswirtschaften teilzuhaben.

**Unternehmensstrategische Chancen**

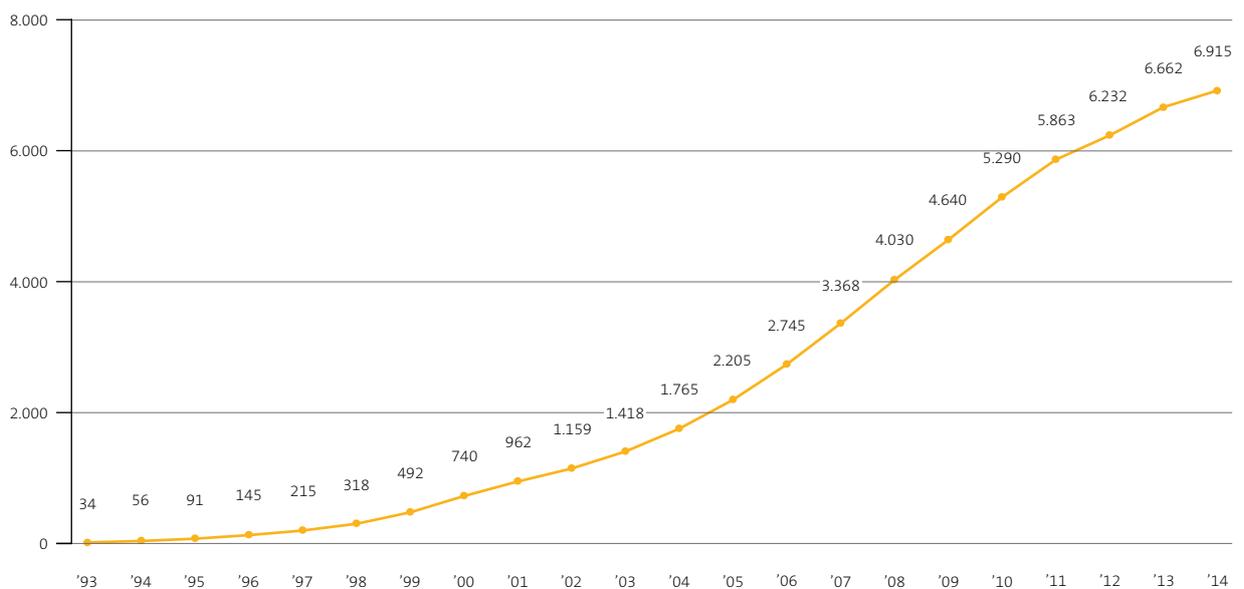
SÜSS MicroTec hat in der Herstellung von Prozessausrüstungen für die Halbleiterindustrie Standards in Präzision und Qualität gesetzt. Kontinuierliche Innovationsleistungen und die Fähigkeit, stets neue Lösungen in einem sich schnell ändernden Umfeld bereit zu stellen, haben SÜSS MicroTec zum Technologieführer gemacht. Diese Stärken zusammen mit einer soliden finanziellen Ausstattung geben dem Konzern die Möglichkeit, aussichtsreiche Entwicklungsprojekte durchzuführen, erfolgsversprechende Kooperationen einzugehen und damit die Produktpalette weiter auszubauen sowie Anwendungen und Technologien weiterzuentwickeln. Der SÜSS MicroTec-Konzern pflegt zahlreiche Entwicklungspartnerschaften mit Forschungsinstituten und Universitäten. Insbesondere die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten bietet großes Potenzial für SÜSS MicroTec, denn diese arbeiten in der Regel sehr eng mit unseren Kunden zusammen und werden zu einem nicht unerheblichen Anteil durch die Kunden finanziert. Neue Basistechnologien werden häufig in den Laboren der Forschungsinstitute entwickelt und finden dann erst ihren Weg in die Industrie. Umso wichtiger ist es für ein Hightech-Unternehmen wie SÜSS MicroTec, von Anfang an in die Neuentwicklung von Technologien und Prozessen mit eingebunden zu sein. Dies erhöht die Chancen, später Maschinen und Lösungen für das industrielle Umfeld in der Volumenproduktion liefern zu können.

Neben der Weiterentwicklung eigener Technologien sieht SÜSS MicroTec grundsätzlich auch die Chance, den Konzern durch Akquisition von außen um neue Geschäftsfelder und Technologien zu erweitern.

**Branchen- und marktspezifische Chancen**

Die von SÜSS MicroTec bedienten Märkte der Halbleiter-Equipment-Industrie unterliegen einem stetigen Wandel, der vor allem durch die rasanten Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie beeinflusst wird. So ist die weltweit immer weiter steigende Anzahl von Smartphones und Tablet-Computern ein wesentlicher Wachstumstreiber für die Hersteller dieser Produkte. Auch die Weiterentwicklung von diversen Elektronikgeräten und die Integration von Hightech-Anwendungen in das tägliche Leben führen zu starken Veränderungen auf den Märkten. Die größten Wachstumsraten sind hierbei nicht in den Industrienationen, sondern vor allem in den sich entwickelnden Ländern Asiens zu verzeichnen.

Anzahl der Mobilfunkanschlüsse weltweit 1993–2014 in Mio.



Quelle: Statista 2015

Wesentliche Bereiche der globalen Halbleiterbranche sind auf Asien fokussiert. Dazu gehören einige große Packaging-Häuser (OSATs) sowie viele der weltweit agierenden Hersteller von Speichermedien und MEMS-Bauteilen.

Die starken Marktzyklen der Halbleiterindustrie bieten SÜSS MicroTec – je nach Art der Entwicklung – zahlreiche neue Chancen im Markt, die kurzfristig für einen starken Anstieg der Auftrags-eingänge und der Umsätze sorgen können.

Unser globales Netzwerk von Vertriebsmitarbeitern, Produkt-ingenieuren und Handelspartnern ist darauf ausgerichtet, die branchen- und marktspezifischen Anforderungen unserer Kunden weltweit zu erfüllen. SÜSS MicroTec ist in den Kernmärkten der Halbleiter-Equipment-Industrie in Taiwan, China, Japan und Südkorea mit eigenen Tochtergesellschaften vertreten. Unsere Niederlassungen pflegen stets den direkten Kontakt mit unseren Kunden und haben damit die Möglichkeit, aktuelle Entwicklungen auf den Halbleitermärkten umgehend zu registrieren. Damit kann SÜSS MicroTec rasch auf sich abzeichnende Neuentwicklungen reagieren und seine Anwendungen entsprechend anpassen.

Um neue Entwicklungen am Markt immer schnell wahrzunehmen, ist uns der direkte und regelmäßige Kontakt zu Kooperationspartnern, Kunden und potenziellen Neukunden sehr wichtig. SÜSS MicroTec ist daher auf Messen für die Halbleiterindustrie vertreten und veranstaltet international Technologie-Foren. So präsentiert SÜSS MicroTec seine Neuentwicklungen regelmäßig auf den Semicon-Messen, die jährlich an verschiedenen Standorten weltweit stattfinden. Daneben präsentiert SÜSS MicroTec seine Entwicklungen auch auf kleineren, lokalen Messen. Parallel zur Semicon West hat SÜSS MicroTec 2014 bereits zum fünften Mal das SUSS Technology Forum in San Francisco ausgerichtet, das von Industriepartnern aus aller Welt sehr gut besucht wurde. Auch in Grenoble fand – zeitgleich zur Semicon Europa – das SUSS Technology Forum MEMS statt, das in Kooperation mit dem Branchenverband SEMI direkt auf dem Messegelände durchgeführt wurde.

Durch die enge Zusammenarbeit mit SEMI und die Aufnahme des SUSS Technology Forums in das reguläre Konferenzprogramm der Semicon Europa kann SÜSS MicroTec einen großen Adressatenkreis ansprechen. Die internationale Präsenz von SÜSS MicroTec und der durch die Messen und Veranstaltungen hohe Bekanntheitsgrad geben uns die Möglichkeit, das Ohr immer direkt am Markt zu haben und auf technologische Fortschritte und Neuentwicklungen schnell zu reagieren.

### *Operative Chancen*

Die Lithografie ist nach wie vor der größte Umsatzbringer der SÜSS MicroTec-Gruppe und sorgt jährlich für etwa zwei Drittel des gesamten Konzernumsatzes. Mit den Produktlinien Mask Aligner und Coater / Developer ist SÜSS MicroTec seit vielen Jahren erfolgreich am Markt vertreten und bedient damit Kunden aus verschiedenen Branchen und Märkten. Das konstante Umsatzvolumen und die relativ stabilen Margen dieser beiden Produktlinien sichern dem SÜSS MicroTec-Konzern eine gleichmäßige Auslastung der Produktionsstandorte Garching und Sternenfels und beständige positive Cashflows. Mit Weiterentwicklungen und Verbesserungen der Technologien dieser beiden Produktlinien festigen wir unsere Marktposition und stellen sicher, dass mit Mask Alignern und Coatern / Developern auch zukünftig stabile Margen und Cashflows erzielt werden können.

Mit den durch die Akquisition der SUSS MicroTec Photonic Systems hinzugewonnenen Technologien – der UV-Projektionsbelichtung und der Laserprozessierung – haben wir unser Produktportfolio im Bereich Lithografie ergänzt und erweitert. 2014 konnten wir weitere Kunden für Laser Tools gewinnen und haben für die im aktuellen Geschäftsjahr installierten Tools von den Kunden problemlos Abnahmen ohne Beanstandungen erzielt. Wir sehen die Chance, weitere Aufträge für Lasertools zu gewinnen und damit unsere Marktposition im Bereich der Laserprozessierung weiter zu stärken.

Die von SUSS MicroTec Photonic Systems ebenfalls entwickelten und produzierten Scanner-Systeme (DSC300, DSC500) müssen am Markt noch Fuß fassen. 2014 konnten wir einige Erfolge mit diesen Systemen verzeichnen. Wir haben sowohl Scanner-Systeme bei Kunden installiert als auch neue Kunden für Evaluierungen gewonnen. Hierdurch erwarten wir weitere positive Impulse im Marktumfeld und gehen davon aus, dass sich auch andere Kunden für diese Technologie entscheiden werden. Wenn es uns gelingt, weitere Kunden von unseren Systemen zu überzeugen, könnten wir in den nächsten Jahren substanzielle Auftragsvolumina und Umsätze mit Scannern erzielen. Bei entsprechend hohen Stückzahlen könnten zukünftig nachhaltig positive Margen erreicht werden.

Das Segment Substrat Bonder, das sich in die beiden Teilbereiche temporäres und permanentes Bonden untergliedert, wurde 2013 neu ausgerichtet und die Schwerpunkte der technologischen Entwicklung wurden neu gesetzt. Im Bereich temporäres Bonden konnten 2014 wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Volumenproduktion erreicht werden. Im Bereich permanentes Bonden haben wir im vierten Quartal 2014 mit dem neuen SB6/8 Gen2 ein halbautomatisches System auf den Markt gebracht, das sowohl für manuelle Prozesse im Forschungs- und Entwicklungsbereich als auch für Volumenwendungen eingesetzt werden

kann. Durch die umfassenden Neuentwicklungen, die wir im Jahr 2014 durchgeführt haben und auch in den Folgejahren weiter fortsetzen werden, erwarten wir für die Zukunft einen deutlichen Ausbau unserer Marktposition, höhere Umsatzvolumina und langfristig positive Margen.

Im Segment Fotomaschinen Equipment haben wir seit der Akquisition der SÜSS MicroTec Photomask Equipment im Jahr 2010 hohe Umsätze und hohe Margen erzielt. Der Großteil der Umsätze wurde mit wenigen Einzelaufträgen erzielt, die jeweils einen sehr hohen Auftragswert von mehreren Millionen Euro aufwiesen. Die Umsätze pro Geschäftsjahr weisen daher große Schwankungen auf. In diesem Segment sehen wir unsere Marktposition als sehr gefestigt an und gehen davon aus, auch in Zukunft hohe Gewinne zu erzielen. Wir rechnen jedoch damit, dass sich langfristig weiterhin starke Schwankungen im Umsatz pro Geschäftsjahr ergeben werden, was sich entsprechend auf das Segmentergebnis pro Geschäftsjahr auswirken kann.

#### *Finanzielle Chancen*

Starke Veränderungen am Währungsmarkt können den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Die momentan stattfindende Abwertung des Euro im Vergleich zum US-Dollar bietet SÜSS MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

#### *Mitarberspezifische Chancen*

SÜSS MicroTec sieht sich selbst als mittelständisches Unternehmen, das aufgrund der relativ geringen Unternehmensgröße flache Hierarchien aufweist und so seinen Mitarbeitern in allen Belangen kurze Kommunikationswege und schnelle Entscheidungsprozesse ermöglicht. Unsere mittelständischen Strukturen in Verbindung mit unserer internationalen Ausrichtung machen SÜSS MicroTec zu einem attraktiven Arbeitgeber. Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit unserer weltweit tätigen Mitarbeiter beläuft sich auf beinahe zehn Jahre. Damit zeigen unsere Bemühungen, unseren Mitarbeitern ein gutes Betriebsklima, interessante Aufgaben und eine attraktive Vergütung zu bieten, ihren Erfolg. Wir sind überzeugt, dass wir auch zukünftig alle freien Stellen mit qualifizierten und motivierten Mitarbeitern besetzen können. Unsere bisherige Strategie, langjährige Mitarbeiter zu halten, werden wir unverändert fortsetzen.

Unser Vergütungssystem beinhaltet für unsere Führungskräfte eine variable Vergütung, deren Höhe sich nach dem Grad der Zielerreichung richtet. Die Ziele werden jährlich neu definiert und basieren auf bestimmten Kenngrößen des Konzerns (wie zum Beispiel EBITDA, Umsatz und Auftragseingang), die anhand der aktuellen Budgetplanung jährlich neu festgelegt werden. Zusätzlich werden mit dem Mitarbeiter persönliche Ziele vereinbart. Für die Mitarbeiter des Vertriebs werden in der Regel Ziele definiert, die im Zusammenhang mit der Gewinnung von Kundenaufträgen stehen. Die persönlichen Ziele von Mitarbeitern anderer Abteilungen haben meist Leistungen oder Projekte zum Inhalt, die einen Zusatznutzen für den jeweiligen Fachbereich mit sich bringen. Durch die Einbindung der Budgetplanung in das Vergütungssystem setzen wir für unsere Führungskräfte einen finanziellen Anreiz, aktiv dazu beizutragen, die gesetzten Ziele zu erreichen. Damit erhöhen wir unsere Chancen, unseren geplanten Umsatz und unser geplantes Ergebnis tatsächlich zu erzielen. Die Definition von persönlichen Zielen für die Führungskräfte bietet uns darüber hinaus die Chance, zahlreiche Projekte in verschiedenen Bereichen umzusetzen, auch wenn dafür ein Arbeitseinsatz der Mitarbeiter notwendig ist, der über das normale Tagesgeschäft hinausgeht.

Als weltweit erfolgreiches Technologie-Unternehmen ist SÜSS MicroTec darauf angewiesen, dass die Mitarbeiter, die im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind, neue Produktentwicklungen gezielt vorantreiben, um so den Bedürfnissen unserer Kunden Rechnung zu tragen. SÜSS MicroTec setzt hierzu die entsprechenden Anreize und vergütet Ideen der Mitarbeiter, die in unseren Produkten zum Einsatz kommen, mit einer jährlich auszuzahlenden Erfindervergütung.

Unsere internationale Präsenz ermöglicht es uns, hochqualifizierte Mitarbeiter weltweit anzuwerben, wenn es aktuelle Entwicklungen erforderlich machen. So haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr am Standort unserer Tochtergesellschaft in Taiwan ein neues Team von Software-Entwicklern aufgebaut, das die bisher in Garching und Sternenfels ansässigen Abteilungen unterstützt. Von dem neuen Team erwarten wir uns neue Impulse für die Weiterentwicklung der auf unseren Maschinen eingesetzten Software sowie mehr Flexibilität, um den Bedürfnissen unserer Kunden im asiatischen Raum gerecht zu werden.

#### *Entwicklungsspezifische Chancen*

Für das kommende Geschäftsjahr 2015 planen wir deutlich erhöhte Entwicklungsaufwendungen vor allem für die Produktlinien Mask Aligner und Coater / Developer sowie für das Segment Fotomaschinen Equipment. Hierfür werden wir verstärkt Mitarbeiter in unseren Entwicklungsabteilungen einstellen, aber auch auf externe Dienstleister und Kooperationspartner zurückgreifen.

Unser Ziel ist es, diese Produktlinien technisch zu überholen, an die neuesten Entwicklungen im Markt anzupassen und neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Damit wollen wir unsere Marktposition festigen und weiter ausbauen.

Generell ist beabsichtigt, dem Bereich Forschung und Entwicklung bei SÜSS MicroTec mehr Gewicht zu verleihen. Der Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG hat einen neuen Vorstand, Dr. Per-Ove Hansson, berufen, der zum 1. Mai 2015 das Amt des Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird. Dr. Hansson ist promovierter Physiker und hat umfangreiche Erfahrungen bei namhaften, weltweit tätigen Semiconductor Capital Equipment Firmen gesammelt. Er wird unter anderem das Ressort Forschung und Entwicklung bei SÜSS MicroTec übernehmen und betreuen. SÜSS MicroTec erwartet sich hiervon neue Impulse und ist überzeugt, von der Fachkompetenz und dem reichen Erfahrungsschatz von Dr. Hansson profitieren zu können.

### **RISIKOMANAGEMENT-SYSTEM**

Zur Erkennung und Steuerung von Risiken sowie zur Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen ist das Risikomanagement-System seit langem Bestandteil der Unternehmensführung.

Neben kurzfristigen (operativen) Risiken befasst sich das Risikomanagement bei SÜSS MicroTec auch mit langfristigen (strategischen) Entwicklungen, die sich negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken können. Auf der Grundlage eines chancenorientierten, gleichzeitig aber risikobewussten Managements ist es jedoch nicht unser Ziel, alle potenziellen Risiken grundsätzlich zu vermeiden. Vielmehr streben wir stets ein Optimum aus Risikovermeidung, -reduzierung und kontrollierter Risikoakzeptanz an. Das Bewusstsein für Risiken sollte nicht die Fähigkeit beeinträchtigen, Chancen zu erkennen und zum Wohle des Unternehmens und seiner Aktionäre zu nutzen.

#### *Organisation und Dokumentation des Risikomanagements*

Die Organisation des Risikomanagements orientiert sich an der funktionellen und hierarchischen Struktur des Konzerns. Mit der Einführung des Risikomanagement-Systems wurde ein Risikomanagement-Beauftragter ernannt, der alle drei Monate direkt an den Vorstand berichtet.

Extern wird das eingerichtete Risikofrüherkennungssystem durch den Abschlussprüfer im Rahmen der Jahresabschlussprüfung geprüft. Er berichtet darüber an Vorstand und Aufsichtsrat.

#### *Risikoidentifikation*

Alle berichtspflichtigen Einheiten des Konzerns veranstalten mindestens einmal jährlich einen Workshop, der neben der Retrospektive vor allem auf zukünftige Entwicklungen eingeht. Außerdem dienen die Workshops dazu, die konzernweit einheitliche Bewertungsmethodik sicherzustellen. Im Rahmen eines strukturierten Prozesses werden vierteljährlich sämtliche identifizierten Risiken mit Hilfe einer intranet-basierten IT-Lösung erfasst und bewertet. Anschließend werden Risikoberichte erstellt, die bekannte Risiken einer kritischen Würdigung unterziehen und neue Themen aufnehmen.

Plötzlich auftretende Risiken werden darüber hinaus unverzüglich an den Risikomanagement-Beauftragten der jeweiligen Einheit gemeldet.

Die Aufbereitung der Informationen erfolgt durch den Risikobeauftragten, der an den Vorstand berichtet. Die Ergebnisse des Gesamtprozesses werden dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich präsentiert.

Wichtiger Bestandteil zur Risikofrüherkennung ist das Qualitätsmanagement des Konzerns. An den großen Produktionsstandorten liegt eine Zertifizierung nach ISO 9001 vor, die ein zuverlässiges, prozess- und systemorientiertes Qualitätsmanagement bestätigt. Klar strukturierte und eindeutig dokumentierte Prozesse im Rahmen des Qualitätsmanagements sorgen nicht nur für Transparenz, sondern sind mittlerweile bei den meisten Produktionskunden eine Vorbedingung für die erfolgreiche Vermarktung unserer Maschinen.

#### *Risikobewertung*

Die Bewertung von Risiken erfolgt zum einen durch die Angabe der maximalen Schadenshöhe, wenn keine Gegenmaßnahmen ergriffen werden. Auf dieser Grundlage wird der Risikowert durch Einbeziehung einer Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt, wobei auch die entsprechenden Gegenmaßnahmen berücksichtigt werden. Die Angabe des Risikowerts bezieht sich jeweils auf den Zeitraum der kommenden zwölf bzw. 24 Monate.

Die identifizierten Risiken werden mit Hilfe einer Risikomatrix in drei verschiedene Risikokategorien eingeordnet, die sowohl die mögliche Schadenshöhe als auch die Eintrittswahrscheinlichkeit berücksichtigen. Risiken ab einer Schadenshöhe von 10 Mio. € – gemessen an der Höhe des Liquiditätsabflusses – werden als „bestandsgefährdend“ angesehen.

Die Kombination von Eintrittswahrscheinlichkeit und Grad der Auswirkung bestimmt, welche Risikokategorien aus Konzernsicht als wesentlich zu betrachten sind. Hierbei wird unterschieden in geringe (grün), mittlere (gelb) und hohe (rot) Risiken.

			Eintrittswahrscheinlichkeit				
			sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch
			0 % bis ≤ 5 %	> 5 % bis ≤ 10 %	> 10 % bis ≤ 25 %	> 25 % bis ≤ 50 %	> 50 % bis ≤ 100 %
<b>Auswirkung</b>	bestandsgefährdend	> 10 Mio. € bis ≤ 20 Mio. €					
	schwerwiegend	> 2 Mio. € bis ≤ 10 Mio. €					
	bedeutend	> 500 Tsd. € bis ≤ 2 Mio. €					
	moderat	> 20 Tsd. € bis ≤ 500 Tsd. €					
	vertretbar	0 € bis ≤ 20 Tsd. €					

Entsprechend unserer Methode zur Risikobewertung werden nur die hohen Risiken als wesentlich eingestuft.

**Risikohandhabung**

Je nach Art des Risikos und der Höhe der Bewertung werden abgestuft Maßnahmen der Risikovermeidung bzw. -minderung getroffen. Dabei orientiert sich das Risikomanagement stets an der einleitend erwähnten Maxime eines chancenorientierten Umgangs mit Risiken.

Die Risikoabwendung und Organisation von Gegenmaßnahmen wird subsidiär durchgeführt. Die Risikoverantwortlichen beziehungsweise die Berichtseinheiten sind zur Entwicklung und Umsetzung von Abwehrstrategien gegen erkannte Risiken verpflichtet. Sollten ihre Kompetenzen nicht zur Umsetzung ausreichen, fordern sie Hilfe von höheren Ebenen an.

Aus der weltweiten Tätigkeit in der Hochtechnologie ergeben sich allgemeine und aktuelle Risiken für das Unternehmen. Der Vorstand hat zur Überwachung von Risiken in geeigneter Weise Maßnahmen getroffen, um Entwicklungen, die den Fortbestand der SÜSS MicroTec-Gruppe gefährden, rechtzeitig zu erkennen.

***Beschreibung der wesentlichen Merkmale des internen Kontroll- und Risikomanagements im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess gemäß § 289 Abs. 5 HGB und § 315 Abs. 2 Nr. 5 HGB***

Das Risikomanagementsystem im Hinblick auf den Konzernrechnungslegungsprozess zielt darauf ab, das Risiko der Falsch-aussage in der Konzernrechnungslegung sowie in der externen Berichterstattung zu minimieren. Es dient im ersten Schritt der Identifikation und Bewertung, weiterhin der Begrenzung und Überprüfung erkannter Risiken im Konzernrechnungslegungsprozess, die dem Ziel der Regelungskonformität des Konzernabschlusses entgegenstehen könnten. Das interne Kontrollsystem des Rechnungslegungsprozesses soll gewährleisten, dass trotz identifizierter Risiken in der Finanzberichterstattung ein mit hinreichender Sicherheit regelkonformer Konzernabschluss erstellt wird.

Die Angemessenheit des Risikofrüherkennungssystems wird im Rahmen der Abschlussprüfung zum Jahresende durch den Abschlussprüfer überprüft. Dabei werden ausgewählte rechnungslegungsbezogene interne Kontrollen untersucht und deren Effektivität beurteilt. Darüber hinaus werden ausgewählte Aspekte der eingesetzten IT-Systeme geprüft.

Die Verantwortung für die Einrichtung und wirksame Unterhaltung angemessener Kontrollen über die Finanzberichterstattung liegt beim Management der SÜSS MicroTec AG, das zu jedem Geschäftsjahresende die Angemessenheit und Wirksamkeit des Kontrollsystems beurteilt. Zum 31. Dezember 2014 hat das Management die Wirksamkeit der internen Kontrollen über die Finanzberichterstattung festgestellt. Allerdings bestehen bei jedem Kontrollsystem gewisse Einschränkungen hinsichtlich seiner Wirksamkeit. Eine absolute Sicherheit kann auch mit angemessenen und funktionsfähigen Systemen nicht gewährleistet werden.

Die SÜSS MicroTec AG nutzt ihr konzernweit gültiges Bilanzierungshandbuch zur einheitlichen Regelung von Bilanzierungsgrundsätzen. Das Bilanzierungshandbuch basiert auf den IFRS-Rechnungslegungsstandards und wird von allen Konzerngesellschaften beim Rechnungslegungsprozess zugrunde gelegt. Durch eindeutige Vorgaben soll der Ermessensspielraum der Mitarbeiter bei Ansatz und Bewertung von Vermögenswerten und Schulden eingeschränkt und somit das Risiko konzernuneinheitlicher Rechnungslegungspraktiken verringert werden. Den Tochtergesellschaften sind bestimmte Berichtspflichten und -umfänge zwingend vorgegeben. Die Einhaltung der Berichtspflichten und -fristen wird durch die zentralen Abteilungen Finanzen und Controlling überwacht.

Die Buchhaltung der Tochtergesellschaften wird entweder lokal mit eigenen Mitarbeitern oder mit der Unterstützung von externen Buchführungsfirmen oder Steuerberatungsgesellschaften durchgeführt. Dabei werden unterschiedliche EDV-Systeme eingesetzt. Alle deutschen Gesellschaften arbeiten bereits seit 2008 mit SAP. Seit 2010 wird SAP auch bei der SÜSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu (Taiwan), verwendet. 2011 wurde SAP schließlich bei der SÜSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien / USA) implementiert. Das Reporting an die Konzernzentrale erfolgt mit Hilfe der Managementinformationssoftware „INFOR PM Application Studio“. Die Einzelabschlüsse werden über ein zentrales Konsolidierungssystem zusammengeführt. Auf Konzernebene wird innerhalb der Finanzabteilung und des Controllings die Ordnungsmäßigkeit und Verlässlichkeit der von den Tochtergesellschaften vorgelegten Einzelabschlüsse überprüft. Kontrollen im Rahmen des Konsolidierungsprozesses, wie beispielsweise der Schulden- oder der Aufwands- und Ertragskonsolidierung, erfolgen manuell. Eventuelle Mängel werden korrigiert und an die Tochtergesellschaften zurück berichtet. Die eingesetzten Finanzsysteme sind durch entsprechende Berechtigungskonzepte und Zugangsbeschränkungen vor Missbrauch geschützt. Zugriffsberechtigungen werden regelmäßig überprüft und gegebenenfalls aktualisiert.

## **RISIKEN DES KONZERNS**

### ***Gesamtwirtschaftliche Risiken***

SÜSS MicroTec ist weltweit vertreten, weist eine breite Kundenstruktur auf und bietet seinen Kunden sieben unterschiedliche Produktlinien an, die in verschiedenen Branchen und Industriezweigen eingesetzt werden können. Damit ist SÜSS MicroTec grundsätzlich weder von einzelnen Märkten noch von einzelnen Abnehmern abhängig. Konjunkturelle Einbrüche in einer Region oder Branche können somit zumindest teilweise aufgefangen werden. Dank der flexiblen Aufstellung wäre SÜSS MicroTec bei größeren konjunkturellen Verwerfungen in der Lage, unverzüglich auf die Marktgegebenheiten zu reagieren und die Kostenstrukturen in angemessener Zeit anzupassen. Als Instrumente stehen Gleitzeitkonten und der Einsatz von Zeitarbeitskräften zur Verfügung. Darüber hinaus besteht die Option, Kurzarbeit zu beantragen. Zudem werden von den Einkaufsabteilungen regelmäßig die Beschaffungsmengen überprüft und angepasst.

Politische Entscheidungen, neue Gesetzgebungen und sonstige Regularien in den Ländern, in denen SÜSS MicroTec tätig ist, können unser Geschäft negativ beeinflussen. Dazu gehören die Steuergesetzgebung in den jeweiligen Ländern, Exportbeschränkungen sowie Verschärfungen in den Bereichen Produkthaftung, Wettbewerbsrecht, Arbeitssicherheit und Patent- und Markenrecht.

Aktuell erschwert zum Beispiel das bestehende Russland-Embargo den Absatz unserer Produkte in Russland. Trotzdem ist es uns gelungen, alle für das Geschäftsjahr 2014 geplanten Umsätze mit russischen Kunden zu realisieren. Aufgrund des Wertverlustes des russischen Rubels in Relation zum Euro gehen wir jedoch davon aus, dass wir in naher Zukunft deutlich weniger Umsatz mit russischen Kunden erzielen werden.

SÜSS MicroTec nimmt regelmäßig an öffentlichen Ausschreibungen teil und zählt zum Beispiel Universitäten und staatliche Forschungseinrichtungen weltweit zu seinen Kunden. Die Regelungen für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen und die Kriterien für die Vergabe unterscheiden sich je nach Land und können das Gewinnen von öffentlichen Aufträgen und deren Abwicklung deutlich erschweren.

Generell können starke Veränderungen am Währungsmarkt den Absatz und das Unternehmensergebnis von SÜSS MicroTec sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Die momentan stattfindende Abwertung des Euro im Vergleich zum US-Dollar bietet SÜSS MicroTec die Möglichkeit, seine in Deutschland hergestellten Produkte vor allem auf den US-Dollar-dominierten Märkten zu attraktiven Preisen anzubieten. Auch die Wertveränderungen des Euro im Vergleich zum japanischen Yen werden künftig den Absatz und die erzielbaren Margen im asiatischen Raum beeinflussen. Eine Aufwertung des Euro im Vergleich zum japanischen Yen würde sich eher negativ auswirken, während eine Abwertung voraussichtlich positive Effekte für SÜSS MicroTec nach sich ziehen würde.

Aus der Aufgabe des Mindestkurses des Franken gegenüber dem Euro, die die Schweizer Zentralbank SNB am 15. Januar 2015 beschlossen hat und die zu einer deutlichen Aufwertung des Franken führte, erwartet SÜSS MicroTec zunächst keine Auswirkungen auf das Bestellverhalten seiner Kunden in den Segmenten Lithografie, Substrat Bonder und Fotomaschinen Equipment. Allerdings werden sich die Margen der MicroOptics-Produkte, die von der SÜSS MicroOptics S.A. am Standort Hauterive/Schweiz hergestellt werden, voraussichtlich signifikant reduzieren. Zudem wird SÜSS MicroTec bei den MicroOptics-Produkten vermutlich Umsatzeinbußen hinnehmen müssen.

In den letzten Monaten ist ein Werteverfall des Euro gegenüber den meisten asiatischen Währungen zu beobachten. So hat der Euro Anfang 2015 gegenüber dem taiwanesischen Dollar, dem Singapur-Dollar, dem südkoreanischen Won und dem chinesischen Renminbi Yuan deutlich an Wert verloren. Der SÜSS MicroTec-Konzern wickelt nur in sehr geringem Umfang Geschäfte in diesen Währungen ab. Die in Taiwan, Singapur, Südkorea und China ansässigen Tochtergesellschaften des Konzerns weisen jedoch in Euro dotierte Forderungen gegen Kunden und

andere SÜSS MicroTec Gesellschaften aus. Je nach Umfang und Fälligkeit können aus der Bewertung dieser Forderungen in der jeweiligen Landeswährung signifikante Währungsverluste im Konzern entstehen.

### ***Branchen- und marktspezifische Risiken***

Die schwierige Einschätzbarkeit der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung gehört unverändert zu den größten Risiken des Unternehmens. Insbesondere die Halbleiterindustrie, die zu unseren Absatzmärkten zählt, ist von starken Marktzyklen geprägt. Ein starker Einbruch des gesamten Halbleitermarktes würde bei SÜSS MicroTec Umsatzrückgänge nach sich ziehen und das Unternehmensergebnis schmälern. Den damit verbundenen Risiken begegnen wir durch schlanke Strukturen, die bei schwacher Geschäftsentwicklung zügig angepasst und gegebenenfalls durch Outsourcing ergänzt werden können.

### ***Mitarbeiterspezifische Risiken***

In einzelnen Bereichen ist das Unternehmen von dem Wissen einzelner Mitarbeiter abhängig, vor allem im Bereich der Forschung und Entwicklung. Eine Nichtverfügbarkeit dieser Mitarbeiter für die Gruppe stellt ein entsprechendes Risiko dar, das durch interne Dokumentationspflichten kontrolliert wird.

### ***Entwicklungsspezifische Risiken***

Das Geschäftsmodell der SÜSS MicroTec-Gruppe basiert auf seiner starken Innovationskultur und Technologieführerschaft. Als Hersteller von Spezialmaschinen liefert SÜSS MicroTec kundenspezifische Lösungen und richtet seine Produktpolitik nach den sich schnell verändernden Bedingungen im Halbleiter-Equipment-Markt. Trotzdem sehen wir das Risiko, dass in Einzelfällen unsere technischen Entwicklungen die Vorstellungen der Märkte und unserer Kunden verfehlen könnten. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass sich die betroffenen Kunden von SÜSS MicroTec abwenden und alternative technische Lösungen bei unseren Konkurrenten suchen.

Neben der Ausarbeitung von kundenspezifischen Lösungen arbeiten die Ingenieure der SÜSS MicroTec-Gruppe permanent an langfristigen Entwicklungsprojekten, die zukünftige Entwicklungen der Märkte antizipieren sollen, damit die Produkte von SÜSS MicroTec auch in Zukunft aktuelle technische Anforderungen erfüllen werden. Es besteht das Risiko, dass einzelne Entwicklungsprojekte nicht zum gewünschten Ergebnis führen oder das erzielte Ergebnis nicht die Erwartungen der Märkte trifft. In diesen Fällen bestünde die Gefahr, dass SÜSS MicroTec auf dem angestrebten Markt zeitweise kein innovatives Produkt anbieten kann. Die betroffenen Kunden könnten sich von SÜSS MicroTec abwenden und Alternativen am Markt suchen. Zudem hätte SÜSS MicroTec knappe Ressourcen im Bereich Entwicklung ungünstig eingesetzt.

Für einige unserer Produkte sehen wir uns als Marktführer, da wir mit technologisch hochwertigen Lösungen die Anforderungen unserer Kunden passgenau erfüllen. Um diese Marktführerschaft und die Zufriedenheit unserer Kunden zu erhalten, sind laufend Neuentwicklungen und Verbesserungen an unseren bestehenden Produkten erforderlich (zum Beispiel um den weiteren Verkleinerungen der Strukturen in der Halbleiterindustrie Rechnung zu tragen). Es besteht das Risiko, dass technische Neuentwicklungen von uns nicht rechtzeitig erkannt oder umgesetzt werden. In diesen Fällen sehen wir die Gefahr, dass SÜSS MicroTec seine Marktführerschaft in einzelnen Bereichen verlieren könnte und auf lange Sicht Umsatzeinbußen hinnehmen müsste.

### *Operative Risiken*

Angesichts des hohen Bestands an flüssigen Mitteln, der hohen Eigenkapitalquote und der schlanken Kostenstruktur sind die Risiken, die sich für SÜSS MicroTec aus der aktuellen Vermögens- und Ertragslage ergeben könnten, begrenzt. Mit einem EBIT von 8,4 Mio. € hat der SÜSS MicroTec-Konzern 2014 zudem ein deutlich positives Ergebnis erzielt. Unter Berücksichtigung des zum Jahresende 2014 vorhandenen Auftragsbestands und den verhaltenen Aussichten für die Halbleiter-Equipment-Branche im Jahr 2015 müssen wir jedoch damit rechnen, 2015 ein ausgeglichenes oder ein leicht negatives Ergebnis zu erzielen.

Zum 31. Dezember 2014 weist SÜSS MicroTec einen Goodwill in Höhe von rund 15,5 Mio. € aus, der ausschließlich dem Segment Lithografie zuzuordnen ist. Das Segment Lithografie erwirtschaftet mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes und ein positives Segmentergebnis. Das Segment Lithografie wird auch im nächsten Jahr mehr als die Hälfte des gesamten Konzernumsatzes erwirtschaften und weiterhin profitabel sein. Für Wertminderungen im Segment Lithografie sehen wir daher keine Anzeichen.

Die Produktlinie Mask Aligner, die zum Segment Lithografie gehört, ist eine der umsatzstarken Produktlinien der SÜSS MicroTec-Gruppe und leistet seit vielen Jahren einen hohen Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Wir gehen fest davon aus, dass diese Produktlinie auch in den kommenden Jahren einen hohen Umsatzbeitrag und stabile Margen erzielen wird. Trotzdem besteht das Risiko, dass der Mask Aligner zukünftig die technischen Anforderungen der Kunden nicht mehr erfüllen kann und von anderen Technologien verdrängt werden könnte. Dieses Risiko sehen wir jedoch als gering an. Zudem könnte SÜSS MicroTec seinen Kunden mit den in den USA angesiedelten Produktlinien, den Laser- und Scannersystemen, alternative Lösungen anbieten.

Auch die Produktlinie Coater, die ebenfalls zum Segment Lithografie gehört, leistet seit vielen Jahren einen hohen Umsatz- und Ergebnisbeitrag zum Konzernergebnis. Seit Mitte 2013 nehmen wir zunehmend chinesische Wettbewerber wahr, die am Markt Kundenaufträge vor allem für technisch weniger anspruchsvolle Tools gewinnen konnten. Auch bringen japanische Hersteller, die teilweise bisher nur am Frontend-Markt tätig waren, verstärkt 300-mm-Systeme auf den Midend-/Backend-Markt und bieten den Kunden technologisch gute Lösungen an. Die Hersteller aus Japan haben aufgrund der veränderten Währungsrelation des japanischen Yen deutlich an Wettbewerbsfähigkeit gewonnen. Es besteht das Risiko, dass sich diese Entwicklung fortsetzt und sowohl die japanischen als auch die chinesischen Hersteller zukünftig auch die technologisch anspruchsvollen Tools, an denen SÜSS MicroTec bisher einen hohen Marktanteil hat, erfolgreich am Markt anbieten. Sollte dieses Szenario eintreten, müssten wir unsere Preise für die angebotenen Tools reduzieren, was Umsatz- und Margeneinbußen zur Folge hätte. Es ist nicht auszuschließen, dass wir trotz dieser Maßnahmen Marktanteile verlieren, wenn die konkurrierenden Hersteller aus Asien auf diesem Markt weiter Fuß fassen.

Im Segment Lithografie sind seit der Akquisition der SÜSS MicroTec Photonic Systems im März 2012 auch die Produktlinien für UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung erfasst. 2014 wiesen diese Produktlinien ein negatives Ergebnis auf. Ein positiver Ergebnisbeitrag kann mit den Photonic Systems-Produktlinien nur erzielt werden, wenn es SÜSS MicroTec insbesondere gelingt, die Scanner-Systeme erfolgreich am Markt zu etablieren. 2014 konnten zwar weitere vielversprechende Installationen und Evaluierungen bei Kunden vorgenommen werden. Damit die Scanner-Systeme einen positiven Ergebnisbeitrag leisten können, sind für die Zukunft jedoch deutlich höhere Umsatzvolumina erforderlich. Sollte es SÜSS MicroTec nicht gelingen, mit den Laser- und Scanner-Systemen substanzielle Umsätze und positive Margen zu erzielen, würden dadurch das Ergebnis des Segments Lithografie und das Konzernergebnis weiterhin negativ beeinflusst werden. Zudem könnte sich im Einzelabschluss der SÜSS MicroTec AG zusätzlicher Wertberichtigungsbedarf auf die Ausleihungen an die SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. ergeben, sofern die in den USA gefertigten Produktlinien dauerhaft ein negatives Ergebnis erzielen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr war das Segment Substrat Bonder erneut defizitär und erzielte ein Segment-EBIT von minus 2,4 Mio. €. Wir gehen davon aus, dass das Segment Substrat Bonder auch im kommenden Jahr ein negatives Ergebnis erzielen wird, da für 2015 nur geringe Umsätze geplant sind. SÜSS MicroTec hat 2013 die Herstellung und Vermarktung von Permanent-Bond-Clustern eingestellt. Dieser strategische Schritt wirkt sich momentan nachteilig auf das Bestellverhalten der Kunden für manuelle permanente Bonder aus, da SÜSS MicroTec am Markt von einigen Kunden nicht mehr als Hersteller von Substrat Bondern wahrgenommen wird. Um dem entgegenzuwirken, haben wir unsere Aktivitäten im Bereich Forschung und Entwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich verstärkt. Im Bereich permanentes Bonden haben wir im vierten Quartal 2014 mit dem SB6/8 Gen2 ein halbautomatisches System auf den Markt gebracht, das sowohl für manuelle Prozesse im Forschungs- und Entwicklungsbereich als auch für Volumenwendungen eingesetzt werden kann. Weitere Produktinnovationen sind geplant. Wir gehen davon aus, dass wir mit diesen Maßnahmen verlorene Marktanteile im Markt für permanentes Bonden wieder zurückgewinnen und unsere Marktposition ausbauen können. Trotzdem besteht das Risiko, dass wir auf dem Markt für permanentes Bonden die erforderlichen Stückzahlen nicht werden erreichen können. In diesem Fall würden die permanenten Bonder auch in Zukunft einen negativen Ergebnisbeitrag zum Segmentergebnis liefern. Zudem könnten davon auch andere Produktlinien negativ beeinflusst werden. So erwarten vor allem Forschungsinstitute und Universitäten, aber auch Kunden im Bereich MEMS, dass sie Mask Aligner, Coater/Developer und Permanent Bonder von einem Anbieter beziehen können. Sollte es uns nicht gelingen unsere permanenten Bondensysteme nachhaltig am Markt zu etablieren, wären auch bei den Produktlinien Coater/Developer und Mask Aligner Umsatzeinbußen denkbar.

Auch im Bereich temporäres Bonden konnten wir im Jahr 2014 wichtige Meilensteine auf dem Weg zur Volumenproduktion erreichen. Generell wird die 3D-Integration für die Volumenproduktion bei unseren Kunden noch nicht eingesetzt. Zudem besteht das Risiko, dass sich am Markt andere Technologien und Prozesse durchsetzen werden als die, die von SÜSS MicroTec entwickelt und angeboten werden. Der Erfolg unserer Technologie des Temporary Bonding und De-Bonding hängt entscheidend davon ab, ob sich die von uns entwickelten Technologien und Prozesse am Markt durchsetzen und ob sich die 3D-Integration in der industriellen Fertigung für die Volumenproduktion etablieren wird. Nur durch den Verkauf hoher Stückzahlen werden wir zukünftig im Segment Substrat Bonder unsere Margen verbessern und nachhaltig positive Ergebnisse erzielen können.

Im jetzigen Marktumfeld besteht unverändert ein deutlicher Preisdruck. Dieser beinhaltet das Risiko, dass auch bei sich erholenden Märkten ursprüngliche Zielverkaufspreise nicht mehr erzielt werden können. Diesem Risiko begegnen wir mit einer stetigen Preispolitik. So verzichten wir bei unattraktiven Konditionen auch auf Aufträge, um bei sich erholenden Märkten den Kunden gegenüber eine konsistente Preisgestaltung zu gewährleisten.

Die Produkte von SÜSS MicroTec werden durch ein umfassendes Risiko- und Qualitätsmanagement regelmäßig analysiert, kontrolliert und optimiert. Aufgrund des Einsatzes der Produkte im Produktionsumfeld von Unternehmen mit wachsenden Anforderungen an die Produktqualität kann sich das Haftungsrisiko für SÜSS MicroTec erhöhen. SÜSS MicroTec verfügt, neben anderen Versicherungen, über eine Produkthaftpflichtversicherung für die Gruppe, die das potenzielle Risiko soweit möglich limitiert. Die Angemessenheit dieser Versicherungen, in deren Schutz auch die Konzerngesellschaften einbezogen sind, wird regelmäßig hinsichtlich der abgedeckten Risiken und Deckungssummen überprüft und bei Bedarf angepasst. Darüber hinaus bemühen wir uns, mit allen Vertragspartnern Haftungsbeschränkungen in den Verträgen zu vereinbaren.

#### *Risiken der Informationstechnologie*

Grundsätzlich sehen wir unsere IT-Infrastruktur als gut ausgebaut an und sind der Meinung, dass wir ausreichend Vorkehrungen getroffen haben, um Datenmanipulationen, Datenverluste oder Datenmissbrauch zu vermeiden. Zudem investieren wir regelmäßig in neue Hard- und Software, um den Ausfall von IT-Systemen und Software-Lösungen möglichst gering zu halten. Mit Virenschaltern und Viren-Schutzprogrammen, die laufend auf dem aktuellen Stand gehalten werden, schützen wir unsere IT-Systeme vor Zugriffen und Beschädigungen von außen. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass es in einzelnen Fällen zu Datenmanipulationen, Datenverlusten oder Datenmissbrauch kommen könnte. Es ist auch denkbar, dass neue Viren oder Trojaner, die von unseren Sicherheitsprogrammen nicht erkannt werden, in unsere IT-Systeme eindringen könnten.

### Finanzielle Risiken

#### Kreditrisiken

Ein Kreditrisiko ist der unerwartete Verlust an Zahlungsmitteln oder Erträgen. Dieser tritt ein, wenn der Kunde nicht in der Lage ist, seinen Verpflichtungen innerhalb der Fälligkeit nachzukommen, oder die als Sicherheit dienenden Vermögenswerte an Wert verlieren. Das Unternehmen hat eine konzernweit gültige Richtlinie zum Thema „Credit Assessment“ implementiert. Diese Richtlinie legt für die einzelnen Vertriebsseinheiten des Unternehmens fest, welche Zahlungsbedingungen und Zahlungsabsicherungen im Einzelfall unter Berücksichtigung kunden- und länderspezifischer Aspekte vereinbart werden. Aufträge mit Kunden, die in sogenannten Risk Countries angesiedelt sind, können demzufolge nur gegen Anzahlung des gesamten Auftragswertes, einer Bankgarantie oder eines Letter of Credit abgewickelt werden. Im Fall von Kunden, die in sogenannten Non Risk Countries ansässig sind und eine bestimmte Größenordnung überschreiten, wird ein entsprechendes Kundenrating erstellt. Die Ratings beruhen auf den Angaben externer Kreditratingagenturen. Je nach Einstufung des Kunden sind für die Auftragsabwicklung abgestufte Zahlungskonditionen bzw. -absicherungen notwendig.

Vom Bruttobestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 13,7 Mio. € (Vorjahr: 12,9 Mio. €) sind zum Bilanzstichtag insgesamt 9,5 Mio. € (Vorjahr: 6,1 Mio. €) der Forderungen weder überfällig noch wertgemindert. Bei diesen Forderungen lagen zum 31. Dezember 2014 keine Anhaltspunkte vor, dass Zahlungsausfälle eintreten werden.

Die Altersstruktur der überfälligen, aber nicht wertgeminderten Forderungen stellt sich zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag wie folgt dar:

in Tsd. €	2014	2013
<b>Altersanalyse der überfälligen Forderungen ohne Wertberichtigung</b>		
1 bis 30 Tage	2.448	2.232
31 bis 60 Tage	546	294
61 bis 90 Tage	626	1.038
91 bis 180 Tage	116	226
<b>Überfällige Forderungen ohne Wertberichtigung</b>	<b>3.736</b>	<b>3.790</b>

Insgesamt sind zum Bilanzstichtag 0,5 Mio. € (Vorjahr: 3,0 Mio. €) des Bruttoforderungsbestands überfällig und wertberichtigt. In dem Bruttobetrag des Vorjahres waren auch Forderungen von 1,1 Mio. € für zwei spezielle Kundenprojekte berücksichtigt, bei denen die vertraglich zugesicherten Spezifikationen noch nicht erreicht werden konnten.

Die Altersstruktur der überfälligen und wertberichtigten Forderungen zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag ist in folgender Tabelle dargestellt:

in Tsd. €	2014	2013
<b>Altersanalyse der überfälligen Forderungen mit Wertberichtigungen</b>		
< 91 Tage	0	73
91 bis 180 Tage	179	767
181 bis 360 Tage	36	1.404
> 360 Tage	250	765
<b>Überfällige Forderungen mit Wertberichtigung</b>	<b>465</b>	<b>3.009</b>

Weitere Informationen zur Bestimmung von Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen finden sich im Konzernanhang.

### Liquiditätsrisiken

Zum Jahresende weist der SÜSS MicroTec-Konzern einen Net Cash-Bestand von 38,0 Mio. € aus (Vorjahr: 35,7 Mio. €). Der Free Cashflow (bereinigt um Effekte aus Wertpapiererwerben und Wertpapierverkäufen) belief sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 2,1 Mio. € (Vorjahr: 4,1 Mio. €).

Zwischen der SÜSS MicroTec AG und der IKB Deutsche Industriebank AG besteht ein Darlehensvertrag, der der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Garching dient. Das Darlehen belief sich ursprünglich auf 7,5 Mio. €. Es wurde am 16. Dezember 2013 valutiert und zur Auszahlung gebracht und weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021 auf. Ein weiterer Darlehensvertrag besteht zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Volksbank und dient der Finanzierung des Betriebsgrundstücks in Sternenfels. Dieses Darlehen belief sich ursprünglich auf 4,5 Mio. €. Es wurde am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Zum 31. Dezember 2014 weist der SÜSS MicroTec-Konzern für diese beiden Darlehen Bankverbindlichkeiten von 10,3 Mio. € aus. Die jährliche Tilgung für die beiden Darlehen wird sich für die kommenden Jahre auf 1,2 Mio. € pro Jahr belaufen. Zudem fallen für die beiden Darlehen bankübliche Zinsen an.

Dem SÜSS MicroTec-Konzern stehen insgesamt Kredit- und Avallinien von 8,0 Mio. € bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen zur Verfügung. Drei Banken stellen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH im Rahmen eines Bankenkonsortiums Kredit- und Avallinien von insgesamt 4,5 Mio. €. Diese Kredit- und Avallinien werden bis auf weiteres gewährt. Eine weitere Kreditlinie in Höhe von 1,0 Mio. € steht der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG zur Verfügung. Darüber hinaus besteht im Rahmen eines Kautionsversicherungsvertrages ein weiterer Bürgschaftsrahmen in Höhe von 2,5 Mio. €, der von der SÜSS MicroTec Lithography GmbH und der SÜSS MicroTec REMAN GmbH genutzt werden kann. Diese Kredit- und Avallinien nutzen wir derzeit, um Anzahlungsbürgschaften im operativen Geschäft zu stellen. Zum 31. Dezember 2014 sind diese Kredit- und Avallinien lediglich in Höhe von 3,5 Mio. € in Form von Avalen in Anspruch genommen.

Wir gehen fest davon aus, dass wir damit auch zukünftig alle erforderlichen Anzahlungsbürgschaften stellen können.

Die Minimierung der Abhängigkeit, insbesondere von kurzfristigem Fremdkapital, soll ein potenzielles Finanzierungsrisiko gering halten. Wir begegnen diesem Risiko vor allem durch das Ziel, mit entsprechenden Cashflows auch aus der Optimierung des Working Capital den Anteil des Fremdkapitals auf niedrigem Niveau zu halten. Weitere Einzelheiten zur Liquiditätssituation der Gesellschaft finden sich unter Textziffer (24) des Konzernanhangs.

### Marktpreisrisiken

Marktpreisschwankungen können für das Unternehmen signifikante Cashflow- sowie Gewinnrisiken zur Folge haben. Änderungen der Fremdwährungskurse und der Zinssätze beeinflussen sowohl das weltweite operative Geschäft als auch die Investitions- und Finanzierungsalternativen.

SÜSS MicroTec ist im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit aufgrund der internationalen Ausrichtung Fremdwährungsrisiken ausgesetzt. Die Währungssicherung erfolgt auf Basis bestehender Fremdwährungsaufträge. Für Aufträge, die binnen drei bzw. sechs Monaten abgearbeitet werden, beträgt die Sicherungsquote rund 65 % bzw. 45 %. Gegenläufige Zahlungsströme, die sich insbesondere aus Fremdwährungsbestellungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen ergeben, werden von dem so ermittelten zu sichernden Fremdwährungsbetrag abgesetzt. Als Sicherungsinstrumente werden Devisentermingeschäfte genutzt. Für weitere Einzelheiten verweisen wir auf den Konzernanhang unter Textziffer (30).

Eine günstige Entwicklung der Fremdwährungskurse kann zu höheren Margen einzelner Aufträge führen und zusätzliche Kursgewinne generieren.

Das Zinsänderungsrisiko des Unternehmens ist begrenzt, da auf das variabel verzinsten Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Sternenfels ein laufzeitkongruenter Zinsswap gelegt wurde. Ursprünglich variable Konditionen wurden dadurch in fixe Konditionen eingetauscht. Das Darlehen im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung Garching ist mit einem fixen Zinssatz belegt.

Das Unternehmen hält festverzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, die zu jeder Zeit über eine Bank oder über die Börse veräußert werden können. Der Kurs ist unter anderem auch beeinflusst durch das aktuelle Marktzinsniveau. Sollte das Unternehmen Wertpapiere vor dem Ende der Laufzeit veräußern (z. B. zur Deckung eines ungeplanten Liquiditätsbedarfs, der nicht durch freie Mittel gedeckt werden kann), könnten ungeplante Kursverluste entstehen.

### GESAMTEINSCHÄTZUNG

Im Konzern wurden im Geschäftsjahr 2014 keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Der Fortbestand des Unternehmens war unter Substanz- und Liquiditätsgesichtspunkten zu keiner Zeit gefährdet.

Die für den SÜSS MicroTec-Konzern wesentlichen Risiken sind in der folgenden Tabelle im Überblick dargestellt. Die Risiken wurden dabei nach der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie nach den möglichen finanziellen Auswirkungen (gemessen an der Höhe des möglichen Liquiditätsabflusses) bewertet.

	Eintrittswahrscheinlichkeit					Auswirkung				
	sehr gering	gering	mittel	hoch	sehr hoch	vertretbar	moderat	bedeutend	schwerwiegend	bestandsgefährdend
	0 % bis ≤ 5 %	> 5 % bis ≤ 10 %	> 10 % bis ≤ 25 %	> 25 % bis ≤ 50 %	> 50 % bis ≤ 100 %	0 € bis ≤ 20 Tsd. €	> 20 Tsd. € bis ≤ 500 Tsd. €	> 500 Tsd. € bis ≤ 2 Mio. €	> 2 Mio. € bis ≤ 10 Mio. €	> 10 Mio. € bis ≤ 20 Mio. €
<b>Gesamtwirtschaftliche Risiken</b>										
Negative Auswirkungen durch Wechselkursschwankungen			X					X		
<b>Entwicklungsspezifische Risiken</b>										
Produktpolitik, Kundenzufriedenheit				X					X	
Ungenügende Innovationsfähigkeit, verfehlte Entwicklungsprojekte				X					X	
Verlust der Marktführerschaft in einzelnen Bereichen			X						X	
<b>Operative Risiken</b>										
Umsatzeinbußen bei Mask Alignern	X							X		
Verlust von Marktanteilen für Coater				X					X	
Keine Profitabilität von UV-Projektionsbelichtung und Laserprozessierung			X					X		
Permanentes Bonden – Marktanteil kann nicht ausgebaut werden			X					X		
Temporäres Bonden – die von SÜSS MicroTec entwickelte Technologie setzt sich am Markt nicht durch			X					X		
Produkthaftung	X							X		
<b>IT-Risiken</b>										
Datensicherheit			X				X			

## Prognosebericht

Nach Aussage der „Gemeinschaftsdiagnose Herbst 2014“ führender deutscher Wirtschaftsforschungsinstitute hat der globale Aufschwung leicht an Fahrt verloren und die Weltwirtschaft expandierte im vergangenen Jahr nur mit mäßigem Tempo. Für die kommenden Quartale wird ein verbessertes konjunkturelles Umfeld und damit mehr Wachstum prognostiziert. Nachdem die Weltwirtschaft im Jahr 2014 voraussichtlich um 3,4% zulegen konnte, wird für 2015 eine leichte Beschleunigung auf 3,7% angenommen (Institut für Weltwirtschaft, Kiel). Ein wichtiger Teil des Aufschwungs wird aus den fortgeschrittenen Volkswirtschaften stammen, wobei hier weiterhin die Dynamik zwischen einzelnen Ländern und Regionen sehr unterschiedlich ist. Die USA werden mit einem erwarteten Plus von 3,2% auch im Jahr 2015 das stärkste Wachstum in den fortgeschrittenen Volkswirtschaften aufweisen können.

Im Vergleich dazu wird für den gesamten Euroraum ein Wachstum von mäßigen 1,2% für 2015 vorhergesagt. Neben den langfristigen Folgen der Schuldenkrise und den Bemühungen zur Haushaltskonsolidierung, leidet Europa unter der geopolitischen Situation – insbesondere unter dem fortwährenden Russland-Ukraine-Konflikt. Insgesamt wird die konjunkturelle Dynamik in Europa vorerst moderat bleiben. Die seit längerer Zeit erwartete Belebung zeichnete sich bisher nicht ab, und die Wirtschaftsforschungsinstitute waren gezwungen, ihre Prognose schrittweise nach unten zu korrigieren. Insbesondere in Frankreich und Italien stehen nach Aussage des Herbstgutachtens 2014 die Indikatoren für die wirtschaftliche Zuversicht niedrig. Welchen langfristigen konjunkturellen Einfluss der gesunkene Ölpreis und die derzeitige Euroschwäche in Europa haben werden, bleibt abzuwarten. Negativ auswirken wird sich dagegen die erneut aufgeflamte Angst vor terroristischen Übergriffen.

Für Deutschland erwartet das Kieler Institut für Weltwirtschaft einen leichten Aufwärtstrend für die kommenden beiden Jahre. Für 2015 wird ein Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts um 1,7% und für 2016 ein Zuwachs von 1,9% prognostiziert. Dieser Aufschwung wird vor allem durch die Binnennachfrage, insbesondere durch den privaten Verbrauch, getrieben. Der Ölpreissturz bedingt bei vielen Haushalten, zumindest temporär, einen deutlichen Zuwachs an Kaufkraft. Daneben spielen das weiterhin günstige Finanzierungsumfeld und eine, unter anderem währungsbedingt, erwartete Belebung der Exporte eine wichtige Rolle.

### HALBLEITERINDUSTRIE

Der gesamte Halbleitermarkt ist im abgelaufenen Geschäftsjahr um 7,9% gewachsen. Das Gesamtvolumen wuchs von 315,0 Mrd. USD im Jahr 2013 auf rund 339,8 Mrd. USD im letzten Jahr (Quelle: Gartner, Januar 2015). Getragen wurde das Wachstum durch eine weiterhin starke Nachfrage nach DRAM-Speicherbausteinen. Hier hat sich der deutliche Nachfrageüberhang bei gleichzeitig stabilen Preisen bereits im Vorjahr positiv auf die Entwicklung des Halbleitermarktes ausgewirkt.

Für das Geschäftsjahr 2015 erwarten die Analysten von Gartner einen erneuten Anstieg der Nachfrage im Halbleitersegment. Der Markt soll um weitere 5,8% im Jahr 2015 wachsen. Die wesentlichen Wachstumstreiber werden weiterhin DRAM-Speicherelemente für Smartphones und Tablet-Computer sein. Der PC-Markt hat sich im Jahr 2014 wie erwartet verhalten entwickelt, zeigt aber nach einigen schwierigen Jahren eine deutliche Tendenz zur Stabilisierung.

Wie sich in den vergangenen Jahren gezeigt hat, ist die Prognosegenauigkeit aufgrund der Besonderheiten und der ausgeprägten Zyklichkeit im Halbleiterbereich sehr begrenzt: so unterscheiden sich einige Schätzungen der Marktforschungsinstitute auch zum Jahresende 2014 deutlich von den eigenen Schätzungen im Vergleich zum Jahresanfang. Vor diesem Hintergrund stellen die nun folgenden Ausführungen Einschätzungen dar, die auf Basis der zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen wurden, aber keine Garantie für das tatsächliche Eintreten der Prognosen bieten.

### HALBLEITER-EQUIPMENT-INDUSTRIE

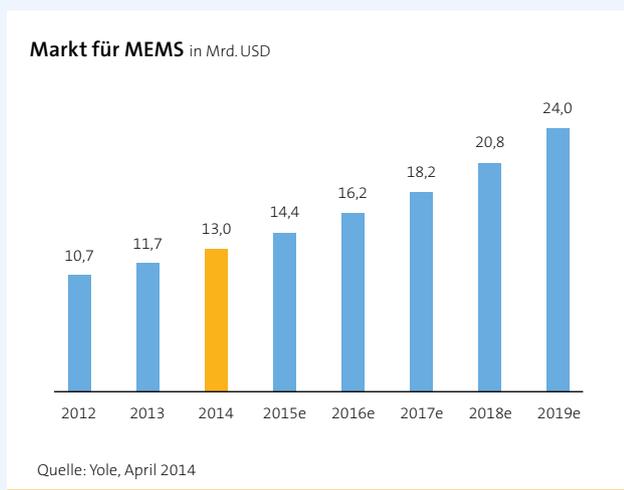
Nach einem deutlichen Rückgang im Jahr 2013 konnte der Halbleiter-Equipment-Markt im Geschäftsjahr 2014 erneut zulegen. Das gesamte Marktsegment ist von rund 31,82 Mrd. USD auf 37,97 Mrd. USD gewachsen, dies entspricht einem Plus von 19,3%. Die deutlichste Erholung zeigten der US-amerikanische Equipment-Markt mit einem Plus von mehr als 57% sowie der europäische Markt mit einem Plus von 38%. Für 2015 erwartet der Branchenverband SEMI ein weiteres Wachstum um rund 15%. Ein erheblicher Anteil der Nachfrage wird weiterhin aus Taiwan, Südkorea und der Region Nordamerika kommen.

## ERWARTETE ENTWICKLUNG IN DEN HAUPTMÄRKTEN

### MIKROSYSTEMTECHNIK (MEMS)

Der Markt für Mikrosystemtechnik hat sich in den vergangenen Jahren sehr dynamisch entwickelt und wird auch in Zukunft weiter mit großen Schritten wachsen, zumindest wenn man das Stückzahlenwachstum betrachtet. Die Marktforscher von Yole erwarten beispielsweise ein durchschnittliches jährliches Stückzahlenwachstum (CAGR) im MEMS-Segment von 20% bis 2019. Dagegen steht jedoch der prognostizierte Preisdruck, welcher nach Schätzungen von Yole pro Jahr rund 7% betragen wird. Daraus folgt ein MEMS-Marktwachstum bis 2019 von rund 13% jährlich. Die am stärksten wachsenden Segmente werden voraussichtlich die Bereiche Konsumelektronik und Medizintechnik sein.

Analysiert man die Auswirkungen dieser Entwicklung nun für die Hersteller von Equipment, so wird deutlich, dass das Wachstum für die Maschinenbauer – und damit auch für SÜSS MicroTec – hinter den 13% des Marktwachstums zurück bleiben wird. Die Hauptgründe hierfür sind der Preisdruck, welcher von den MEMS-Herstellern weitergereicht wird und zum anderen die stetig geforderten Verbesserungen an den Maschinen, um den Durchsatz und die Ausbeute zu erhöhen. Der MEMS-Markt wird auch in Zukunft ein sehr attraktives Geschäftsfeld für SÜSS MicroTec sein, aber die großen Wachstumsraten wie bei der MEMS-Stückzahl, werden im Equipment-Markt nicht erreicht werden.

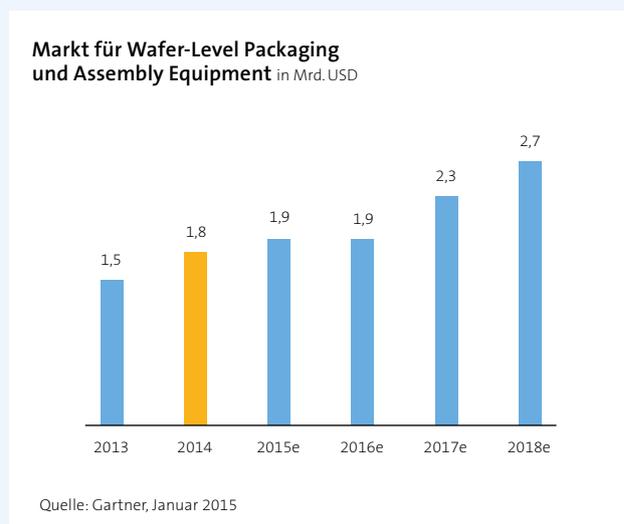


### ADVANCED PACKAGING UND 3D-INTEGRATION

Unter dem Begriff Advanced Packaging subsumiert man heute verschiedene Technologien, wie beispielsweise das Wafer-Level Packaging WLP, bei dem die jeweilige Kontaktierung bereits stattfindet, während die einzelnen Chips sich noch auf dem Wafer befinden. Dazu gibt es die Unterformen fan-in und fan-out WLP, Flip Chip-Bonding, Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging sowie die 2,5D-Integration und die 3D-Integration. SÜSS MicroTec ist insbesondere mit seinen Lithografie- und Temporary Bonding-Lösungen in diesem Feld aktiv.

Neben kürzeren Verbindungswegen und einer höheren Verbindungsgeschwindigkeit ist ein weiterer Vorteil der geringere Platzbedarf, welcher bei Smartphones, Tablet-Computern, Ultrabooks und Smart Watches eine wichtige Rolle spielt. Ohne Advanced Packaging-Technologien könnten darüber hinaus die schlanken Formfaktoren vieler moderner Endgeräte nicht dargestellt werden.

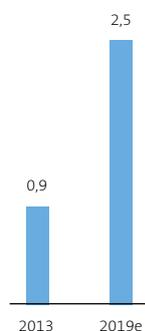
Laut einer Analyse des Marktforschungsinstituts Gartner ist der Markt für Wafer-Level-Packaging und Assembly Equipment im Jahr 2014 um 19,4% auf rund 1,8 Mrd. USD gewachsen. In einer Studie vom Januar 2015 erwartet Gartner für 2015 ein abgeschwächtes Wachstum in Höhe von 8,9% auf ein Gesamtvolumen von rund 1,9 Mrd. USD, für 2016 wird ein leicht rückläufiges Marktvolumen prognostiziert.



Die 3D-Integration ist eine Weiterführung der heute im Volumen eingesetzten Advanced Packaging-Technologien, hierbei werden gedünnte Mikrochips übereinander gestapelt und durch sogenannte TSV (Thru Silicon Vias) miteinander verbunden. Die entscheidenden Vorteile sind die hohe Packungsdichte und die enorme Komplexität, die auf kleinstem Raum erreicht werden kann. Durch die 3D-Integration ist es zudem möglich, verschiedene Funktionalitäten, wie beispielsweise Speicher und Prozessor, in einem Package zu vereinigen. Laut dem Marktforschungsinstitut Yole wird das Jahr 2015 eine besondere Bedeutung haben. So erwarten die Marktanalysten, dass in diesem Jahr erste Aufträge für den Übergang zur Volumenproduktion platziert werden könnten, nachdem im Jahr 2014 verschiedene Speicherchiphersteller den Einstieg in die Vorserienproduktion bzw. die Produktion von Prototypen bekannt gegeben haben. Als nächstes wird der Markteintritt der Hersteller von Logik-Bausteinen erwartet.

SÜSS MicroTec bietet mit seinen Lösungen zum Thin Wafer Handling, insbesondere zum temporären Bonden, eine Schlüsseltechnologie, die in der 3D-Integration flächendeckend eingesetzt wird. Das Unternehmen arbeitet kontinuierlich daran, die Technologie beziehungsweise die Prozesse so zu modifizieren, dass die Maschinen einen möglichst hohen Durchsatz bei gleichzeitig hoher Ausbeute erreichen. Die Wachstumsperspektive in dem Marktsegment Advanced Packaging und 3D-Integration ist mit einem erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstum von mehr als 20% besonders attraktiv.

**Markt für Equipment für 3D-IC und Wafer-Level Packaging** in Mrd. USD



Quelle: Yole, November 2014

## VERBINDUNGSHALBLEITER (LED)

Der Markt für Verbindungshalbleiter (LED) hat mit Ausnahme der Jahre 2010 und 2011 für SÜSS MicroTec immer eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Der Anteil am Gesamtumsatz des Unternehmens lag im Geschäftsjahr 2014 deutlich unter 10% und aus heutiger Sicht ist ein erneuter und nennenswerter Anstieg dieses Anteils nicht abzusehen. Der Hauptgrund hierfür liegt am gestiegenen Wettbewerb, insbesondere aus China. Hier können Equipment-Anbieter zu deutlich günstigeren Preisen als SÜSS MicroTec, eine für den LED-Markt ausreichende Qualität liefern. SÜSS MicroTec fokussiert sich auf technologisch anspruchsvolle Nischenmärkte, die deutlich weniger preissensitiv sind. Insgesamt erwartet das Marktforschungsinstitut Yole, dass der Equipment-Markt für LEDs in den Jahren 2015 und 2016 weiter wachsen wird, geht aber ab 2017 von einem deutlichen Rückgang des Marktvolumens für Equipment aus.

## ENDOGENE INDIKATOREN

Neben der Entwicklung in den Zielmärkten ist für den Geschäftserfolg das Innovationspotenzial entscheidend. SÜSS MicroTec ist auch im Geschäftsjahr 2014 wichtige Entwicklungskooperationen mit namhaften Partnern aus Industrie und Forschung eingegangen. Beispielhaft sei hier die Ausweitung des Joint Development Agreements mit IBM genannt, das wir in einer Pressemeldung im Januar 2014 vermeldet haben. Neben dem Innovationspotenzial ist die Kundenzufriedenheit ein weiterer Erfolgsfaktor. Aufgrund der außerordentlichen Leistungen der SÜSS MicroTec-Mitarbeiter konnte das Unternehmen auch im Geschäftsjahr 2014 wichtige Aufträge von asiatischen Packaging-Häusern sowie eine Auszeichnung zum Preferred Supplier der Firma NANIUM erhalten.

Produktseitig konnten wir im Geschäftsjahr 2014 wichtige neue Produktgenerationen von SÜSS MicroTec Photonic Systems in den Markt einführen. Dazu gehört der Launch der zweiten Generation des Projektionsscanners DSC300. Ausgestattet mit einer Vollfeldmaske und einer Breitbandprojektionsoptik belichtet der Scanner den Wafer in einem Belichtungsschritt (scan). In das Design des Maskenlayouts lassen sich bereits zusätzliche Funktionen wie die Belichtung der Ränder integrieren – ein wichtiger Schritt vor der Durchführung weiterer Prozessschritte. Die zweite Generation von Projektionsscannern enthält Verbesserungen und Neuerungen, um die Anforderungen fortschrittlicher Advanced Packaging-Technologien, wie beispielsweise Cu-Pillar-Bumping und Wafer-Level-Chip-Scale-Packaging (WLCSP), im Hinblick auf Overlay, Auflösung und Automatisierung zu erfüllen. Mit der DSC300 Gen2 und dem Mask Aligner MA300 Gen2 bietet SÜSS MicroTec nunmehr zwei komplementäre Lithografielösungen an, welche dem Kunden eine Optimierung von Preis und Leistung ermöglichen.

Einer unserer wichtigsten Zielmärkte, die Wafer-Level-Packaging-Industrie, ist seit langem auf der Suche nach alternativen Technologien zur Herstellung von Vias, die die Fertigung von leistungsfähigeren Packages ermöglichen. Mit der Markteinführung des Excimer Laser Steppers ELP300 adressiert SÜSS MicroTec diese Anforderungen, denn bei der Excimer Laser Ablation können organische Polymere eingesetzt werden, welche Vorteile im Hinblick auf ihre mechanischen, physikalischen, thermischen und chemischen Eigenschaften aufweisen. Das Unternehmen verspricht sich von diesen beiden Technologien zukünftig ein nicht unbeträchtliches Wachstumspotenzial.

Im Verlauf des Jahres 2014 wurden weitere wichtige Produktneuerungen in den Markt eingeführt, dazu gehören zwei neue Generationen von Mask Alignern, die MA200 GEN und die MA12. Im Segment Substrat Bonder wurde dem Markt mit dem ELD 300 ein neuartiger Laser Debonder für die 3D-Integration vorgestellt. Darüber hinaus wurde mit der SB6/8 Gen2 im Herbst 2014 ein neuer halbautomatischer permanenter Wafer Bonder in den Markt eingeführt.

Im Geschäftsjahr 2014 wurde auf der Produktseite viel erreicht, aber ohne den Einsatz und die Schaffenskraft der Mitarbeiter an allen Standorten wären diese Leistungen nicht möglich gewesen. Erst der persönliche Einsatz jedes einzelnen Mitarbeiters macht das Unternehmen zu dem, was es ist: ein führender Anbieter für Produkte und Lösungen in der Halbleiter- und halbleiternahen Industrie.

## **GESAMTAUSSAGE ZUR VORAUSSICHTLICHEN ENTWICKLUNG DES KONZERNS – AUSBLICK 2015**

Aufgrund des Auftragsbestands zum Jahresende 2014 und der erwarteten Auftragseingangsentwicklung für das erste Halbjahr 2015 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr in der Bandbreite zwischen 130 Mio. € und 140 Mio. € sowie ein ausgeglichenes Ergebnis (EBIT). Ein wesentlicher Grund für die erwartete Verringerung des Ergebnisses gegenüber 2014 sind die deutlich erhöhten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung. Für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2015 wird ein Auftragseingang in Höhe von 25 bis 35 Mio. € erwartet. Wir gehen davon aus, dass der Auftragseingang für das gesamte Jahr 2015 in etwa das gleiche Niveau erreichen wird wie im abgelaufenen Geschäftsjahr. Der Free Cashflow 2015 wird voraussichtlich leicht negativ sein.

Das Segment Lithografie wird im Geschäftsjahr 2015 erneut den größten Umsatz- und Ergebnisbeitrag für den Konzern liefern. Auf Basis des zum Jahresende 2014 gebuchten Auftragsbestands und der Auftragseingangserwartung für das erste Quartal 2015, rechnen wir gegenüber 2014 mit einem kaum veränderten bis leicht rückläufigen Umsatz. Aufgrund der erhöhten Aufwendungen für Forschung und Entwicklung gehen wir gegenüber Vorjahr von einem verringerten EBIT im einstelligen Millionenbereich aus. Im Segment Substrat Bonder erwarten wir einen Umsatzrückgang gegenüber Vorjahr, da durch die Refokussierung im Bereich permanentes Bonden die Produktlinie Permanente-Bond-Cluster eingestellt wurde. Das Ergebnis wird sich voraussichtlich im negativen mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich bewegen. Die Umsätze des Segments Fotomasken Equipment werden im kommenden Jahr erwartungsgemäß auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr liegen, dabei wird das Segment ein positives EBIT ausweisen. Am Ziel, das organische Wachstum unseres Basisgeschäfts ohne zusätzliche Fremdmittel bestreiten zu können, halten wir weiterhin fest.

## ZUKUNFTSGERICHTETE ANGABEN

Dieser Bericht enthält Angaben und Prognosen, die sich auf zukünftige Entwicklungen des SÜSS MicroTec-Konzerns und seiner Gesellschaften beziehen. Die Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum derzeitigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zu Grunde gelegten Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie die im Risikobericht angesprochenen – eintreten, so können die tatsächlichen Ergebnisse von den derzeit erwarteten Ergebnissen abweichen.

Garching, 10. März 2015



**Michael Knopp**  
Finanzvorstand  
(Vorstandssprecher)



**Walter Braun**  
Produktionsvorstand

# KONZERN- ABSCHLUSS NACH IFRS

*der SÜSS-MicroTec AG  
für das Geschäftsjahr 2014*

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)	66
Gesamtergebnisrechnung (IFRS)	67
Konzernbilanz (IFRS)	68
Konzernkapitalflussrechnung (IFRS)	70
Konzernerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)	72
Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2014	74
Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens 2013	76
Segmentberichterstattung (IFRS)	78
<b>Anhang zum IFRS-Konzernabschluss</b>	<b>80</b>
Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung	90
Erläuterungen zu den Aktiva	97
Erläuterungen zu den Passiva	100
Sonstige Angaben	108
<b>Versicherung der gesetzlichen Vertreter</b>	<b>121</b>
<b>Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers</b>	<b>122</b>
<b>Glossar</b>	<b>123</b>
<b>Finanzkalender / Impressum</b>	<b>128</b>

---

---

## Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS)

in Tsd. €	Anhang	01.01.2014–31.12.2014	01.01.2013–31.12.2013
Umsatzerlöse	(3)	145.331	134.508
Umsatzkosten	(4)	-96.519	-112.724
<b>Bruttoergebnis vom Umsatz</b>		<b>48.812</b>	<b>21.784</b>
Vertriebskosten		-17.520	-17.493
Forschungs- und Entwicklungskosten		-10.490	-10.186
Verwaltungskosten		-14.189	-14.976
Sonstige betriebliche Erträge	(5)	4.478	5.501
Sonstige betriebliche Aufwendungen	(6)	-2.695	-4.053
<b>Analyse des operativen Ergebnisses (EBIT)</b>			
EBITDA (Earnings before Interest and Taxes, Depreciation and Amortization)		12.645	-13.400
Abschreibungen auf Sachanlagen, immaterielle Vermögenswerte und Finanzanlagen	(10)	-4.249	-6.023
<b>Operatives Ergebnis (EBIT)</b>		<b>8.396</b>	<b>-19.423</b>
Finanzerträge		349	464
Finanzaufwendungen		-545	-597
<b>Finanzergebnis</b>	<b>(7)</b>	<b>-196</b>	<b>-133</b>
<b>Gewinn/Verlust vor Steuern</b>		<b>8.200</b>	<b>-19.556</b>
Ertragsteuern	(8)	-3.587	3.584
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>4.613</b>	<b>-15.972</b>
davon SÜSS MicroTec-Aktionäre		4.613	-15.972
davon nicht beherrschende Anteile		0	0
<b>Ergebnis je Aktie (unverwässert)</b>	<b>(9)</b>		
Ergebnis je Aktie in €		0,24	-0,84
<b>Ergebnis je Aktie (verwässert)</b>	<b>(9)</b>		
Ergebnis je Aktie in €		0,24	-0,84

## Gesamtergebnisrechnung (IFRS)

in Tsd. €	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2013 – 31.12.2013
<b>Periodenergebnis</b>	<b>4.613</b>	<b>-15.972</b>
<b>Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden</b>		
Neubewertung leistungsorientierter Pensionspläne	-982	-89
Latente Steuern	199	6
<b>Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden</b>	<b>-783</b>	<b>-83</b>
<b>Posten die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden</b>		
Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	-19	-218
Fremdwährungsanpassung	2.918	-1.657
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-144	163
Latente Steuern	53	7
<b>Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden</b>	<b>2.808</b>	<b>-1.705</b>
<b>Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen</b>	<b>2.025</b>	<b>-1.788</b>
<b>Summe der in der Periode erfassten Erträge und Aufwendungen</b>	<b>6.638</b>	<b>-17.760</b>
davon SÜSS MicroTec-Aktionäre	6.638	-17.760
davon nicht beherrschende Anteile	0	0

## Konzernbilanz (IFRS)

<b>Aktiva</b> in Tsd. €	<b>Anhang</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>		<b>44.718</b>	<b>46.995</b>
Immaterielle Vermögenswerte	(11)	4.471	4.517
Geschäfts- oder Firmenwert	(12)	15.546	15.318
Sachanlagen	(13)	20.198	20.906
Steuererstattungsansprüche	(19)	50	65
Sonstige Vermögenswerte	(14)	563	522
Latente Steueransprüche	(8)	3.890	5.667
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>		<b>123.246</b>	<b>132.872</b>
Vorräte	(15)	58.883	71.133
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(16)	13.390	11.073
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	(17)	204	320
Wertpapiere	(18)	1.026	2.072
Steuererstattungsansprüche	(19)	725	721
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente		47.309	45.059
Sonstige Vermögenswerte	(20)	1.709	2.494
<b>Bilanzsumme</b>		<b>167.964</b>	<b>179.867</b>

<b>Passiva</b> in Tsd. €	<b>Anhang</b>	<b>31.12.2014</b>	<b>31.12.2013</b>
<b>Eigenkapital</b>		<b>116.070</b>	<b>109.432</b>
Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG		116.070	109.432
Gezeichnetes Kapital	(21)	19.116	19.116
Rücklagen	(21)	98.584	93.971
Kumuliertes übriges Eigenkapital	(21)	-1.630	-3.655
<b>Langfristige Schulden</b>		<b>13.929</b>	<b>14.613</b>
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	(22)	4.751	3.760
Rückstellungen	(23)	29	62
Finanzschulden	(24)	9.100	10.280
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(25)	49	496
Latente Steuerschulden	(8)	0	15
<b>Kurzfristige Schulden</b>		<b>37.965</b>	<b>55.822</b>
Rückstellungen	(26)	3.238	5.939
Steuerschulden	(29)	1.495	651
Finanzschulden	(24)	1.187	1.191
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	(27)	5.807	6.366
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.446	5.563
Sonstige Verbindlichkeiten	(28)	22.792	36.112
<b>Bilanzsumme</b>		<b>167.964</b>	<b>179.867</b>

## Konzernkapitalflussrechnung

in Tsd. €	01.01.2014–31.12.2014	01.01.2013–31.12.2013
Gewinn /Verlust (nach Steuern)	4.613	-15.972
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte	1.515	3.464
Abschreibungen auf Sachanlagen	2.734	2.558
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen	6	68
Ergebnis aus dem Abgang von Wertpapieren	0	8
Veränderung der Wertberichtigung auf das Vorratsvermögen	-177	10.465
Veränderung der Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.493	1.198
Zahlungsunwirksame Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-512	-10
Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen	-340	1.531
Veränderung des Vorratsvermögens	14.030	-145
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	362	8.187
Veränderung der übrigen Vermögenswerte	860	-293
Veränderung der Pensionsrückstellungen	991	-359
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.199	-900
Veränderung der erhaltenen Anzahlungen	-13.110	13.575
Veränderung der übrigen Verbindlichkeiten und Rückstellungen	-4.521	-2.339
Veränderung der Steuerforderungen und Steuerverbindlichkeiten	2.324	-4.729
<b>Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>5.083</b>	<b>16.307</b>

in Tsd. €	01.01.2014 – 31.12.2014	01.01.2013 – 31.12.2013
Auszahlungen für den Kauf der Immobilie Garching (Grundstück und Gebäude)	0	-8.939 <sup>1</sup>
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagen	-1.766	-2.679
Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögenswerte	-1.190	-588
Einzahlungen aus Einlösung von zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren	1.028	9.097
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.928</b>	<b>-3.109</b>
Aufnahme von Bankdarlehen	0	7.500
Tilgung von Bankdarlehen	-1.180	-180
Veränderung von Kontokorrentverbindlichkeiten	0	-97
Veränderung der übrigen Finanzverbindlichkeiten	-4	-21
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.184</b>	<b>7.202</b>
Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	279	-533
<b>Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente</b>	<b>2.250</b>	<b>19.867</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Jahresanfang</b>	<b>45.059</b>	<b>25.192</b>
<b>Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente zum Ende der Periode</b>	<b>47.309</b>	<b>45.059</b>
Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit enthält		
Zinszahlungen während der Periode	427	189
Zinseinnahmen während der Periode	309	592
Steuerzahlungen während der Periode	1.179	1.146
Steuererstattungen während der Periode	63	41

<sup>1</sup> In dem Betrag 2013 sind neben dem Kaufpreis von 8.600 Tsd. € Erwerbsnebenkosten von 339 Tsd. € enthalten.

## Konzerneigenkapital-Veränderungsrechnung (IFRS)

in Tsd. €	Gezeichnetes Kapital	Kapitalrücklage	Gewinnrücklage	Bilanzgewinn / Verlust
<b>Stand 01.01.2013</b>	<b>19.116</b>	<b>97.614</b>	<b>433</b>	<b>11.896</b>
Periodenergebnis				-15.972
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen				
Gesamtergebnis				-15.972
<b>Stand 31.12.2013</b>	<b>19.116</b>	<b>97.614</b>	<b>433</b>	<b>-4.076</b>
<b>Stand 01.01.2014</b>	<b>19.116</b>	<b>97.614</b>	<b>433</b>	<b>-4.076</b>
Periodenergebnis				4.613
Im Eigenkapital zu erfassende Erträge und Aufwendungen				
Gesamtergebnis				4.613
<b>Stand 31.12.2014</b>	<b>19.116</b>	<b>97.614</b>	<b>433</b>	<b>537</b>

Kumuliertes übriges Eigenkapital							Eigenkapital der Aktionäre der SÜSS MicroTec AG	Nicht beherrschende Anteile	Eigenkapital
Posten, die nicht aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden			Posten, die in späteren Perioden aufwands- oder ertragswirksam umgegliedert werden						
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	Latente Steuern	Fremdwährungsanpassungen	Absicherung künftiger Zahlungsströme	Marktwertänderungen der zur Veräußerung verfügbaren Wertpapiere	Latente Steuern				
<b>-1.242</b>	<b>327</b>	<b>-768</b>	<b>-505</b>	<b>248</b>	<b>73</b>	<b>127.192</b>	<b>0</b>	<b>127.192</b>	
						-15.972	0	-15.972	
-89	6	-1.657	163	-218	7	-1.788	0	-1.788	
-89	6	-1.657	163	-218	7	-17.760	0	-17.760	
<b>-1.331</b>	<b>333</b>	<b>-2.425</b>	<b>-342</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>109.432</b>	<b>0</b>	<b>109.432</b>	
<b>-1.331</b>	<b>333</b>	<b>-2.425</b>	<b>-342</b>	<b>30</b>	<b>80</b>	<b>109.432</b>	<b>0</b>	<b>109.432</b>	
						4.613		4.613	
-982	199	2.918	-144	-19	53	2.025		2.025	
-982	199	2.918	-144	-19	53	6.638	0	6.638	
<b>-2.313</b>	<b>532</b>	<b>493</b>	<b>-486</b>	<b>11</b>	<b>133</b>	<b>116.070</b>	<b>0</b>	<b>116.070</b>	

# Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

## Anlagespiegel 2014

Der Anlagespiegel ist Teil des Konzernanhangs.

in Tsd. €	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2014	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang
<b>I. Immaterielle Vermögenswerte</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	16.729	178	1.145	0	828
2. Entwicklungskosten	29.360	91	45	0	95
3. Aktivierte Leasinggegenstände					
Software	166	-1	0	0	0
4. Andere immaterielle Vermögenswerte	2.840	249	0	0	0
	<b>49.095</b>	<b>517</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>923</b>
<b>II. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>29.731</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.426</b>
<b>III. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	16.482	112	447	37	156
2. Technische Anlagen und Maschinen	8.767	313	569	0	4
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.887	85	734	14	307
4. Fahrzeuge	400	7	14	0	0
5. Anlagen im Bau	52	0	2	-52	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände					
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	0	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	610	43	0	0	52
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18	0	0	0	0
Fuhrpark	26	0	0	0	0
	<b>36.242</b>	<b>560</b>	<b>1.766</b>	<b>-1</b>	<b>519</b>
<b>IV. Finanzanlagen</b>					
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	143
	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>

	Kumulierte Abschreibungen						Restbuchwerte		
	31.12.2014	01.01.2014	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
	17.224	14.431	88	801	0	828	14.492	2.298	2.732
	29.401	28.567	91	456	0	95	29.019	793	382
	165	166	-1	0	0	0	165	0	0
	3.089	1.414	60	258	0	0	1.732	1.426	1.357
	<b>49.879</b>	<b>44.578</b>	<b>238</b>	<b>1.515</b>	<b>0</b>	<b>923</b>	<b>45.408</b>	<b>4.517</b>	<b>4.471</b>
	<b>25.533</b>	<b>14.413</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.426</b>	<b>9.987</b>	<b>15.318</b>	<b>15.546</b>
	16.922	2.019	57	617	0	156	2.537	14.463	14.385
	9.645	4.659	132	1.176	0	3	5.964	4.108	3.681
	10.413	7.660	57	917	0	302	8.332	2.227	2.081
	421	359	4	14	0	0	377	41	44
	2	0	0	0	0	0	0	52	2
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	601	607	43	3	0	52	601	3	0
	18	18	0	0	0	0	18	0	0
	26	14	0	7	0	0	21	12	5
	<b>38.048</b>	<b>15.336</b>	<b>293</b>	<b>2.734</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>17.850</b>	<b>20.906</b>	<b>20.198</b>
	2.120	2.263	0	0	0	143	2.120	0	0
	<b>2.120</b>	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143</b>	<b>2.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Entwicklung des Konzern-Anlagevermögens

## Anlagespiegel 2013

Der Anlagespiegel ist Teil des Konzernanhangs.

in Tsd. €	Historische Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten				
	01.01.2013	Währungs- differenz	Zugang aus Investitionen	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang
<b>I. Immaterielle Vermögenswerte</b>					
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.111	-83	526	0	825
2. Entwicklungskosten	29.329	-31	62	0	0
3. Aktivierte Leasinggegenstände	0	0	0	0	0
Software	3.168	-45	0	0	2.957
4. Andere immaterielle Vermögenswerte	2.922	-82	0	0	0
	<b>52.530</b>	<b>-241</b>	<b>588</b>	<b>0</b>	<b>3.782</b>
<b>II. Geschäfts- oder Firmenwert</b>	<b>34.231</b>	<b>-74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.426</b>
<b>III. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, Gebäude, Einbauten	7.852	-202	9.221	0	389
2. Technische Anlagen und Maschinen	7.280	-133	1.499	208	87
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.629	-137	814	0	1.419
4. Fahrzeuge	373	0	32	0	5
5. Anlagen im Bau	207	1	52	-208	0
6. Aktivierte Leasinggegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke, Gebäude, Einbauten	0	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen	725	-76	0	0	39
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	714	-7	0	0	689
Fuhrpark	33	-7	0	0	0
	<b>27.813</b>	<b>-561</b>	<b>11.618</b>	<b>0</b>	<b>2.628</b>
<b>IV. Finanzanlagen</b>					
Sonstige Finanzanlagen	2.263	0	0	0	0
	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kumulierte Abschreibungen							Restbuchwerte		
31.12.2013	01.01.2013	Währungs- differenz	Zugang	Umbuchungen/ Umgliederungen	Abgang	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	
16.729	14.448	-47	854	0	824	14.431	2.663	2.298	
29.360	26.331	-30	2.266	0	0	28.567	2.998	793	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
166	3.094	-45	74	0	2.957	166	74	0	
2.840	1.153	-10	271	0		1.414	1.769	1.426	
<b>49.095</b>	<b>45.026</b>	<b>-132</b>	<b>3.465</b>	<b>0</b>	<b>3.781</b>	<b>44.578</b>	<b>7.504</b>	<b>4.517</b>	
<b>29.731</b>	<b>18.837</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.426</b>	<b>14.413</b>	<b>15.394</b>	<b>15.318</b>	
16.482	1.977	-145	524	-1	336	2.019	5.875	14.463	
8.767	3.742	-65	1.064	1	83	4.659	3.538	4.108	
9.887	8.248	-114	936	0	1.410	7.660	2.381	2.227	
400	352	0	8	0	1	359	21	41	
52	0	0	0	0	0	0	207	52	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
610	705	-76	17	0	39	607	20	3	
18	712	-7	2	0	689	18	2	0	
26	9	-2	7	0	0	14	24	12	
<b>36.242</b>	<b>15.745</b>	<b>-409</b>	<b>2.558</b>	<b>0</b>	<b>2.558</b>	<b>15.336</b>	<b>12.068</b>	<b>20.906</b>	
2.263	2.263	0	0	0	0	2.263	0	0	
<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.263</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Segmentberichterstattung (IFRS) Segmentinformationen nach Geschäftsfeldern

Die Segmentberichterstattung ist Teil des Konzernanhangs.

in Tsd. €	Lithografie		Substrat Bonder	
	2014	2013	2014	2013
Außenumsatz	96.719	88.305	22.436	22.854
Innenumsatz	0	0	0	0
<b>Gesamter Umsatz</b>	<b>96.719</b>	<b>88.305</b>	<b>22.436</b>	<b>22.854</b>
Segmentergebnis (EBIT)	10.661	3.156	-2.435	-21.687
Ergebnis vor Steuern	10.618	2.821	-2.439	-21.689
Wesentliche nicht zahlungswirksame Aufwendungen (-)/Erträge (+)	-1.169	240	2.851	-12.019
Segmentvermögen	68.139	67.872	10.243	21.764
davon Geschäfts- oder Firmenwert	15.546	15.318	0	0
Nicht zugeordnetes Konzernvermögen				
<b>Konzernaktiva</b>				
Segmentschulden	-17.801	-23.567	-2.435	-13.445
Nicht zugeordnete Konzernschulden				
<b>Konzernschulden</b>				
Abschreibungen	1.979	2.093	349	2.098
davon planmäßig	1.979	2.093	349	942
davon außerplanmäßig	0	0	0	1.156
<b>Investitionen</b>	<b>979</b>	<b>523</b>	<b>178</b>	<b>98</b>
Mitarbeiter zum 31.12.	413	404	95	99

## Segmentinformationen nach Regionen

in Tsd. €	Umsatzerlöse		Investitionen		Vermögen (ohne Goodwill)	
	2014	2013	2014	2013	2014	2013
EMEA	42.740	41.258	2.708	11.925	76.649	86.526
Nordamerika	21.472	22.577	196	145	16.829	15.464
Japan	10.171	5.196	8	55	955	3.055
Sonstiges Asien	70.948	65.477	44	81	2.788	2.652
Konsolidierungseffekte	0	0	0	0	-278	-66
<b>Gesamt</b>	<b>145.331</b>	<b>134.508</b>	<b>2.956</b>	<b>12.206</b>	<b>96.943</b>	<b>107.631</b>

Fotomaschinen Equipment		Sonstige		Konsolidierungseffekte		Summe	
2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
20.763	18.438	5.413	4.911	–	–	145.331	134.508
0	0	4.979	5.870	-4.979	-5.870	0	0
<b>20.763</b>	<b>18.438</b>	<b>10.392</b>	<b>10.781</b>	<b>-4.979</b>	<b>-5.870</b>	<b>145.331</b>	<b>134.508</b>
4.707	1.557	-4.537	-2.449	–	–	8.396	-19.423
4.702	1.552	-4.681	-2.240	–	–	8.200	-19.556
415	-781	-1.190	-237	–	–	907	-12.797
12.673	12.518	21.434	20.795	–	–	112.489	122.949
0	0	0	0	–	–	15.546	15.318
						55.475	56.918
						<b>167.964</b>	<b>179.867</b>
-8.974	-8.880	-2.142	-2.287	–	–	-31.352	-48.179
						-20.542	-22.256
						<b>-51.894</b>	<b>-70.435</b>
168	299	1.753	1.533	–	–	4.249	6.023
168	299	1.753	1.533	–	–	4.249	4.867
0	0	0	0	–	–	0	1.156
<b>269</b>	<b>136</b>	<b>1.530</b>	<b>11.449</b>	<b>–</b>	<b>–</b>	<b>2.956</b>	<b>12.206</b>
97	100	54	52	–	–	659	655

# ANHANG ZUM IFRS-KONZERNABSCHLUSS

der SÜSS MicroTec AG für das Geschäftsjahr 2014

## (1) BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

Die SÜSS MicroTec AG (das „Unternehmen“ oder die „Gesellschaft“) mit Sitz in D-85748 Garching, Schleißheimer Str. 90, und ihre Tochtergesellschaften bilden einen international tätigen Konzern, der Produkte im Bereich der Mikrosystemtechnik und der Mikroelektronik fertigt und vertreibt. Die Produktion konzentriert sich auf die Standorte Garching und Sternenfels in Deutschland sowie Corona (seit März 2012) in den USA und Hauterive (Kanton Neuchâtel) in der Schweiz. Vertrieben werden die Produkte sowohl über die Produktionsstandorte selbst als auch zusätzlich über selbstständige Vertriebsgesellschaften in den USA, in Frankreich, Großbritannien, Japan, Singapur, Taiwan, China und Korea. In den Ländern, in denen der Konzern nicht selbst vertreten ist, wird der Vertrieb über Handelsvertretungen abgewickelt.

## (2) ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

### A) GRUNDLAGE DER DARSTELLUNG

Der vorliegende Konzernabschluss wurde nach den vom International Accounting Standards Board (IASB) verabschiedeten und veröffentlichten International Financial Reporting Standards (IFRS) sowie den zugehörigen Interpretationen des IFRS Interpretations Committee (IFRIC) aufgestellt, wie sie in der Europäischen Union verpflichtend anzuwenden sind. Die Anforderungen der IFRS wurden vollständig erfüllt und führen zur Vermittlung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des SÜSS MicroTec-Konzerns.

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht. Nach den Regelungen des Handelsgesetzbuches muss die Gesellschaft einen Konzernabschluss nach den Rechnungslegungsvorschriften des § 315a HGB aufstellen, da es sich bei der SÜSS MicroTec AG um ein kapitalmarktorientiertes Unternehmen handelt. Der Konzernlagebericht wurde nach den Vorschriften des § 315 HGB erstellt.

Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht zum 31. Dezember 2014 werden beim elektronischen Bundesanzeiger eingereicht und veröffentlicht.

### B) ERSTMALIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Die SÜSS MicroTec AG wendete im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 IFRS 10 „Consolidated Financial Statements“, IFRS 11 „Joint Arrangements“ und IFRS 12 „Disclosure of Interests in Other Entities“ erstmals an. Auch die Folgeänderungen zu IAS 27 (2011) „Separate Financial Statements“ und IAS 28 (2011) „Investments in Associates and Joint Ventures“ wurden im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 erstmals angewandt. IFRS 10 schafft eine einheitliche Definition für den Begriff „Beherrschung“ und damit eine einheitliche Grundlage für das Vorliegen einer Mutter-Tochter-Beziehung und die hiermit verbundene Abgrenzung des Konsolidierungskreises. IFRS 11 regelt die Bilanzierung von Sachverhalten, in denen ein Unternehmen gemeinschaftliche Führung (joint control) über ein Gemeinschaftsunternehmen (joint venture) oder eine gemeinschaftliche Tätigkeit (joint operation) ausübt. Aus IFRS 12 ergeben sich die Anhangangaben zu Unternehmensverbindungen im Konzernabschluss (neuer IFRS 10) und Joint Arrangements (neuer IFRS 11).

Im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 wendete die SÜSS MicroTec AG auch den ergänzten IAS 32 „Financial Instruments: Presentation“, den geänderten IAS 36 „Impairment of Assets“ und den geänderten IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ erstmalig an. Die Ergänzung zu IAS 32 regelt die Saldierung von Finanzinstrumenten. Die Änderungen zu IAS 36 betreffen Angaben zum erzielbaren Betrag bei nicht-finanziellen Vermögenswerten. Die Änderungen zu IAS 39 haben Novationen von Derivaten zum Inhalt.

Aus der erstmaligen Anwendung der genannten Standards haben sich keine wesentlichen Auswirkungen auf den Konzernabschluss ergeben.

## C) NICHT VORZEITIG ANGEWANDTE STANDARDS UND INTERPRETATIONEN

Das IASB hat die nachfolgend dargestellten Standards und Änderungen zu Standards herausgegeben, deren Anwendung noch die Übernahme in EU-Recht („Endorsement“) erfordert:

### *IFRS 9: „Financial Instruments“*

Im November 2009 veröffentlichte das IASB eine erste Fassung des neuen Standard IFRS 9 „Financial Instruments“ zur Klassifizierung und Bewertung von finanziellen Vermögenswerten. Nach mehreren Überarbeitungen und Änderungen hat das IASB die finale Fassung des Standards am 24. Juli 2014 veröffentlicht.

IFRS 9 „Financial Instruments“ enthält Vorschriften für den Ansatz, die Bewertung und Ausbuchung von Finanzinstrumenten sowie für die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen. Die bisher unter IAS 39 „Financial Instruments: Recognition and Measurement“ vorgenommene Bilanzierung von Finanzinstrumenten kann nun vollständig durch die Bilanzierung unter IFRS 9 ersetzt werden.

Die zentralen Anforderungen des finalen IFRS 9 lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Die Regelungen von IFRS 9 sehen im Vergleich zu IAS 39 ein neues Klassifizierungsmodell für finanzielle Vermögenswerte vor. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte richtet sich künftig nach drei Kategorien mit unterschiedlichen Wertmaßstäben und einer unterschiedlichen Erfassung von Wertänderungen.
- Für finanzielle Verbindlichkeiten wurden die bestehenden Vorschriften des IAS 39 weitgehend unverändert in IFRS 9 übernommen. Die einzig wesentliche Neuerung betrifft finanzielle Verbindlichkeiten in der Fair-Value-Option.
- IFRS 9 sieht drei Stufen vor, welche die Höhe der zu erfassenden Verluste und die Zinsvereinnahmung künftig bestimmen.
- Neben umfangreichen Übergangsvorschriften ist IFRS 9 auch mit umfangreichen Offenlegungsvorschriften sowohl bei Übergang als auch in der laufenden Anwendung verbunden.

Der neue IFRS 9 wird voraussichtlich für alle Geschäftsjahre anzuwenden sein, die am oder nach dem 1. Januar 2018 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards haben wird, sofern der Standard verabschiedet und von der EU in dieser Form übernommen wird.

### *IFRS 11: „Joint Arrangements“*

Am 6. Mai 2014 veröffentlichte das IASB Änderungen zum IFRS 11 „Joint Arrangements“ hinsichtlich der Bilanzierung eines Erwerbs von Anteilen an einer gemeinschaftlichen Tätigkeit, die einen Geschäftsbetrieb in Sinne des IFRS 3 „Unternehmenszusammenschlüsse“ darstellt. In solchen Fällen soll der Erwerber die Grundsätze für die Bilanzierung von Unternehmenszusammenschlüssen nach IFRS 3 anwenden. Zudem greifen auch in diesen Fällen die Angabepflichten des IFRS 3.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen. Eine frühere Anwendung ist zulässig.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung der Änderungen, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen werden, keine Auswirkungen.

### *IFRS 15: „Revenue from Contracts with Customers“*

Am 28. Mai 2014 veröffentlichte das IASB den neuen IFRS 15 „Revenue from Contracts with Customers“, der vorschreibt, wann und in welcher Höhe Erlöse zu erfassen sind. Der neue Standard fordert zudem zusätzliche informative Angaben zu Verträgen mit Kunden. IFRS 15 ist grundsätzlich auf alle Verträge mit Kunden anzuwenden. Eine Ausnahme bilden die folgenden Verträge:

- Leasingverhältnisse, die unter IAS 17 fallen;
- Finanzinstrumente und andere vertragliche Rechte und Pflichten, die unter IFRS 9, IFRS 10, IFRS 11, IAS 27 oder IAS 28 fallen;
- Versicherungsverträge im Anwendungsbereich von IFRS 4; und
- nicht-finanzielle Tauschgeschäfte zwischen Unternehmen derselben Branche, die darauf abzielen, Veräußerungen an Kunden oder potenzielle Kunden zu erleichtern.

Der neue Standard sieht im Gegensatz zu den aktuell gültigen Vorschriften ein einziges, prinzipienbasiertes fünfstufiges Modell vor, das auf alle Verträge mit Kunden anzuwenden ist.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2017 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG kann derzeit noch nicht abschließend beurteilen, welche Auswirkungen die Erstanwendung des Standards haben wird, sofern der Standard verabschiedet und von der EU in dieser Form übernommen wird.

### ***IAS 16 „Property, Plant and Equipment“ und IAS 38 „Intangible Assets“***

Am 12. Mai 2014 hat das IASB Änderungen an IAS 16 „Property, Plant and Equipment“ sowie an IAS 38 „Intangible Assets“ veröffentlicht. Mit den Änderungen wird klargestellt, dass umsatzbasierte Abschreibungsmethoden für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte grundsätzlich nicht sachgerecht sind.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung der Änderungen, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen werden, keine Auswirkungen.

### ***Amendments to IAS 1 – „Disclosure Initiative“***

Am 18. Dezember 2014 hat das IASB im Rahmen der „Disclosure Initiative“ Änderungen an IAS 1 veröffentlicht, die hinsichtlich der in IAS 1 geregelten Angabepflichten eine zu restriktive Auslegung des Standards verhindern und sachgerechte Ermessensentscheidungen ermöglichen sollen.

Die Änderungen sind für Geschäftsjahre anzuwenden, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung der Änderungen, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen werden, keine Auswirkungen.

### ***Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2012–2014***

Am 25. September 2014 veröffentlichte das IASB jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2012–2014. Die Änderungen sind verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2016 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung der Änderungen, sofern sie von der EU in dieser Form übernommen werden, keine Auswirkungen.

Die nachfolgend dargestellten neuen und geänderten Standards wurden bereits von der EU-Kommission in EU-Recht übernommen, sind jedoch im Geschäftsjahr 2014 noch nicht verpflichtend anzuwenden. Eine Anwendung der neuen und geänderten Standards ist ab den obligatorischen Erstanwendungszeitpunkten vorgesehen. Von einer vorzeitigen Anwendung der neuen und geänderten Standards wurde kein Gebrauch gemacht.

### ***IAS 19 „Employee Benefits“***

Am 21. November 2013 veröffentlichte das IASB Änderungen an IAS 19 „Employee Benefits“, mit denen klargestellt wird, wie Arbeitnehmerbeiträge oder Beiträge Dritter zu leistungsorientierten Plänen zu bilanzieren sind.

Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 17. Dezember 2014 wurde die Verordnung Nr. 2015/29 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten Änderungen an IAS 19 übernommen wurden.

Der geänderte IAS 19 ist verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

### ***Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2011–2013***

Am 12. Dezember 2013 veröffentlichte das IASB jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2011–2013. Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 18. Dezember 2014 wurde die Verordnung Nr. 1361/2014 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten jährlichen Verbesserungen übernommen wurden. Die Änderungen sind verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

### ***Jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2010–2012***

Am 12. Dezember 2013 veröffentlichte das IASB jährliche Verbesserungen der IFRS – Zyklus 2010–2012. Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 17. Dezember 2014 wurde die Verordnung Nr. 2015/28 bekannt gemacht, mit der die vom IASB veröffentlichten jährlichen Verbesserungen übernommen wurden. Die Änderungen sind verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Juli 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

**IFRIC 21 „Abgaben“**

Am 20. Mai 2013 veröffentlichte das IASB den neuen IFRIC 21 „Abgaben“, der Regelungen zur Bilanzierung von Verpflichtungen zur Zahlung öffentlicher Abgaben beinhaltet, die keine Abgaben im Sinne des IAS 12 „Ertragsteuern“ darstellen. Im Amtsblatt der Europäischen Union vom 13. Juni 2014 wurde die Verordnung Nr. 634/2014 bekannt gemacht, mit der die Interpretation übernommen wurde. Die Änderungen sind verpflichtend anzuwenden auf Geschäftsjahre, die am oder nach dem 17. Juli 2014 beginnen.

Die SÜSS MicroTec AG erwartet aus der erstmaligen Anwendung keine Auswirkungen.

**D) WESENTLICHE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN**

Der Konzernabschluss erfüllt unter Beachtung der qualitativen Kriterien der Rechnungslegung sowie der anzuwendenden IFRS den Grundsatz des true and fair views sowie der fair presentation. Bei der Erstellung des IFRS-Konzernabschlusses wurden im Wesentlichen die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unverändert gegenüber Vorjahr angewendet.

**Geschäfts- oder Firmenwert**

Nach IFRS 3 wird der derivative Geschäfts- oder Firmenwert nicht planmäßig abgeschrieben, sondern wird einmal jährlich auf Wertminderung überprüft. Eine Überprüfung erfolgt auch, wenn Ereignisse oder Umstände (Triggering Events) eintreten, die auf eine mögliche Wertminderung hindeuten.

Die Überprüfung der Werthaltigkeit des Goodwills erfolgt auf der Ebene zahlungsmittelgenerierender Einheiten (Cash Generating Units), die im SÜSS MicroTec-Konzern den operativen Segmenten entsprechen.

Eine Wertminderung wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch den erzielbaren Betrag der jeweiligen Cash Generating Unit gedeckt sind. Der erzielbare Betrag ist der höhere der beiden Beträge aus beizulegendem Zeitwert abzüglich Verkaufskosten und Nutzungswert. Die SÜSS MicroTec AG hat im Berichtsjahr den erzielbaren Betrag der zahlungsmittelgenerierenden Einheiten auf der Basis des Nutzungswertes errechnet. Dieser Wert beruht grundsätzlich auf Bewertungen mittels diskontierter Mittelzuflüsse.

**Sonstige immaterielle Vermögenswerte**

Erworbene und selbst geschaffene immaterielle Vermögenswerte werden gemäß IAS 38 aktiviert, wenn es wahrscheinlich ist, dass mit der Nutzung des Vermögenswertes ein zukünftiger wirtschaftlicher Vorteil verbunden ist und die Kosten des Vermögenswertes zuverlässig bestimmt werden können. Sie werden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt und planmäßig linear über ihre jeweilige Nutzungsdauer, die maximal zehn Jahre beträgt, abgeschrieben.

Entwicklungskosten im Rahmen der Produktentwicklung werden zu Herstellungskosten aktiviert, soweit eine eindeutige Aufwandszuordnung möglich und sowohl technische Realisierbarkeit als auch erfolgreiche Vermarktung sichergestellt ist. Die Entwicklungstätigkeit muss ferner mit hinreichender Wahrscheinlichkeit einen künftigen wirtschaftlichen Nutzen erzeugen. Die aktivierten Entwicklungsleistungen umfassen alle direkt dem Entwicklungsprozess zurechenbaren Kosten einschließlich entwicklungsbezogener Gemeinkosten. Aktivierte Entwicklungskosten werden ab Produktionsstart planmäßig linear über den erwarteten Produktlebenszyklus von in der Regel drei bis fünf Jahren abgeschrieben.

Sonstige immaterielle Vermögenswerte mit einer unbestimmten Nutzungsdauer liegen in der SÜSS MicroTec-Gruppe nicht vor.

**Sachanlagen**

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bilanziert und nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungsdauern für die wesentlichen Anlagekategorien sind nachstehend wiedergegeben:

Gebäude, Einbauten	10 – 40 Jahre
Technische Anlagen und Maschinen	4 – 5 Jahre
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3 – 5 Jahre
Fahrzeuge	5 Jahre

Bei Anlagenabgängen werden die zugehörigen historischen Anschaffungskosten und kumulierten Abschreibungen ausgebucht und die Differenz zum Verkaufserlös als sonstiger betrieblicher Aufwand oder Ertrag erfasst.

Bei gemieteten Anlagegegenständen wird gemäß IAS 17 zwischen „Finance Lease“ und „Operating Lease“ unterschieden. Gegenstände des „Finance Lease“ werden unter Ansatz des Barwertes aller künftigen Mindestleasingzahlungen bei gleichzeitiger Passivierung der Leasingschuld aktiviert. Die aktivierten Gegenstände werden über ihre maßgebliche Nutzungsdauer abgeschrieben, die Leasingschuld wird gemäß den vertraglichen Bedingungen des Leasingvertrages getilgt und verzinst. Beim „Operating Lease“ erfolgt keine Aktivierung, sondern eine Erfassung der periodisierten Leasingzahlungen im Aufwand.

Eine Neubewertung der Sachanlagen gemäß den Regelungen des IAS 16 erfolgte nicht.

### *Wertminderungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen*

Eine Wertminderung auf immaterielle Vermögenswerte einschließlich des Geschäfts- oder Firmenwerts sowie auf Sachanlagen wird vorgenommen, sofern die Buchwerte der Vermögenswerte nicht mehr durch die zu erwartenden Veräußerungserlöse bzw. die diskontierten Netto-Cashflows aus der weiteren Nutzung gedeckt sind. Ist die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Die Zuordnung des Geschäfts- oder Firmenwerts erfolgt auf der Grundlage der Berichtseinheiten (Segmente).

Sofern in den Folgeperioden die Gründe für die Wertminderungen entfallen sind, werden Zuschreibungen vorgenommen. Die Zuschreibung erfolgt dabei höchstens auf den Betrag, der sich ohne die Vornahme der Wertminderung ergeben hätte. Eine Zuschreibung auf abgewertete Geschäfts- oder Firmenwerte erfolgt nicht.

### *Vorräte*

Die Vorräte werden zu Herstellungs- bzw. Anschaffungskosten oder zum niedrigeren Nettoveräußerungswert bewertet. Der Nettoveräußerungswert stellt dabei den voraussichtlich erzielbaren Verkaufserlös abzüglich der bis zum Verkauf noch anfallenden Kosten dar. Zudem werden Bestandsrisiken des Vorratsvermögens, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und technischen Risiken ergeben, durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Herstellungskosten der unfertigen bzw. fertigen Erzeugnisse beinhalten direkte Material- und Fertigungskosten sowie zurechenbare Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgt die Ermittlung der Anschaffungskosten auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnittswertes.

Bei Wegfall der Gründe, die zu einer Wertberichtigung der Vorräte geführt haben, wird eine entsprechende Wertaufholung vorgenommen.

### *Finanzinstrumente*

Finanzinstrumente sind Vertragsverhältnisse, die bei der einen Partei zu einem finanziellen Vermögenswert und bei der anderen Partei zu einer finanziellen Schuld oder zu einem Eigenkapitalinstrument führen. Diese werden in die Klassen „bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten“, „bewertet zu Marktwerten“ und in „Leasingverbindlichkeiten“ eingeteilt.

Das Unternehmen erfasst Finanzinstrumente in der Bilanz, sobald die SÜSS MicroTec-Gruppe Vertragspartner eines Finanzinstruments wird. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Marktwert. Die Folgebewertung finanzieller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten erfolgt entsprechend der Kategorie, der sie zugeordnet sind – den zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerten, den Krediten und Forderungen, den finanziellen Verbindlichkeiten oder den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten.

Die Kategorien „Held to Maturity“ sowie die „Fair Value Option“ werden nicht genutzt.

### *Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte*

Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie Kredite und Forderungen zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Es erfolgen angemessene Wertberichtigungen bei zweifelhaften und als uneinbringlich betrachteten Forderungen. Darüber hinaus werden Wertberichtigungen in Abhängigkeit von der Altersstruktur überfälliger Forderungen gebildet. Diese Wertminderungen werden auf separaten Wertberichtigungskonten erfasst.

### *Wertpapiere*

Wertpapiere werden als zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte klassifiziert, da sie nicht zu Spekulationszwecken gehalten werden. Sie werden zum beizulegenden Zeitwert bilanziert, sofern dieser verlässlich ermittelbar ist. Unrealisierte Gewinne und Verluste werden unter Berücksichtigung latenter Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

### **Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente**

Die Zahlungsmitteläquivalente umfassen alle liquiditätsnahen Vermögenswerte, die zum Zeitpunkt der Anschaffung bzw. der Anlage eine Restlaufzeit von weniger als drei Monate haben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden zu Anschaffungskosten bewertet.

### **Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

Die Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen wird gemäß IAS 19 („Employee Benefits“) bilanziert.

Beitragsorientierte Pläne („Defined Contribution Plans“) führen in der Regel nicht zu einer Rückstellungsbildung, da sich die Verpflichtung des Unternehmens auf die Zahlung von Beiträgen an den Versorgungsträger / Fonds beschränken. Die Prämienzahlungen an die Versorgungsträger / Fonds werden in der Periode ihres Anfalls als Aufwand erfasst.

Bei leistungsorientierten Plänen („Defined Benefit Plans“) besteht die Verpflichtung des Unternehmens in der Gewährung der zugesagten Leistungen an aktive und frühere Arbeitnehmer. Leistungsorientierte Pläne führen in der Regel zur Bildung von Pensionsrückstellungen.

Die Nettoschuld aus leistungsorientierten Versorgungsplänen (Barwert der leistungsorientierten Verpflichtung abzüglich bewertetem Planvermögen) wird mittels des Anwartschaftsbarwertverfahrens („Projected Unit Credit Method“) berechnet. Zukünftige Gehaltssteigerungen und sonstige Erhöhungen der Leistungen werden berücksichtigt. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgt auf Basis von Pensionsgutachten unter Einbeziehung der zur Deckung dieser Verpflichtungen bestehenden Vermögenswerte (zum beizulegenden Zeitwert bewertetes Planvermögen). Die Effekte aus der Neubewertung der Nettoschuld (versicherungsmathematische Gewinne und Verluste, Erträge aus dem Planvermögen sowie die Veränderungen in der Auswirkung der Vermögensobergrenze) werden in voller Höhe im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Im Fall künftiger Planänderungen wird der nachzuerrechnende Dienstzeitaufwand sofort ergebniswirksam erfasst.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen werden gemäß IAS 37 gebildet, wenn eine Verpflichtung gegenüber Dritten besteht, deren Inanspruchnahme wahrscheinlich und die voraussichtliche Höhe des notwendigen Rückstellungsbetrages zuverlässig schätzbar ist. Die Bewertung erfolgt zu Vollkosten. Langfristige Rückstellungen werden auf Grundlage angemessener Zinssätze mit ihrem auf den Bilanzstichtag abgezinsten Erfüllungsbetrag angesetzt.

### **Finanzschulden**

Die Finanzschulden umfassen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Verbindlichkeiten aus dem Finanzierungsleasing, die der Klasse „Leasingverbindlichkeiten“ zugeordnet sind, werden gemäß IAS 17 bewertet.

### **Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten**

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme der derivativen Finanzinstrumente der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

### **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen werden der Kategorie finanzielle Verbindlichkeiten zugeordnet und zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet.

### **Leasing**

Die Feststellung, ob eine Vereinbarung ein Leasingverhältnis enthält, wird auf Basis des wirtschaftlichen Gehalts der Vereinbarung zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung getroffen und erfordert eine Einschätzung, ob die Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung von der Nutzung eines bestimmten Vermögenswerts oder bestimmter Vermögenswerte abhängig ist und ob die Vereinbarung ein Recht auf die Nutzung des Vermögenswerts einräumt, selbst wenn dieses Recht in einer Vereinbarung nicht ausdrücklich festgelegt ist.

Bei Leasingvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden, gilt in Übereinstimmung mit den Übergangsvorschriften von IFRIC 4 der 1. Januar 2005 als Zeitpunkt des Abschlusses der Leasingvereinbarung.

Finanzierungs-Leasingverhältnisse, bei denen im Wesentlichen alle mit dem Eigentum verbundenen Chancen und Risiken am Leasinggegenstand auf den Konzern übertragen werden, führen zur Aktivierung des Leasinggegenstands zu Beginn der Laufzeit des Leasingverhältnisses. Der Leasinggegenstand wird mit seinem beizulegenden Zeitwert angesetzt oder mit dem Barwert der Mindestleasingzahlungen, sofern dieser Wert niedriger ist. Leasingzahlungen werden derart in Finanzierungsaufwendungen und den Tilgungsanteil der Restschuld aufgeteilt, dass sich über die Laufzeit des Leasingverhältnisses ein konstanter Zinssatz auf die verbliebene Leasingverbindlichkeit ergibt. Finanzierungsaufwendungen werden erfolgswirksam erfasst.

Leasinggegenstände werden über die Nutzungsdauer des Gegenstands beschrieben. Ist der Eigentumsübergang auf den Konzern am Ende der Laufzeit des Leasingverhältnisses jedoch nicht hinreichend sicher, wird der Leasinggegenstand über den kürzeren der beiden Zeiträume aus erwarteter Nutzungsdauer und Laufzeit des Leasingverhältnisses vollständig beschrieben. Leasingzahlungen für Operating-Leasingverhältnisse werden linear über die Laufzeit des Leasingverhältnisses als Aufwand für Operating-Leasingverhältnisse in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

#### ***Nicht fortgeführte Aktivitäten***

Nicht fortgeführte Aktivitäten werden ausgewiesen, sobald ein Unternehmensbestandteil mit Geschäftsaktivitäten und Cashflows, die operativ und für Zwecke der Rechnungslegung vom restlichen Unternehmen klar abgegrenzt werden können, als zur Veräußerung klassifiziert wird oder bereits abgegangen ist, und der Geschäftsbereich einen gesonderten wesentlichen Geschäftszweig darstellt.

#### ***Umsatzrealisierung***

Umsatzerlöse aus Maschinenverkäufen werden gemäß IAS 18 erfasst, wenn die Voraussetzungen zur Umsatzrealisierung erfüllt sind. Umsatzerlöse werden zum Zeitpunkt der Übertragung der maßgeblich mit dem Eigentum der verkauften Ware verbundenen Risiken und Chancen auf den Käufer realisiert, wenn es hinreichend wahrscheinlich ist, dass der Gesellschaft der wirtschaftliche Nutzen aus dem Verkauf zufließen wird. Die Höhe der erfassten Umsatzerlöse basiert auf den beizulegenden Zeitwerten der zu erhaltenen oder zu beanspruchenden Gegenleistung.

Kundenaufträge der Gesellschaft beinhalten in der Regel Installationsleistungen, die notwendig sind, um die verkaufte Maschine in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Aufgrund der Komplexität der Installationsvorgänge geht die Gesellschaft davon aus, dass signifikante Eigentumsrisiken bis zum Abschluss der Installation beim Unternehmen verbleiben. Daher wird bei Verträgen, bei denen neben der Lieferung einer Maschine auch die Installation und die Endabnahme mit dem Kunden vereinbart ist, der Umsatz erst realisiert, wenn Aufstellung und Montage erbracht sind, und die Endabnahme durch den Kunden erfolgt ist.

Umsätze aus Serviceleistungen werden bei erbrachter Leistung oder, bei vorhandenen Serviceverträgen, zeitanteilig realisiert. Im Fall von Ersatzteilverkäufen wird der Umsatz bei Lieferung realisiert.

#### ***Umsatzkosten***

Die Umsatzkosten umfassen die den Umsatzerlösen zuzuordnenden Herstellungs- und Beschaffungskosten der verkauften Erzeugnisse und Ersatzteile. Sie beinhalten neben den direkt zurechenbaren Material- und Fertigungseinzelkosten auch Gemeinkosten einschließlich der Abschreibungen auf die Produktionsanlagen und die immateriellen Vermögenswerte sowie die Abwertungen auf die Vorräte.

#### ***Forschungs- und Entwicklungskosten***

Aufwendungen für Forschung und nicht aktivierungsfähige Entwicklungen werden bei Entstehung als Aufwand erfasst.

#### ***Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge***

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge werden dem operativen Ergebnis zugeordnet und periodengerecht erfasst. Dies betrifft auch die Aufwendungen und Erträge aus der Fremdwährungsumrechnung.

#### ***Latente Steuern***

Latente Steueransprüche und -verbindlichkeiten werden entsprechend IAS 12 („Income Taxes“) für alle temporären Differenzen zwischen den steuerlichen Bemessungsgrundlagen der Vermögenswerte und Schulden und deren Wertansätzen in der IFRS-Konzernbilanz sowie auf steuerliche Verlustvorträge gebildet. Die latenten Steuern werden auf Basis der Steuersätze ermittelt, die nach der derzeitigen Rechtslage in den einzelnen Ländern zum Realisationszeitpunkt gelten bzw. erwartet werden. Latente Steueransprüche auf temporäre Differenzen bzw. Verlustvorträge werden nur dann angesetzt, sofern ihre Realisierbarkeit in näherer Zukunft hinreichend gesichert erscheint.

Auf temporäre Unterschiede beim Geschäfts- oder Firmenwert werden latente Steuern nur dann angesetzt, wenn die Abschreibungen auf derivative Geschäfts- oder Firmenwerte steuerlich geltend gemacht werden können.

#### ***Ergebnis pro Aktie (EPS – Earnings per Share)***

Die Gesellschaft berechnet das Ergebnis pro Aktie nach IAS 33 („Earnings per Share“).

Das unverwässerte Ergebnis pro Aktie (EPS) wird berechnet, indem das Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien dividiert wird.

Das verwässerte Ergebnis pro Aktie wird ermittelt, indem das bereinigte Jahresergebnis durch den gewichteten Durchschnitt der ausgegebenen Aktien zuzüglich der zu einer Verwässerung führenden Aktienäquivalente dividiert wird.

### *Derivative Finanzinstrumente*

Zur Absicherung von Währungs- und Zinsrisiken werden in der SÜSS MicroTec-Gruppe derivative Finanzinstrumente abgeschlossen.

Die Bilanzierung der derivativen Finanzinstrumente erfolgt gemäß IAS 39. Derivative Finanzinstrumente werden den zu Handelszwecken gehaltenen finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten zugeordnet, zum Marktwert bilanziert und unter den sonstigen kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten bzw. sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten ausgewiesen. Der erstmalige Ansatz erfolgt zum Handelstag. Marktwertänderungen werden entweder in der Gewinn- und Verlustrechnung oder, sofern es sich um einen Cashflow Hedge handelt, nach der Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital ausgewiesen.

### *Cashflow Hedges*

Der effektive Teil der Marktwertänderungen derivativer Instrumente, die als Cashflow Hedges bestimmt sind, wird nach Berücksichtigung von latenten Steuern im kumulierten übrigen Eigenkapital erfasst. Der ineffektive Teil wird sofort erfolgswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst.

### *Bilanzierung von Zuschüssen*

Zuwendungen aus der öffentlichen Hand werden gemäß IAS 20 („Accounting for Government Grants“) nur erfasst, wenn eine angemessene Sicherheit dafür besteht, dass die damit verbundenen Bedingungen erfüllt und die Zuwendungen gewährt werden. Sie werden erfolgswirksam behandelt und grundsätzlich in den Perioden verrechnet, in denen die Aufwendungen anfallen, die durch die Zuwendungen kompensiert werden sollen. Zuschüsse, die sich auf aktivierungsfähige Entwicklungskosten beziehen, werden von diesen abgesetzt.

### *Transaktionen in Fremdwährung*

Einkäufe und Verkäufe in Fremdwährungen werden mit dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Tageskurs umgerechnet. Vermögenswerte und Schulden in Fremdwährung werden mit dem geltenden Währungskurs am Bilanzstichtag in die funktionale Währung umgerechnet. Die aus diesen Umrechnungen entstandenen Fremdwährungsgewinne und -verluste werden ergebniswirksam erfasst.

## **E) VERWENDUNG VON SCHÄTZUNGEN**

Die Aufstellung eines Konzernabschlusses nach den IFRS verlangt Einschätzungen und Annahmen, die Einfluss auf den Ausweis von Vermögenswerten und Schulden, die Angabe von Eventualverbindlichkeiten zum Bilanzstichtag sowie den Ausweis von Erträgen und Aufwendungen haben. Die tatsächlichen Werte können in Einzelfällen von den getroffenen Annahmen und Schätzungen abweichen.

### *Forderungen aus Lieferungen und Leistungen*

Die Wertberichtigung zweifelhafter Forderungen umfasst in erheblichem Maß Einschätzungen und Beurteilungen einzelner Forderungen, die auf der Kreditwürdigkeit des jeweiligen Kunden, den aktuellen Konjunktorentwicklungen und der Analyse historischer Forderungsausfälle auf Portfoliobasis beruhen. Soweit das Unternehmen die Wertberichtigung aus historischen Ausfallraten auf Portfoliobasis ableitet, vermindert ein Rückgang des Forderungsvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt. Zum 31. Dezember 2014 betrug die gesamte Wertberichtigung auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 322 Tsd. € (Vorjahr: 1.815 Tsd. €).

### *Wertminderungen*

Die SÜSS MicroTec AG überprüft den Geschäfts- oder Firmenwert mindestens einmal jährlich auf mögliche Wertminderung. Die Bestimmung des erzielbaren Betrags einer Cash Generating Unit, der der Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet wurde, ist mit Schätzungen des Managements verbunden. Der erzielbare Betrag ist der höhere Wert aus dem beizulegenden Zeitwert, abzüglich der Verkaufskosten, und dem Nutzungswert. Die Gesellschaft bestimmt diese Werte grundsätzlich mit Bewertungsmethoden, die auf diskontierten Cashflows basieren. Diese diskontierten Cashflows werden für einen Fünf-Jahres-Zeitraum ermittelt. Dabei werden für die unmittelbare Zukunft die aus der Konzernplanung abgeleiteten Cashflows zugrunde gelegt. Für die über die Detailplanungsperiode hinausgehenden Cashflow-Prognosen werden geeignete Forecasts aus der Halbleiterzulieferindustrie herangezogen. Auf Basis dieser Forecasts wird für jedes Jahr des Betrachtungszeitraums eine Wachstumsrate ermittelt. Für den Fünf-Jahres-Zeitraum errechnet sich für die Cash Generating Unit Lithografie, der der bilanzierte Geschäfts- oder Firmenwert zugeordnet ist, ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 8,8% (Vorjahr: 9,7%). Die Diskontierung der prognostizierten Netto-Cashflows wird unter Nutzung eines risikoadjustierten Zinssatzes in Höhe von 9,5% (Vorjahr: 10,0%) durchgeführt. Diese Prämissen sowie die zugrundeliegende Methodik können einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung des Geschäfts- oder Firmenwerts haben.

Ist im Rahmen von Wertminderungstests bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten die Ermittlung des erzielbaren Betrags für einzelne Vermögenswerte nicht möglich, wird der Cashflow für die nächsthöhere Gruppierung von Vermögenswerten bestimmt, für die ein derartiger Cashflow ermittelt werden kann. Auch bei Sachanlagen oder sonstigen immateriellen Vermögenswerten ist die Bestimmung des erzielbaren Betrags der Vermögenswerte gleichermaßen mit Schätzungen des Managements verbunden, was einen erheblichen Einfluss auf die jeweiligen Werte und letztlich auf die Höhe einer möglichen Wertminderung haben kann.

### *Pensionen und ähnliche Verpflichtungen*

Verpflichtungen für Pensionen und damit zusammenhängende Aufwendungen und Erträge werden in Übereinstimmung mit versicherungsmathematischen Bewertungen ermittelt. Diese Bewertungen beruhen auf Schlüsselprämissen, darunter Abzinsungsfaktoren, die erwartete Rendite des Fondsvermögens, Gehaltstrends sowie Lebenserwartungen. Die angesetzten Abzinsungsfaktoren spiegeln die Zinssätze wider, die am Bilanzstichtag für hochwertige festverzinsliche Anlagen mit entsprechender Laufzeit erzielt werden.

Aufgrund schwankender Markt- und Wirtschaftslage können die zugrunde gelegten Prämissen von der tatsächlichen Entwicklung abweichen, was wesentliche Auswirkungen auf die Verpflichtungen für Pensionen haben kann.

### *Rückstellungen*

Die Bestimmung von Rückstellungen für vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche ist in erheblichem Maß mit Einschätzungen verbunden. Soweit das Unternehmen diese Rückstellungen aus historischen Garantie- und Gewährleistungsfällen ableitet, vermindert ein Rückgang des Umsatzvolumens solche Vorsorgen entsprechend und umgekehrt.

### *Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten*

Die sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert. Sie werden ausgebucht, wenn die vertraglichen Verpflichtungen erfüllt, aufgehoben oder ausgelaufen sind. Abhängig vom Inhalt der vertraglichen Vereinbarungen sind Schätzungen notwendig, um den wahrscheinlichen Erfüllungsbetrag zu bestimmen.

### *Purchase Price Allocation*

Bei Unternehmenserwerben nach IAS 27 (rev. 2008) und IFRS 3 (rev. 2008) ist der Kaufpreis für den Unternehmenserwerb auf die beim Kauf erworbenen identifizierbaren Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden vorzunehmen. Vermögenswerte, Schulden und Eventualschulden sind mit einzelnen Ausnahmen (z. B. Steuerschulden, Pensionsverpflichtungen, anteilsbasierte

Vergütungen) zum beizulegenden Zeitwert anzusetzen. Hierbei sind nicht nur bilanzierte Vermögenswerte zu berücksichtigen, sondern auch bislang nicht angesetzte immaterielle Vermögenswerte.

## F) KONSOLIDIERUNG

### *Konsolidierungsgrundsätze*

In den Konzernabschluss werden die Abschlüsse der SÜSS MicroTec AG und aller wesentlichen Gesellschaften, bei denen nach dem Control-Prinzip unabhängig von der Beteiligungshöhe die Beherrschungsmöglichkeit besteht, einbezogen. Bei einer Mehrheit der Stimmrechte wird grundsätzlich von der Kontrolle ausgegangen.

Forderungen und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen zwischen den in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen werden ebenso wie die Zwischenergebnisse eliminiert.

### *Umrechnung von Jahresabschlüssen in fremder Währung*

Die Darstellungswährung des Konzerns ist der Euro, die der funktionalen Währung der Muttergesellschaft entspricht. Alle Angaben erfolgen in Tausend Euro, sofern nichts anderes vermerkt ist.

Bilanzposten von Tochtergesellschaften, deren funktionale Währung die jeweilige lokale Währung ist, werden (mit Ausnahme des Eigenkapitals, das zu historischen Kursen umgerechnet wird) zum Kurs am Bilanzstichtag umgerechnet, die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung zu Durchschnittskursen.

	2014		2013	
	Bilanz	G & V	Bilanz	G & V
1 EUR vs. 1 USD	1,216	1,326	1,377	1,329
1 EUR vs. 1 JPY	145,040	140,805	144,510	128,878
1 EUR vs. 1 GBP	0,779	0,806	0,833	0,848
1 EUR vs. 1 CHF	1,202	1,214	1,227	1,227
1 EUR vs. 1 TWD	38,635	40,278	41,337	39,609
1 EUR vs. 1 SGD	1,606	1,683	1,739	1,663
1 EUR vs. 1 CNY	7,480	8,156	8,418	8,250
1 EUR vs. 1 KRW	1.336,150	1.397,795	1.463,890	1.456,471

Die resultierenden Umrechnungsdifferenzen werden als separate Komponente des Eigenkapitals (kumuliertes übriges Eigenkapital) ausgewiesen.

### Angaben zum Konsolidierungskreis

Im Vergleich zum Konzernabschluss zum 31. Dezember 2013 ergaben sich keine Veränderungen im Konsolidierungskreis.

In den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2014 werden demzufolge folgende Tochterunternehmen und Beteiligungen der SÜSS MicroTec AG (Konzernobergesellschaft) einbezogen (Angaben zu Kapital und Jahresergebnis der einzelnen Gesellschaften gemäß lokalem Recht und in lokaler Währung).

Gesellschaft/Sitz	Währung	gezeichnetes Kapital	Beteiligung	Eigenkapital	Jahresergebnis	Konsolidierung
SÜSS MicroTec AG, Garching <sup>1</sup>	EUR	19.115.538,00	Holding	86.220.048,68	-2.938.872,18	voll
SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching <sup>2</sup>	EUR	2.000.100,00	100%	49.495.358,10	8.768.881,85	voll
SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG, Sternenfels	EUR	3.000.000,00	100%	2.991.623,68	2.619.337,56	voll
SUSS MicroTec Photomask Equipment Beteiligungs GmbH, Sternenfels	EUR	25.000,00	100%	14.331,21	-1.553,92	voll
SUSS MicroTec Ltd., Coventry	GBP	10.000,00	100%	1.207.384,90	56.230,49	voll
SUSS MicroTec KK, Yokohama	JPY	30.000.000,00	100%	-522.151.046,00	-5.245.156,00	voll
SUSS MicroTec S.a.r.l., Pierre Bénite	EUR	114.750,00	100%	894.894,16	-68.400,00	voll
SUSS MicroOptics S.A., Hauterive	CHF	500.000,00	100%	8.426.256,39	310.920,20	voll
SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale	USD	4.197.000,00	100%	19.804.212,05	-357.857,87	voll
SUSS MicroTec (Taiwan) Company Ltd., Hsinchu	TWD	5.000.000,00	100%	182.946.723,00	44.803.088,00	voll
SUSS MicroTec Company Ltd., Shanghai	CNY	1.655.320,00	100%	37.607.948,80	5.430.357,55	voll
HUGLE Lithography Inc., San José <sup>3</sup>	USD	1.190.442,00	53,1%	-39.579,00	-2.063,00	at cost
SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleissheim <sup>2</sup>	EUR	25.564,59	100%	1.333.360,98	1.150.488,92	voll
SUSS MicroTec (Singapore) Pte Ltd., Singapur	SGD	25.000,00	100%	2.408.284,74	1.790.007,93	voll
SUSS MicroTec Korea Co. Ltd., Seoul	KRW	50.000.000,00	100%	2.846.586.944,00	762.073.723,00	voll
SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona	USD	10.400,00	100%	-9.795.262,20	-6.747.839,77	voll

<sup>1</sup> Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung der Ergebnisabführungsverträge mit der SUSS MicroTec Lithography GmbH und der SUSS MicroTec REMAN GmbH

<sup>2</sup> Eigenkapital und Jahresergebnis vor Berücksichtigung des Ergebnisabführungsvertrages mit der SÜSS MicroTec AG

<sup>3</sup> wegen Unwesentlichkeit keine Konsolidierung

Für alle einbezogenen Unternehmen liegen Abschlüsse zum 31. Dezember des jeweiligen Jahres zugrunde.

Von den inländischen Tochtergesellschaften in der Rechtsform der Kapitalgesellschaft haben die SUSS MicroTec Lithography GmbH, Garching, und die SUSS MicroTec REMAN GmbH, Oberschleissheim, die gemäß § 264 Abs. 3 HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

Die SUSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG (in der Rechtsform der Personengesellschaft) hat die gemäß § 264b HGB erforderlichen Bedingungen für die Inanspruchnahme der Befreiungsvorschrift erfüllt. Auf eine Offenlegung der Jahresabschlussunterlagen wird daher verzichtet.

## Erläuterungen zur IFRS-Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung

Die folgenden Erläuterungen zur Konzerngewinn- und Verlustrechnung beinhalten ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

### (3) UMSATZERLÖSE

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Maschinen	107.913	102.107
Ersatzteile und Upgrades	23.779	18.332
Serviceleistungen	8.467	9.481
Sonstige	5.172	4.588
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>145.331</b>	<b>134.508</b>

Hinsichtlich der Aufteilung der Umsatzerlöse auf Produktlinien und Regionen verweisen wir auf die Segmentberichterstattung. Die sonstigen Umsatzerlöse beinhalten Erlöse aus dem Bereich Mikrooptik.

### (4) UMSATZKOSTEN

In den Umsatzkosten sind insgesamt planmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen von 456 Tsd. € enthalten, die komplett auf das Segment Lithografie entfallen. Der zum 31. Dezember 2014 verbleibende Restbuchwert der aktivierten Entwicklungskosten in Höhe von 382 Tsd. € betrifft ebenfalls ausschließlich das Segment Lithografie.

Im Vorjahr waren in den Umsatzkosten insgesamt 1.110 Tsd. € planmäßige und 1.156 Tsd. € außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungsleistungen enthalten. Die planmäßigen Abschreibungen betrafen mit 552 Tsd. € Entwicklungsprojekte im Segment Lithografie und mit 558 Tsd. € das Segment Substrat Bonder. Die außerplanmäßigen Abschreibungen wurden vorgenommen auf Entwicklungsleistungen, die in der Vergangenheit im Zusammenhang mit der Produktlinie Permanent-Bond-Cluster aktiviert wurden.

In den Umsatzkosten des aktuellen Geschäftsjahres sind darüber hinaus planmäßige Abschreibungen auf die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von 258 Tsd. € (Vorjahr: 228 Tsd. €) enthalten. Diese Technologie weist zum 31. Dezember 2014 einen Restbuchwert von 1.357 Tsd. € auf. Im Vorjahr waren außerdem Abschreibungen auf die erworbene Technologie der SUSS MicroTec Photomask Equipment in Höhe von 43 Tsd. € in den Umsatzkosten erfasst. Die Technologie der SUSS MicroTec Photomask Equipment war bereits zum 31. Dezember 2013 komplett (planmäßig) abgeschrieben.

Des Weiteren sind in die Umsatzkosten Wertminderungen auf Lagerbestände (Demogeräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie fertige und unfertige Erzeugnisse) von 4.652 Tsd. € (Vorjahr: 17.194 Tsd. €) eingeflossen. Dabei entfallen 2.978 Tsd. € (Vorjahr: 4.161 Tsd. €) auf Bestände des Segments Lithografie und 1.447 Tsd. € (Vorjahr: 12.729 Tsd. €) auf Bestände des Segments Substrat Bonder. Die Bestände des Segments Fotomasken Equipment wurden um 227 Tsd. € (Vorjahr: 251 Tsd. €) abgewertet. Auf die Bestände des Segments Sonstiges entfallen im aktuellen Geschäftsjahr keine Abwertungen (Vorjahr: 52 Tsd. €). Im Vorjahr waren in den Abwertungen des Segments Lithografie außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 1.904 Tsd. € auf insgesamt vier Demonstrationsmaschinen der SUSS MicroTec Photonic Systems enthalten, die im Rahmen der Purchase Price Allocation in 2012 neu bewertet wurden. Die Wertminderungen des Segments Substrat Bonder enthielten im Vorjahr Sonderabwertungen in Höhe von 9.337 Tsd. €, die im Zusammenhang mit der Refokussierung der Permanent-Bond-Cluster-Systeme gebildet wurden.

## (5) SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	1.280	253
Fremdwährungsgewinne	1.265	2.127
Kommissionen	397	430
Reduzierung Earn-Out-Verpflichtung SÜSS MicroTec Photonic Systems	293	2.136
Kfz-Sachbezüge	245	274
Aktiviert Eigenleistungen	217	0
Erträge aus der Lagerung von Maschinen für Kunden	198	0
Auflösung von sonstigen Verpflichtungen	241	0
Rückstellungsaufösungen	0	10
Teilweise Auflösung der bedingten Kaufpreisverpflichtung aus dem Erwerb der SMO	82	0
Erträge aus dem Abgang der 10%-Beteiligung an Electron Mec	40	0
Erstattungen von Versicherungen	35	40
Sonstige Zuschüsse	31	130
Mieterträge	25	19
Auflösung Rückbauverpflichtung Reinraum Garching	0	75
Sonstiges	129	7
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.478</b>	<b>5.501</b>

Die Fremdwährungsgewinne entstanden im Wesentlichen aus verschiedenen Geschäftsvorfällen im operativen Bereich, die in Fremdwährung abgewickelt wurden (vorwiegend in US-Dollar und japanischen Yen) und durch die unterjährige Veränderung der Wechselkurse beeinflusst waren. Zudem sind hier Erträge aus der Stichtagsbewertung von konzerninternen Verrechnungskonten erfasst, die aus Sicht der bilanzierenden Gesellschaft in Fremdwährung bestehen.

Die Kommissionen wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt.

Die aktivierten Eigenleistungen betreffen Eigenleistungen im Zusammenhang mit der Erweiterung des konzernweiten SAP-Systems. Zum einen wurde in Deutschland ein Modul für Personalwirtschaft (Employee Self Service sowie Manager Self Service) eingeführt. Zum anderen ist geplant, bei SÜSS MicroTec Photonic Systems (Corona / USA) im Jahr 2015 SAP einzuführen. Darüber hinaus wurde ein neues Customer Relationship Management System eingeführt. Für alle drei Projekte wurden von Mitarbeitern der SÜSS MicroTec AG und der SÜSS MicroTec Lithography GmbH umfangreiche Eigenleistungen erbracht, die aktiviert wurden.

Die Erträge aus der Reduzierung der Earn-Out-Verpflichtung SÜSS MicroTec Photonic Systems resultieren aus einer komplett-Auflösung der bisher noch verbliebenen Earn-Out-Verpflichtung, die im Rahmen der Erstkonsolidierung der Tamarack Scientific Co., Inc. passiviert wurde. Auch im Vorjahr hat der Konzern bereits einen Ertrag aus der Auflösung eines Teilbetrags dieser Earn-Out-Rückstellung realisiert.

Im Vorjahr resultierten die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus der SÜSS MicroTec AG.

Aus dem Verkauf der 10%-Beteiligung an der Electron Mec S.r.l. mit Sitz in Mailand / Italien erzielte die SÜSS MicroTec Lithography GmbH einen Veräußerungserlös in Höhe von 40 Tsd. €. Die Beteiligung gehörte seit 1996 zur SÜSS MicroTec-Gruppe und war komplett wertberichtigt.

Die sonstigen Zuschüsse in Höhe von rund 30 Tsd. € wurden von unserer Tochtergesellschaft in China erzielt. Die Zuschüsse des Vorjahres betrafen mit rund 80 Tsd. € Zuschüsse des Kantons Neuchâtel, die der SÜSS MicroOptics gewährt wurden sowie mit rund 50 Tsd. € Zuschüsse an SÜSS MicroTec China.

## (6) SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Fremdwährungsverluste	2.021	1.485
Sonstige Steuern	546	391
Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen	44	1.451
Verluste aus Anlagenabgang	6	68
Vertragsstrafen	0	45
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Reduzierung der Niederlassung Japan	0	295
Aufwendungen für Earn-Out SUSS MicroTec Photonic Systems (vormals: Tamarack Scientific)	0	201
Sonstiges	78	117
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.695</b>	<b>4.053</b>

Die Fremdwährungsverluste entstanden – wie im Vorjahr – im Wesentlichen aus Bewertungsänderungen von Kundenforderungen in US-Dollar aufgrund unterjährig veränderter Wechselkurse sowie aus Bewertungsänderungen von konzerninternen Verrechnungskonten in Fremdwährung. 103 Tsd. € der Fremdwährungsverluste resultierten aus der Rückführung von konzerninternen Fremdwährungskrediten durch die SÜSS MicroTec AG gegenüber der SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale. Dieser Betrag wurde bis zur Rückführung der Kredite im sonstigen Ergebnis (OCI) erfasst.

Im Zusammenhang mit dem Erwerb der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. wurden einzelnen Mitarbeitern von SUSS MicroTec Photonic Systems erfolgsabhängige Vergütungen gewährt, die innerhalb der nächsten drei Jahre zur Auszahlung kommen sollen. Diese Earn-Out-Verbindlichkeiten gegenüber den Mitarbeitern wurden – im Gegensatz zu den Earn-Out-Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern – aufwandswirksam passiviert. Im Vorjahr wurden hierfür 201 Tsd. € als Aufwand erfasst. Eine Neubewertung der für den Earn-Out maßgeblichen Umsatzplanung der SUSS MicroTec Photonic Systems führte zu einer kompletten Auflösung der noch verbliebenen Earn-Out-Verbindlichkeiten. Somit wurden 2014 keine weiteren Aufwendungen im Zusammenhang mit der Earn-Out-Verpflichtung mehr erfasst.

Die Zuführungen zu Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen wurden im Wesentlichen von der SUSS MicroTec Lithography GmbH sowie von der SUSS MicroTec, Inc. gebildet. Von den Aufwendungen des Vorjahres für die Zuführung von Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen betrafen 490 Tsd. € Forderungen, die im Zusammenhang mit der Refokussierung des Bereichs Permanent-Bond-Cluster stehen. Weitere 645 Tsd. € resultierten aus Wertberichtigungen auf eine Kundenforderung der SUSS MicroTec Photomask Equipment. Die übrigen Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen wurden im Vorjahr im Wesentlichen von der SUSS MicroTec Lithography gebildet.

## (7) FINANZERGEBNIS

Das Finanzergebnis setzt sich aus Zinsaufwendungen und Zinserträgen sowie sonstigen Finanzaufwendungen und sonstigen Finanzerträgen zusammen.

Die Finanzerträge in Höhe von 349 Tsd. € (Vorjahr: 464 Tsd. €) resultieren im Wesentlichen aus Zinserträgen für Geldmarktanlagen sowie Wertpapieren.

Die Finanzaufwendungen setzen sich folgendermaßen zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Bankverbindlichkeiten	428	198
Avalprovisionen	37	37
Buchverluste aus der Einlösung von Wertpapieren	28	0
Aufzinsung von Rückstellungen	29	350
Sonstige Zins- und Finanzaufwendungen	23	12
<b>Finanzaufwendungen</b>	<b>545</b>	<b>597</b>

Die Zinsen für Bankverbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht und betrafen im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Grundstücksfinanzierungen Sternenfels (Darlehensstand zum 31. Dezember 2014: 3.780 Tsd. €) und Garching (Darlehensstand zum 31. Dezember 2014: 6.500 Tsd. €). Auf das Darlehen für die Grundstücksfinanzierung Sternenfels entfielen im Berichtsjahr 154 Tsd. € Zinsen (Vj. 161 Tsd. €). Das Darlehen für die Grundstücksfinanzierung Garching wurde im Dezember 2013 ausbezahlt und verursachte im Berichtsjahr Zinsaufwendungen in Höhe von 260 Tsd. € (Vj. 11 Tsd. €).

Die Zinsaufwendungen für die Aufzinsung von langfristigen Verbindlichkeiten resultieren aus der Barwertermittlung der Earn-Out-Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem Erwerb der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. sowie in geringem Umfang aus der Barwertermittlung der bedingten Kaufpreisverpflichtung für den Erwerb der verbleibenden Anteile an der SUSS MicroOptics.

## (8) ERTRAGSTEUERN

Der Steueraufwand und die Aufteilung in laufende und latente Steuern stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2014	2013
Laufender Steueraufwand	1.570	587
Latenter Steuerertrag (-)/-aufwand	2.017	-4.171
davon auf temporäre Differenzen	1.067	-886
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>3.587</b>	<b>-3.584</b>

Die folgende Tabelle zeigt eine Überleitungsrechnung vom im jeweiligen Geschäftsjahr erwarteten zum ausgewiesenen Steueraufwand.

in %	2014	2013
<b>Angenommener Steuersatz</b>		
Körperschaftsteuer	15,00	15,00
Solidaritätszuschlag	5,50	5,50
Gewerbesteuer	12,43	12,43
<b>Kombinierter Steuersatz</b>	<b>28,25</b>	<b>28,25</b>

in Tsd. €	2014	2013
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>8.200</b>	<b>-19.556</b>
<b>Erwartete Ertragsteuern</b>	<b>2.317</b>	<b>-5.525</b>
Abweichende Steuersätze im Ausland	-875	-1.216
Mindestbesteuerung	94	0
Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen und Kürzungen	13	33
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	181	195
Steueraufwand Vorjahre	111	-453
Veränderung der Wertberichtigung auf aktive latente Steuern	2.499	3.789
Inanspruchnahme wertberechtigter Verlustvorträge	-435	9
Steuerfreie Erträge	-292	-639
Sonstiges	-26	223
<b>Effektive Ertragsteuern</b>	<b>3.587</b>	<b>-3.584</b>

Die Gegenüberstellung der erwarteten zu den effektiven Ertragsteuern aus den fortgeführten Aktivitäten zeigt eine Abweichung von -1.270 Tsd. € (Vorjahr: -1.941 Tsd. €). Anstatt eines erwarteten Steueraufwands in Höhe von 2.317 Tsd. € ergab sich auf Konzernebene im Berichtsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 3.587 Tsd. €.

Im Berichtsjahr wurden zusätzliche Wertberichtigungen auf aktive latente Steuern in Höhe von 2.499 Tsd. € gebildet. Der größte Wertberichtigungsbedarf entstand bei den US-Gesellschaften SUSS MicroTec, Inc., Sunnyvale (Kalifornien/USA), und SUSS MicroTec Photonic Systems Inc., Corona (Kalifornien/USA). Die beiden US-Gesellschaften SUSS MicroTec, Inc. und SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bilden eine „Tax Group“, deren zu versteuerndes Einkommen in den USA der Gruppenbesteuerung unterliegt. Auf Basis der aktuellen Konzernplanung wird für die SUSS MicroTec Photonic Systems in den nächsten drei Jahren ein negatives Ergebnis erwartet. Grund für das negative Ergebnis ist vor allem die für 2015 erwartete geringe Rohertragsmarge sowie eine verhaltene Umsatzerwartung bis 2016. Das Ergebnis der SUSS MicroTec, Inc. wird ab dem kommenden Jahr voraussichtlich leicht positiv sein. Insgesamt wird die US-amerikanische Tax Group bis 2016 ein negatives Ergebnis erzielen, ab 2017 wird das Ergebnis in den USA voraussichtlich positiv sein.

Der positive Steuereffekt aus der Erzielung von steuerfreien Erträgen ist – wie auch im Vorjahr – im Wesentlichen auf die Erträge aus der Auflösung der noch verbliebenen Earn-Out-Verpflichtung zurückzuführen, die im Zuge der Neubeurteilung zum Jahresende erfasst wurden.

Der negative Effekt aus Steuern für Vorjahre resultiert im Wesentlichen aus der SÜSS MicroTec AG (Organträger) sowie aus SÜSS MicroTec Taiwan.

Aufgrund positiver Ergebnisse 2014 konnten SÜSS MicroTec Singapur und SÜSS MicroTec KK (Japan) Verlustvorträge in Anspruch nehmen, die im Vorjahr komplett wertberichtigt waren.

Es wurde keine Steuerabgrenzung auf nicht ausgeschüttete Gewinne von Tochtergesellschaften vorgenommen. Von einer Ermittlung der möglichen steuerlichen Auswirkungen wurde wegen des unverhältnismäßig hohen Aufwands abgesehen.

Die Abgrenzungsposten für latente Steuern ermitteln sich wie folgt:

in Tsd. €	Aktiva		Passiva	
	2014	2013	2014	2013
Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	57	555	0	0
Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.127	959	0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4	0	20	17
Langfristige Rückstellungen	11	9	3	3
Immaterielle Vermögenswerte	2.184	2.653	0	0
Sonstige kurzfristige Vermögenswerte	64	64	0	0
Finanzschulden	0	1	0	0
Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	2.064	2.064
Passiver Ausgleichsposten SMT Photomask Equipment	0	0	336	370
Vorräte	495	338	0	68
Sachanlagen	0	0	1	5
Sonstiges	134	315	96	0
Verlustvorträge	2.334	3.285	0	0
Saldierung	-2.520	-2.512	-2.520	-2.512
<b>Gesamt</b>	<b>3.890</b>	<b>5.667</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

Der Konzern verfügt über steuerliche Verlustvorträge in Höhe von 46.646 Tsd. € (Vorjahr: 43.907 Tsd. €). Davon verfallen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2022 insgesamt 4.589 Tsd. €. Im Zeitraum von 2028 bis 2034 verfallen insgesamt 32.911 Tsd. €. Verlustvorträge in Höhe von 9.146 Tsd. € sind unbegrenzt nutzbar.

Der Anstieg der Verlustvorträge im Vergleich zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus dem negativen Jahresergebnis der US-amerikanischen Tax Group der SÜSS MicroTec, Inc. und der SÜSS MicroTec Photonic Systems Inc. Zum 31. Dezember 2014 verfügt diese Tax Group in den USA über Verlustvorträge in Höhe von 40.003 Tsd. USD. Die Verlustvorträge in Deutschland haben sich hingegen durch das positive Ergebnis der Organisationsgesellschaften SÜSS MicroTec Lithography GmbH und SÜSS MicroTec REMAN GmbH sowie durch das ebenfalls positive Ergebnis der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG auf 8.263 Tsd. € (Vorjahr: 11.627 Tsd. €) reduziert.

Für Verlustvorträge in Höhe von 38.383 Tsd. € (Vorjahr: 32.280 Tsd. €) und temporäre Differenzen in Höhe von 10.031 Tsd. € (Vorjahr: 4.651 Tsd. €) wurden keine aktiven latenten Steuern angesetzt.

Nach IAS 12.74 f. ist eine Saldierung aktiver und passiver latenter Steuern vorzunehmen, wenn zum einen eine zivilrechtliche Aufrechnungslage gegeben ist, und zum anderen die latenten Steueransprüche und latenten Steuerschulden sich auf Ertragsteuern beziehen, die von der gleichen Steuerbehörde erhoben werden. Zum 31. Dezember 2014 wurden somit aktive und passive latente Steuern in Höhe von 2.520 Tsd. € (Vorjahr: 2.512 Tsd. €) saldiert.

## (9) ERGEBNIS JE AKTIE

Die folgende Tabelle zeigt die Ermittlung des unverwässerten und verwässerten Ergebnisses je Aktie.

in Tsd. €	2014	2013
Gewinn (Vorjahr: Verlust), der auf Aktionäre der SÜSS MicroTec AG entfällt	4.613	-15.972
Gewichteter Durchschnitt ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	19.115.538
Effekt aus der (potenziellen) Ausübung von Aktienoptionen (Stück)	0	0
Angepasste gewichtete durchschnittliche Anzahl ausstehender Aktien (Stück)	19.115.538	19.115.538
<b>Ergebnis je Aktie in € – unverwässert –</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,84</b>
<b>Ergebnis je Aktie in € – verwässert –</b>	<b>0,24</b>	<b>-0,84</b>

## (10) SONSTIGE ANGABEN ZUR IFRS-KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

### AUFWENDUNGEN FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

Neben den in der Gewinn- und Verlustrechnung explizit ausgewiesenen Aufwendungen für Forschung und Entwicklung sind im Geschäftsjahr auch Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten erfasst worden sowie in geringem Umfang Neu-Aktivierungen von Entwicklungskosten vorgenommen worden.

Die Netto-Investitionen und Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2014	2013
<b>Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen</b>	<b>10.490</b>	<b>10.186</b>
Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten	456	2.266
Neu-Aktivierungen von Entwicklungskosten	45	62
<b>Netto-Investitionen</b>	<b>-411</b>	<b>-2.204</b>

## PERSONALAUFWAND

In der Gewinn- und Verlustrechnung der SÜSS MicroTec-Gruppe sind im Folgenden dargestellte Personalaufwendungen in den verschiedenen Positionen enthalten:

in Tsd. €	2014	2013
Löhne und Gehälter	43.016	45.458
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	4.106	3.875
Aufwendungen für Altersvorsorge	2.749	3.028
<b>Personalaufwand</b>	<b>49.871</b>	<b>52.361</b>

In den Löhnen und Gehältern des Vorjahres waren Zuführungen zu den Earn-Out-Verbindlichkeiten für die Mitarbeiter der SÜSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von 201 Tsd. € enthalten.

Die sozialen Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung enthalten vor allem die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Berufsgenossenschaftsbeiträge.

Die Aufwendungen für Altersvorsorge beinhalten Pensionsaufwendungen aus betrieblichen Versorgungsplänen sowie Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung.

## MATERIALAUFWAND

Die Materialaufwendungen betragen im Geschäftsjahr 2014 54.851 Tsd. € (Vorjahr: 62.550 Tsd. €).

## ABSCHREIBUNGEN

Die Abschreibungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Immaterielle Vermögenswerte	1.515	3.465
Sachanlagen	2.734	2.558
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.249</b>	<b>6.023</b>

Im Geschäftsjahr wurden Konzessionen und gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten in Höhe von 801 Tsd. € (Vorjahr 854 Tsd. €) und aktivierte Entwicklungskosten in Höhe von 456 Tsd. € abgeschrieben. In den Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten des Vorjahres von 2.266 Tsd. € waren außerplanmäßige Abschreibungen auf aktivierte Entwicklungskosten des Segments Substrat Bonder in Höhe von 1.156 Tsd. € enthalten.

Im Vorjahr wurden letztmalig Abschreibungen auf die zum 1. Oktober 2009 an eine Leasinggesellschaft verkaufte und zurückgeleaste SAP-Software in Höhe von 74 Tsd. € vorgenommen. Damit endete der Leasingvertrag für die SAP-Software. Die SÜSS MicroTec AG erwarb im Januar 2013 die SAP-Software von der Leasinggesellschaft zurück. Der Kaufpreis betrug 228 Tsd. €.

Auf die im Rahmen der Unternehmensakquisition der SÜSS MicroTec Photomask Equipment erworbene Technologie wurden im Vorjahr letztmalig Abschreibungen in Höhe von 43 Tsd. € vorgenommen. Diese Technologie war somit bereits zum 31. Dezember 2013 komplett abgeschrieben. Die im Rahmen der Erstkonsolidierung der SÜSS MicroTec Photonic Systems angesetzte Technologie und weitere erworbene immaterielle Vermögenswerte wurden mit 258 Tsd. € (Vorjahr: 228 Tsd. €) abgeschrieben.

## Erläuterungen zu den Aktiva

Die folgenden Erläuterungen zur Konzernbilanz beinhalten für das Berichtsjahr ausschließlich die fortgeführten Aktivitäten des Konzerns. Alle Angaben erfolgen – soweit nichts anderes angegeben ist – in Tsd. €.

### (11) IMMATERIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den immateriellen Vermögenswerten werden zum Stichtag neben Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten in Höhe von 2.732 Tsd. € (Vorjahr: 2.298 Tsd. €) Entwicklungsleistungen von 382 Tsd. € (Vorjahr: 793 Tsd. €) und die erworbene Technologie der SÜSS MicroTec Photonic Systems von 1.357 Tsd. € (Vorjahr: 1.426 Tsd. €) ausgewiesen. Die Technologie wird planmäßig über acht Jahre abgeschrieben und weist eine verbleibende Restnutzungsdauer bis zum 31. März 2020 auf. In den Patenten, Lizenzen und ähnlichen Rechten ist das konzernweite SAP-System enthalten.

Die aktivierten Entwicklungsleistungen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Entwicklung neuer Maschinen. Der Restbuchwert zum 31. Dezember 2014 betrifft allein das Segment Lithografie.

Unter den anderen immateriellen Vermögenswerten wird die im Rahmen der Unternehmensakquisition der SÜSS MicroTec Photonic Systems erworbene Technologie mit einem Restbuchwert von 1.357 Tsd. € (Vorjahr: 1.426 Tsd. €) ausgewiesen. Da der Wert der Technologie in US-Dollar erfasst und fortgeführt wurde, wirkt die Veränderung des Umrechnungskurses des US-Dollar im Vergleich zum Euro zum 31. Dezember 2014 werterhöhend.

### (12) GESCHÄFTS- ODER FIRMENWERT

Der zum Bilanzstichtag ausgewiesene Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 15.546 Tsd. € (Vorjahr: 15.318 Tsd. €) entfällt in voller Höhe auf die Cash Generating Unit Lithografie.

### (13) SACHANLAGEN

Die Aufgliederung der in der Bilanz zusammengefassten Positionen des Sachanlagevermögens sowie ihre Entwicklung im Berichtsjahr sind im Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist, enthalten.

Im Sachanlagevermögen sind mit einem Restbuchwert in Höhe von 5 Tsd. € (Vorjahr: 15 Tsd. €) auch geleaste technische Anlagen und Maschinen, geleaste Betriebs- und Geschäftsausstattung und geleaster Fuhrpark enthalten, die wegen der Gestaltung der ihnen zugrunde liegenden Leasingverträge („Finance Lease“) dem Konzern als wirtschaftlichem Eigentümer zuzurechnen sind.

In den Zugängen des Vorjahres zum Sachanlagevermögen war der Immobilienerwerb des Firmenhauptsitzes in Garching mit 8.939 Tsd. € berücksichtigt. Neben dem Kaufpreis von 8.600 Tsd. € sind Erwerbsnebenkosten von 339 Tsd. € enthalten.

### (14) SONSTIGE (LANGFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Die sonstigen langfristigen Vermögenswerte enthalten Aktivwerte von Rückdeckungsversicherungen, welche die Verrechnungskriterien mit bestehenden Pensionsrückstellungen nicht erfüllen, sowie geleistete Kautionen für angemietete Bürogebäude.

in Tsd. €	2014	2013
Rückdeckungsversicherung	150	145
Kautionen	413	377
<b>Sonstige langfristige Vermögenswerte</b>	<b>563</b>	<b>522</b>

## (15) VORRÄTE

Die Vorräte lassen sich wie folgt aufteilen:

in Tsd. €	2014	2013
Materialien und Hilfsstoffe	22.091	25.204
Unfertige Erzeugnisse	26.109	23.332
Fertigerzeugnisse	8.971	24.156
Demonstrationsgeräte	20.490	21.467
Handelswaren	838	700
Wertberichtigungen	-19.616	-23.726
<b>Vorratsvermögen</b>	<b>58.883</b>	<b>71.133</b>

Von dem Gesamtbetrag der zum 31. Dezember 2014 bilanzierten Vorräte in Höhe von 58.883 Tsd. € (Vorjahr: 71.133 Tsd. €) sind 37.885 Tsd. € (Vorjahr: 37.173 Tsd. €) zu ihrem Nettoveräußerungswert bilanziert.

Der Betrag der Vorräte, der im Geschäftsjahr als Aufwand erfasst wurde, beträgt rund 85.580 Tsd. € (Vorjahr: 85.316 Tsd. €).

## (16) FORDERUNGEN AUS LIEFERUNGEN UND LEISTUNGEN

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2014	2013
Forderungen gegen Dritte	13.713	12.888
Wertberichtigungen	-323	-1.815
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>13.390</b>	<b>11.073</b>

Die folgende Tabelle gibt die Veränderungen in den Wertberichtigungen auf den Bestand der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wieder.

in Tsd. €	2014	2013
<b>Wertberichtigungen zum Beginn des Geschäftsjahres</b>	<b>1.815</b>	<b>617</b>
Ausbuchung von Forderungen	-256	-89
Zahlungseingänge und Wertaufholungen auf ursprünglich abgeschriebene Forderungen	-1.280	-164
Zuführung	44	1.451
<b>Wertberichtigungen zum Geschäftsjahresende</b>	<b>323</b>	<b>1.815</b>

## (17) SONSTIGE FINANZIELLE VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen finanziellen Vermögenswerten sind folgende Positionen ausgewiesen:

in Tsd. €	2014	2013
Zinsabgrenzungen	29	104
Förderprojekte	31	56
Lieferantenboni	57	37
Bietungsgarantien	41	71
Mitarbeiterforderungen	24	0
Sonstiges	22	52
<b>Sonstige finanzielle Vermögenswerte</b>	<b>204</b>	<b>320</b>

Die Zinsabgrenzungen betreffen im Wesentlichen Zinsansprüche aus Wertpapieren.

## (18) WERTPAPIERE

Die SÜSS MicroTec AG hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Teil ihrer Liquidität in zur Veräußerung verfügbare Wertpapiere investiert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen. Die Bewertung der Wertpapiere erfolgt zu Marktpreisen. Etwaige Marktpreisschwankungen werden erfolgsneutral im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

Zum Bilanzstichtag verfügte die Gesellschaft über Wertpapiere in Höhe von 1.026 Tsd. € (Vorjahr: 2.072 Tsd. €).

## (19) STEUERERSTATTUNGSANSPRÜCHE

Die langfristigen Steuerforderungen resultieren ausschließlich aus der Aktivierung des Körperschaftsteuer-Guthabens deutscher Konzerngesellschaften in Höhe von 50 Tsd. € (Vorjahr: 65 Tsd. €) in Folge des Gesetzes über steuerliche Begleitmaßnahmen zur Einführung der Europäischen Gesellschaft und zur Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (SEStEG). Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresbeträgen in den Jahren 2008 bis 2017 ausbezahlt. Da der Auszahlungsbetrag unverzinslich ist, erfolgte eine entsprechende Abzinsung. Dabei wurde ein durchschnittlicher Effektivzinssatz von 3,1 % p. a. zugrunde gelegt.

Die kurzfristigen Steuerforderungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Geleistete Steuervorauszahlungen	691	518
Steuerliche Zuschüsse	34	45
Rückerstattungsansprüche aufgrund eines steuerlichen Verlustrücktrags	0	158
<b>Steuererstattungsansprüche</b>	<b>725</b>	<b>721</b>

## (20) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERMÖGENSWERTE

Unter den sonstigen kurzfristigen Vermögenswerten sind folgende Positionen enthalten:

in Tsd. €	2014	2013
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.061	592
Geleistete Anzahlungen	172	1.357
Umsatzsteuer	312	514
Kauttionen	59	20
Bietungsgarantien	71	0
Forderungen aus Förderprojekten	0	5
Sonstiges	34	6
<b>Sonstige kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>1.709</b>	<b>2.494</b>

Die aktive Rechnungsabgrenzung enthält Vorauszahlungen für zukünftige Aufwendungen, z. B. Versicherungsbeiträge oder Mietvorauszahlungen.

Die geleisteten Anzahlungen betrafen im Vorjahr zum Großteil Vorauszahlungen der SÜSS MicroTec Lithography GmbH für ein Kooperationsprojekt mit einem Forschungsinstitut.

## Erläuterungen zu den Passiva

### (21) EIGENKAPITAL

#### GEZEICHNETES KAPITAL

Das Grundkapital der SÜSS MicroTec AG betrug zum Bilanzstichtag unverändert 19.115.538,00 € (eingeteilt in 19.115.538 auf den Namen lautende und voll einbezahlte Stückaktien mit einem rechnerischen Nennwert von je 1,00 €). Wir verweisen hier auf die Darstellung der Eigenkapitalveränderungsrechnung.

Jede Stückaktie berechtigt zur Abgabe einer Stimme bei Abstimmungen. Die Stückaktien sind nicht rückzahlbar und nicht konvertierbar. Dividenden können ausschließlich aus den ausschüttbaren Gewinnen gemäß handelsrechtlichem Jahresabschluss der SÜSS MicroTec AG ausgeschüttet werden.

Das genehmigte Kapital beträgt zum Bilanzstichtag 9.000 Tsd. € (Vorjahr: 9.000 Tsd. €).

in Tsd. €	2014	2013
Grundkapital	19.116	19.116
Genehmigtes Kapital	9.000	9.000

#### RÜCKLAGEN

Die Rücklagen des Konzerns setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Kapitalrücklage	97.614	97.614
Gewinnrücklage	433	433
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	537	-4.076
<b>Rücklagen</b>	<b>98.584</b>	<b>93.971</b>

Die Kapitalrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Die Gewinnrücklage ist im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses in Höhe von 4.613 Tsd. € ergibt sich zum 31. Dezember 2014 ein Bilanzgewinn in Höhe von 537 Tsd. €.

#### KUMULIERTES ÜBRIGES EIGENKAPITAL

Die Entwicklung des kumulierten übrigen Eigenkapitals stellt sich wie folgt dar:

in Tsd. €	2014	2013
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	-1.331	-1.242
Fremdwährungsanpassungen	-2.426	-769
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-342	-505
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	30	248
<b>Steuereffekte</b>		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	333	327
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	0	-69
Absicherung künftiger Zahlungsströme	81	143
<b>Stand zu Beginn der Periode</b>	<b>-3.655</b>	<b>-1.867</b>
<b>Veränderungen vor Steuern</b>		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	-982	-89
Fremdwährungsanpassungen	2.918	-1.657
Absicherung künftiger Zahlungsströme	-144	163
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	-19	-218
<b>Steuereffekte</b>		
Neubewertung von leistungsorientierten Plänen	199	6
Unrealisierte Gewinne / Verluste aus Wertpapieren	13	69
Absicherung künftiger Zahlungsströme	40	-62
<b>Stand am Ende der Periode</b>	<b>-1.630</b>	<b>-3.655</b>

Die SÜSS MicroTec AG hat 2010 einen Zinsswap als Sicherungsinstrument für das variabel verzinsliche Darlehen, das der Finanzierung des neu erworbenen Grundstücks in Sternenfels dient, abgeschlossen. Für diesen Zinsswap wurde Hedge Accounting angewendet: Anstelle der Abbildung in der Gewinn- und Verlustrechnung werden die Marktwertänderungen im kumulierten übrigen Eigenkapital abgebildet.

## EIGENKAPITALMANAGEMENT

Das Eigenkapital des SÜSS MicroTec-Konzerns – bestehend aus dem gezeichneten Kapital, den Rücklagen und dem kumulierten übrigen Eigenkapital – beläuft sich zum 31. Dezember 2014 auf insgesamt 116.070 Tsd. € (Vorjahr: 109.432 Tsd. €); das entspricht einer Eigenkapitalquote von 69,1% (Vorjahr: 60,8%). Neben einer angemessenen Eigenkapitalrentabilität strebt der SÜSS MicroTec-Konzern eine nachhaltig hohe Eigenkapitalquote sowie eine hohe Liquiditätsreserve an, um künftiges Wachstum sicherzustellen und den Unternehmenswert zu steigern. Zur Aufrechterhaltung oder Anpassung der Kapitalstruktur kann der Konzern alle Möglichkeiten nutzen, die die Börsennotierung der SÜSS MicroTec AG mit sich bringt.

Der Vorstand der Gesellschaft geht nach derzeitigem Planungsstand davon aus, im kommenden Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Bei einer Verfehlung der Planung besteht die Gefahr, dass sich das Eigenkapital in Folge eines Jahresfehlers verringern könnte.

## (22) PENSIONEN UND ÄHNLICHE VERPFLICHTUNGEN

Das Unternehmen gewährt verschiedene Versorgungszusagen, die im Wesentlichen die Risiken Alter, Tod und Invalidität berücksichtigen. Die Pläne unterscheiden sich je nach rechtlichen, steuerlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der einzelnen Länder. Die Leistungen berechnen sich in der Regel auf Basis der Gehälter und der Dauer der Betriebszugehörigkeit der versicherten Mitarbeiter.

Es ist zwischen leistungs- und beitragsorientierten Versorgungssystemen zu unterscheiden. Bei leistungsorientierten Versorgungszusagen besteht die Verpflichtung des Konzerns darin, die zugesagten Leistungen an ehemalige Mitarbeiter zu erfüllen, für die entsprechende Rückstellungen gebildet werden.

Bei beitragsorientierten Versorgungsplänen geht der Konzern über die Entrichtung von Beitragszahlungen an zweckgebundene Fonds hinaus keine weitere Verpflichtung ein. Die Beitragszahlungen werden ergebniswirksam erfasst, Rückstellungen werden hier nicht gebildet.

Die Pensionsverpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Barwert der Pensionsverpflichtungen	7.278	5.935
Zeitwert des Planvermögens	-2.527	-2.175
<b>Errechnete Pensionsverbindlichkeit</b>	<b>4.751</b>	<b>3.760</b>

## LEISTUNGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED BENEFIT PLANS“)

Der Konzern verfügt in Deutschland, Japan und in der Schweiz über leistungsorientierte Pensionspläne.

Die vorhandenen Pensionszusagen in Deutschland umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet einerseits in Abhängigkeit vom Jahresgehalt und andererseits als feste Zusagen. Anspruchsberechtigt sind ausgewählte Personen der Geschäftsleitung. Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2014	2013
Abzinsungssatz	1,93	3,10
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	1,93	3,10
Gehaltssteigerung	0,00	0,00
Rentensteigerung	2,00	2,00
Lebenserwartung gem. Richttafeln Dr. Heubeck 2005 G		

Beim Gehalt wurden keine Steigerungsraten berücksichtigt, da in den deutschen Plänen keine aktiven Anwärter mehr enthalten sind.

Die Pensionszusagen der Tochtergesellschaft in der Schweiz umfassen Ansprüche auf Alters-, Invaliden- und Hinterbliebenenrenten, ausgestaltet in Abhängigkeit vom Grundgehalt. Anspruchsberechtigt sind alle Angestellten und Geschäftsführer der Tochtergesellschaft.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2014	2013
Abzinsungssatz	1,10	2,30
Erwartete Rendite auf das Planvermögen	1,10	2,30
Gehaltssteigerung	1,50	1,50
Rentensteigerung	0,00	0,00

Die Tochtergesellschaft in Japan verfügt über einen beitragsfreien und ungedeckten leistungsorientierten Pensionsplan, aus dem bestimmte Mitarbeiter nach Ausscheiden aus dem Unternehmen eine Pensionszahlung erhalten. Die Höhe der Pensionszahlung richtet sich nach einem festgelegten Berechnungsschema und sieht für jeden anspruchsberechtigten Mitarbeiter eine Zuwendung von 80% eines Monatsgehalts pro Beschäftigungsjahr vor. Anspruchsberechtigt ist jeder Mitarbeiter der Gesellschaft nach einer Betriebszugehörigkeit von mindestens drei Jahren.

Die wesentlichen versicherungsmathematischen Annahmen sind nachfolgend dargestellt:

in %	2014	2013
Abzinsungssatz	1,00	2,00
Gehaltssteigerung	1,63	1,62
Rentensteigerung	0,00	0,00

Die Anwartschaftsbarwerte der Versorgungsverpflichtungen und beizulegenden Zeitwerte des Planvermögens haben sich in den Geschäftsjahren 2014 und 2013 wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2014	2013
<b>Anwartschaftsbarwert am 01.01.</b>	<b>5.935</b>	<b>6.086</b>
Dienstzeitaufwand	351	277
Zinsaufwand	156	132
Pensionszahlungen	-206	-438
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust aus Veränderungen der finanziellen Annahmen	879	-264
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust aus Veränderungen der demografischen Annahmen	-55	176
Versicherungsmathematischer (-) Gewinn / (+) Verlust aus erfahrungsbedingten Anpassungen	176	185
Währungsveränderungen	42	-219
<b>Anwartschaftsbarwert am 31.12.</b>	<b>7.278</b>	<b>5.935</b>

in Tsd. €	2014	2013
<b>Planvermögen am 01.01.</b>	<b>2.175</b>	<b>1.967</b>
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	56	43
Geleistete Fondsdotierungen	253	162
Versicherungsmathematischer (+) Gewinn / (-) Verlust	15	21
Währungsveränderungen	28	-18
<b>Planvermögen am 31.12.</b>	<b>2.527</b>	<b>2.175</b>

Die wesentlichen Komponenten des Planvermögens sind Rückdeckungsversicherungen. Im Zusammenhang mit den Pensionsverpflichtungen in Deutschland wurden entsprechende Rückdeckungsversicherungen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG abgeschlossen. Die Pensionsverpflichtungen in der Schweiz sind über die Helvetia Sammelstiftung abgesichert, die hierfür entsprechende Rückdeckungsversicherungen abgeschlossen hat. Die beiden Rückdeckungsversicherungen sind als konservative, risikoarme Anlageform zu sehen, deren Wert nur geringen Marktschwankungen unterliegt.

Die Abstimmung des Deckungsstatus mit dem in der Konzernbilanz ausgewiesenen Betrag ergibt folgendes Bild:

in Tsd. €	2014	2013
<b>Barwert der Pensionsverpflichtungen</b>	<b>7.278</b>	<b>5.935</b>
Zeitwert des Planvermögens	-2.527	-2.175
<b>Errechnete Pensionsverbindlichkeit</b>	<b>4.751</b>	<b>3.760</b>

Der Barwert der Pensionsverpflichtungen entfällt in Höhe von 4.987 Tsd. € (Vorjahr: 3.767 Tsd. €) auf fondsfinanzierte Versorgungsansprüche.

Die Pensionsaufwendungen gliedern sich wie folgt:

in Tsd. €	2014	2013
Dienstzeitaufwand	227	172
<b>Personalaufwandskomponente</b>	<b>227</b>	<b>172</b>
Zinsaufwand	125	110
Erwartete Erträge aus dem Planvermögen	-25	-21
Versicherungsmathematische Gewinne/Verluste	85	-13
<b>Zinsaufwandskomponente</b>	<b>185</b>	<b>76</b>

Für 2015 erwartet der Konzern zur Erfüllung der Pensionsverpflichtungen Zahlungsmittelabflüsse von insgesamt 332 Tsd. €.

In der folgenden Übersicht wird aufgezeigt, in welcher Weise der Barwert aller definierten Leistungsverpflichtungen durch Veränderungen der maßgeblichen versicherungsmathematischen Annahmen beeinflusst worden wäre:

in Tsd. €	2014
<b>Barwert aller definierten Leistungsverpflichtungen falls</b>	
der Abzinsungssatz 50 Basispunkte niedriger wäre	7.824
der Abzinsungssatz 50 Basispunkte höher wäre	6.806
die Lohnsteigerung 50 Basispunkte niedriger wäre	7.188
die Lohnsteigerung 50 Basispunkte höher wäre	7.378
die künftige Rentensteigerung 0,50% niedriger wäre	7.248
die künftige Rentensteigerung 0,50% höher wäre	7.596

## BEITRAGSORIENTIERTE PLÄNE („DEFINED CONTRIBUTION PLANS“)

Der Konzern hat für seine Mitarbeiter in den USA einen „Defined Contribution Plan“ eingerichtet. Von dem Plan profitieren alle Mitarbeiter der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. (Corona) und der SUSS MicroTec, Inc. (Sunnyvale) ab einem Alter von 18 bzw. 21 Jahren und einem Minimum an geleisteten Arbeitsstunden von 1.000 Stunden pro Jahr. Beide Defined Contribution Plans beinhalten zwei Komponenten: eine Gewinnbeteiligung und einen 401 (k) Plan.

Bei der SUSS MicroTec, Inc. werden die in den Gewinnbeteiligungsplan einfließenden Beiträge jährlich neu bestimmt. Sämtliche Beiträge des Unternehmens werden in einem „Trust Fund“ gehalten. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen den unverfallbaren Leistungsanspruch über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Unter dem 401 (k) Plan beträgt der Arbeitgeberbeitrag 0,50 USD für jeden 1,00 USD des Arbeitnehmerbeitrages bis zu einem maximalen Arbeitnehmerbeitrag von 3.000 USD (d. h. der maximale Arbeitgeberbeitrag beträgt 1.500 USD). Anspruch auf den vollen Arbeitgeberbeitrag haben die Arbeitnehmer erst nach Vollendung des dritten Arbeitsjahres. Davor haben sie keinen Anspruch auf Arbeitgeberbeiträge.

Der 401 (k) Plan der SUSS MicroTec Photonic Systems Inc. bietet den Mitarbeitern die Möglichkeit, 25 % ihrer jährlichen Vergütung in den 401 (k) Plan einzubezahlen. Für jeden 1,00 USD Arbeitnehmerbeitrag wird ein Arbeitgeberbeitrag von 1,00 USD beigesteuert bis zu einem Maximalbetrag von 3 % des Gehalts. Die anspruchsberechtigten Mitarbeiter erreichen einen unverfallbaren Leistungsanspruch gestaffelt in 20 %-Schritten über einen Zeitraum von sechs Jahren.

Im Geschäftsjahr 2014 betragen die Aufwendungen des Konzerns für den 401 (k) Plan 185 Tsd. USD. (Vorjahr: 145 Tsd. USD).

Weiterhin wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Rentenversicherung in Höhe von 2.611 Tsd. € (Vorjahr: 2.919 Tsd. €) abgeführt.

## (23) (LANGFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Verpflichtungen des Konzerns aus Altersteilzeitvereinbarungen. Die Rückstellungen haben sich folgendermaßen entwickelt:

	Stand 01.01.2014	Verbrauch	Zuführung	Stand 31.12.2014
Altersteilzeit	62	-33	0	29

Die im Rahmen einer Betriebsvereinbarung geschlossene Alters-  
teilzeitregelung gilt für Arbeitnehmer der SÜSS MicroTec Litho-  
graphy GmbH und der SÜSS MicroTec AG, die das 57. Lebens-  
jahr vollendet haben und im aktuellen Arbeitsverhältnis in den  
letzten fünf Jahren vor Beginn der Altersteilzeit mindestens drei  
Jahre eine Vollzeitbeschäftigung / Teilzeitbeschäftigung ausge-  
übt haben.

Während der Dauer der Altersteilzeit wird die bisherige Regel-  
arbeitszeit auf 50 % reduziert. Die während der Altersteilzeit-  
Gesamtdauer zu erbringende Arbeitszeit wird regelmäßig so  
verteilt, dass diese vollständig in der ersten Hälfte der Alters-  
teilzeit geleistet wird (Arbeitsphase) und der Mitarbeiter in  
der zweiten Hälfte von der Arbeitsleistung freigestellt wird  
(Freistellungsphase).

Zusätzlich zum auf 50 % reduzierten Bruttoarbeitsentgelt erhält  
der Mitarbeiter einen Aufstockungsbetrag, der so zu bemessen ist,  
dass das monatliche Altersteilzeit-Nettoentgelt mindestens 82 %  
des monatlichen Vollzeit-Nettoarbeitsentgelts beträgt. Der Auf-  
stockungsbetrag wird steuer- und sozialversicherungsfrei gezahlt.

## (24) FINANZSCHULDEN

Die Fälligkeitsstruktur der Verbindlichkeiten gegenüber Kredit-  
instituten, der Verbindlichkeiten aus Schuldscheindarlehen sowie  
der Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing ergibt sich zum  
31. Dezember 2014 bzw. zum Vorjahresstichtag wie folgt:

31.12.2014 in Tsd. €	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlich- keiten gegen- über Kredit- instituten	1.180	4.720	4.380	10.280
Verbindlich- keiten aus Finance Lease	7	0	0	7
<b>Gesamt</b>	<b>1.187</b>	<b>4.720</b>	<b>4.380</b>	<b>10.287</b>

31.12.2013 in Tsd. €	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Summe
Verbindlich- keiten gegen- über Kredit- instituten	1.180	4.720	5.560	11.460
Verbindlich- keiten aus Finance Lease	11	0	0	11
<b>Gesamt</b>	<b>1.191</b>	<b>4.720</b>	<b>5.560</b>	<b>11.471</b>

### VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Ver-  
bindlichkeiten aus einem langfristigen Darlehensvertrag in Höhe  
von 3.780 Tsd. € (Vorjahr: 3.960 Tsd. €), der der Finanzierung des  
Betriebsgrundstücks Sternenfels dient. Der Darlehensvertrag  
wurde am 25. /28. Mai 2010 zwischen der SÜSS MicroTec AG und  
einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen belief sich auf  
4,5 Mio. € und hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Es wurde  
am 6. Juli 2010 valutiert und zur Auszahlung gebracht.

Darüber hinaus sind Verbindlichkeiten in Höhe von 6.500 Tsd.€ (Vorjahr: 7.500 Tsd.€) enthalten, die der Finanzierung des 2013 erworbenen Betriebsgrundstücks Garching dienen. Der Darlehensvertrag wurde am 23./28. Oktober 2013 zwischen der SÜSS MicroTec AG und einer lokalen Bank abgeschlossen. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2021. Es wurde am 16. Dezember 2013 valuiert und zur Auszahlung gebracht.

Im Einzelnen setzen sich die Darlehensstände per Ende des Geschäftsjahres wie folgt zusammen:

<b>Konzerngesellschaft</b> in Tsd. €	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>Zinssatz</b>	<b>Fälligkeit</b>
SÜSS MicroTec AG	3.780	3.960	3,98 %	30.6.2020
SÜSS MicroTec AG	6.500	7.500	3,65 %	30.6.2021
<b>Gesamt</b>	<b>10.280</b>	<b>11.460</b>		
davon kurzfristig fällig	1.180	1.180		
davon langfristig fällig	9.100	10.280		
fällig 2015	1.180			
2016	1.180			
2017	1.180			
2018	1.180			
2019	1.180			
später	4.380			
	<b>10.280</b>			

Die Gesellschaft verfügt über diverse Kreditlinien bei nationalen und internationalen Bankinstituten und Versicherungen. Die gesamten Kreditlinien und deren Inanspruchnahme haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Kreditlinie	8.000	8.000
Inanspruchnahme	3.484	3.347
<b>Verfügbare Kreditlinie</b>	<b>4.516</b>	<b>4.653</b>

Bis zum 15. Dezember 2014 stellte das Bankenkonsortium unter Führung der BayernLB und unter Beteiligung der Deutsche Bank AG sowie der DZ Bank AG eine Kredit- und Avallinie in Höhe von insgesamt 4,5 Mio.€. Der Kreditvertrag mit der BayernLB wurde von SÜSS MicroTec zum 15. Dezember 2014 gekündigt. Seit dem 16. Dezember wird die Kredit- und Avallinie von einem neu zusammengesetzten Bankenkonsortium fortgeführt. Als Konsortialführer fungiert nun die Deutsche Bank AG, des Weiteren sind die DZ Bank AG sowie die Baden-Württembergische Bank am Konsortium beteiligt. Die Kredit- und Avallinien des veränderten Bankenkonsortiums betragen weiterhin 4,5 Mio.€. Die Linien wurden bis auf weiteres gewährt und wurden ohne Covenants gestellt.

Im Mai 2010 hat die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG mit der BW-Bank Mannheim einen Rahmenkreditvertrag abgeschlossen, mit dem eine Kreditlinie in Höhe von 1 Mio.€ gestellt wird. Die Kreditlinie läuft auf unbestimmte Zeit und wurde ohne Covenants gestellt. Die SÜSS MicroTec AG hat zur Besicherung der Kreditlinie eine harte Patronatserklärung für die SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG abgegeben.

Bei einer Versicherung besteht eine weitere Kreditlinie zur Unterlegung von Anzahlungsbürgschaften in Höhe von 2,5 Mio.€.

Zum Bilanzstichtag ist die Linie in Höhe von 3.484 Tsd.€ (Vorjahr: 3.347 Tsd.€) in Form von Avalen genutzt.

Der durchschnittliche Zinssatz für die Inanspruchnahme der Kreditlinien in Form von Avalen betrug 1,09% (Vorjahr: 1,01%).

## VERBINDLICHKEITEN AUS FINANCE LEASE

Der Konzern least derzeit diverse Einrichtungen und Ausrüstungsgegenstände sowohl im Fertigungs- als auch im Verwaltungsbereich unter Operating Lease-Verträgen. Darüber hinaus bestehen bezüglich Software, Gebäuden, Grundstücken und Einbauten, technischen Anlagen und Maschinen sowie anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung Finance Lease-Verträge, deren zugrunde liegende Vermögenswerte aktiviert und planmäßig abgeschrieben werden.

Die Fristigkeit der Leasingverbindlichkeiten sowie die künftigen finanziellen Verpflichtungen aus Operating Lease stellen sich wie folgt dar:

in Tsd. €	Finance Lease	Operating Lease
Abschreibungen / Aufwendungen 2014	11	1.190
Abschreibungen / Aufwendungen 2013	98	2.112
Künftige Verpflichtungen fällig 2015	7	1.007
2016		712
2017		516
2018		29
2019		0
Später		0
<b>Gesamt zukünftig</b>	<b>7</b>	<b>2.264</b>
Zinsanteil	0	
<b>Verbindlichkeit 31.12.2014</b>	<b>7</b>	
davon kurzfristig	7	
davon langfristig	0	

Größten Anteil an den Aufwendungen für Finance Lease hatten im Vorjahr die Leasing-Raten für das in Deutschland, den USA und Taiwan genutzte SAP-System. Dieser Leasing-Vertrag hatte eine Laufzeit bis zum 31. Januar 2013. Der Vertrag beinhaltet eine Kaufoption, die mit Beendigung des Leasing-Vertrags ausgeübt werden konnte. Die SÜSS MicroTec AG hat diese Kaufoption ausgeübt und das SAP-System zum 1. Februar 2013 für einen Kaufpreis von 228 Tsd. € erworben.

## (25) SONSTIGE (LANGFRISTIGE) FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die langfristigen finanziellen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
ERA Anpassungsfond	0	140
Sonstiges	49	39
Bedingte Kaufpreisverpflichtung aus dem Erwerb der SMO	0	115
Earn-Out SÜSS MicroTec Photonic Systems	0	202
<b>Sonstige langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>49</b>	<b>496</b>

## (26) (KURZFRISTIGE) RÜCKSTELLUNGEN

Die kurzfristigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Garantierückstellungen	1.434	2.098
Rückstellungen für Abfindungen	1.050	451
Übrige Rückstellungen	754	3.390
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>3.238</b>	<b>5.939</b>

Die Garantierückstellungen wurden für gesetzliche und vertraglich vereinbarte Garantien und Gewährleistungsansprüche von Kunden aus Maschinenlieferungen in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme gebildet.

Die Rückstellung für Abfindungen betrifft in voller Höhe ein ausgeschiedenes Vorstandsmitglied. Der Aufwand zur Bildung der Rückstellung ist in den Verwaltungskosten enthalten.

Die übrigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Nachlaufkosten sowie Personalrückstellungen.

Die kurzfristigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	Stand 01.01.2014	Ver- brauch	Auf- lösung	Zufüh- rung	Stand 31.12.2014
Garantie- rück- stellungen	2.098	-2.098	0	1.434	1.434
Abfindungen	451	-451	0	1.050	1.050
Übrige Rück- stellungen	3.390	-3.390	0	754	754
<b>Kurzfristige Rückstel- lungen</b>	<b>5.939</b>	<b>-5.939</b>	<b>0</b>	<b>3.238</b>	<b>3.238</b>

## (27) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) FINANZIELLE VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen finanziellen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2014	2013
Prämien und Provisionen	2.684	1.724
Fremdleistungen	1.566	3.235
Aufsichtsratsvergütung	159	148
Negative Marktwerte aus Zinsswaps	488	344
Bedingte Kaufpreisverpflichtung SUSS MicroOptics	163	247
Earn-Out SUSS MicroTec Photonic Systems	0	138
Noch abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	527	438
Lizenzgebühren	70	0
Sonstiges	150	92
<b>Sonstige (kurzfristige) finanzielle Verbindlichkeiten</b>	<b>5.807</b>	<b>6.366</b>

Die Gesellschaft weist unter den sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten die negativen Marktwerte der Zinsderivate aus. Weitere Einzelheiten zu den Zinssicherungsgeschäften finden sich in Textziffer 30 „Zusätzliche Informationen über Finanzinstrumente“.

## (28) SONSTIGE (KURZFRISTIGE) VERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen kurzfristigen Verbindlichkeiten teilen sich wie folgt auf:

in Tsd. €	2014	2013
Erhaltene Anzahlungen	17.964	30.773
Abgegrenzte Personalkosten	3.826	4.138
Passive Rechnungsabgrenzung	233	266
Umsatzsteuer	569	553
Sonstiges	200	382
<b>Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>22.792</b>	<b>36.112</b>

Die erhaltenen Anzahlungen enthalten alle Kundenanzahlungen für Maschinen vor der endgültigen Abnahme. Nach erfolgter Abnahme und entsprechender Umsatzrealisierung werden die Anzahlungen mit den entstandenen Forderungen verrechnet.

In den abgegrenzten Personalkosten sind im Wesentlichen Verpflichtungen für Urlaubsrückstände und Gleitzeitguthaben enthalten.

## (29) STEUERSCHULDEN

Die Steuerverbindlichkeiten enthalten inländische Ertragsteuern in Höhe von 991 Tsd. € (Vorjahr: 69 Tsd. €) und ausländische Ertragsteuern in Höhe von 504 Tsd. € (Vorjahr: 582 Tsd. €).

## Sonstige Angaben

### (30) ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN ÜBER FINANZINSTRUMENTE

Unter Finanzinstrumente fallen nach IAS 32 grundsätzlich sämtliche auf vertraglicher Basis vorgenommene wirtschaftliche Vorgänge, die einen Anspruch auf Zahlungsmittel beinhalten. Hierzu gehören einerseits originäre Finanzinstrumente wie Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andererseits Finanzforderungen und -verbindlichkeiten. Weiterhin umfassen die Finanzinstrumente auch derivative Instrumente, die zur Sicherung von Währungs- und Zinsänderungsrisiken eingesetzt werden. Die geschätzten Marktwerte der Finanzinstrumente stellen nicht notwendigerweise die Werte dar, die das Unternehmen bei einer tatsächlichen Transaktion unter aktuellen Marktbedingungen realisieren würde. Folgender Abschnitt gibt einen umfassenden Überblick über die Bedeutung von Finanzinstrumenten für das Unternehmen und liefert zusätzliche Informationen über Bilanzpositionen, die Finanzinstrumente enthalten.

Die folgende Tabelle zeigt die Buchwerte aller Kategorien von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten:

in Tsd. €	2014	2013
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>		
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	47.309	45.059
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	1.026	2.072
Kredite und Forderungen	13.594	11.393
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Vermögenswerte	0	0
	<b>61.929</b>	<b>58.524</b>
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>		
Zu Handelszwecken gehaltene finanzielle Verbindlichkeiten	488	344
Finanzielle Verbindlichkeiten	19.101	23.552
	<b>19.589</b>	<b>23.896</b>

Die folgende Tabelle stellt die Marktwerte sowie die Buchwerte der finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dar.

in Tsd. €	2014		Bewertungskategorien gem. IAS 39	davon Fair Value Stufe 1	davon Fair Value Stufe 2	davon Fair Value Stufe 3
	Buchwert	Marktwert				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	47.309	47.309	Kredite und Forderungen	47.309		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.390	13.390	Kredite und Forderungen			
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	204	204	Kredite und Forderungen			
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	204	204	Kredite und Forderungen			
bewertet zum Marktwert	0	0	Kredite und Forderungen			
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	1.026	1.026	Zur Veräußerung verfügbar	1.026		
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.446	3.446	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Finanzschulden	10.287	11.769				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.280	11.762	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	7	7	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	5.856	5.856				
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	5.368	5.368	Fortgeführte Anschaffungskosten			
bewertet zum Marktwert	488	488	Derivate		488	

in Tsd. €	2013		Bewertungskategorien gem. IAS 39	davon Fair Value Stufe 1	davon Fair Value Stufe 2	davon Fair Value Stufe 3
	Buchwert	Marktwert				
<b>Finanzielle Vermögenswerte</b>						
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	45.059	45.059	Kredite und Forderungen	45.059		
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.073	11.073	Kredite und Forderungen			
Sonstige finanzielle Vermögenswerte	320	320	Kredite und Forderungen			
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	320	320	Kredite und Forderungen			
bewertet zum Marktwert	0	0	Kredite und Forderungen			
Wertpapiere, bewertet zum Marktwert	2.072	2.072	Zur Veräußerung verfügbar	2.072		
<b>Finanzielle Verbindlichkeiten</b>						
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.563	5.563	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Finanzschulden	11.471	12.341				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.460	12.330	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Verbindlichkeiten aus Finance Lease	11	11	Fortgeführte Anschaffungskosten			
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten	6.862	6.862				
bewertet zu fortgeführten Anschaffungskosten	6.518	6.518	Fortgeführte Anschaffungskosten			
bewertet zum Marktwert	344	344	Derivate		344	

Für die Ermittlung der Marktwerte werden die folgenden Methoden verwendet und Annahmen getroffen:

#### Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente

Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Anlagen den Marktwerten der Instrumente.

#### Forderungen/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Buchwerte entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Forderungen und Verbindlichkeiten annäherungsweise den Marktwerten der Instrumente.

#### Sonstige finanzielle Vermögenswerte/Verbindlichkeiten

Die Buchwerte der zu fortgeführten Anschaffungskosten bewerteten sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten entsprechen aufgrund der Kurzfristigkeit der Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in etwa dem Marktwert.

Die Bewertung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die zu Marktwerten bewertet werden, hängt von ihrem Typ ab. Der Marktwert von Devisentermingeschäften bestimmt sich in Abhängigkeit von Devisenterminkursen. Der Marktwert von Zinsderivaten bestimmt sich durch Abzinsung der erwarteten zukünftigen Zahlungsströme über die Restlaufzeit des Kontrakts auf der Basis aktueller Marktzinsen und der Zinsstrukturkurve.

### Wertpapiere

Der Marktwert der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte entspricht dem Kurswert in einem aktiven Markt.

### Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Der Marktwert der Finanzverbindlichkeiten betreffend die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

### Verbindlichkeiten aus Finance Lease

Der Marktwert der Verbindlichkeiten aus Finance Lease wurde durch Diskontierung des erwarteten Mittelabflusses zu den marktüblichen Zinssätzen für Schuldtitel mit vergleichbaren Konditionen und Restlaufzeiten ermittelt.

Die Nettogewinne bzw. -verluste aus Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2014	2013
Kredite und Forderungen	1.236	-1.198
Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte	-47	-226

Nettogewinne bzw. -verluste aus Krediten und Forderungen enthalten Veränderungen in den Wertberichtigungen, Gewinne und Verluste aus der Ausbuchung sowie Zahlungseingänge auf ursprünglich abgeschriebene Darlehen und Forderungen.

Im Berichtsjahr wurde die während der Laufzeit im kumulierten übrigen Eigenkapital – nach der Berücksichtigung latenter Steuern – erfasste Marktwertveränderung der zur Veräußerung verfügbaren finanziellen Vermögenswerte in Höhe von -28 Tsd. € (Vorjahr: -8 Tsd. €) infolge der Endfälligkeit dieser Wertpapiere aus dem Eigenkapital in die Gewinn- und Verlustrechnung umgegliedert.

## DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE

Im Rahmen des Risikomanagements werden derivative Finanzinstrumente eingesetzt, um Wechselkursschwankungen und Zinsrisiken zu begrenzen.

Die direkten Marktwerte der einzelnen Arten von derivativen Finanzinstrumenten haben sich wie folgt entwickelt:

in Tsd. €	2014		2013	
	positiver Marktwert	negativer Marktwert	positiver Marktwert	negativer Marktwert
Devisentermingeschäfte	0	0	0	0
Zinsswaps	0	488	0	344

Einkaufs- und Verkaufsverpflichtungen in Fremdwährungen entstehen durch grenzübergreifende Lieferbeziehungen zwischen den SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus dem Euroraum und externen Kunden oder Lieferanten, die nicht im Euroraum ansässig sind. Dies betrifft vor allem Kunden oder Lieferanten in den Währungsräumen des US-Dollars und des japanischen Yen, die Produkte von SÜSS MicroTec-Gesellschaften aus dem Euro-Währungsraum beziehen oder an diese verkaufen. Zum Zeitpunkt der Erteilung des Auftrages werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um Währungsveränderungen bis zum Zeitpunkt der Bezahlung abzusichern. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses das Grundgeschäft selbst noch nicht vorliegt und erst mit Umsatzrealisierung entsteht, handelt es sich um die Absicherung geplanter Transaktionen. Die Veränderung der Marktwerte weist das Unternehmen unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus. Die potenziellen Risiken liegen einerseits in der Fluktuation der Währungskurse und andererseits im Bonitätsrisiko der Gegenpartei, die ausschließlich aus deutschen Kreditinstituten erstklassiger Bonität besteht.

Die Fremdwährungssensitivität wird durch die Aggregation der Fremdwährungspositionen des operativen Geschäfts und des Konzern-Treasury ermittelt. Dabei werden die Fremdwährungsrisiken durch Simulation einer zehnpromtigen Abwertung aller Fremdwährungen gegenüber dem Euro berechnet. Diese simulierte Abwertung hätte zum Bilanzstichtag zu einer Reduzierung der Euro-Gegenwerte in Höhe von 217 Tsd. € (Vorjahr: Reduzierung um 114 Tsd. €) und einer entsprechenden Verringerung (Vorjahr: Verringerung) des Jahresergebnisses geführt.

Die folgenden Tabellen zeigen die Zusammensetzung des Fremdwährungsexposures und die Auswirkungen auf das Jahresergebnis zum Bilanzstichtag und zum Vorjahresstichtag:

in Tsd. €	2014		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2.045	3.065	5.110
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.545	786	3.331
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-938	-230	-1.168
Kundenanzahlungen	-4.889	-2	-4.891
<b>Netto-Exposure</b>	<b>-1.237</b>	<b>3.619</b>	<b>2.382</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	112	-329	-217

in Tsd. €	2013		
	USD	JPY	Summe
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	3.615	609	4.224
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.575	805	2.380
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.351	-114	-1.465
Kundenanzahlungen	-3.861	-26	-3.887
<b>Netto-Exposure</b>	<b>-22</b>	<b>1.274</b>	<b>1.252</b>
Effekt auf das Jahresergebnis bei 10%iger Aufwertung des Euro	2	-116	-114

Das Unternehmen ist bestrebt, Zinsrisiken, die sich aus der Sensitivität von Finanzschulden in Bezug auf Schwankungen des Marktzinsniveaus ergeben können, durch den Einsatz von Zinsderivaten wie Zinsswaps zu begrenzen. So hat die Gesellschaft den variablen Zins des 2010 aufgenommenen Darlehens, das der Finanzierung des Grundstücks Sternenfels dient, mit einem laufzeitkongruenten Swap gesichert. Der Zinsswap gleicht die Auswirkungen zukünftiger Veränderungen der Zinssätze auf die Zahlungsströme der zugrunde liegenden variabel verzinslichen Anlage aus. Um die Marktwertschwankungen des Zinsswaps für das Grundstücksdarlehen im kumulierten übrigen Eigenkapital abzubilden, hat die Gesellschaft für diesen Zinsswap Hedge Accounting angewendet. Der Zinsswap im Zusammenhang mit der Grundstücksfinanzierung weist eine Laufzeit bis zum 30. Juni 2020 auf.

## (31) NAHESTEHENDE PERSONEN

Nach IAS 24 müssen Personen angegeben werden, die die SÜSS MicroTec AG beherrschen oder von ihr beherrscht werden, soweit sie nicht bereits in den Konzernabschluss einbezogen wurden.

Beherrschung liegt vor, wenn ein Aktionär mehr als die Hälfte der Stimmrechte der SÜSS MicroTec AG hält oder kraft Satzung oder vertraglicher Vereinbarung die Möglichkeit besitzt, die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG zu steuern.

Darüber hinaus erstreckt sich die Angabepflicht nach IAS 24 auf Geschäfte mit Joint Ventures sowie auf Geschäfte mit Personen, die einen maßgeblichen Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik der SÜSS MicroTec AG ausüben, einschließlich naher Familienangehöriger oder zwischengeschalteter Unternehmen. Ein maßgeblicher Einfluss auf die Finanz- und Geschäftspolitik des Konzerns kann hierbei auf einem Anteilsbesitz an der SÜSS MicroTec AG von 20% oder mehr, einem Sitz im Vorstand oder Aufsichtsrat der SÜSS MicroTec AG oder einer anderen Schlüsselposition im Management beruhen.

Im Geschäftsjahr wurde der Konzern von den Angabepflichten nach IAS 24 „Angaben über Beziehungen zu nahe stehenden Unternehmen und Personen“ – mit Ausnahme der Angaben zur Vergütung der Organe – nicht berührt.

## (32) FINANZIELLE VERPFLICHTUNGEN UND EVENTUALVERBINDLICHKEITEN

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen und Eventualverbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

in Tsd. €	2014	2013
Bestellobligo	13.543	10.266
Mietverpflichtungen	926	1.334
<b>Summe</b>	<b>14.469</b>	<b>11.600</b>

Das Bestellobligo verpflichtet das Unternehmen zu einer späteren Abnahme von Fremdleistungen oder Materialien.

### (33) ERLÄUTERUNGEN ZUR KONZERNKAPITALFLUSSRECHNUNG

In der Konzernkapitalflussrechnung des SÜSS MicroTec-Konzern wird entsprechend IAS 7 („Cashflow Statements“) zwischen Zahlungsströmen aus betrieblicher Geschäftstätigkeit und aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterschieden.

Der in der Kapitalflussrechnung betrachtete Finanzmittelfonds umfasst alle in der Bilanz ausgewiesenen flüssigen Mittel, d. h. Kassenbestände, Schecks und Guthaben bei Kreditinstituten, soweit sie innerhalb von drei Monaten ohne nennenswerte Wertschwankungen verfügbar sind. Im Berichtsjahr diente ein Betrag von 350 Tsd. € (Vorjahr: 350 Tsd. €) der ausgewiesenen flüssigen Mittel zum Bilanzstichtag als Sicherheit für einen Kautionsversicherungsvertrag. Dieser Betrag kann jederzeit durch die Stellung einer Rückbürgschaft abgelöst werden.

Die Cashflows aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit werden zahlungsbezogen ermittelt. Demgegenüber wird der Cashflow aus betrieblicher Geschäftstätigkeit ausgehend vom Jahresergebnis indirekt abgeleitet.

Im Rahmen der indirekten Ermittlung werden die berücksichtigten Veränderungen von Bilanzpositionen um Effekte aus der Währungsumrechnung bereinigt. Die Veränderungen der betreffenden Bilanzpositionen können daher nicht mit den entsprechenden Werten auf Grundlage der Konzernbilanzen abgestimmt werden.

Die sonstigen nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen in Höhe von -340 Tsd. € (Vorjahr: 1.531 Tsd. €) beinhalten im Wesentlichen Währungseffekte. Für das abgelaufene Geschäftsjahr sind hier außerdem die Effekte aus der Zuführung zu einer Rückstellung für Abfindungen in Höhe von 1.050 Tsd. € enthalten. Im Betrag des Vorjahres waren in dem Betrag die Effekte aus der Anpassung der Earn-Out-Verpflichtung SÜSS MicroTec Photonic Systems in Höhe von -2.136 Tsd. € sowie Sonderaufwendungen im Zusammenhang mit der Refokussierung des Permanent-Bond-Cluster-Bereichs in Höhe von 2.987 Tsd. € erfasst.

Im Cashflow aus Investitionstätigkeit des Vorjahres waren Zahlungsausgänge in Höhe von 8.939 Tsd. € enthalten, die den Erwerb der Immobilie am Firmensitz in Garching betrafen. Neben dem Kaufpreis von 8.600 Tsd. € waren hier Erwerbsnebenkosten von 339 Tsd. € erfasst.

### (34) SEGMENTBERICHTERSTATTUNG

#### INFORMATIONEN ZU DEN SEGMENTEN

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden im Rahmen der Segmentberichterstattung gemäß den Regeln von IFRS 8 („Operating Segments“) nach Produktlinien und nach Regionen abgegrenzt. Diese Aufgliederung orientiert sich an der internen Steuerung und Berichterstattung an den Vorstand und berücksichtigt die unterschiedlichen Risiko- und Ertragsstrukturen der Segmente.

Die Aktivitäten des SÜSS MicroTec-Konzerns werden in die operativen Segmente Lithografie, Substrat Bonder und Fotomasken Equipment aufgeteilt. Im Segment Sonstige werden weitere Aktivitäten des Konzerns sowie die nicht zuordenbaren Kosten der Konzernfunktionen gebündelt.

Im Segment Lithografie entwickelt, produziert und vertreibt der SÜSS MicroTec-Konzern die Produktlinien Mask Aligner, Developer und Coater sowie die Produktlinien UV Projection und Laser Processing. Die Entwicklungs- und Produktionsaktivitäten sind in Deutschland an den Standorten Garching bei München und Sternenfels bei Stuttgart angesiedelt. Die Entwicklung und Produktion der Produktlinien UV Projection und Laser Processing erfolgt in Corona (USA). Darüber hinaus sind wesentliche Teile der Vertriebsorganisationen in Nordamerika und Asien für das Segment Lithografie tätig. Die Lithografie stellt deutlich mehr als die Hälfte des Gesamtgeschäftes der Gruppe dar und ist in den Märkten Advanced Packaging, MEMS und Verbindungshalbleiter vertreten.

Im Segment Substrat Bonder sind die Entwicklung, Produktion und der Vertrieb der Produktlinie Substrat Bonder ausgewiesen. Die Aktivitäten in diesem Segment sind in Sternenfels bei Stuttgart konzentriert. Der Vertrieb für das Segment Substrat Bonder ist über Sternenfels hinaus weltweit in kleinen Einheiten an Standorten in Europa, in den USA und in Asien ansässig. In diesem Segment bilden die XBC300 Gen2 und die XBS300, beides Produktions-Bonder für Wafergrößen bis zu einem Durchmesser von 300-mm, die Ausgangsplattformen im Bereich der 3D-Integration (einer unserer Zukunftsmärkte) für das temporäre und permanente Bonden sowie das Debonden und Reinigen von Wafern. Zu den Schlüsseltechnologien, die die 3D-Integration erfordert, zählt darüber hinaus die Handhabung der äußerst fragilen Substrate („Thin Wafer Handling“). Daneben werden vor allem manuelle Maschinen für 6- und 8-Zoll-Wafer-Anwendungen angeboten.

Das Segment Fotomasken Equipment umfasst die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb der Produktlinien HMx, ASx, MaskTrack und MaskTrack Pro der SÜSS MicroTec Photomask Equipment GmbH & Co. KG. Die Entwicklung und Produktion der auf die Reinigung und Prozessierung von Fotomasken für die Halbleiterindustrie spezialisierten Systeme ist am Standort Sternenfels angesiedelt.

Im Segment Sonstige werden neben den nicht zuordenbaren Kosten der SÜSS MicroTec AG die operativen, nicht den Segmenten zugeordneten Aktivitäten im Bereich Mikrooptik gezeigt.

### **SONSTIGE ERLÄUTERUNGEN ZUR SEGMENTBERICHTERSTATTUNG**

Die Segmentdaten wurden auf der Grundlage der im Konzernabschluss angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ermittelt. In Folge der gesellschaftsübergreifenden Segmentierung des Konzerns nach Produktlinien treten grundsätzlich keine wesentlichen intersegmentären Transaktionen auf. Eine Ausnahme bilden die Weiterbelastungen der SÜSS MicroTec AG, die im Segment Sonstige erfasst sind, an die anderen Segmente für die Wahrnehmung bestimmter Konzernfunktionen wie Finanzierungs- und Strategiefragen. Diese Weiterbelastungen enthalten auch die in der Holding angefallenen Aufwendungen im Zusammenhang mit der Einführung und dem Systembetrieb von SAP.

Um den Anforderungen des IFRS 8 „Segmentberichterstattung“ zu entsprechen, enthält die Segmentberichterstattung die Angabe eines Vorsteuerergebnisses je Segment. Damit ist die Überleitung der Summe der Segmentergebnisse zum Gesamtkonzernergebnis vor Steuern möglich.

Im Geschäftsjahr wie auch im Vorjahr lagen sämtliche Umsätze von SÜSS MicroTec mit einzelnen Kunden unter einem Anteil von 10% des Gesamtumsatzes.

Unter den wesentlichen nicht zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen werden neben den Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Abwertungen auf das Vorratsvermögen auch die Zuführung zu und die Auflösung von Rückstellungen und sonstigen Verpflichtungen gezeigt.

Das Segmentvermögen stellt das betriebsnotwendige Vermögen der einzelnen Segmente dar. Es umfasst die immateriellen Vermögenswerte inklusive Geschäfts- oder Firmenwert, die Sachanlagen sowie das Vorratsvermögen und die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den Segmentschulden sind die operativen Schulden und Rückstellungen der einzelnen Segmente enthalten.

Bei den Investitionen handelt es sich um Zugänge von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen.

Für die geografische Segmentberichterstattung werden die Umsatzerlöse nach dem Standort der Kunden segmentiert. SÜSS MicroTec hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsätze in Höhe von 18.388 Tsd. € (Vorjahr: 21.608 Tsd. €) in Deutschland erzielt.

Das Vermögen und die Investitionen wurden auf der Grundlage des Standortes der jeweiligen Konzerngesellschaft ermittelt. Das langfristige Vermögen des Konzerns besteht im Wesentlichen aus immateriellen Vermögenswerten, Geschäfts- oder Firmenwerten und Sachanlagen. Vom langfristigen Vermögen sind 32.297 Tsd. € (Vorjahr: 32.297 Tsd. €) Gesellschaften in Deutschland zuzurechnen; 7.918 Tsd. € (Vorjahr: 8.444 Tsd. €) entfallen auf ausländische Gesellschaften. Der SÜSS MicroTec-Konzern hat im abgelaufenen Geschäftsjahr Investitionen in Höhe von 2.242 Tsd. € (Vorjahr: 10.513 Tsd. €) in Deutschland vorgenommen.

## **(35) NACHTRAGSBERICHT**

Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag, die einen signifikanten Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Konzerns haben, haben sich nicht ergeben.

## (36) VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

### VORSTAND DER KONZERNBEREINIGUNGSGESELLSCHAFT

*Mitglieder des Vorstandes der SÜSS MicroTec AG im Geschäftsjahr 2014 waren:*

**Frank Averdung (bis 24. August 2014)**

Diplom-Elektroingenieur, Feldkirchen, Vorstandsvorsitzender

**Zuständigkeitsbereiche:**

Vertrieb, Marketing, Produktion, Forschung und Entwicklung, Investor Relations, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Patentwesen, Konzernstrategie

**weitere Mandate:**

- Semi European Advisory Board (Mitglied)
- IMS Nanofabrication AG, Wien (Mitglied des Aufsichtsrats)

**Michael Knopp**

Diplom-Kaufmann, Ratingen, Finanzvorstand, Vorstandssprecher seit 24. August 2014

**Zuständigkeitsbereiche:**

Finanz- und Rechnungswesen, Informatik, Recht, Steuern und Versicherungen, Personal, Facility Management, Materialwirtschaft und Logistik (bis 1. Juli 2014). Seit 24. August 2014 zusätzlich Marketing und Vertrieb, Konzernstrategie, Investor Relations.

**weitere Mandate:**

- keine

**Walter Braun (seit 01. Juli 2014)**

Diplom-Ingenieur, Altensteig, Mitglied des Vorstands

**Zuständigkeitsbereiche:**

Produktion, Arbeitssicherheit, Qualitätsmanagement, Umweltschutz, Materialwirtschaft und Logistik. Seit 24. August 2014 zusätzlich Patentwesen, Konzernstrategie, Forschung und Entwicklung

**Weitere Mandate:**

- keine

### AUFSICHTSRAT

*Mitglieder des Aufsichtsrats im Geschäftsjahr 2014 waren:*

**Dr. Stefan Reineck**

Kirchart, Geschäftsführender Gesellschafter der RMC Dr. Reineck Management & Consulting GmbH, Kirchart; Aufsichtsratsvorsitzender der SÜSS MicroTec AG

**Weitere Mandate:**

- AttoCube Systems AG, München (Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats)
- AWS-Group AG, Heilbronn (Mitglied im Aufsichtsrat)
- Phoseon Technology Inc., Hillsboro, Oregon, USA (Mitglied im „Board of Directors“)
- Wittenstein AG, Igersheim (Mitglied im Aufsichtsrat)

**Jan Teichert**

Metten, Mitglied des Vorstands der Einhell Germany AG, Landau / Isar; Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der SÜSS MicroTec AG

**Weitere Mandate:**

- seit 1. Januar 2014 Kolb Technology GmbH, Hengersberg (Mitglied des Beirats)

**Gerhard Pegam**

Au bei Bad Aibling, Geschäftsführender Gesellschafter der GPA Consulting GmbH, Au bei Bad Aibling; Aufsichtsratsmitglied der SÜSS MicroTec AG

**Weitere Mandate:**

- OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats);
- Schaffner Holding AG, Solothurn, Schweiz (Mitglied des Verwaltungsrats)

## VERGÜTUNG VORSTAND UND AUFSICHTSRAT

Die Mitglieder des Vorstands erhielten eine Barvergütung in Höhe von 2.173 Tsd. € (Vorjahr: 811 Tsd. €). Der Betrag der Vorstandsvergütung 2014 enthält eine Abfindung in Höhe von 1.050 Tsd. € für Herrn Averdung, der am 24. August 2014 ausgeschieden ist.

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats betrug einschließlich Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen 159 Tsd. € (Vorjahr: 152 Tsd. €).

Individualisierte Angaben zur Vergütung des Vorstands und des Aufsichtsrats sind im Vergütungsbericht, der Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts ist, dargestellt.

Aktien- und Optionsbestände der Organmitglieder zum Jahresende:

	2014		2013	
	Aktien	Optionen	Aktien	Optionen
Michael Knopp	25.000	0	28.100	0
Walter Braun	10.500	0	0	0
Frank Averdung	95.720	0	90.540	0
Dr. Stefan Reineck	9.600	0	9.600	0

## (37) MITARBEITER

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 651 Mitarbeiter (Vorjahr: 675 Mitarbeiter) in der SÜSS MicroTec-Gruppe beschäftigt.

Stand am Jahresende:

	2014	2013
Verwaltung	66	65
Marketing und Vertrieb	249	263
Produktion und Technik	344	327
<b>Summe</b>	<b>659</b>	<b>655</b>

## (38) HONORARE DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Im aktuellen Geschäftsjahr hat SÜSS MicroTec für den Abschlussprüfer des Konzernabschlusses, BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, Honoraraufwendungen nach § 314 Abs. 1 Nr. 9 HGB in Höhe von 260 Tsd. € (Vorjahr: 250 Tsd. €) erfasst. Die Aufwendungen betreffen ausschließlich die Abschlussprüfung.

Die Aufwendungen für die Abschlussprüfung enthalten das gesamte Honorar für die Jahresabschlussprüfung der SÜSS MicroTec AG sowie die Konzernabschlussprüfung und die durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Jahresabschlüsse von Tochtergesellschaften. Von dem Prüfungshonorar entfallen 227 Tsd. € direkt auf den bestellten Abschlussprüfer und 33 Tsd. € auf Netzwerkpartner des Abschlussprüfers.

Beratungsleistungen wurden durch die BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft weder im Geschäftsjahr noch im Vorjahr erbracht.

## (39) CORPORATE GOVERNANCE

Wie bereits in den Vorjahren haben Vorstand und Aufsichtsrat im Januar 2014 eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 mit fünf Ausnahmen – Selbstbehalt bei der D&O-Versicherung, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – entsprechen werden und den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2013 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Im Januar 2015 haben Vorstand und Aufsichtsrat eine Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG abgegeben und erklärt, dass sie den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 24. Juni 2014 mit folgenden Ausnahmen – Selbstbehalt bei D&O-Versicherungen, vertikaler Vergütungsvergleich, Versorgungszusagen, Bildung von Ausschüssen und Ziele für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats – entsprechen werden. Ferner haben Vorstand und Aufsichtsrat erklärt, dass sie den Empfehlungen des Kodex in der Fassung vom 13. Mai 2013 seit der Abgabe der letzten jährlichen Entsprechenserklärung im Januar 2014 mit den darin angegebenen Ausnahmen entsprochen haben.

Die Entsprechenserklärungen wurden im Internet unter  
 > [www.suss.com](http://www.suss.com) dauerhaft zugänglich gemacht.

## (40) ANGABE GEMÄSS § 160 NR. 8 AKTG

Im Geschäftsjahr wurden gegenüber der Gesellschaft folgende Mitteilungen gemäß § 21 Abs. 1 WpHG i.V.m. § 32 Abs. 2 InvG gemacht:

Die Henderson Group Plc, London, United Kingdom, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

### Korrektur der Stimmrechtsmeldung vom 28.01.2014

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizontal Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Der Henderson Horizontal Fund – Pan European Smaller Companies Fund, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,17 % beträgt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizontal Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizontal Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

### Korrektur der Stimmrechtsmeldung vom 28.01.2014

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 3 % überschritten hat und zu diesem Tag 3,17 % beträgt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 24. Januar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5 % überschritten hat und zu diesem Tag 5,13 % beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,13 % (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3 % oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund – Pan European Smaller Companies Fund gehalten.

Die Baillie Gifford & Co, Edinburgh, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 27. Februar 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 26. Februar 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,003% beträgt (574.032 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,275% (243.632 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,728% (330.400 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG sowie § 22 Abs. 1 Satz 2 (via Baillie Gifford Overseas Limited) zuzurechnen.

Der Henderson Horizon Fund, SICAV, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22. April 2014 mitgeteilt, dass der Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,18% beträgt (606.922 Stimmrechte).

Die Henderson Global Investors (Holdings) Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22. April 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5% überschritten hat und zu diesem Tag 5,14% beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund, SICAV gehalten.

Die Henderson Global Investors Limited, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22. April 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5% überschritten hat und zu diesem Tag 5,14% beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund, SICAV gehalten.

Die Henderson Group Plc, London, UK, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 22. April 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 23. Januar 2014 die Schwelle von 5% überschritten hat und zu diesem Tag 5,14% beträgt (982.355 Stimmrechte). Davon sind ihr 5,14% (982.355 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen. Von diesen Stimmrechten werden 3% oder mehr direkt von der Henderson Horizon Fund, SICAV gehalten.

Die Dimensional Fund Advisors LP, Austin, Texas, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Juli 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 7. Juli 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,01% beträgt (574.432 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,86% (546.861 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 0,17% (33.256 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Dimensional Holdings Inc., Austin, Texas, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 9. Juli 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 7. Juli 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,01% beträgt (574.432 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,01% (574.432 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 15. Juli 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 15. Juli 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,07% beträgt (585.900 Stimmrechte).

Die Union Investment Privatfonds GmbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 12. August 2014 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,64% beträgt (505.188 Stimmrechte).

Die Credit Suisse Fund Management S.A, Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 13. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 11. August 2014 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,97% beträgt (566.933 Stimmrechte). Davon sind ihr 0,39% (74.640 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG zuzurechnen.

Die ING Investment Management Belgium S.A., Brüssel, Belgien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 8. August 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,42% beträgt (654.298 Stimmrechte).

Die ING Investment Management Luxembourg S.A., Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 08. August 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,42% beträgt (654.298 Stimmrechte).

Die ING Fund Management B.V., Den Haag, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 08. August 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,42% beträgt (654.298 Stimmrechte).

#### Korrektur der Stimmrechtsmeldung vom 15. August 2014

Die ING Investment Management Belgium S.A., Brüssel, Belgien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 8. August 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,42% beträgt (654.298 Stimmrechte). Davon sind ihr 3,42% (654.298 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen.

Die ING Investment Management Luxembourg S.A., Luxemburg, Luxemburg, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 8. August 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,42% beträgt (654.298 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,35% (448.348 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen.

Die ING Fund Management B.V., Den Haag, Niederlande, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 12. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 08. August 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,42% beträgt (654.298 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,08% (205.950 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 2 WpHG zuzurechnen.

Die Sycomore Asset Management, Paris, Frankreich, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 21. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 12. August 2014 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 3,14% beträgt (600.000 Stimmrechte).

Die Dimensional Fund Advisors LP, Austin, Texas, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 28. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 26. August 2014 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,99% beträgt (572.286 Stimmrechte).

Davon sind ihr 2,83% (540.460 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 0,20% (37.511 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Dimensional Holdings Inc., Austin, Texas, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 28. August 2014 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 26. August 2014 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,99% beträgt (572.286 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,99% (572.286 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 8. Januar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 2. Januar 2015 die Schwelle von 3% überschritten hat und zu diesem Tag 4,44% beträgt (848.291 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,59% (304.356 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,57% (492.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 3. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 30. Januar 2015 die Schwelle von 5% überschritten hat und zu diesem Tag 5,04% beträgt (964.360 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,32% (444.356 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,62% (500.000 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroders PLC, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 3. Februar 2015 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,96% beträgt (564.820 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,96% (564.820 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroder Administration Limited, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 3. Februar 2015 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,96% beträgt (564.820 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,96% (564.820 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Die Schroder Investment Management Ltd, London, Großbritannien, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 4. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, 3. Februar 2015 die Schwelle von 3 % unterschritten hat und zu diesem Tag 2,96 % beträgt (564.820 Stimmrechte). Davon sind ihr 1,34% (256.507 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 1,61% (308.313 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

Der Vanguard Whitehall Funds, Delaware, USA, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 10. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 5. Februar 2015 die Schwelle von 3% unterschritten hat und zu diesem Tag 2,919% beträgt (558.034 Stimmrechte).

Die Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, Deutschland, hat uns gemäß § 21 Abs. 1 WpHG am 18. Februar 2015 mitgeteilt, dass ihr Stimmrechtsanteil an der SÜSS MicroTec AG, Garching, Deutschland, am 13. Februar 2015 die Schwelle von 5% unterschritten hat und zu diesem Tag 4,89% beträgt (933.859 Stimmrechte). Davon sind ihr 2,37% (453.856 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG und 2,51% (479.965 Stimmrechte) nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG in Verbindung mit § 22 Abs. 1 Satz 2 zuzurechnen.

## (41) FREIGABE DES ABSCHLUSSES

Der Vorstand der SÜSS MicroTec AG hat den IFRS-Konzernabschluss am 10. März 2015 zur Weitergabe an den Aufsichtsrat freigegeben. Der Aufsichtsrat hat die Aufgabe, den Konzernabschluss zu prüfen und zu erklären, ob er den Konzernabschluss billigt.

Garching, 10. März 2015

Der Vorstand



Michael Knopp



Walter Braun

## VERSICHERUNG DER GESETZLICHEN VERTRETER

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Konzernabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns vermittelt und im Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der Süss MicroTec AG zusammengefasst ist, der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Konzerns so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Konzerns beschrieben sind.

Garching, den 10. März 2015

SÜSS MicroTec AG



**Michael Knopp**  
Finanzvorstand  
(Vorstandssprecher)



**Walter Braun**  
Produktionsvorstand

# BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den von der SÜSS MicroTec AG, Garching, aufgestellten Konzernabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Gesamtergebnisrechnung, Eigenkapitalveränderungsrechnung, Kapitalflussrechnung und Anhang – sowie den Konzernlagebericht, der mit dem Lagebericht der SÜSS MicroTec AG zusammengefasst ist, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014 geprüft. Die Aufstellung von Konzernabschluss und Konzernlagebericht nach den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Konzernabschluss und den Konzernlagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Konzernabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Konzernabschluss unter Beachtung der anzuwendenden Rechnungslegungsvorschriften und durch den Konzernlagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Konzerns sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben im Konzernabschluss und Konzernlagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der Jahresabschlüsse der in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen, der Abgrenzung des Konsolidierungskreises, der angewandten Bilanzierungs- und Konsolidierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Konzernabschluss der SÜSS MicroTec AG, Garching, den IFRS, wie sie in der EU anzuwenden sind, und den ergänzend nach § 315a Abs. 1 HGB anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Konzerns. Der Konzernlagebericht steht in Einklang mit dem Konzernabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Konzerns und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

München, den 11. März 2015

BDO AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

**M. Oppel**  
Wirtschaftsprüfer

**T. Steiner**  
Wirtschaftsprüfer

# GLOSSAR

## 3D-INTEGRATION

3D-Integration unterteilt sich in zwei Hauptkategorien: das 3D-Packaging und 3D-Interconnect. 3D-Packaging bezeichnet Bauteile, die auf Wafer Level Packaging-Ebene gestapelt werden ohne durch sogenannte Through-Silicon Vias (TSV) miteinander verbunden zu sein. Unter 3D-Packaging werden Technologien wie SOC (System-on-a-Chip) sowie weitere Verfahren subsumiert, bei denen die Verbindung üblicherweise auf Wire Bonding (Drahtbonden) basiert. 3D-Interconnect beinhaltet dagegen Bauteile, die durch Through-Silicon Vias (TSV) verbunden sind. Dabei handelt es sich um vertikale Durchkontaktierungen durch das in der Regel stark gedünnte massive Silizium.

## 300-mm-TECHNOLOGIE

Wafer sind runde Scheiben z. B. aus einkristallinem Reinst-Silizium, das als Grundmaterial für die Herstellung von Mikrochips dient. Der allergrößte Teil (~42%) der heute weltweit verwendeten Silizium-Scheiben hat einen Durchmesser von 300 Millimetern. Je größer der Durchmesser des Wafers, umso größer ist auch die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können. Je höher die Anzahl der Chips, die auf einem Wafer hergestellt werden können, desto geringer sind die Produktionskosten pro individuellem Chip.

## ADVANCED PACKAGING

Mit dem Begriff „Packaging“ wird die Technologie des „Verpackens“ von Mikrochips in Gehäuse bezeichnet. Dabei müssen alle Anschlusskontakte des Mikrochips einzeln auf die Außenseite des Gehäuses geführt werden, um dann die Verbindung zur Leiterplatte zu gewährleisten. Unter Advanced Packaging versteht man weiterentwickelte Packaging-Verfahren, die in der Regel Methoden einsetzen, die bisher nur bei der Herstellung der Mikrochips selbst, also im sogenannten Frontend der Chipfertigung eingesetzt wurden. Als Beispiel können hier Lithografie und Fotoresist-Techniken genannt werden.

## BACKEND

Backend bezeichnet den zweiten (hinteren) Teil der Fertigungskette in der Mikrochipfertigung. Nachdem der Wafer sämtliche Prozessschritte zur Herstellung des eigentlichen Mikrochips durchlaufen hat (Frontend), beginnt der Backend-Prozess. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet und ggf. für das Bonden vorbereitet.

Danach werden die Wafer in die einzelnen Mikrochips zersägt und diese werden in Gehäuse „verpackt“. Aus Kostengründen findet der Backend-Prozess überwiegend in Asien statt, wo die Halbleiterhersteller eigene Backend-Werke betreiben oder Test und Packaging bei Drittfirmen (Foundries) durchführen lassen.

## BONDEN

Mit dem Begriff „Bonden“ bezeichnet man das Verbinden von zwei oder mehreren Bauteilen oder Wafern mit Hilfe verschiedener chemischer und physikalischer Effekte, z. B. bedeutet „adhesives Bonden“ das Verkleben zweier Bauteile durch Klebstoffe (meistens Epoxidharze oder Fotoresist); „Fusion Bond“ oder „Direct Bond“ ist das direkte Verbinden zweier Wafer, die zunächst nur durch die schwachen atomaren Kräfte von Wassermolekülen in der Grenzschicht (Van-der-Waals-Kräfte) miteinander verbunden werden. Durch ein anschließendes Ausheizen werden die Wassermoleküle aufgebrochen und die frei werdenden Sauerstoffatome verbinden sich mit Siliziumatomen des Wafers zu Siliziumoxid (kovalente Bindung). Diese Bindung stellt eine sehr feste, nichtlösbare Verbindung der beiden Wafer dar.

## BUMP

(engl.: Unebenheit); metallische (Lot, Gold, o. ä.), dreidimensionale Kontaktstelle auf einem Chip. Kann vereinfacht auch als Lotkugelchen auf einem einzelnen Anschlusskontakt eines Mikrochips bezeichnet werden.

## CHIP

Allgemeiner Begriff für Halbleiterbauelemente. In der Elektronik versteht man unter einem Chip oder Mikrochip den IC (Integrated Circuit), der in ein Gehäuse eingebettet ist. Von außen sieht man in der Regel nur das schwarze Gehäuse und die Anschlussstelle, mit denen der Chip mit der Leiterplatte verbunden wird (durch Wire Bonding oder Flip Chip Bonding). Als Chip oder Mikrochip wird häufig aber auch nur das Stück Silizium bezeichnet, das im Gehäuse sitzt.

## CLUSTER

Eine Gerätegruppe von einzelnen Prozessmodulen (z. B. Coater, Aligner), die von einem zentral angeordneten Roboter mit den zu bearbeitenden Wafern bestückt wird.

## COATER (BESCHICHTUNGSGERÄT)

Coater sind Spezialmaschinen für die Halbleiterfertigung, die einen fotoempfindlichen Lack mittels Rotationskraft auf dem Wafer verteilen.

**COMPOUND SEMICONDUCTOR**

siehe Verbindungshalbleiter

**COST-OF-OWNERSHIP**

Bewertet Anschaffungs- und Betriebskosten sowie die Kosten für Reinraumfläche, Verbrauch und Wartung der Maschinen. Diese Kosten werden dann in Bezug auf den Anteil funktionsfähiger Bauteile am Ende des Herstellungsverfahrens berechnet. Je höher die Ausbeute an perfekten Chips, desto besser ist die Cost-of-Ownership der Maschinen für den Kunden. Eine hervorragende Cost-of-Ownership ist besonders im Rahmen der Massenproduktion von großer Bedeutung.

**C4NP**

IBM hat in den späten 1960er-Jahren den Weg für das Flip Chip Bonding bereitet. Zum ersten Mal wurde diese Technologie 1973 in dem IBM-System/3 eingesetzt. Seither wurden unter dem Namen IBM C4 Milliarden Chips in diesem Verfahren mit der Außenwelt kontaktiert. C4 steht für Controlled Collapse Chip Connection und wird teilweise auch synonym für Flip Chip Bonding verwendet. C4NP ist die Technologie der nächsten Generation, die IBM gemeinsam mit SÜSS MicroTec auf Basis des bewährten C4-Prozesses entwickelt hat. NP steht dabei für New Process.

**DIE**

„Die“, IC (Integrated Circuit), Chip sind oft synonym verwendete Begriffe. „Die“ heißen die IC, solange sie noch nicht in das Gehäuse integriert wurden. Solange der Wafer also die einzelnen Prozessschritte durchläuft, spricht man von „Dies“. Erst nach dem Vereinzeln und Verpacken der „Dies“ spricht man von Chips.

**DRAM**

DRAM steht für Dynamic Random Access Memory. Elektronischer Speicherbaustein, der hauptsächlich in Computern eingesetzt wird.

**FAB**

(engl.: Fabrik); Fabriken, die sich auf die Produktion von IC auf Wafern (Chips) spezialisiert haben. Die Errichtung einer großen modernen Fab mit den erforderlichen Reinräumen und Maschinen (Equipment) kostet heute ca. 1,5 bis 4 Mrd. USD.

**FLIP CHIP BONDING**

Fortschrittliche Verbindungstechnik zwischen Mikrochip und Chipgehäuse, die höhere Taktfrequenzen bei der Signalübertragung ermöglicht. Die aktive Chipseite zeigt dabei nach unten, d. h. der Chip muss vor der Montage umgedreht (engl.: to flip) werden.

**FOTORESIST**

Lichtempfindliches Material, das zunächst als Schicht auf den Wafer aufgetragen wird und dann mit Hilfe von UV-Licht durch eine Maske hindurch belichtet wird. An den belichteten Stellen werden durch das UV-Licht chemische Veränderungen erzeugt. Diese Teilbereiche werden während der Entwicklung aus der Schicht herausgelöst, so dass eine reliefartige Struktur im Fotoresist entsteht. Dieser Prozess ist dem in der Fotografie sehr ähnlich.

**FOUNDRY**

Foundry ist eine Fabrik zur Chipherstellung, in der Mikrochips nach einem vom Kunden vorgegebenen Design der Schaltkreise gefertigt werden. Es handelt sich somit um eine Art Auftragsfertigung. Da den Foundry-Betreibern keine Kosten für das Chipdesign sowie für den Vertrieb und das Marketing ihrer Produkte entstehen, können sie ihre Forschung und Entwicklung für Ressourcen vollständig auf die Prozesstechnologie konzentrieren. Die weltweit führenden Foundries sind in Taiwan und Singapur angesiedelt.

**FRONTEND**

Frontend-Prozesse sind sämtliche Produktionsschritte, die der Wafer als Ganzes durchläuft. Hier wird der Chip an sich hergestellt. Danach schließt sich das Backend an. Dort werden die Mikrochips auf dem Wafer getestet, der Wafer anschließend in die einzelnen Chips zersägt, die dann mit einem Gehäuse versehen werden.

**HALBLEITER**

Ein kristalliner Werkstoff, dessen elektrischer Widerstand sich durch das Implantieren von Fremdatomen in das Kristallgitter verändern lässt. Silizium ist das wichtigste und am häufigsten vorkommende Halbleiterelement. Auch IC aus diesem Werkstoff werden oft Halbleiter genannt.

**IC**

Integrated Circuit, ein integrierter Schaltkreis besteht aus elektronischen Bauelementen wie Transistoren, Widerständen und Kondensatoren, die auf engstem Raum auf einem Mikrochip integriert sind. Heute werden viele zehn Millionen solcher Zellen auf einem Chip integriert und miteinander verschaltet. Die hohe Integrationsdichte von Mikrochips hat zu einer enormen Leistungsfähigkeit der Chips geführt.

**IDM (INTEGRATED DEVICE MANUFACTURER)**

Hierbei handelt es sich um Unternehmen in der Halbleiterbranche, die Halbleiter-Bauteile selbst entwickeln, produzieren und vermarkten.

## LASERPROZESSIERUNG

Neue Entwicklungen in der Festkörper-Laser-Technologie, wie z. B. die hochleistungsfähigen UV-Laser mit hohen Pulsraten in Pikosekunden, haben die Anwendungsmöglichkeiten für Laser um die Mikrostrukturierung erweitert. SÜSS MicroTec bietet zwei Lasertechnologien an:

**Excimer-Laserabdampfung:** In der Mikrostrukturierung bietet der Einsatz von Excimer-Laser vor allem Möglichkeiten für eine Materialabdampfung. Durch Beschuss mit gepulster Laserstrahlung lässt sich Material von einer Oberfläche abtragen. Dabei stößt eine photochemische Reaktion eine Elektronenanregung an, die in einem plötzlichen Druckanstieg und einer explosiven Abtragung von Material in Form von Monomeren und Gasen resultiert. Die thermische Wirkung ist hierbei minimal – die Prozesstechnologie schont temperaturempfindliche Materialien. Die Systeme verwenden eine Photomaske, die mit einem Laserstrahl beleuchtet wird. Eine Projektionsoptik zwischen Maske und Wafer bildet, ähnlich einem Projektionsstepper in der Lithografie, die Maskenstrukturen auf dem Wafer ab. Jedoch wird das Material nicht belichtet, sondern direkt abgetragen. Mit einem Step-and-Repeat-Verfahren wird der komplette Wafer strukturiert.

**Prozessierung mit Festkörper-Laser:** Die Festkörper-Laser-Technologie verspricht alle Vorteile der Laserprozessierung: Sie erreicht hohe Auflösungen von bis zu zwei Mikrometer und sorgt für besonders präzise Ergebnisse. Strukturierungsprozesse laufen ohne thermische Nebenwirkungen ab. Die Systeme kommen ohne Maske aus und verwenden eine direkte Schreibmethode.

## LED

Light Emitting Diode; Leuchtdioden sind Halbleiterbauteile, die Licht erzeugen können. LED leuchten sehr hell und verbrauchen gleichzeitig sehr wenig Energie. Darüber hinaus haben sie eine mehr als zehnmal so große Lebensdauer wie eine normale Glühbirne.

## LITHOGRAFIE

Die elektrischen Schaltkreise der IC werden durch Strukturierung einzelner Ebenen auf einem Siliziumwafer in einer Art Schichten- und Aufbau hergestellt. Um die sehr kleinen Strukturen in den einzelnen Schichten zu erzeugen, wird der Wafer mit einem lichtempfindlichen Material (Fotoresist) beschichtet und dann unter Verwendung einer Maske belichtet. Die Strukturen auf der Maske werden so mittels Schattenwurf auf den Wafer aufgebracht. An Stellen, an denen die Maske lichtundurchlässig ist, wird der Fotoresist auf dem Wafer nicht belichtet. An lichtdurchlässigen Stellen der Maske fällt Licht auf den Wafer und der Fotoresist wird belichtet. Während der Entwicklung im Anschluss an die Belichtung werden die Stellen des Fotoresist, die durch die transparenten Stellen der Maske belichtet wurden, aus der Schicht herausgelöst und der Wafer wird an diesen Stellen freigelegt. Typische Strukturgrößen für Lithografieanwendungen im Frontend liegen heute in einer Größenordnung von 32 Nanometer (0,032 Mikrometer) bis 0,6 Mikrometer. Im Backend werden Strukturgrößen von einigen Mikrometern bis einigen zehn Mikrometern fotolithografisch erzeugt, z. B. um die Bumps für das Flip Chip Bonding herzustellen.

## MASKE

Eine teiltransparente Platte aus Glas oder Quarzglas, auf der die Muster abgebildet sind, die zur Herstellung eines IC benötigt werden; die Muster bestehen aus durchsichtigen und undurchsichtigen Bereichen entsprechend der Größe und Form der gewünschten Schaltkreise.

## MASK ALIGNER (BELICHTUNGSGERÄT)

Mask Aligner richten eine Glasmasken submikrometergenau zu einem Wafer aus. Das mikroskopische Bild auf der Glasmasken wird mittels Belichtung auf den belackten Wafer übertragen.

## MEMS

MEMS steht für Micro Electro Mechanical System und ist der vor allem in Nordamerika verwendete Begriff für die Mikrosystemtechnik (MST, in Europa gebräuchlicher). Fertigungstechnologien und Prozesse der Halbleiterfertigung werden eingesetzt, um mechanische und andere nichtelektronische Elemente herzustellen. MEMS-Produkte werden beispielsweise in der Automobilindustrie, der Telekommunikation, der Optoelektronik und der Medizintechnik eingesetzt.

## MIKROMETER / MIKRON

Metrisches Längenmaß; Symbol:  $\mu\text{m}$ . Ein Mikrometer ist ein Millionstel Meter. Zur Veranschaulichung: Der Durchmesser eines menschlichen Haares beträgt ca. 60  $\mu\text{m}$ .

**MIKROSYSTEM**

Ein aus verschiedenen Bauteilen, die in der Dimension unterhalb eines Millimeters liegen, zusammengesetztes System.

**MIKROSYSTEMTECHNIK**

Je nach Region gibt es die unterschiedlichsten Definitionen des Begriffs. In Europa wird damit die gesamte Verkleinerung von Bauteilen aus der Feinwerktechnik in den Bereich von Strukturen unterhalb eines Millimeters verstanden. In den USA und Asien bedeutet Micro System Technology oder der häufiger verwendete Begriff Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) den Einsatz von Techniken der Halbleiterelektronik zur Erzeugung kleinster Sensoren oder aber auch komplexer Systeme, wie z. B. einer kompletten chemischen oder biologischen Analyseeinheit. MEMS-Baugruppen sind z. B. der Beschleunigungssensor aus Silizium, der zum Auslösen des Airbags eingesetzt wird, oder aber die Düse in der Patrone des Tintenstrahldruckers.

**NANOIMPRINTING / NANO IMPRINT LITHOGRAFIE (NIL)**

Ein mechanisches Verfahren, mit dem zwei- oder dreidimensionale Strukturen im Nanometerbereich mit einem Abformwerkzeug oder Stempel hergestellt werden. Im Gegensatz zur fotolithografischen Erzeugung von Schaltungen auf Halbleiter-Wafern werden die Strukturen durch „Stempeln“ in einem weichen Kunststoff vorgegeben. Man erhofft sich vom Nanoimprinten in der Zukunft einen Preisvorteil, weil die Fortsetzung der Fotolithografie in Richtung höchste Auflösung extrem kurze Wellenlängen der Lichtstrahlung (EUV, Röntgen) benötigen wird, und das entsprechende Equipment unangemessen teuer zu werden droht.

**NANOTECHNOLOGIE**

Sammelbegriff für eine breite Auswahl von Technologien, die sich mit Strukturen und Prozessen im Größenbereich von einem bis mehreren hundert Nanometer befassen. Ein Nanometer ist ein Milliardstel Meter ( $10^{-9}$  m) und bezeichnet einen Grenzbereich, in dem die typischen Abmessungen von einzelnen Molekülen liegen. Nanotechnologie ist eine konsequente Fortsetzung und Erweiterung der Mikrotechnik mit meist völlig unkonventionellen neuen Ansätzen: Die Nanotechnologie beschäftigt sich damit, Werkstoffe und Strukturen im Nanometerbereich zu schaffen.

**OPTOELEKTRONIK**

Durch das gezielte Kombinieren von Technologien der Halbleiterelektronik mit sogenannten III/V-Materialien wie z. B. Galliumarsenid kann Licht erzeugt oder detektiert werden (Halbleiterlaser, LED, Fotodioden etc.). Diese Technologie wird hauptsächlich in der Telekommunikation für die Übertragung sehr großer Datenmengen (faseroptische Netze) eingesetzt. Allerdings finden LED wegen ihrer vielen Vorteile, wie des geringen Energiebedarfs, der sehr hohen Helligkeit und der sehr langen Lebensdauer, zunehmend Verwendung im Automobilbau und im Haushalt.

**OSAT (OUTSOURCED ASSEMBLY AND TEST HOUSES)**

Diese Unternehmen sind im Mid- und Backend der Halbleiterindustrie angesiedelt. Sie offerieren Packaging-Lösungen, Testsysteme und weitere Serviceleistungen für Halbleiterhersteller, ohne dabei an einen bestimmter Hersteller gebunden zu sein. Schwerpunkt ist häufig das Packaging und Assembly von ICs und anderen Halbleiterprodukten.

**PACKAGING FOUNDRIES**

siehe Backend

**PROJEKTIONS-LITHOGRAFIE**

Während bei der Vollfeld-Lithografie (Mask Aligner) der komplette Wafer in einem Vorgang belichtet wird, werden bei projektionslithografischen Prozessen typischerweise nur einzelne Bereiche des Wafers unter Verwendung einer Projektionsoptik belichtet. Die komplette Belichtung des Wafers wird dann entweder schrittweise (step and repeat) oder kontinuierlich (scan) durchgeführt. SÜSS MicroTec fertigt 1:1-Projektionsscanner für das Halbleiter-Mid- und Backend. Hierbei wird eine Vollfeldmaske verwendet und der Wafer in einem Scannvorgang belichtet. Eine Verkleinerung der Strukturgrößen von der Maske zum Wafer findet nicht statt. Die Projektionsscanner-Technologie von SÜSS MicroTec kombiniert Vorteile der Vollfeldbelichtung mit denen der klassischen Projektionslithografie und bietet eine Alternative zu Mask Aligner und Projektions-Steppern.

**SENSOR**

Ein Bauteil zum Erfassen und Umwandeln von Messgrößen wie Temperatur, Druck oder Beschleunigung; diese Größe wird in ein elektrisches Signal gewandelt und an eine Signalauswertungseinheit weitergegeben.

**SILIZIUM**

Werkstoff mit dem Aufbau eines Kristallgitters mit halbleitenden Eigenschaften; halbleitend bedeutet, dass je nach Einbau von bestimmten Fremdatomen der Werkstoff als elektrischer Leiter oder als Nichtleiter verwendet werden kann. In der Halbleiterindustrie wird Silizium in Form von Scheiben eines Einkristalls als der wesentliche Grundstoff verwendet.

**SUBSTRAT BONDER (VERBINDUNGSGERÄT)**

Der Substrat Bonder verbindet zwei oder mehr äußerst präzise zueinander ausgerichtete Substrate, meist Wafer, durch Lötten, Kleben oder andere physikalisch-chemische Verfahren miteinander. Viele MEMS-Bausteine benötigen diesen Prozessschritt. Erst dann können Airbags, Reifendrucksensoren, GPS-Sensoren, Tintenstrahldrucker, etc. funktionieren.

**SYSTEM-ON-A-CHIP**

Hochkomplexe IC, die viele verschiedene Funktionen enthalten; bis vor Kurzem musste man diese noch auf mehreren IC unterbringen. Die gewaltige Innovationskraft in der Prozesstechnik, die die Fertigung von IC mit immer kleineren Strukturbreiten erlaubt, ermöglicht heute, dass auf einem Chip verschiedene Sorten von Speichern, digitale Signalprozessoren und analoge Funktionen untergebracht werden können. Vorteil hiervon ist, dass anstatt vieler Chips nur noch sehr wenige oder ein einzelner erforderlich sind, und sich so der Platzbedarf, der Montageaufwand (und damit die Kosten des Endprodukts) und, was sehr wichtig ist, die Leistungsaufnahme verringern. In batteriebetriebenen Geräten (Notebooks, Handys) verlängert sich so die Lebensdauer der Batterien. Der Trend zu immer kleineren und mobilen Geräten, die zudem immer günstiger werden sollen, verleiht System-on-a-Chip immer größere Bedeutung.

**THROUGH-SILICON VIA (TSV)**

Bei der Through-Silicon Via-Technik werden die einzelnen Chip-Komponenten übereinander gestapelt und mittels vertikaler Durchkontaktierungen (Through-Silicon Via) miteinander verbunden. Dadurch verkürzt sich der Weg des Datenstroms zwischen den einzelnen Chipkomponenten, und lassen sich Kapazitätsverluste wesentlich reduzieren. Through-Silicon Vias tragen somit zu einer Verringerung der Baugröße von Chips bei gleichzeitiger Steigerung der Leistungsfähigkeit bei.

**TOOL**

Maschinen, Werkzeuge, Roboter usw.; Tools sind alle Einzelsysteme, die in einer Halbleiterfabrik zu einer Produktionslinie kombiniert werden.

**VERBINDUNGSHALBLEITER**

Halbleiter, die sich aus mehreren Elementen zusammensetzen (Galliumarsenid, Indiumphosphid, Siliziumgermanium etc.); Vorteile gegenüber einfachen Element-Halbleitern: Verbindungshalbleiter sind besonders schnell und können auch bei sehr hohen Temperaturen arbeiten und verbrauchen trotzdem weniger Energie als einfache Siliziumchips.

**WAFER**

Runde Scheiben z. B. aus Reinst-Silizium oder Verbindungshalbleitern (Galliumarsenid, Indiumphosphid, etc.), auf denen Chips produziert werden; in den letzten zehn Jahren hat sich der Durchmesser von 150 über 200 auf heute sogar 300 Millimeter vergrößert. Auf die Grundfläche der neuesten 300-mm-Wafer passen doppelt so viele Chips wie auf einen 200-mm-Wafer – die Produktionskosten sind dadurch ca. 30% niedriger.

**WIRE BONDING**

Gängiges Kontaktverfahren, um Chips über Metalldrähte mit einem Gehäuse zu verbinden

**YIELD**

Die Ausbeute ist eine der wesentlichen Kenngrößen in der Halbleiterfertigung. Sie bezeichnet die Ausbeute der funktionsfähigen Mikrochips im Verhältnis zur Gesamtzahl der Mikrochips auf einem Wafer. Je höher der Yield, desto effektiver und kostengünstiger ist die Chipproduktion für den Kunden.

# Finanzkalender 2015

Geschäftsbericht 2014	30. März
3-Monatsabschluss	7. Mai
Hauptversammlung, Haus der Bayerischen Wirtschaft, München	2. Juni
6-Monatsabschluss	6. August
9-Monatsabschluss	5. November

## IMPRESSUM

Herausgeber	SÜSS MicroTec AG
Redaktion	Finance, Julia Natterer Investor Relations, Franka Schielke
Wirtschaftsprüfer	BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Konzept und Gestaltung	Whitepark GmbH & Co., Hamburg
Druck	Eberl Print GmbH, Immenstadt
Fotos	SÜSS MicroTec AG, Creativ Fotostudio Allan Richard Tobis, iStock

## KONTAKT

SÜSS MicroTec AG  
Schleißheimer Straße 90  
85748 Garching, Deutschland  
Telefon: +49 (0)89-32007-0  
E-Mail: info@suss.com

Investor Relations  
Telefon: +49 (0)89-32007-161  
E-Mail: ir@suss.com

**Zukunftsorientierte Aussagen:** Die Jahresberichte enthalten zukunftsorientierte Aussagen. Zukunftsorientierte Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, einschließlich Aussagen über Erwartungen und Ansichten des Managements der SÜSS MicroTec AG. Diese Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Plänen, Einschätzungen und Prognosen des Managements der Gesellschaft. Anleger sollten sich nicht uneingeschränkt auf diese Aussagen verlassen. Zukunftsorientierte Aussagen stehen im Kontext ihres Entstehungszeitpunkts. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse zu aktualisieren. Unberührt hiervon bleibt die Pflicht der Gesellschaft, ihren gesetzlichen Informations- und Berichtspflichten nachzukommen. Zukunftsorientierte Aussagen beinhalten immer Risiken und Ungewissheiten. Eine Vielzahl von Faktoren, die in diesem Bericht beschrieben sind, können dazu führen, dass die tatsächlich eintretenden Ereignisse erheblich von den in diesem Bericht enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen abweichen.



SÜSS MicroTec AG  
Schleißheimer Straße 90  
85748 Garching, Deutschland  
Telefon: +49 (0)89-32007-0  
E-Mail: [info@suss.com](mailto:info@suss.com)

[www.suss.com](http://www.suss.com)